

深圳市崇达电路技术股份有限公司

SHENZHEN SUNTAK CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD.

(深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路 3 栋三楼)

首次公开发行股票招股说明书

(申报稿)

保荐人（主承销商）



西南证券

SOUTHWEST SECURITIES

(重庆市江北区桥北苑 8 号)

二〇一二年八月

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）	发行股数	3,750 万股
每股面值	1.00 元	发行价格	【 】元/股
预计发行日期	【 】年【 】月【 】日	拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	15,000 万股	保荐人（主承销商）	西南证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2012 年【 】月【 】日		
股份限制流通及自愿锁定承诺	公司控股股东和实际控制人姜雪飞、朱雪花承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东姜曙光、彭卫红、邓峻、余忠、袁进、彭建均、张庭主、严安辉、杨林、白会斌、汪广明、刘保海、王俊浩、尹建华、赵金秋、谢华、王剑峰承诺：自崇达技术股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东汇投投资有限公司、深圳市同威创业投资有限公司、深圳市超淦贸易有限公司承诺：自崇达技术股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司董事、监事、高级管理人员姜雪飞、朱雪花、余忠、彭建均、姜曙光、彭卫红、邓峻、汪姜维除分别遵守上述承诺外，还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过其所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占其所持有股份总数的比例不超过 50%。		

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

一、股份限制流通及自愿锁定承诺

本公司本次发行前总股本为 11,250 万股，本次拟发行 3,750 万股人民币普通股，发行后总股本为 15,000 万股。

公司控股股东和实际控制人姜雪飞、朱雪花承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东姜曙光、彭卫红、邓峻、余忠、袁进、彭建均、张庭主、严安辉、杨林、白会斌、汪广明、刘保海、王俊浩、尹建华、赵金秋、谢华、王剑峰承诺：自崇达技术股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东汇投投资有限公司、深圳市同威创业投资有限公司、深圳市超淦贸易有限公司承诺：自崇达技术股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事、监事、高级管理人员姜雪飞、朱雪花、余忠、彭建均、姜曙光、彭卫红、邓峻、汪姜维除分别遵守上述承诺外，还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过其所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占其所持有股份总数的比例不超过 50%。

二、本次发行前未分配利润的处理

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司累计未分配利润为 23,952.88 万元。根据公司 2012 年 3 月 8 日召开的年度股东大会审议通过的《关于公司 2011 年度利润分

配和首次公开发行前滚存利润分配的议案》，本次发行前的未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

三、本次发行上市后的股利分配政策

本公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司发行后的利润分配政策如下：

“（1）公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润；

（2）公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（3）公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请股东大会审议批准。在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案；

（4）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

此外，公司制定了《深圳市崇达电路技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2011—2013 年度）》，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，重新制定的分红比例不低于《公司章程》规定的分红比例。

关于公司股利分配政策和分红回报的具体内容，请参见本招股说明书“第十三章 股利分配政策”。

四、特别提醒投资者注意以下风险因素

（一）人民币升值的风险

报告期内，本公司外销销售收入占收入总额的比例分别高达69.61%、81.43%、80.46%、81.05%，外销区域主要集中在欧洲、美洲和除中国之外的亚洲其他地区，业务主要以美元结算。报告期内，本公司汇兑损失分别为124.98万元、525.49万元、676.00万元和-115.91万元，占当期利润总额的比例分别为2.00%、4.26%、4.34%、-1.37%。如果未来人民币继续大幅升值，公司产品相对国外竞争对手的价格优势可能被削弱，导致公司产品销售增长率下降，人民币升值可能对公司经营业绩造成不利影响。

（二）出口退税政策变化的风险

本公司产品销售业务适用增值税。其中，内销产品销项税率为17%，出口产品适用“免、抵、退”规定，报告期内退税率为17%。报告期内，本公司外销收入占收入总额的比例分别高达69.61%、81.43%、80.46%、81.05%，在公司目前的销售结构下，如果国家出口退税率的相关政策发生变化，可能对本公司经营产生不利影响。

（三）租赁厂房及搬迁风险

目前，本公司位于深圳福永、沙井的生产厂房及员工宿舍均为租赁方式取得，由于该部分厂房所在的土地为集体用地，因深圳市历史遗留问题原因未取得房屋产权证书，此种土地情形为深圳市宝安、龙岗两区的普遍现象，属深圳市宝安、龙岗两区城市化过程中的历史遗留问题。该部分物业租赁合同均已根据《深圳经济特区房屋租赁条例》在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室办理了备案登记，且该部分物业均已取得深圳市宝安区城中村（旧村）改造办公室出具的证明，证明该等物业迄今为止尚未纳入拆迁改造范围，且在未来3-5年内暂无拆迁计划；同时出租方深圳市塘尾股份合作公司、深圳市宝恒源实业有限公司及深圳市新全物业管理有限公司均承诺，未来5年内不主动拆迁。

本公司福永分公司承租的位于深圳市宝安区福永街道塘尾南玻大道东侧的

厂房分别将于 2012 年 11 月 30 日、2012 年 12 月 19 日到期，本公司计划于到期前将福永分公司搬迁至江门崇达。假设福永分公司租赁集体用地之上房产立即进行搬迁（以 2012 年 6 月 30 日的资产状况为测算基础），将导致本公司 2012 年度经营成本增加 765.87 万元。

本公司子公司深圳崇达承租的房产将分别于 2017 年 11 月、2025 年 4 月到期，租赁期限较长，目前无搬迁计划。但深圳崇达租赁的房产所在土地均未能取得房屋产权证书，因此存在可能搬迁的风险，假设深圳崇达立即搬迁、未来 3 年后搬迁、未来 5 年后搬迁的情况下，可能导致本公司经营成本分别增加 3,685.17 万元、2,689.96 万元、1,450.72 万元。

本公司实际控制人姜雪飞、朱雪花出具了《补偿承诺函》，承诺如在本公司与出租方深圳市塘尾股份合作公司、深圳市宝恒源实业有限公司、深圳市新全物业管理有限公司签署的租赁合同有效期内，因租赁厂房拆迁或其他原因无法继续租用，将全额承担由此给本公司造成的损失。

为全面了解发行人面临的各项风险，本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三章 风险因素”的全部内容。

目 录

第一章 概览	17
一、发行人概况	17
二、控股股东和实际控制人简介	19
三、发行人主要财务数据及财务指标	19
四、本次发行情况	21
第二章 本次发行概况	22
一、发行人基本情况	22
二、本次发行基本情况及发行费用	22
三、本次发行的有关当事人	23
四、本次发行的重要日期	25
第三章 风险因素	26
一、市场风险	26
二、原材料价格波动的风险	27
三、人民币升值的风险	28
四、出口退税政策变化的风险	28
五、环保风险	28
六、租赁厂房及搬迁风险	29
七、管理风险	29
八、募集资金投资项目的风险	30
九、人力资源风险	31
十、实际控制人控制的风险	31
第四章 发行人基本情况	32
一、发行人基本情况	32
二、发行人的历史沿革及改制重组情况	32
三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况	37
四、发行人历次验资情况	49

五、发行人的组织结构.....	51
六、发行人控股及参股公司、分公司情况.....	55
七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.....	66
八、发行人股本情况.....	71
九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况.....	75
十、发行人员工及其社会保障情况.....	75
十一、主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺..	78
第五章 业务和技术	80
一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况.....	80
二、发行人所处行业的基本情况简介.....	80
三、行业发展状况.....	92
四、小批量 PCB 行业的竞争情况	109
五、发行人的行业地位.....	117
六、发行人的主营业务情况.....	126
七、发行人的主要固定资产和无形资产.....	151
八、发行人的研究开发情况.....	166
九、发行人的质量控制情况.....	171
第六章 同业竞争与关联交易	173
一、同业竞争.....	173
二、关联交易.....	173
第七章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	187
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况.....	187
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况.....	192
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.....	193
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况.....	193
五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况.....	194
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系	

.....	195
七、本公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的协议情况	195
.....	195
八、董事、监事及高级管理人员的任职资格.....	196
九、董事、监事及高级管理人员最近三年的变动情况.....	196
第八章 公司治理	197
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会运作及履行职责情况	197
二、发行人最近三十六个月违法违规情况.....	201
三、发行人最近三年资金被占用和对关联方担保情况.....	202
四、发行人内部控制制度情况.....	203
第九章 财务会计信息.....	204
一、财务报表.....	204
二、审计意见.....	222
三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.....	222
四、主要会计政策和会计估计.....	224
五、分部报告信息.....	238
六、最近一年收购兼并情况.....	238
七、非经常性损益明细表.....	238
八、最近一期末固定资产、在建工程和对外投资情况.....	240
九、最近一期末无形资产情况.....	241
十、最近一期末的主要债项.....	241
十一、发行人所有者权益情况.....	243
十二、报告期内现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响.....	248
十三、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.....	248
十四、主要财务指标.....	248
十五、发行人盈利预测及披露情况.....	251
十六、发行人设立时及报告期内资产评估情况.....	251
十七、发行人历次验资情况.....	252

第十章 管理层讨论与分析	253
一、财务状况分析	253
二、盈利能力分析	279
三、现金流量分析	308
四、资本支出情况分析	312
五、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析	313
六、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项	314
七、未来股利分配的具体计划	315
第十一章 业务发展目标	320
一、发行人当年和未来两年发展规划及发展目标	320
二、公司未来的发展计划	321
三、本次募集资金运用对实现发行人发展规划和目标的作用	322
四、拟订上述计划所依据的假设条件	323
五、实施上述计划所面临的主要困难	323
六、业务发展规划与现有业务的关系	323
第十二章 募集资金运用	324
一、募集资金运用概况	324
二、募集资金投资项目与公司现有业务及发展战略之间的关系	324
三、本次募集资金投资项目情况	325
四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响	337
第十三章 股利分配政策	339
一、股利分配政策	339
二、报告期内利润分配情况	340
三、公司未来三年的分红回报规划	341
四、本次发行前滚存利润的分配安排	342
第十四章 其他重要事项	343
一、信息披露制度相关情况	343
二、重要合同	343
三、对外担保事项	347

四、重大诉讼、仲裁事项及控股股东、实际控制人重大违法情况.....	347
第十五章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	349
第十六章 备查文件	356

释 义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一般名词：	
本公司、公司、发行人、崇达技术	指深圳市崇达电路技术股份有限公司
集锦电子	指深圳市集锦电子实业有限公司，本公司初始注册登记之企业法人工商登记名称，2003 年 3 月 10 日更名为深圳市集锦线路板科技有限公司
集锦线路板	指深圳市集锦线路板科技有限公司，2010 年 8 月 26 日集锦线路板整体变更设立股份公司，并更名为深圳市崇达电路技术股份有限公司
深圳崇达	指深圳崇达多层线路板有限公司，本公司之全资子公司
大连崇达	指大连崇达电路有限公司，本公司之全资子公司
江门崇达	指江门崇达电路技术有限公司，本公司之全资子公司
香港崇达	指崇达科技有限公司，本公司在香港注册之全资子公司
福永分公司	指深圳市崇达电路技术股份有限公司福永分公司
宝安分公司	指深圳崇达多层线路板有限公司宝安分公司
香港汇锦	指汇锦线路板科技有限公司，本公司之关联方
香港崇达线路板	指崇达多层线路板有限公司，本公司之关联方
汇投投资	指汇投控股集团有限公司，原名为汇投投资有限公司，本公司发起人股东之一
同威创业	指深圳市同威创业投资有限公司，本公司发起人股东之一
超淦贸易	指深圳市超淦贸易有限公司，本公司发起人股东之一
大连多层	指大连崇达多层线路板有限公司
大连电子	指大连崇达电子有限公司
坦程电子	指深圳市坦程电子有限公司

香港乐蔚	指乐蔚发展有限公司，注册于香港
香港永达	指永达科技有限公司，注册于香港
深圳高新投	指深圳市高新技术投资担保有限公司
深圳中小担保	指深圳市中小企业信用担保中心有限公司
工商银行	指中国工商银行股份有限公司
华夏银行	指华夏银行股份有限公司
建设银行	指中国建设银行股份有限公司
兴业银行	指兴业银行股份有限公司
花旗银行	指花旗银行（中国）有限公司
中信银行	指中信银行股份有限公司
平安银行	指平安银行股份有限公司
中国银行	指中国银行股份有限公司
招商银行	指招商银行股份有限公司
上市	指本次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易的行为
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
保荐人、主承销商、西南证券	指西南证券股份有限公司
上海众华、发行人会计师	指上海众华沪银会计师事务所有限公司
深圳鹏城	指深圳市鹏城会计师事务所有限公司
信达律师事务所、发行人律师	指广东信达律师事务所
国友大正	指发行人资产评估事务所，北京国有大正资产评估有限公司

Prismark	指一家从事 PCB 行业统计与分析的国际机构
IPC	指 Institute of Printed Circuits, 印制电路协会, 上世纪 70 年代在美国成立的全球性的 PCB 行业协会
EMS	指 Electronics Manufacturing Services, 电子制造服务
IDC	指 International Data Corporation, 国际数据公司, 全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
工信部	指中华人民共和国工业和信息化部
CPCA	指中国印制电路行业协会
元	指人民币元
《公司法》	指 2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第 10 届全国人民代表大会常务委员会第 18 次会议修正, 自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 2005 年 10 月 27 日中华人民共和国第 10 届全国人民代表大会常务委员会第 18 次会议修正, 自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指本公司《公司章程》及《公司章程(草案)》
最近三年一期、报告期	指 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年 1—6 月, 即 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
最近一年一期	指 2011 年、2012 年 1—6 月, 即 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
《企业会计准则》	指财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则
申报财务报表	指本公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表
社会公众股、A 股	指发行人向社会公开发行的面值为 1 元的人民币普通股
本次发行	指本次向社会公众发行 3,750 万股 A 股的行为
专有名词:	

印制电路板/PCB	印制电路板（Printed Circuit Board）是指在绝缘基材上，按预定设计形成点到点间连接导线及印制元件的印制板。
单面板	指仅在绝缘基板的一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其中一面的 PCB
双面板	指在基板两面形成导体图案的 PCB
多层板	指使用数片单面或双面板，并在每层板间放进一层绝缘层后压合的 PCB
高层板	指 8 层及 8 层以上的 PCB
中低层板	指 8 层以下的 PCB
柔性板/ 挠性板	指由柔性基材制成的印制电路板，其优点是可以弯曲，便于电器部件的组装
刚挠板	指由刚性板和挠性板有序地层压在一起，并以金属化孔形成电气连接的电路板
HDI	指高密度互连板（High Density Interconnection），针对 PCB 线路互连密度高而言。通常指：线宽/线距 0.1mm 以下，小导通孔孔径 0.15mm 以下，含有盲孔和埋孔的多层板，也被称为层积（Build-Up）技术。
ERP	指企业资源规划，Enterprise Resource Planning 的缩写，是对企业资源进行有效管理、共享与利用的系统
Mil	指 PCB 行业的一种长度计量单位，1mil=0.025mm
IC	指集成电路，Integrate Circuit 的缩写
ROHS	指 Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment，即《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》
电镀	指一种电离子沉积过程，利用电极通过电流，使金属附着在物体表面上，其目的为改变物体表面的特性或尺寸

第一章 概览

重要提示

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人概况

（一）基本情况

发行人名称：深圳市崇达电路技术股份有限公司

英文名称：Shen Zhen Suntak Circuit Technology Co.,Ltd.

注册资本：11,250 万元

法定代表人：姜雪飞

有限公司成立日期：1995 年 5 月 4 日

发行人成立日期：2010 年 8 月 26 日

住所：深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路 3 栋三楼

公司网址：www.suntakpcb.com

经营范围：国内贸易，货物及技术进出口业务（按深贸管登证字第 2003-703 号办理）；双面线路板、多层线路板、柔性线路板的生产（由分支机构经营）和销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

（二）发行人的主营业务

本公司的主营业务为小批量 PCB 的生产与销售。

“小批量”源自于英文“Low Volume”，国际上一般将小批量 PCB 生产企业或小批量行业定义为“High Mix、Low Volume、Quick Turn”。小批量 PCB

与大批量 PCB 面向的客户所处领域不同，导致单个订单需求量有较大差异。小批量 PCB 企业主要面向以企事业单位为主要终端客户（Business To Business）的通信设备、工业控制、医疗仪器、国防、航天航空、安防电子等行业，这些行业客户的单笔 PCB 订单需求量相对较低，均单面积一般在 10 平方米左右，并且产品个性化要求较高，品种相对较多，产品价格也相对较高；而大批量 PCB 企业主要面向以个人消费者为主要终端客户（Business To Customer）的计算机、通信终端、消费电子等行业，一般而言，大批量 PCB 产品的市场需求量较大，单笔采购订单面积一般在 50 平方米以上甚至几百或上千平方米，产品个性化要求较低，品种相对较少，产品单价相对较低，PCB 生产企业采用大规模批量生产模式。由于小批量 PCB 行业具有单个订单面积小、订单数量多、产品品种多、客户数量多、产品交期短等行业特点，小批量 PCB 生产企业必须具有根据客户需求快速作出反应并组织生产的能力，因此小批量 PCB 生产企业对生产管理的要求较高。

本公司专注于小批量 PCB 的生产与销售，主要产品为小批量 PCB，产品类型覆盖 HDI 板、背板、厚铜板、软硬结合板、埋容板、高多层板、立体板、铝基板、高频板等，可一站式满足客户对多品种、小批量 PCB 产品的需求。公司产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、航天航空等高科技领域。报告期内，本公司订单数量分别为 37,966 个、60,477 个、70,127 个、45,099 个，均单面积分别为 7.79 平方米、8.33 平方米、8.29 平方米、7.28 平方米，交货期分别为 15 天、17 天、14 天、14 天，平均日处理订单数为 105 个、167 个、195 个、250 个，平均单个订单金额为 1.13 万元、1.27 万元、1.34 万元、1.15 万元。公司在满足客户多样化需求、快速交货方面，形成了独特、有效的服务模式和柔性化生产模式。最近三年一期，本公司客户数量分别为 304 个、360 个、442 个、452 个，客户数量逐年增多。由于提供的产品个性化程度较高，公司对下游客户的议价能力较强，具有较高的毛利率水平。

本公司连续六年（2006 年、2007 年、2008 年、2009 年、2010 年、2011 年）入选中国印制电路行业协会评选的中国印制电路行业百强企业，2010 年 9 月，本公司被授予“高新技术企业证书”。2011 年 10 月，深圳崇达被科学技术部火炬高技术产业开发中心授予《国家火炬计划重点高新技术企业证书》。

（三）发行人设立情况

本公司由集锦线路板整体变更设立为股份有限公司，2010年8月26日在深圳市市场监督管理局登记注册，注册号为：440306103723886，注册资本11,250万元。

二、控股股东和实际控制人简介

本公司控股股东为姜雪飞，实际控制人为姜雪飞、朱雪花夫妇。

姜雪飞，中国国籍，无境外居留权，43岁，现任本公司董事长、总经理，直接持有本公司77,688,300股股份，持股比例为69.0564%。姜雪飞的简历详见本招股说明书“第七章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。

朱雪花，中国国籍，无境外居留权，43岁，现任本公司董事，直接持有本公司8,632,100股股份，持股比例为7.6730%。朱雪花的简历详见本招股说明书“第七章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。

三、发行人主要财务数据及财务指标

本公司最近三年一期的财务数据已经上海众华审计并出具标准无保留意见的审计报告（沪众会字(2012)第2792号）。报告期内本公司的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31
资产总计	103,315.26	95,926.43	73,225.88	47,541.15
负债合计	56,464.20	51,359.59	38,354.84	25,039.43
所有者权益	46,851.05	44,566.84	34,871.04	22,501.72
归属于母公司的股东权益	46,851.05	44,566.84	34,871.04	17,165.40

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
----	-----------	-------	-------	-------

营业收入	53,151.53	96,609.66	78,286.30	43,604.82
营业利润	8,257.21	15,190.94	12,420.53	6,025.14
利润总额	8,450.09	15,593.97	12,329.77	6,240.11
净利润	6,589.21	13,153.29	10,339.09	5,340.55
归属于母公司股东的净利润	6,589.21	13,153.29	9,611.63	4,095.07
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	6,430.91	12,812.04	11,855.88	3,829.56

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2012 年 1—6 月	2011 年	2010 年	2009 年
经营活动产生的现金流量净额	10,168.66	17,868.42	14,286.07	11,255.30
投资活动产生的现金流量净额	-7,593.54	-27,606.89	-22,282.05	-6,005.86
筹资活动产生的现金流量净额	-3,658.39	9,514.51	10,879.23	-2,274.74
现金及现金等价物净增加额	-1,016.14	-396.99	2,657.94	2,915.98

（四）主要财务指标

财务指标	2012. 6. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31
流动比率（倍）	1.04	0.92	1.12	1.22
速动比率（倍）	0.82	0.76	0.91	1.07
资产负债率（合并报表）	54.65%	53.81%	52.38%	52.67%
资产负债率（母公司）	50.24%	43.34%	34.87%	28.78%
无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权）	1.53%	1.74%	0.11%	0.02%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	4.16	3.94	3.10	-
财务指标	2012 年 1—6 月 /2012. 6. 30	2011 年 /2011. 12. 31	2010 年 /2010. 12. 31	2009 年 /2009. 12. 31
应收账款周转率（次）	-	4.81	4.76	2.90
存货周转率（次）	-	9.70	10.04	11.58
利息保障倍数（倍）	8.16	9.98	18.55	12.08
息税折旧摊销前利润（万元）	12,981.34	22,559.94	16,729.57	9,535.10
归属于发行人股东的净利润（万元）	6,589.21	13,153.29	9,611.63	4,095.07
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	6,430.91	12,812.04	11,855.88	3,829.56
每股经营活动现金流量（元）	0.90	1.59	1.27	-

每股净现金流量（元）	-0.09	-0.04	0.24	-
------------	-------	-------	------	---

四、本次发行情况

（一）本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00 元
发行股数及占发行后总股本的比例	3,750 万股，占发行后总股本的 25%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准
每股发行价格	【 】元/股
发行方式	网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
上市地点	深圳证券交易所

（二）本次发行前后的股本结构

类型	发行前		发行后	
	持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
有限售条件的股份	11,250	100.00	11,250	75.00
本次发行的股份	-	-	3,750	25.00
合 计	11,250	100.00	15,000	100.00

（三）募集资金运用

若本次股票发行成功，募集资金将投资下列项目：

序号	项目	总投资额（万元）	募集资金投入金额（万元）	项目备案情况
1	小批量 PCB 生产基地建设项目	47,415	47,415	广东省发改委备案号 100700406229009

如首次公开发行实际募集资金超出以上预计投资金额，本公司将按照目前的资金状况和有关的管理制度，将多余资金用于补充流动资金。首次募集资金若不能满足拟投资项目的资金需求，本公司将通过自有资金及银行贷款等方式解决。募集资金投资项目的具体内容详见本招股说明书“第十二章 募集资金运用”。

第二章 本次发行概况

一、发行人基本情况

- 1、名称：深圳市崇达电路技术股份有限公司
- 2、英文名称：Shen Zhen Suntak Circuit Technology Co.,Ltd.
- 3、注册资本：11,250 万元
- 4、法定代表人：姜雪飞
- 5、有限公司成立日期：1995 年 5 月 4 日
- 6、股份公司成立日期：2010 年 8 月 26 日
- 7、住所：深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路 3 栋三楼
- 8、邮政编码：518132
- 9、电话：0755-26068047
- 10、传真：0755-26068671
- 11、公司网址：www.suntakpcb.com
- 12、联系电子信箱：zyu@suntakpcb.com
- 13、负责信息披露和投资者关系的部门：证券部
- 14、负责信息披露和投资者关系的负责人：余忠
- 15、负责信息披露和投资者关系的部门电话：0755-26055208

二、本次发行基本情况及发行费用

（一）本次发行基本情况

序号	项目	基本情况
----	----	------

1	股票种类	人民币普通股（A 股）
2	每股面值	1.00 元
3	发行股数	3,750 万股，占发行后总股本的 25 %
4	每股发行价格	【 】元
5	发行市盈率	【 】倍
6	发行后每股收益	【 】元/股（以 2011 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润和发行后总股本计算）
7	发行前每股净资产	4.16 元/股（以 2012 年 6 月 30 日经审计的净资产和发行前总股本计算）
8	发行后每股净资产	【 】元/股（以 2012 年 6 月 30 日经审计的净资产加上募集资金净额和发行后总股本计算）
9	市净率	【 】倍
10	发行方式	网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
11	发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
12	承销方式	余额包销
13	募集资金总额	【 】万元
14	募集资金净额	【 】万元

（二）主要发行费用概算

项目	金额
承销费用	【 】万元
保荐费用	【 】万元
审计费用	【 】万元
评估费用	【 】万元
律师费用	【 】万元
发行手续费用	【 】万元

三、本次发行的有关当事人

1	发行人：深圳市崇达电路技术股份有限公司 住所：深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路 3 栋三楼
---	--

	法定代表人：姜雪飞 联系人：余忠 电话：0755-26055208 传真：0755-26068671
2	保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：余维佳 保荐代表人：秦翠萍、吴玓 项目协办人：许超 项目联系人：秦翠萍、吴玓、阳航、田野、陈建华、张涛 电话：010-88092288 传真：010-88092031
3	发行人律师：广东信达律师事务所 住所：广东省深圳市福田区深南大道4019号航天大厦24楼 负责人：麻云燕 经办律师：韦少辉、陈荣生、肖剑 电话：0755-88265288 传真：0755-83243108
4	会计师事务所：上海众华沪银会计师事务所有限公司 住所：上海市延安东路550号海洋大厦12楼 法定代表人：孙勇 经办会计师：傅林生、陆士敏 电话：021-63525500 传真：021-63525566
5	验资机构：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 住所：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 法定代表人：饶永 经办会计师：梁烽、陈芝莲 电话：0755-83732888 传真：0755-82237546

6	资产评估机构：北京国友大正资产评估有限公司 住所：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 法定代表人：陈冬梅 经办资产评估师：李巨林、陈松 电话：010-85868816 传真：010-85868385
7	股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 电话：0755-25938000 传真：0755-25988122
8	拟上市证券交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市深南东路 5045 号 电话：0755-82083333 传真：0755-82083190
9	保荐人（主承销商）收款银行： 户名：西南证券股份有限公司 账号：【】 开户行：【】

本公司及全体董事确认：本公司与本次发行有关的保荐人（承销机构）、证券服务机构（包括发行人律师、发行人会计师等）及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或者其他权益关系。

四、本次发行的重要日期

询价推介日期	【】年【】月【】日
定价公告刊登日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

请投资者关注发行人与保荐人（主承销商）于相关媒体披露的公告。

第三章 风险因素

投资者在评价及投资公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料以外，应特别注意下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，并不表示风险因素会依次发生。

一、市场风险

1、金融危机冲击带来风险

PCB 行业作为电子元器件基础行业，受宏观经济形势的影响较大。2008 年下半年以来，美国次贷危机引发全球性金融危机，对各国实体经济造成严重影响，部分国家和地区的经济甚至出现了负增长。受金融危机的影响，PCB 下游行业通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、国防、航空航天市场规模出现不同程度的下降，PCB 的市场需求减少。本公司订单自 2008 年 11 月开始出现下滑，至 2009 年 6 月订单量均保持在相对较低水平；2009 年 7 月开始，受益于国际经济形势的逐渐好转，本公司订单和销量迅速恢复，并快速增长。

本公司定位于小批量 PCB 的生产和销售，与大批量 PCB 生产厂商相比，本公司具有下游行业分布广泛、客户数量多、均单面积小、客户和订单较为分散的特点，因此在一定程度上分散了金融危机对公司的影响。但是，目前全球经济回升基础仍不稳固，如果金融危机再次发生或经济回升速度减慢，仍有可能引致下游需求萎缩从而使本公司面临盈利能力降低的风险。

2、市场竞争风险

PCB 行业市场竞争充分，各类规模的生产企业众多，未出现市场主导者，市场集中度较低。据 PCB 行业著名市场调研公司 Prismark 的统计，2011 全球产值最大的 PCB 制造商 Unimicron 在全球的市场占有率仅为 4.31%，而 2011 国内最大的 PCB 制造商珠海超毅电子有限公司在国内的市场占有率仅为 4.19%。目前，全世界约有近 3,000 家 PCB 生产企业，主要分布在美国、日本、欧洲、韩国、中国大陆及台湾地区，PCB 行业竞争比较激烈。

本公司所处小批量 PCB 行业属于 PCB 细分行业之一。与大批量 PCB 生产厂商相比，小批量 PCB 生产厂商客户更为分散，均单面积更小，订单品种更多，对订单反应速度、生产管理、订单处理及交货期要求更高，因此毛利率相对较高。目前，国内专业定位于小批量 PCB 生产的厂商不多，与国内其他 PCB 生产厂商相比，本公司一直专注于小批量 PCB 的生产，积累了丰富的管理经验和客户资源，具有明显的先发优势，但国外小批量 PCB 生产企业因人力成本过高存在向中国大陆转移的趋势，未来小批量 PCB 市场竞争可能加剧。本公司将继续通过加强柔性化管理、提高生产技术水平 and 产品质量等方式，抵御国内外激烈的市场竞争。

二、原材料价格波动的风险

报告期内，本公司原材料成本占销售成本的比重分别为 60.63%、64.77%、65.60%、62.92%，比重较高。本公司主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片。其中，覆铜板、铜球、铜箔主要受铜价影响，半固化片主要受石油价格影响。报告期内，由于铜价和石油价格大幅波动，导致原材料采购价格出现较大幅度的波动。2009 年，公司主要原材料覆铜板、半固化片、铜球、铜箔平均采购价格与 2008 年相比，跌幅均达到 20%以上。2010 年，上述原材料价格较 2009 年出现较大幅度回升；2011 年，原材料单价继续保持上涨趋势；2012 年上半年，原材料单价有所下滑。

原材料名称	2012 年 1—6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	均价 (元)	增幅	均价 (元)	增幅	均价 (元)	增幅	均价 (元)	增幅
覆铜板 (m ²)	93.14	-10.55%	104.12	10.79%	93.98	12.63%	83.44	-24.54%
铜球 (KG)	53.24	-12.06%	60.54	12.11%	54.00	34.33%	40.20	-25.82%
铜箔 (KG)	75.39	-12.49%	86.15	10.36%	78.06	25.80%	62.05	-29.93%
半固化片 (m ²)	12.37	-14.69%	14.50	1.67%	14.26	17.56%	12.13	-23.47%
氰化金钾 (G)	199.34	2.55%	194.38	21.10%	160.51	21.72%	131.87	11.60%
油墨 (KG)	86.76	9.30%	79.38	-2.35%	81.29	6.88%	76.06	-10.78%

原材料采购价格的变化是导致公司毛利率波动的重要因素。如果未来原材料的价格出现大幅上涨，而本公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能

通过技术工艺创新抵销成本上涨的压力，将会对本公司的经营成果产生不利影响。

三、人民币升值的风险

报告期内，本公司外销销售收入占收入总额的比例分别高达69.61%、81.43%、80.46%、81.05%，外销区域主要集中在欧洲、美洲和除中国之外的亚洲其他地区，业务主要以美元结算。报告期内，本公司汇兑损失分别为124.98万元、525.49万元、676.00万元和-115.91万元，占当期利润总额的比例分别为2.00%、4.26%、4.34%、-1.37%。人民币升值对公司经营业绩造成不利影响。

如果未来人民币继续大幅升值，公司相对国外竞争对手的价格优势可能被削弱，导致公司产品销售收入增长率下降，人民币升值可能对公司经营业绩造成不利影响。

四、出口退税政策变化的风险

本公司产品销售业务适用增值税。其中，内销产品销项税率为17%，出口产品适用“免、抵、退”规定，报告期内退税率为17%。报告期内，本公司外销收入占收入总额的比例分别为69.61%、81.43%、80.46%、81.05%。

假设退税率降为13%，对主营业务成本的影响如下：

项目	2012年1—6月	2011年	2010年	2009年
增加主营业务成本（万元）：外销收入*退税率变化幅度（17%—13%）	1,723.17	3,109.38	2,549.88	1,214.15
增加主营业务成本	4.95%	4.91%	5.18%	4.26%

在公司目前的销售结构下，如果国家出口退税的相关政策发生变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、环保风险

本公司的生产环节包括电镀、蚀刻等加工程序，生产过程中会产生一定的废水、废液。虽然本公司及下属子公司目前的生产线以及本次募集资金投资项目的环保投入能够保证各项环保指标达到国家和地方的相关环保标准，但如果国家提

高对PCB行业的环保要求，本公司的环保投入将会进一步增加，环保成本相应增大，可能对公司业绩产生一定影响。

六、租赁厂房及搬迁风险

目前，本公司位于深圳福永、沙井的生产厂房及员工宿舍均为租赁方式取得，由于该部分厂房所在的土地为集体用地，因深圳市历史遗留问题原因未取得房屋产权证书，此种土地情形为深圳市宝安区、龙岗两区的普遍现象，属深圳市宝安区、龙岗两区城市化过程中的历史遗留问题。该部分物业租赁合同均已根据《深圳经济特区房屋租赁条例》在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室办理了备案登记，且该部分物业均已取得深圳市宝安区城中村（旧村）改造办公室出具的证明，证明该等物业迄今为止尚未纳入拆迁改造范围，且在未来 3-5 年内暂无拆迁计划；同时出租方深圳市塘尾股份合作公司、深圳市宝恒源实业有限公司及深圳市新全物业管理有限公司均承诺，未来 5 年内不主动拆迁。

本公司福永分公司承租的位于深圳市宝安区福永街道塘尾南玻大道东侧的厂房分别将于 2012 年 11 月 30 日、2012 年 12 月 19 日到期，本公司计划于到期前将福永分公司搬迁至江门崇达。假设福永分公司租赁集体用地之上房产立即进行搬迁（以 2012 年 6 月 30 日的资产状况为测算基础），将导致本公司 2012 年度经营成本增加 765.87 万元。

本公司子公司深圳崇达承租的房产将分别于 2017 年 11 月、2025 年 4 月到期，租赁期限较长，目前无搬迁计划。但深圳崇达租赁的房产所在土地均未能取得房屋产权证书，因此存在可能搬迁的风险，假设深圳崇达立即搬迁、未来 3 年后搬迁、未来 5 年后搬迁的情况下，可能导致本公司经营成本分别增加 3,685.17 万元、2,689.96 万元、1,450.72 万元。

本公司实际控制人姜雪飞、朱雪花出具了《补偿承诺函》，承诺如在本公司与出租方深圳市塘尾股份合作公司、深圳市宝恒源实业有限公司、深圳市新全物业管理有限公司签署的租赁合同有效期内，因租赁厂房拆迁或其他原因无法继续租用，将全额承担由此给本公司造成的损失。

七、管理风险

相对于大批量PCB生产模式，小批量PCB生产模式最主要的特征是平均订单面积小、订单数量和订单品种多。按欧美PCB行业的惯例，小批量PCB企业一般被表述为“多品种、小批量、短交期”（High Mix、Low Volume、Quick Turn），如何通过合理、有效的管理和组织调度，生产出各类量小而品种繁杂的产品，并能满足客户快速交货的需求是小批量PCB生产企业核心竞争力的重要体现。

本公司通过长期的积累，虽然已经从实践中逐渐总结出一套行之有效的使公司的生产系统能够对客户纷繁多样的需求作出及时、快速反应的管理技术和能力，但随着公司生产规模不断扩大、PCB 生产技术含量越来越高、工艺流程日趋复杂，如果公司未来不能在管理方式上及时创新，以适应公司规模快速扩张的需要，可能导致交货期延长、竞争力削弱、成本上升等风险。

八、募集资金投资项目的风险

1、募集资金投资项目实施风险

本公司本次募集资金拟投资项目的可行性分析是基于当前国际、国内宏观经济形势、市场供求、产业政策等综合因素做出的。虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在募集资金按期足额到位、项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、通线试产、量产达标以及市场开发等方面都还存在一定风险，如有不当，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益。

2、扩充的产能不能及时消化的风险

本次募集资金投资项目建成投产后，将形成年产36万平方米小批量多层PCB和4万平方米小批量HDI的生产能力。2011年，公司小批量PCB和HDI的产能分别是63.6万平方米和2.4万平方米，募投项目的实施将使目前小批量PCB和HDI的产能分别扩大57%和167%。虽然巨大的市场需求为本次募集资金投资项目的成功实施提供了有力的保障，但是若市场增速低于预期或公司市场开拓不力，募集资金投资项目将给公司带来产能不能及时消化的风险。

3、固定资产折旧增加的风险

小批量PCB生产基地建设项目建成后，预计每年新增固定资产折旧如下表所示：

单位：万元

项目	第二年折旧	第三年折旧	第四年折旧	第五年至第十年 每年折旧
小批量 PCB 生产基地建设项目	1,966	3,201	3,819	3,385

募投项目完全达产后，预计将新增年利润总额1.08亿元，预计新增利润完全能够弥补新增固定资产折旧的增加。尽管公司已对募集资金投资项目进行了严密的市场调研和论证，但如果募投项目市场拓展不足，在固定资产折旧增加的同时，无法实现预期的投资收益，将对公司的经营业绩造成不利影响。

4、净资产收益率下降的风险

本次发行完成后，公司的净资产将会大幅增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在投资项目尚未产生效益或因市场发生不利变化使募集资金投资项目未按期完成时，存在净资产收益率下降的风险。

九、人力资源风险

随着本公司业务规模的快速扩张，对公司人员整体素质也提出更高的要求，公司需要不断招聘优秀人才，并通过内部培养机制培养出大量业务骨干，以适应业务发展的需要。如果公司人力资源供应不足、管理能力滞后，将制约公司业务扩张速度和规模。

十、实际控制人控制的风险

姜雪飞、朱雪花夫妇为本公司的实际控制人，合计持有本公司 76.73%的股份，本次发行完成后，姜雪飞、朱雪花仍将持有本公司 57.55%的股份。股权的相对集中削弱了中小股东对公司生产经营的影响力，未来姜雪飞、朱雪花可能利用其实际控制人地位，在股东大会上行使表决权，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，作出有利于实际控制人但却可能损害公司利益或对公司发展不利的决策。

第四章 发行人基本情况

一、发行人基本情况

发行人名称：深圳市崇达电路技术股份有限公司

英文名称：Shen Zhen Suntak Circuit Technology Co.,Ltd.

注册资本：11,250 万元

法定代表人：姜雪飞

有限公司成立日期：1995 年 5 月 4 日

发行人成立日期：2010 年 8 月 26 日

住所：深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路 3 栋三楼

邮政编码：518132

联系电话：0755-26068047

联系传真：0755-26068671

互联网网址：www.suntakpcb.com

电子信箱：zyu@suntakpcb.com

经营范围：国内贸易，货物及技术进出口业务（按深贸管登证字第 2003-703 号办理）；双面线路板、多层线路板、柔性线路板的生产（由分支机构经营）和销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

二、发行人的历史沿革及改制重组情况

（一）发行人设立方式

2010 年 7 月 30 日，经集锦线路板股东会审议通过，集锦线路板以截至 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产 201,951,635.76 元中的 112,500,000 元折合股本

112,500,000 股，余额 89,451,635.76 元计入资本公积，折股比例为 1:0.5571，整体变更设立深圳市崇达电路技术股份有限公司，并于 2010 年 8 月 26 日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，取得注册号为 440306103723886 的《企业法人营业执照》，注册资本为 11,250 万元。

（二）发起人

本公司的发起人为姜雪飞、朱雪花、汇投投资、同威创业、姜曙光、超淦贸易、彭卫红、邓峻、余忠、袁进、彭建均、张庭主、严安辉、杨林、白会斌、汪广明、刘保海、王俊浩、尹建华、赵金秋、谢华、王剑峰。本公司设立时，各发起人的持股情况如下：

序号	发起人名称	持股数量（股）	持股比例
1	姜雪飞	77,688,300	69.0564%
2	朱雪花	8,632,100	7.6730%
3	汇投投资	5,356,000	4.7609%
4	同威创业	5,356,000	4.7609%
5	姜曙光	4,614,400	4.1017%
6	超淦贸易	3,213,800	2.8567%
7	彭卫红	2,050,700	1.8228%
8	邓峻	1,538,000	1.3671%
9	余忠	1,538,000	1.3671%
10	袁进	512,700	0.4557%
11	彭建均	512,700	0.4557%
12	张庭主	153,900	0.1368%
13	严安辉	153,900	0.1368%
14	杨林	153,900	0.1368%
15	白会斌	153,900	0.1368%
16	汪广明	153,900	0.1368%
17	刘保海	153,900	0.1368%
18	王俊浩	153,900	0.1368%
19	尹建华	102,500	0.0911%
20	赵金秋	102,500	0.0911%
21	谢华	102,500	0.0911%

22	王剑峰	102,500	0.0911%
	合计	112,500,000	100.00%

（三）发行人设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司设立前，主要发起人姜雪飞拥有的主要资产为持有的本公司股权。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

1、主要资产

本公司成立时拥有的主要资产为流动资产和固定资产，具体明细如下：

资产	金额（万元）
流动资产	33,180.87
固定资产	19,998.58
总资产	59,950.72

2、主要业务

本公司成立时实际从事的业务与目前一致，主要业务是小批量 PCB 的生产和销售。

（五）在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司设立后，截至本招股说明书签署日，主要发起人姜雪飞拥有的主要资产没有发生变化。

（六）发行人成立前后的业务流程及其联系

本公司由集锦线路板整体变更设立，改制前后的业务流程没有发生变化。本公司主要业务为小批量 PCB 的生产与销售。业务的详细流程参见本招股说明书“第五章 业务和技术”之“六、发行人的主营业务情况”。

（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

本公司主要发起人为姜雪飞，在集锦线路板整体变更设立为股份有限公司后，本公司在生产经营方面与主要发起人不存在关联关系。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

本公司是由集锦线路板整体变更设立的股份有限公司，本公司承继了集锦线路板所有的资产、负债及权益。集锦线路板所有机器设备、车辆、办公设施等有形资产已全部转入本公司名下；集锦线路板专利所有权人、著作权更名为本公司的手续已办理完毕，不存在法律障碍。

（九）发行人独立运行情况

本公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全了法人治理结构。本公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面与各股东及关联方完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

本公司具有独立的生产、销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。目前本公司控股股东姜雪飞、实际控制人姜雪飞、朱雪花夫妇除本公司外未投资、控制其他与本公司存在竞争关系的企业，姜雪飞、朱雪花作出了避免同业竞争的承诺；公司在采购、生产和销售上不依赖于任何企业或个人，完全独立有序地开展所有业务。

2、资产独立情况

本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，承继了原有限责任公司所有的资产、负债及权益，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法使用与生产经营有关的资产，具有独立的原料采购和产品销售系统。截至本招股说明书签署日，本公司没有以资产或信誉为公司股东提供担

保,也未以本公司名义向公司股东提供借款或其他资助。本公司不存在任何资产、资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况。

3、机构独立情况

本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督执行机构,各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行。各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。自公司设立以来,未发生股东违规干预本公司正常生产经营活动的情况。

本公司生产经营、办公场所与各股东及其关联方完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。本公司设立了与经营业务相适应的组织机构和部门,完全拥有机构设置的主权。

4、人员独立情况

本公司拥有独立的人事、工资、福利制度,拥有从事印制电路板业务的各类专业人员。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职;本公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪,未从事与本公司业务相同或相似的业务,未在与本公司业务相同或相似的公司服务,未从事损害本公司利益的活动;公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

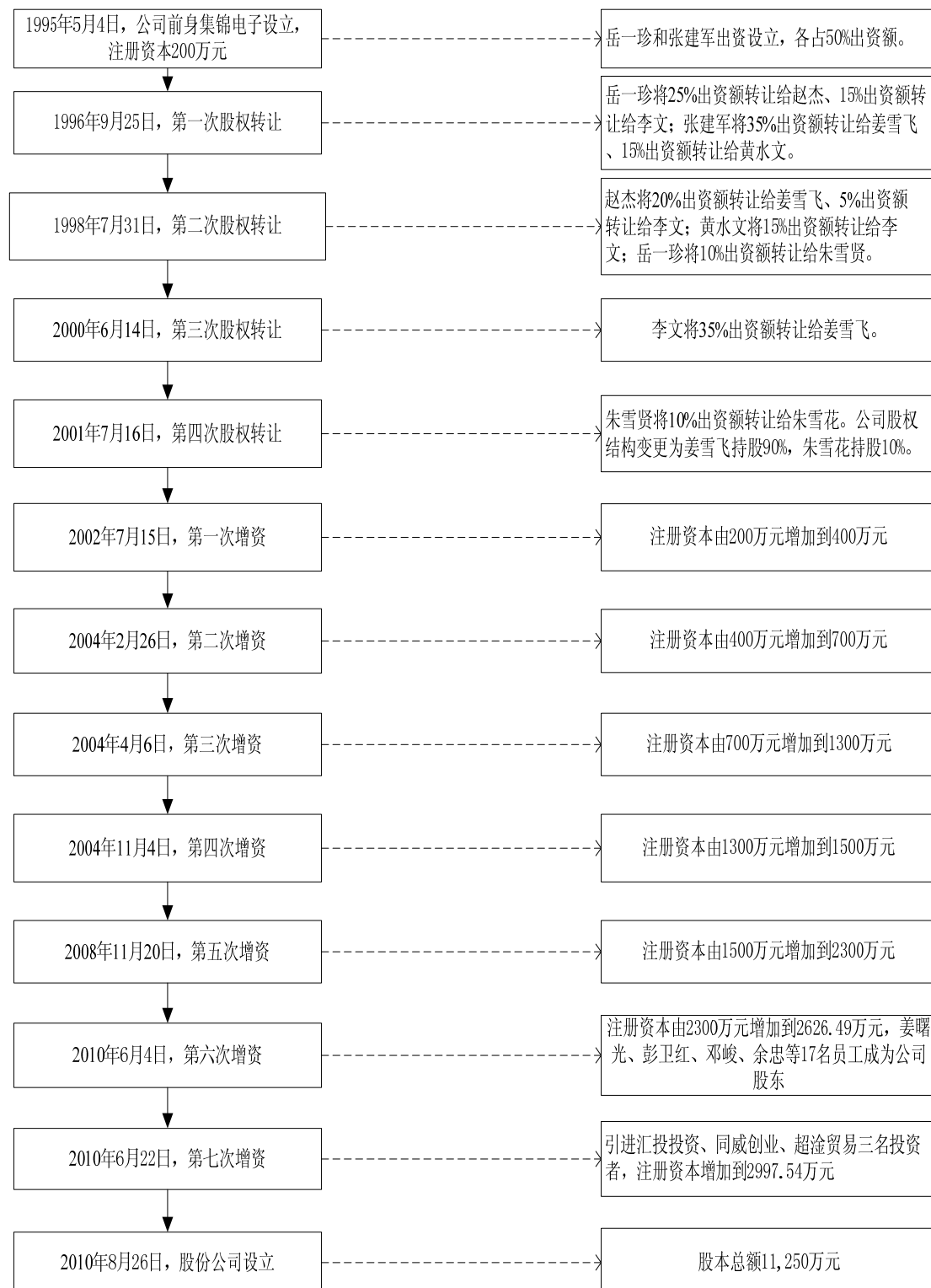
5、财务独立情况

本公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算体系,制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度,配备了必要的财务人员,在银行独立开设账户,独立纳税。

综上所述,本公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与各股东及其关联方相互独立,拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况

（一）发行人的股本形成、变化情况概述



（二）股份公司设立前的股本形成及历次变化情况

1、1995 年 5 月，发行人的前身—集锦电子设立

集锦电子成立于 1995 年 5 月 4 日；法定代表人：岳一珍；营业执照注册号：19233760-0；注册地址：深圳市福田区振华路 19 号桑达大厦 219 室；经营范围：生产经营计算机，工业自动化仪器及控制系统、CAD/CAM 技术；注册资本：200 万元，岳一珍和张建军分别以现金出资 100 万元。集锦电子 1995 年设立时履行法定程序为：

（1）1995 年 4 月 4 日，深圳市工商行政管理局核发了《公司名称预先核准通知书》，同意以集锦电子作为公司名称注册。

（2）1995 年 4 月 24 日，股东岳一珍和张建军签署了《深圳市集锦电子实业有限公司章程》。

（3）1995 年 4 月 30 日，集锦电子召开股东会，选举岳一珍为执行董事、张建军为监事，集锦电子执行董事任命岳一珍为总经理。

（4）1995 年 4 月 20 日，深圳市民孚审计师事务所出具了深民审所验字（1995）298 号《验资报告书》，截至 1995 年 4 月 16 日，集锦电子注册资本为 200 万元，全部以货币出资，其中岳一珍、张建军各以现金出资 100 万元。

（5）1995 年 5 月 4 日，深圳市工商行政管理局向集锦电子核发了《企业法人营业执照》。

集锦电子设立时的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
岳一珍	100.00	50.00
张建军	100.00	50.00
合计	200.00	100.00

集锦电子设立出资已经深圳市民孚审计师事务所审验并出具了深民审所验字（1995）298 号《验资报告书》。集锦电子于 1995 年 4 月 10 日分别收到岳一珍、张建军现金投资款各 100 万元，集锦电子出资时资金已充实到位。上述出资

到位后，主要用于购买原材料和办公支出。

根据 1994 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》第二十五条规定，股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立的有限公司在银行开设的临时账户。集锦电子设立时，股东岳一珍、张建军以现金出资，但未按上述规定将出资现金存入银行账户，存在一定的法律瑕疵。

保荐机构经核查后认为：鉴于股东出资已实际到位、深圳市民孚审计师事务所出具《验资报告书》对股东出资到位予以验证、深圳市工商行政管理局对集锦电子进行了设立登记，现金出资未存入银行账户的行为对发行人本次发行上市不构成障碍。

发行人律师经核查后认为：尽管集锦电子 1995 年设立时的出资存在法律瑕疵，但股东出资充实到位，股东以现金出资未存入银行账户的行为对发行人本次发行上市不构成障碍。

2、1996 年 9 月，第一次股权转让

1996 年 3 月 18 日，集锦电子股东会通过决议，同意岳一珍将所持有的集锦电子 25% 出资额以 50 万元转让给赵杰、15% 出资额以 30 万元转让给李文；张建军将所持有的集锦电子 35% 出资额以 70 万元转让给姜雪飞、15% 出资额以 30 万元转让给黄水文。股权转让的定价依据是每元出资额作价 1 元。1996 年 4 月 16 日，岳一珍分别与赵杰和李文、张建军分别与姜雪飞和黄水文签订了《股权转让协议》。深圳市公证处分别出具（96）深证字第 445 号、第 446 号、第 447 号、第 448 号公证书对上述股权转让协议进行了公证。

1996 年 9 月 25 日，集锦电子在深圳市工商行政管理局办理了上述股权转让的工商变更登记手续，并领取了《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，集锦电子的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
姜雪飞	70.00	35.00
赵杰	50.00	25.00
黄水文	30.00	15.00

李文	30.00	15.00
岳一珍	20.00	10.00
合计	200.00	100.00

3、1998 年 7 月，第二次股权转让

1998 年 4 月 3 日，集锦电子股东会通过决议，同意赵杰将其持有的集锦电子 20%出资额以 80 万元转让给姜雪飞、5%出资额以 20 万元转让给李文；黄水文将其持有的集锦电子 15%出资额以 60 万元转让给李文；岳一珍将其持有的集锦电子 10%出资额以 40 万元转让给朱雪贤。股权转让的定价依据是每元出资额作价 2 元。同日，赵杰与姜雪飞和李文、黄水文与李文、岳一珍与朱雪贤分别签订了《股权转让协议》。深圳市公证处分别出具（98）深证经字第 493 号、第 494 号、第 495 号、第 496 号《公证书》对上述股权转让协议进行了公证。

1998 年 7 月 31 日，集锦电子在深圳市工商行政管理局办理了上述股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，集锦电子的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
姜雪飞	110.00	55.00
李文	70.00	35.00
朱雪贤	20.00	10.00
合计	200.00	100.00

4、2000 年 6 月，第三次股权转让

1999 年 10 月 26 日，李文与姜雪飞签订了《股权转让协议》，约定李文将其持有的集锦电子 35%出资额以 230 万元转让给姜雪飞，股权转让的价格经双方协商确定为每元出资额作价 3.29 元。深圳市福田区公证处出具（99）深福证字第 4887 号《公证书》对本次股权转让进行了公证。2000 年 5 月 15 日，集锦电子股东会通过决议，同意上述股权转让事项。

2000 年 6 月 14 日，集锦电子在深圳市工商行政管理局办理了上述股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，集锦电子的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
姜雪飞	180.00	90.00
朱雪贤	20.00	10.00
合计	200.00	100.00

5、2001 年 7 月，第四次股权转让

2001 年 6 月 26 日，集锦电子股东会通过决议，朱雪贤将其持有的集锦电子 10%出资额以 20 万元转让给朱雪花。股权转让的定价依据是每元出资额作价 1 元。2001 年 6 月 20 日，朱雪贤与朱雪花签订了《股权转让协议》，6 月 22 日，深圳市福田区公证处出具（2001）深福证字第 2574 号公证书对股权转让协议进行了公证。

2001 年 7 月 16 日，集锦电子在深圳市工商行政管理局办理了上述股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，集锦电子的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
姜雪飞	180.00	90.00
朱雪花	20.00	10.00
合计	200.00	100.00

6、2002 年 7 月，第一次增资

2002 年 6 月 30 日，集锦电子股东会决议增资 200 万元，其中由股东姜雪飞增资 180 万元，股东朱雪花增资 20 万元，每元出资额作价 1 元，全部为货币出资。增资后集锦电子的注册资本增加到 400 万元。

2002 年 7 月 15 日，集锦电子在深圳市工商行政管理局办理了本次增资的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，集锦电子的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
姜雪飞	360.00	90.00

朱雪花	40.00	10.00
合计	400.00	100.00

7、2003 年 3 月，集锦电子更名为集锦线路板

2003 年 3 月 7 日，集锦电子股东会决议公司名称变更为深圳市集锦线路板科技有限公司。

2003 年 3 月 10 日，集锦线路板在深圳市工商行政管理局办理了更名的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

8、2004 年 2 月，第二次增资

2004 年 2 月 15 日，集锦线路板股东会决议增资 300 万元，其中由股东姜雪飞增资 270 万元，股东朱雪花增资 30 万元。每元出资额作价 1 元。增资后集锦线路板的注册资本增加到 700 万元。

2004 年 2 月 26 日，集锦线路板在深圳市工商行政管理局办理了本次增资的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后，集锦线路板的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
姜雪飞	630.00	90.00
朱雪花	70.00	10.00
合计	700.00	100.00

9、2004 年 4 月，第三次增资

2004 年 3 月 18 日，集锦线路板股东会决议增资 600 万元，其中由股东姜雪飞增资 540 万元，股东朱雪花增资 60 万元。每元出资额作价 1 元。增资后集锦线路板的注册资本增加到 1,300 万元。

2004 年 4 月 6 日，集锦线路板在深圳市工商行政管理局办理了本次增资的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后，集锦线路板的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
----	----------	---------

姜雪飞	1,170.00	90.00
朱雪花	130.00	10.00
合计	1,300.00	100.00

10、2004 年 11 月，第四次增资

2004 年 10 月 20 日，集锦线路板股东会决议增资 200 万元，其中由股东姜雪飞增资 180 万元，股东朱雪花增资 20 万元。每元出资额作价 1 元。增资后集锦线路板的注册资本增加到 1,500 万元。

2004 年 11 月 4 日，集锦线路板在深圳市工商行政管理局办理了本次增资的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后，集锦线路板的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
姜雪飞	1,350.00	90.00
朱雪花	150.00	10.00
合计	1,500.00	100.00

11、2008 年 11 月，第五次增资

2008 年 10 月 28 日，集锦线路板股东会决议增资 800 万元，其中由股东姜雪飞增资 720 万元，股东朱雪花增资 80 万元。每元出资额作价 1 元。增资后集锦线路板的注册资本增加到 2,300 万元。

2008 年 11 月 20 日，集锦线路板在深圳市工商行政管理局办理了本次增资的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后，集锦线路板的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
姜雪飞	2,070.00	90.00
朱雪花	230.00	10.00
合计	2,300.00	100.00

12、2010 年 6 月，第六次增资

2010 年 4 月 23 日，集锦线路板股东会决议由公司员工姜曙光、彭卫红、邓

峻、余忠、袁进、彭建均、张庭主、严安辉、杨林、白会斌、汪广明、刘保海、王俊浩、尹建华、赵金秋、谢华、王剑峰等 17 人对公司进行增资。该 17 名公司员工合计投入 2,390 万元，增加注册资本 326.49 万元，溢价 2,063.51 万元计入公司资本公积。员工增资的定价依据是以 2009 年经审计的净资产为基础确定为每元注册资本作价 7.32 元。

2010 年 6 月 4 日，集锦线路板在深圳市市场监督管理局办理了本次增资的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后，集锦线路板的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
姜雪飞	2,070.00	78.8125
朱雪花	230.00	8.7569
姜曙光	122.95	4.6812
彭卫红	54.64	2.0803
邓峻	40.98	1.5603
余忠	40.98	1.5603
袁进	13.66	0.5201
彭建均	13.66	0.5201
张庭主	4.10	0.1561
严安辉	4.10	0.1561
杨林	4.10	0.1561
白会斌	4.10	0.1561
汪广明	4.10	0.1561
刘保海	4.10	0.1561
王俊浩	4.10	0.1561
尹建华	2.73	0.1039
赵金秋	2.73	0.1039
谢华	2.73	0.1039
王剑峰	2.73	0.1039
合计	2,626.49	100.00

（1）17 名公司员工基本情况介绍及出资资金来源说明

本次增资的 17 名员工入职时间、身份证号码、任职情况如下表所示：

序号	股东名称	身份证号码	入职时间	任职情况
1	姜曙光	21020419670312****	1998年10月	2007年至2008年初,就职于集锦线路板担任副总经理;2008年3月至今,任大连崇达执行董事、总经理;2010年8月至今,任崇达技术副总经理。
2	彭卫红	43250219741107****	2000年1月	2007年1月至7月,任深圳崇达制造部经理同时兼任工程部、工艺研发部、计划部经理及公司安全主任;2007年8月至2008年7月,任深圳崇达制造总监;2008年8月至今,任深圳崇达副总经理;2010年8月至今,任崇达技术副总经理。
3	邓 峻	42010519680415****	2005年5月	2007年至2008年,任集锦线路板制造部经理;2008年至2010年7月,任集锦线路板副总经理;2010年8月至今,任崇达技术副总经理,兼任江门崇达总经理。
4	余 忠	51101119740513****	2009年8月	2007年至2009年,任深圳市三三得玖科技有限公司投资经理兼总经理助理、监事;2009年至2010年,任集锦线路板财务总监;2009年至今,任深圳崇达董事;2010年8月至今,任崇达技术董事、董事会秘书、财务总监。
5	袁进	42062619650205****	2000年10月	2007年至今,任深圳崇达设备部经理。
6	彭建均	43300119720128****	2002年8月	2007年,任深圳崇达制造部副经理;2008年1月1日至今,任深圳崇达制造部高级经理;2010年4月起任深圳崇达监事;2010年8月至今,任崇达技术监事。
7	张庭主	41302819740925****	2005年8月	2007年至2008年6月30日,任集锦线路板工艺研发副经理;2008年7月1日至2009年7月30日,任集锦线路板工艺研发经理;2009年8月1日至2010年6月30日,任集锦线路板品保部经理;2010年7月1日至2011年3月31日,任崇达技术福永分公司研发部经理;2011年4月1日至今,任大连崇达工艺部经理。
8	严安辉	42242819740323****	2007年10月	2007年10月至2011年2月,任深圳崇达人力资源经理;2011年3月至今,任深圳崇达人力资源副经理。
9	杨林	37243219780401****	2007年6月	2007年6月至2008年6月,任集锦线路板工程部副经理;2008年7月至2010年8月,任集锦线路板工程部经理;2010年8月至今,任福永分公司工程部经理。
10	白会斌	41130219780312****	2003年11月	2007年1月至11月,任集锦线路板阻焊课主管;2007年12月至2008年1月,任集锦线路板计划课主管;2008年2月至2009年7月,任集锦线路板制造部副经理;2009年8月至2010年2月,任集锦线路板品保部副经理;2010年3月至2010年7月,任集锦线路板制造部经理;2010年8月至今,任福永分公司制造部经理。

11	汪广明	34102219791014****	1998 年 8 月	2007 年 1 月至 8 月，任集锦线路板维护课副经理；2007 年 9 月至 2009 年 4 月，任集锦线路板设备部副经理；2009 年 5 月 2010 年 7 月，任集锦线路板设备部经理；2010 年 8 月至今，任福永分公司设备部高级经理。
12	刘保海	36232519780806****	2003 年 7 月	2007 年至 2008 年 1 月，任深圳崇达销售工程师；2008 年 2 月至 2009 年 2 月，任深圳崇达市场部业务主管、市场副经理；2009 年 3 月至今，任崇达技术销售部经理。
13	王俊浩	41230119801204****	2004 年 3 月	2007 年至 2008 年 1 月，任集锦线路板制造总管；2008 年 2 月至今，任大连崇达生产部经理。
14	尹建华	43242319770129****	2004 年 7 月	2007 年至 2008 年 1 月，任深圳崇达销售工程师；2008 年 2 月至 2010 年 4 月，任深圳崇达市场部业务主管；2010 年 5 月至今，任崇达技术业务经理。
15	赵金秋	43250319720922****	2005 年 11 月	2007 年至 2010 年 4 月，任深圳崇达财务部副经理；2010 年 5 月至今，任崇达技术财务部经理。
16	谢华	43020219750902****	2004 年 5 月	2007 年 1 至 11 月，任集锦线路板市场部主管；2007 年 12 月至 2009 年 6 月，任集锦线路板市场部副经理；2009 年 7 月至今，任崇达技术业务经理。
17	王剑峰	42010719740705****	2005 年 9 月	2007 年至 2008 年 1 月，任深圳崇达业务、销售工程师；2008 年 2 月至 2010 年 4 月，任深圳崇达市场部业务主管；2010 年 5 月至今，任崇达技术业务经理。

上述员工增资的资金来源为自有资金，不存在借款出资的情形。

(2) 本次增资员工与本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员及家庭关系密切成员及本次发行中介机构及签字人员之间的关联关系

上述员工中除姜曙光系姜雪飞胞兄，其他增资员工与本公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及家庭关系密切成员不存在亲属及其他关联关系，与本公司本次发行中介机构及签字人员不存在亲属及其他关联关系。上述增资员工不存在代持股份和信托持股情形，担任本公司股东合法合规。

13、2010 年 6 月，第七次增资

2010 年 6 月 10 日，集锦线路板股东会同意引进汇投投资、同威创业、超淦贸易 3 名股东。其中汇投投资投入 2,000 万元，增加注册资本 142.71 万元；同威创业投入 2,000 万元，增加注册资本 142.71 万元；超淦贸易投入 1,200 万元，增

加注册资本 85.63 万元。3 名股东合计投入 5,200 万元，增加注册资本 371.05 万元，溢价 4,828.95 万元计入公司资本公积。本次增资以公司 2009 年净利润的 8 倍市盈率为基础，确定为每元注册资本作价 14.01 元。

2010 年 6 月 22 日，集锦线路板在深圳市市场监督管理局办理了本次增资的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后，集锦线路板的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
姜雪飞	2,070.00	69.0564
朱雪花	230.00	7.6730
汇投投资	142.71	4.7609
同威创业	142.71	4.7609
姜曙光	122.95	4.1017
超淦贸易	85.63	2.8567
彭卫红	54.64	1.8228
邓峻	40.98	1.3671
余忠	40.98	1.3671
袁进	13.66	0.4557
彭建均	13.66	0.4557
张庭主	4.10	0.1368
严安辉	4.10	0.1368
杨林	4.10	0.1368
白会斌	4.10	0.1368
汪广明	4.10	0.1368
刘保海	4.10	0.1368
王俊浩	4.10	0.1368
尹建华	2.73	0.0911
赵金秋	2.73	0.0911
谢华	2.73	0.0911
王剑峰	2.73	0.0911
合计	2,997.54	100.00

汇投投资和同威创业的出资来源均为企业自有资金，不存在借款出资；超淦

贸易的出资来源包括两部分，420 万元为企业自有资金、780 万元为向本公司及子公司以外的第三方借款，截至 2011 年 12 月 31 日，上述借款已全部偿还完毕，超淦贸易不存在向本公司及其子公司借款的情形，本公司及其子公司亦未向超淦贸易提供任何财务资助。

除同威创业股东汪姜维为本公司董事之外，汇投投资、同威创业、超淦贸易的股东与本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员及家庭关系密切成员不存在亲属及其他关联关系，与本公司本次发行中介机构及签字人员不存在亲属及其他关联关系。汇投投资、同威创业、超淦贸易不存在代持股份和信托持股情形，担任本公司股东合法合规。

（三）发行人设立及其后的股本形成及历次变化情况

2010 年 7 月 30 日，经集锦线路板临时股东会审议通过，集锦线路板以截至 2010 年 6 月 30 日经审计的母公司净资产 201,951,635.76 元中的 112,500,000 元折合股本 112,500,000 股，余额 89,451,635.76 元计入资本公积，折股比例为 1:0.5571，整体变更设立深圳市崇达电路技术股份有限公司，并于 2010 年 8 月 26 日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，取得注册号为 440306103723886 的《企业法人营业执照》，注册资本为 11,250 万元。

崇达技术设立时的股权结构如下：

发起人名称	持股数量（股）	持股比例（%）
姜雪飞	77,688,300	69.0564
朱雪花	8,632,100	7.6730
汇投投资	5,356,000	4.7609
同威创业	5,356,000	4.7609
姜曙光	4,614,400	4.1017
超淦贸易	3,213,800	2.8567
彭卫红	2,050,700	1.8228
邓峻	1,538,000	1.3671
余忠	1,538,000	1.3671
袁进	512,700	0.4557
彭建均	512,700	0.4557

张庭主	153,900	0.1368
严安辉	153,900	0.1368
杨林	153,900	0.1368
白会斌	153,900	0.1368
汪广明	153,900	0.1368
刘保海	153,900	0.1368
王俊浩	153,900	0.1368
尹建华	102,500	0.0911
赵金秋	102,500	0.0911
谢华	102,500	0.0911
王剑峰	102,500	0.0911
合计	112,500,000	100.00

自设立以后，截至本招股说明书签署之日，发行人股本未发生变化。

（四）发行人的重大资产重组情况

自设立以来，截至本招股说明书签署之日，发行人无重大资产重组事项。

四、发行人历次验资情况

发行人及其前身自成立以来，历经了九次验资，具体情况如下：

（一）发行人前身——集锦电子、集锦线路板的历次验资

1、1995 年集锦电子设立时的验资

1995 年 4 月 20 日，深圳市民孚审计师事务所出具深民审所验字（1995）298 号《验资报告书》对集锦电子设立的出资进行了审验。经审验，截至 1995 年 4 月 16 日，集锦电子实收资本为人民币 200 万元。

2、2002 年 7 月，集锦电子增资 200 万元时的验资

2002 年 7 月 4 日，深圳广信会计师事务所出具深广信所验字（2002）第 237 号《验资报告书》对本次增资进行了审验。经审验，截至 2002 年 7 月 3 日，集锦电子增加投入注册资本人民币 200 万元，变更后的注册资本总额为人民币 400 万元，实收资本人民币 400 万元。

3、2004 年 1 月，集锦线路板增资 300 万元时的验资

2004 年 1 月 8 日，深圳广信会计师事务所出具深广信所验字（2004）第 005 号《验资报告书》对本次增资进行了审验。经审验，截至 2004 年 1 月 8 日，集锦线路板已收到姜雪飞和朱雪花缴纳的新增注册资本合计人民币 300 万元，本次变更后，集锦电子注册资本和实收金额为人民币 700 万元。

4、2004 年 3 月，集锦线路板增资 600 万元时的验资

2004 年 3 月 18 日，深圳广信会计师事务所出具深广信所验字（2004）第 042 号《验资报告书》对本次增资进行了审验。经审验，截至 2004 年 3 月 18 日，集锦线路板已收到姜雪飞和朱雪花缴纳的新增注册资本合计人民币 600 万元，本次变更后，集锦电子注册资本和实收金额为人民币 1,300 万元。

5、2004 年 10 月，集锦线路板增资 200 万元时的验资

2004 年 10 月 21 日，深圳广信会计师事务所出具深广信所验字（2004）第 738 号《验资报告书》对本次增资进行了审验。经审验，截至 2004 年 10 月 21 日，集锦线路板已收到姜雪飞和朱雪花缴纳的新增注册资本合计人民币 200 万元，本次变更后，集锦电子注册资本和实收金额为人民币 1,500 万元。

6、2008 年 11 月，集锦线路板增资 800 万元时的验资

2008 年 11 月 13 日，深圳毅华会计师事务所出具深毅华所验字【2008】第 428 号《验资报告书》对本次增资进行了审验。经审验，截至 2008 年 11 月 12 日，集锦线路板已收到姜雪飞和朱雪花缴纳的新增注册资本合计人民币 800 万元，本次变更后，集锦电子注册资本和实收资本为人民币 2,300 万元。

7、2010 年 5 月，集锦线路板增资 326.49 万元时的验资

2010 年 5 月 12 日，鹏城会计师事务所出具深鹏所验字【2010】193 号《验资报告》对本次增资进行了审验。经审验，截至 2010 年 5 月 12 日，公司已收到姜曙光等 17 名股东缴纳的新增注册资本人民币 326.49 万元，资本溢价 2,063.51 万元，合计人民币 2,390 万元。其中 326.49 万元计入公司实收资本，2,063.51 万元计入公司资本公积。本次变更后公司累计实收资本人民币 2,626.49 万元。

8、2010年6月，集锦线路板增资371.05万元时的验资

2010年6月13日，鹏城会计师事务所出具深鹏所验字【2010】220号《验资报告》对本次增资进行了审验。经审验，截至2010年6月13日，公司已收到汇投投资、同威创业、超淦贸易等3名股东缴纳的新增注册资本人民币371.05万元，资本溢价4,828.95万元，合计人民币5,200万元。其中，371.05万元计入公司实收资本，4,828.95万元计入公司资本公积。本次变更后公司累计实收资本人民币2,997.54万元。

（二）公司设立时的验资

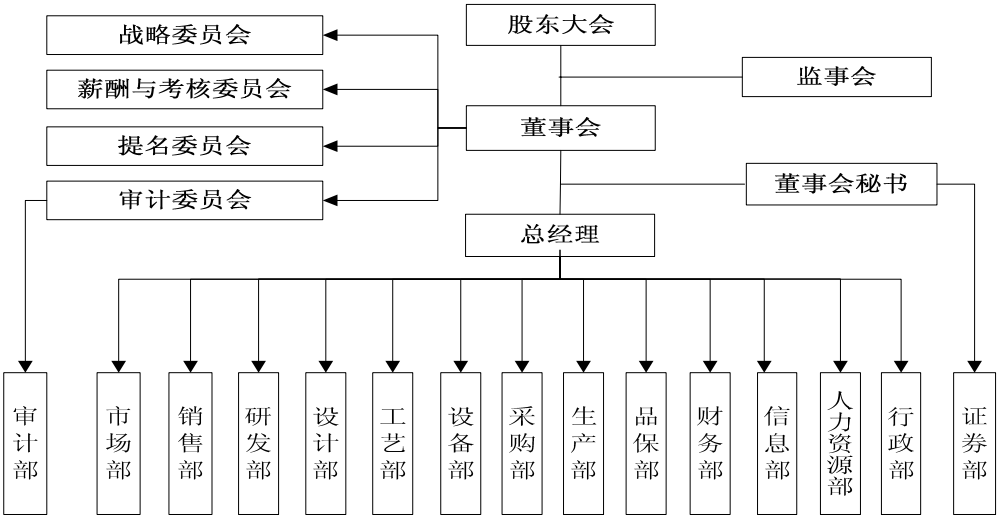
2010年7月30日，集锦线路板以截至2010年6月30日经审计的母公司净资产201,951,635.76元中的112,500,000元折合股本112,500,000股，其余计入资本公积，整体变更为股份有限公司。

2010年8月14日，鹏城会计师事务所出具了深鹏所验字【2010】第304号《验资报告》。经审验，折股后崇达技术股本和注册资本为11,250万元，资本公积89,451,635.76元。

五、发行人的组织结构

（一）发行人的组织结构图

本公司按照《公司法》等有关法律、法规的要求，召开创立大会暨第一次股东大会，选举股份公司的董事、监事，设立股份公司的股东大会、董事会、监事会等法人治理机构。公司的组织结构如下：



（二）发行人各主要职能部门及工作职责

本公司设立了相关职能部门，具体职能如下：

1、市场部

负责建立市场信息收集管理体系和制度，确保公司及时获取有效的市场信息；批准并督促执行市场调研计划，随时掌握市场信息，为准确决策提供依据；负责公司 CI 系统（企业形象识别系统）的建立、应用、管理和监控；组织制定品牌定位、品牌形象策划方案，规范公司品牌管理；组织制订及调整市场政策及公司市场定位；负责细分市场信息收集，并撰写报告；制定各类客户的管理政策，提升客户满意度；负责公司对外宣传等相关事项。

2、销售部

根据业务发展的需要，建立并发展销售网络；销售计划管理：负责拟定公司年度销售计划，编制销售报表，并对销售计划执行情况进行统计、分析；根据市场部的要求，收集竞争对手信息，为市场决策提供依据；获取客户订单信息，跟进相关部门进行订单评审；进行商务合同谈判及签订合同、销售订单；追踪生产进度，收集客户验货信息，转交品保部处理；负责与国外客户对账，确保应收账款的准确性；负责客户长期逾期货款、或者有争议逾期货款的处理；负责客户管理，收集并反馈客户对产品质量的意见和要求，受理客户投诉。

3、研发部

负责新产品、新工艺、新技术的研究与开发；负责新材料试用并提出材料试用报告，组织新工艺试验并提出实施方案组织实施；负责环保材料的开发及研究；负责公司专利技术研发及知识产权的申请与管理；“产、学、研”和技术中心日常事务管理；国家扶持项目的跟进与管理。

4、设计部

负责各种生产准备资料的制作、程序更改控制；负责工程标准制定和维护；组织实施订单评审；组织外协供应商的开发与管理；为生产制造提供生产技术支持。

5、工艺部

负责解决生产现场出现的工艺技术问题，保证生产的正常运行；负责对客户、外协供应商、采购供应商的咨询进行技术指导；制定并组织实施工艺能力改善计划，提升公司的技术能力；制定工艺规范、工艺标准等文件，保证符合技术要求、管理要求；制定新设备的工艺验收标准，保证引进设备的工艺性能满足要求。根据有关作业指导书的要求定期进行理化实验分析，发现不合格或质量隐患及时通知采取纠正和预防措施，并跟踪实施效果；负责生产技术和工艺文件的编制、修订并监督执行。

6、设备部

负责编制和修订设备管理文件并监督执行；负责新设备的安装、调试和验收，并建立设备管理档案；做好设备维护保养工作，及时排除设备故障并保存记录；负责环境监测和测量活动，并根据需要统筹环保工程相关事宜。

7、采购部

了解市场信息，拟定采购需求，按计划实施采购策略，负责供应商开发、管理和考核，建立、管理采购渠道，组织供应商管理体系审查、产品认证，实施辅导与考核，及时了解市场信息和原材料价格变动趋势，组织开展询价、议价等价格管理工作，及时、低成本地完成采购计划。

8、生产部

负责实施生产计划，保证生产进度；负责工序的产品品质检查及成品检查，保证产品质量，控制物料消耗，降低成本；负责现场的环境、安全管理，统筹有关生产活动方面的环境管理活动；实施质量改进计划，生产技术改进方案和设备改造引进方案；负责实施员工生产技术培训。

9、品保部

负责编制进料、制程和成品检验规范，并对进料、制程工序和成品抽样监督检验，确保产品和原材料符合规定标准；根据具体要求参与编制质量计划，组织实施并跟踪结果；根据检验记录进行质量统计分析，发现质量问题和隐患及时通报有关各方采取预防和纠正措施；负责公司质量管理体系的建设与维护，确保公司规范运作；处理客户投诉。

10、财务部

及时准确地进行会计核算，编制会计报表；审核与财务相关的经济合同，编制财务计划与财务预算、资产管理及运作方案，及时做出财务报告和预测报告，为公司经营决策、资本运作提供支持和依据。

11、信息部

根据公司战略规划，制定与企业战略规划相匹配的信息化规划，并组织实施与评估；主导企业信息网络架设与维护，信息系统的引进、实施、维护及二次开发工作；制定并实施系统安全、数据安全、网络安全、信息安全等相关制度，保障公司信息系统安全运行；负责信息资产及软件产权的管理与监控。

12、人力资源部

根据公司的发展战略，制定人力资源发展规划，组织人才的招聘与选拔，实现人才的合理配置；组织建立科学的绩效管理体系，促进人才潜力的发掘与运用；组织制定完善的薪酬福利制度，建立有效的激励机制，促进人才稳定；根据企业的发展需求，组织人才的培训与开发，不断提升员工综合素质，并结合人才的发展需求，组织实施员工职业生涯发展规划，为员工建立良好的职业发展通道和福

利保障。

13、行政部

制定并组织实施公司日常行政管理制度；负责公司总务后勤管理工作；负责员工职业健康安全、消防及生产安全管理；负责公司对外联络工作。

14、审计部

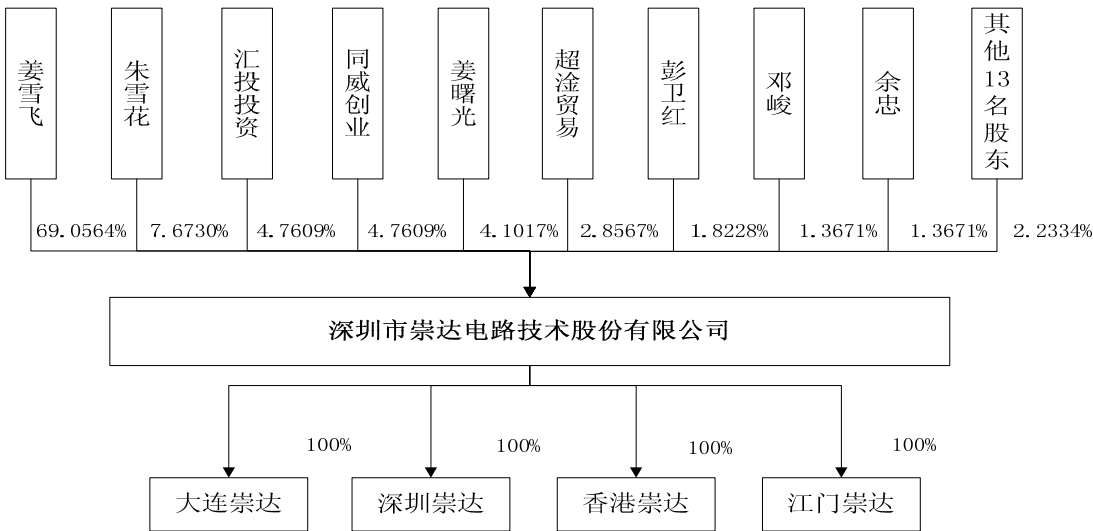
组织并实施日常和专项审计，向董事会提交内部审计报告，向公司有关部门通报审计结果，并提出加强、改进和完善公司内控制度、操作流程的管理建议；执行并监督审计结果完成情况，保证公司信息的可靠性、资产的安全性、经营的高效性及合规性。

15、证券部

参与公司股票发行等资本运营工作；协助董事会秘书筹备公司三会并保存会议资料；协助董事会秘书进行信息披露等相关工作；拟定和执行公司各项与证券事务有关的制度，负责与投资者的沟通。

六、发行人控股及参股公司、分公司情况

（一）发行人的股权结构图



各公司业务定位

公司名称	业务定位
崇达技术	主要生产 4 层到 6 层的 PCB，由福永分公司生产
深圳崇达	主要生产 6 层以上的 PCB 及 HDI
大连崇达	主要生产双面板
江门崇达	募投项目实施
香港崇达	产品外销、进口原材料采购窗口

(二) 发行人的子公司

1、深圳崇达

(1) 深圳崇达的基本情况

深圳崇达为发行人的全资子公司，成立于 1999 年 8 月 27 日，法定代表人：姜雪飞，注册资本和实收资本：7,937.50 万元。注册地和主要生产经营地为深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路 3 栋、横岗下工业区第一排 5 号厂房一楼、四楼。经营范围为双面电路板、多层电路板、多层柔性电路板、HDI 电路板、多层刚柔结合型电路板的生产（限新桥横岗下工业区新玉路 3 栋）与销售；线路板钻孔加工（限横岗下工业区第一排 5 号厂房一楼、四楼）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。主营业务为多层 PCB 的生产和销售。

深圳崇达最近一年一期的主要财务数据如下：

项目	2012. 6. 30/2012 年 1—6 月	2011. 12. 31/2011 年
总资产（万元）	76,744.21	70,915.99
净资产（万元）	32,683.83	27,154.10
净利润（万元）	5,529.73	11,476.99

注：以上数据经上海众华审计。

(2) 深圳崇达的股权演变

①1999 年 8 月，深圳崇达成立

1999 年 8 月 2 日，经深圳市外商投资局批准，深圳崇达由集锦电子、香港乐蔚和坦程电子共同出资组建，注册资本为 400 万元。同日，深圳崇达取得外经

贸【粤深合资证】字【1999】3017号《台港澳侨投资企业批准证书》。1999年8月27日，深圳崇达领取国家工商行政管理局颁发的企合粤深总副字第108820号《企业法人营业执照》。经营范围为：生产经营双面线路板、多层线路板，产品40%外销。

根据深圳敬业会计师事务所出具敬会验字【1999】第142号《验资报告》、敬会验字【1999】第164号《验资报告》，截至1999年11月2日，深圳崇达的注册资本为400万元，全部以货币出资。

深圳崇达设立后股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
集锦电子	100.00	25.00
香港乐蔚	200.00	50.00
坦程电子	100.00	25.00
合计	400.00	100.00

② 2002年9月，第一次股权转让

2002年6月26日，经董事会决议，坦程电子将其持有的25%深圳崇达的股权作价100万元转让给集锦电子。2002年6月28日，坦程电子与集锦电子签订《股权转让协议书》，7月11日，深圳市南山区公证处就该股权转让协议书出具（2002）深南内经字第187号《公证书》。2002年8月2日，深圳市对外贸易经济合作局以《关于合资企业“深圳崇达多层线路板有限公司”股权变更的批复》（深外经贸资复【2002】2604号）批准同意本次股权转让。2002年8月5日，深圳崇达换取了新的《台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸【粤深合资证】字【1999】3017A号）。

2002年8月8日和2002年8月27日香港乐蔚、坦程电子与集锦电子分别出具确认书：同意坦程电子将其拥有的25%公司股份以100万元转让给集锦电子。

本次股权转让后深圳崇达的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
----	----------	---------

集锦电子	200.00	50.00
香港乐蔚	200.00	50.00
合计	400.00	100.00

③ 2003 年 6 月，深圳崇达第一次增资

2003 年 1 月 5 日，深圳崇达董事会决议以 2002 年 12 月 31 日的累计未分配利润 900 万元转增注册资本，另集锦电子、香港乐蔚再各投入 50 万元现金，增资后深圳崇达的注册资本由 400 万元增加到 1,400 万元；同时同意中方股东集锦电子更名为集锦线路板。2003 年 4 月 8 日，深圳市对外贸易经济合作局以《关于合资企业“深圳崇达多层线路板有限公司”增资的批复》（深外经贸资复【2003】1234 号）批准同意本次增资。2003 年 4 月 9 日，深圳崇达换取了新的《台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸【粤深合资证】字【1999】3017A 号）。

2003 年 6 月 9 日，深圳敬业会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了敬会验字【2003】第 250 号《验资报告》。

2003 年 6 月 13 日，深圳市工商行政管理局向深圳崇达核发了变更后的《企业法人营业执照》。

增资后深圳崇达的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
集锦线路板	700.00	50.00
香港乐蔚	700.00	50.00
合计	1,400.00	100.00

④ 2004 年 3 月，第二次增资

2004 年 2 月 5 日，深圳崇达董事会决议以截至 2003 年 12 月 31 日的未分配利润 950 万元转增注册资本，转增后公司的实收资本从 1,400 万元增至 2,350 万元。2004 年 3 月 18 日，深圳市对外贸易经济合作局以《关于合资企业“深圳崇达多层线路板有限公司”增资的批复》（深外经贸资复【2004】0769 号）批准同意本次增资。2004 年 3 月 19 日，深圳崇达换领了《台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深合资证字【1999】3017A 号）。

2004年4月19日，深圳天华会计师事务所有限公司对本次增资进行了验证，并出具了验变【2004】62号《验资报告》。

2004年4月26日，深圳市工商行政管理局向深圳崇达核发了变更后的《企业法人营业执照》。

增资后深圳崇达的股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
集锦线路板	1,175.00	50.00
香港乐蔚	1,175.00	50.00
合计	2,350.00	100.00

⑤ 2005年12月，第二次股权转让

2005年11月24日，深圳崇达董事会决议同意香港乐蔚将其持有的深圳崇达30%股权以705万元转让给香港汇锦。2005年12月6日，香港乐蔚与香港汇锦签订《股权转让协议书》。2005年12月7日，深圳市公证处就该股权转让协议书出具（2005）深证字第37153号《公证书》。

2005年12月23日，深圳市南山区经济贸易局以《关于合资企业“深圳崇达多层线路板有限公司”股权转让的批复》（深外资南复【2005】0697号）批准同意本次股权转让。同日，深圳崇达换取了新的《台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深合资证字【1999】3017A号）。

本次股权变更后深圳崇达股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
集锦线路板	1,175.00	50.00
香港汇锦	705.00	30.00
香港乐蔚	470.00	20.00
合计	2,350.00	100.00

⑥ 2006年6月，第三次增资

2006年3月15日，公司董事会决议将深圳崇达的注册资本从2,350万元增加至6,350万元。本次增加注册资本4,000万元为公司2004年至2005年末分配

利润转增。2006年3月30日，深圳市南山区贸易工业局以《关于合资企业“深圳崇达多层线路板有限公司”增资的批复》（深外资南复【2006】0136号）批准同意本次增资。同日，深圳崇达换取了新的《台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深合资证字【1999】3017A号）。

2006年5月22日，深圳天华会计师事务所有限公司对本次增资进行了验证，并出具了深天华验变报字【2006】第16号《验资报告》。

2006年6月2日，深圳市工商行政管理局向深圳崇达核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后深圳崇达股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
集锦线路板	3,175.00	50.00
香港汇锦	1,905.00	30.00
香港乐蔚	1,270.00	20.00
合计	6,350.00	100.00

⑦ 2007年9月，第三次股权转让

2007年8月3日，深圳崇达董事会决议同意香港乐蔚将其持有的深圳崇达20%股权以1,270万元转让给香港汇锦。2007年9月13日，深圳市南山区贸易工业局以《关于合资企业“深圳崇达多层线路板有限公司”股权转让的批复》（深外资南复【2007】号）批准同意本次股权转让。2007年9月17日，深圳崇达换领了新的《台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深合资证字【1999】3017A号）。2007年9月24日，香港乐蔚与香港汇锦签订《股权转让合同》。2007年9月25日，深圳市公证处就该次股权转让出具（2007）深证字第171956号《公证书》。

本次股权转让后深圳崇达股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
集锦线路板	3,175.00	50.00
香港汇锦	3,175.00	50.00
合计	6,350.00	100.00

⑧ 2008 年 11 月，第四次增资

2008 年 10 月 6 日，深圳崇达董事会决议将注册资本从 6,350 万元增加至 7,937.50 万元，增资部分全部由集锦线路板以货币资金认缴。2008 年 10 月 17 日，深圳市南山区贸易工业局向深圳崇达核发了《关于合资企业“深圳崇达多层线路板有限公司”增资的批复》。2008 年 10 月 17 日，深圳崇达换领了新的《台港澳侨投资企业批准证书》。2008 年 11 月 14 日，深圳大公会会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了深大公所验字【2008】158 号《验资报告》。

2008 年 11 月 20 日，深圳市工商行政管理局向深圳崇达核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后深圳崇达股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
集锦线路板	4,762.50	60.00
香港汇锦	3,175.00	40.00
合计	7,937.50	100.00

⑨ 2009 年 12 月，第四次股权转让

2009 年 11 月 16 日，深圳崇达董事会决议同意香港汇锦将其持有的深圳崇达 40% 股权作价 5,045.29 万元转让给集锦线路板，作价依据为深圳崇达截至 2009 年 9 月 30 日经审计的净资产。2009 年 11 月 30 日，香港汇锦与集锦线路板签订股权转让协议。2009 年 12 月 1 日，深圳市公证处就该次股权转让出具（2009）深证字第 194347 号《公证书》。

2009 年 12 月 14 日，深圳市南山区贸易工业局以《关于合资企业“深圳崇达多层线路板有限公司”股权转让、企业性质变更的批复》（深外资南复【2009】0434 号）批准同意本次股权转让。

2009 年 12 月 25 日，深圳市市场监督管理局向深圳崇达核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后深圳崇达股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
集锦线路板	7,937.50	100.00
合计	7,937.50	100.00

至此，深圳崇达的注册资本和股权结构未再发生变化。

2、大连崇达

（1）大连崇达的基本情况

大连崇达为本公司的全资子公司，设立于 2008 年 3 月 21 日，法定代表人为姜曙光；注册资本和实收资本均为 1,000 万元；注册地和主要生产经营地：大连经济技术开发区淮河中路 3 号；经营范围及主营业务为：印制电路板加工、设计和销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）；经营期限自 2008 年 3 月 21 日至 2018 年 3 月 20 日；营业执照注册号：210241000003864。

大连崇达最近一年一期的主要财务数据如下：

项目	2012. 6. 30/2012 年 1—6 月	2011. 12. 31/2011 年
总资产（万元）	6,486.97	5,258.43
净资产（万元）	1,496.93	1,096.67
净利润（万元）	400.27	187.10

注：以上数据经上海众华审计。

（2）大连崇达的股权演变

① 2008 年 3 月 21 日，大连崇达成立

2008 年 3 月 21 日，经大连市工商行政管理局核准，大连崇达成立，获得注册号为大开工商企法字 2102411108978 的《企业法人营业执照》，住所为大连经济技术开发区淮河中路 3 号，法定代表人为姜曙光，注册资本为 1,000 万元，营业期限为 2008 年 3 月 21 日至 2018 年 3 月 20 日。根据辽宁海天会计师事务所有限公司出具的辽海会验字【2008】023 号、辽海会验字【2008】第 098 号、辽海会验字【2008】0124 号《验资报告》，2008 年 3 月 18 日、2008 年 7 月 17 日和 2008 年 10 月 21 日，大连崇达分别收到其股东缴纳的第 1 期出资 300 万元、第 2 期出资 300 万元、第 3 期出资 400 万元。

出资完成后的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
集锦线路板	600.00	60.00
姜曙光	300.00	30.00
大连多层	100.00	10.00
合计	1,000.00	100.00

② 2009 年 4 月，股权转让

2009 年 4 月 16 日，姜曙光、大连多层分别与集锦线路板签署股权转让协议，姜曙光、大连多层分别将其持有的大连崇达 30%股权、10%股权转让给集锦线路板，本次股权转让以大连崇达截至 2009 年 3 月 31 日经审计的净资产 4,283,491.73 元为基准，姜曙光、大连多层分别以 30%股权、10%股权对应的净资产计 1,285,047.52 元、428,349.17 元作为转让价格。

2009 年 5 月 8 日，大连市工商行政管理局核准了大连崇达上述股权转让事宜。2009 年 6 月 29 日，集锦线路板已支付全部相关股权转让款，大连崇达成为本公司的全资子公司。

本次股权转让后大连崇达股权结构如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
集锦线路板	1,000.00	100.00
合计	1,000.00	100.00

至此，大连崇达的注册资本和股权结构未再发生变化。

3、香港崇达

（1）香港崇达的基本情况

香港崇达为本公司的全资子公司。2008 年 11 月 10 日，深圳市贸易工业局出具《关于核准设立崇达科技有限公司的函》（深贸工经字【2008】295 号）同意集锦线路板在香港独资设立香港崇达，香港崇达主要从事总公司产品的销售，原材料和设备的采购和售后服务，注册资本与投资总额均为 100 万港币。2008 年 11 月 17 日，中华人民共和国商务部出具《批准证书》（【2008】商合境外投资

证字第 002479 号) 同意集锦线路板在香港投资设立境外企业。2009 年 1 月 21 日, 香港崇达在香港公司注册处注册, 领取了公司注册证书, 注册资本和实收资本均为 100 万元港币。注册地和主要生产经营地为香港新界屯门建发街 5 号广建贸易中心 10 楼 1008 室。香港崇达主要从事本公司产品的销售, 原材料和设备的采购及售后服务。

(2) 香港崇达的设立目的

本公司及子公司深圳崇达产品以外销为主, 部分境外客户要求公司提供香港账户用以结算, 本公司在 2008 年 11 月以前在香港没有设立分支机构, 故本公司及子公司深圳崇达使用香港汇锦和香港崇达线路板的银行账户代收部分海外客户的货款。

本公司主要生产设备及部分原材料从国外进口, 供应商经常会要求公司在短期内付款, 由于通过香港公司支付货款的审批流程较短, 为了提高采购货款的支付效率, 保持公司在境外供应商中良好的商业信用和资信水平, 公司部分原材料和设备的采购货款由香港汇锦和香港崇达线路板代为支付。

2008 年 11 月, 本公司对上述事项进行了规范, 不再通过香港汇锦、香港崇达线路板代收货款和代付采购款, 香港汇锦于 2008 年 12 月收回全部代收货款并于 2011 年 6 月 24 日合法注销, 香港崇达线路板于 2010 年 3 月前收回全部代收货款并于 2011 年 4 月 15 日合法注销。

为了顺利过渡本公司的海外业务, 以及满足部分海外客户从香港港口发货的需求, 2009 年 1 月 21 日, 本公司在香港设立了全资子公司香港崇达。香港崇达的经营范围为本公司产品的销售, 原材料和设备的采购及售后服务。

由于与客户及供应商充分沟通并取得其谅解, 在停止香港汇锦和香港崇达代收代付职能后, 客户和供应商均直接与本公司结算。因此香港崇达设立至今未发生任何代收代付业务, 仅承担以其名义在香港港口报关出口的职能。

香港崇达最近一年一期的主要财务数据如下:

项目	2012. 6. 30/2012 年 1—6 月	2011. 12. 31/2011 年
总资产 (万元)	79.75	79.78

净资产（万元）	79.75	79.78
净利润（万元）	-0.02	-3.68

注：以上数据经上海众华审计。

4、江门崇达

江门崇达为本公司的全资子公司，设立于 2010 年 7 月 9 日，法定代表人为姜雪飞。注册资本和实收资本：5,000 万元；注册地：江门市高新区连海路 363 号；主要经营地：江门市高新区连海路 363 号；经营范围为：双面线路板、多层线路板、柔性线路板的设计、生产和销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。主营业务为：印制电路板的生产和销售。

江门崇达最近一年一期的主要财务数据如下：

项目	2012. 6. 30/2012 年 1—6 月	2011. 12. 31/2011 年
总资产（万元）	17,216.70	13,320.18
净资产（万元）	4,661.19	4,755.70
净利润（万元）	-94.51	-197.81

注：以上数据经上海众华审计。

（三）发行人的参股公司

截至本招股说明书签署之日，发行人除上述四家全资子公司外，无其他参股公司。

（四）发行人的分公司

报告期内发行人及全资子公司设立的分公司共有 2 家。

1、福永分公司

福永分公司成立于 2010 年 8 月 13 日，营业期限自 2010 年 8 月 13 日至永续经营，负责人为邓峻。营业场所：深圳市宝安区福永街道塘尾南玻大道东侧。经营范围为双面线路板、多层线路板、柔性线路板的生产与销售。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。福永分公司系崇达技术的生产主体，负责崇达技术产品的生产。

2、宝安分公司

宝安分公司成立于 2008 年 11 月 27 日，负责人为姜雪飞，营业场所：深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路 3 栋。经营范围为生产经营双面线路板、多层线路板。营业期限自 2008 年 11 月 27 日至 2010 年 9 月 27 日。2010 年 11 月 1 日，深圳市市场监督管理局核准宝安分公司注销。

七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）发起人的基本情况

本公司的发起人如下：

1、姜雪飞

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：21020419691208****，住址：广东省深圳市福田区福荣路****。

2、朱雪花

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：44072219691207****，住址：广东省深圳市福田区福荣路****。

3、汇投控股集团有限公司

（1）设立时间：1994 年 5 月 31 日

（2）法定代表人：丁梅英

（3）注册资本和实收资本：5,000 万元

（4）股东构成及持股比例如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
丁宏广	3,500.00	70.00
丁梅英	1,500.00	30.00
合计	5,000.00	100.00

(5) 注册地和主要生产经营地：浙江省诸暨市应店街镇工业区

(6) 经营范围及主营业务

经营范围：许可经营项目：无；一般经营范围：实业投资；投资管理及咨询；从事货物的进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

主营业务：股权投资

(7) 汇投投资最近一年一期的主要财务数据如下：

项目	2012. 6. 30/2012 年 1—6 月	2011. 12. 31/2011 年
总资产（万元）	47,405.41	48,037.40
净资产（万元）	26,864.27	24,409.40
净利润（万元）	3,011.31	3,538.34

注：以上数据未经审计。

4、深圳市同威创业投资有限公司

(1) 设立时间：2008 年 3 月 2 日

(2) 法定代表人：韩涛

(3) 注册资本和实收资本：8,200 万元

(4) 股东构成及持股比例如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
韩涛	3,010	36.71
杜永忠	2,050	25.00
刘涛	800	9.75
李驰	760	9.27
翟晓慧	480	5.85
林建成	400	4.88
许灵芝	400	4.88
汪姜维	200	2.44
刘桂芬	100	1.22
合计	8,200	100.00

(5) 注册地和主要生产经营地：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 1102

(6) 经营范围及主营业务

经营范围：直接投资高新技术产业和其他创新产业、受托管理和经营创业资本；创业投资咨询、企业管理咨询、信息咨询（以上不含限制项目）。

主营业务：股权投资

(7) 同威创业最近一年一期的主要财务数据如下：

项目	2012. 6. 30/2012 年 1—6 月	2011. 12. 31/2011 年
总资产（万元）	12,863.78	11,243.38
净资产（万元）	8,273.44	4,146.16
净利润（万元）	26.09	62.05

注：以上数据未经审计。

5、姜曙光

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：21020419670312****，住址：辽宁省大连市沙河口区连胜街****。

6、深圳市超淦贸易有限公司

(1) 设立时间：1999 年 12 月 3 日

(2) 法定代表人：贡超

(3) 注册资本和实收资本：50 万元

(4) 股东构成及持股比例如下：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）
贡超	45.00	90.00
张忆	5.00	10.00
合计	50.00	100.00

(5) 注册地和主要生产经营地：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 2305 号

(6) 经营范围及主营业务

经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

主营业务为：国内商业、物资供销

（7）超淦贸易最近一年一期的主要财务数据如下：

项目	2012. 6. 30/2012 年 1—6 月	2011. 12. 31/2011 年
总资产（万元）	3,591.57	3,735.83
净资产（万元）	532.15	388.27
净利润（万元）	158.91	101.56

注：以上数据未经审计。

7、彭卫红

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：43250219741107****，住址：广东省深圳市南山区****。

8、邓峻

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：42010519680415****，住址：广东省深圳市宝安区宝安大道****。

9、余忠

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：51101119740513****，住址：广东省深圳市南山区南山大道****。

10、袁进

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：42062619650205****，住址：广东省深圳市南山区桃园路****。

11、彭建均

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：43300119720128****，住址：广东省深圳市宝安区沙井中心路****。

12、张庭主

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：41302819740925****，住址：

河南省罗山县彭新镇****。

13、严安辉

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：42242819740323****，住址：广东省深圳市南山区****。

14、杨林

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：37243219780401****，住址：广东省深圳市宝安区福永街道****。

15、白会斌

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：41130219780312****，住址：河南省尉氏县庄头乡****。

16、汪广明

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：34102219791014****，住址：安徽省休宁县海阳镇****。

17、刘保海

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：36232519780806****，住址：广东省深圳市南山区南山大道****。

18、王俊浩

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：41230119801204****，住址：河南省虞城县城关镇****。

19、尹建华

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：43242319770129****，住址：广东省深圳市宝安区前进二路****。

20、赵金秋

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：43250319720922****，住址：

广东省深圳市南山区南山大道****。

21、谢华

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：43020219750902****，住址：广东省深圳市宝安区****。

22、王剑峰

中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：42010719740705****，住址：湖北省武汉市青山区****。

（二）持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日，持有公司 5%以上股份的主要股东为姜雪飞、朱雪花。姜雪飞的持股比例为 69.0564%，朱雪花的持股比例为 7.6730%，二人合计持有本公司 76.7294%的股份。

本公司由姜雪飞和朱雪花夫妇共同控制。

姜雪飞和朱雪花的简历详见“第七章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。

（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况

截至本招股说明书签署日，姜雪飞、朱雪花未控制除发行人之外的其他企业。

（四）股份质押及其他争议情况

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人姜雪飞、朱雪花持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

八、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

本公司本次发行前的总股本为 11,250 万股，本次拟向社会公开发行 3,750 万股，发行后本公司总股本为 15,000 万股，本次发行的股份占发行后总股本的

比例为 25%。

类 型	股东名称	发行前		发行后	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
有 限 售 条 件 的 股 份	姜雪飞	77,688,300	69.0564	77,688,300	51.7922
	朱雪花	8,632,100	7.6730	8,632,100	5.7547
	汇投投资	5,356,000	4.7609	5,356,000	3.5707
	同威创业	5,356,000	4.7609	5,356,000	3.5707
	姜曙光	4,614,400	4.1017	4,614,400	3.0763
	超淦贸易	3,213,800	2.8567	3,213,800	2.1425
	彭卫红	2,050,700	1.8228	2,050,700	1.3671
	邓峻	1,538,000	1.3671	1,538,000	1.0253
	余忠	1,538,000	1.3671	1,538,000	1.0253
	袁进	512,700	0.4557	512,700	0.3418
	彭建均	512,700	0.4557	512,700	0.3418
	张庭主	153,900	0.1368	153,900	0.1026
	严安辉	153,900	0.1368	153,900	0.1026
	杨林	153,900	0.1368	153,900	0.1026
	白会斌	153,900	0.1368	153,900	0.1026
	汪广明	153,900	0.1368	153,900	0.1026
	刘保海	153,900	0.1368	153,900	0.1026
	王俊浩	153,900	0.1368	153,900	0.1026
	尹建华	102,500	0.0911	102,500	0.0683
	赵金秋	102,500	0.0911	102,500	0.0683
	谢华	102,500	0.0911	102,500	0.0683
	王剑峰	102,500	0.0911	102,500	0.0683
本次发行的股份		-	-	37,500,000	25.00
合 计		112,500,000	100.00	150,000,000	100.00

（二）前十名股东

本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	发行前比例（%）	发行后比例（%）
1	姜雪飞	77,688,300	69.0564	51.7922
2	朱雪花	8,632,100	7.6730	5.7547

3	汇投投资	5,356,000	4.7609	3.5707
4	同威创业	5,356,000	4.7609	3.5707
5	姜曙光	4,614,400	4.1017	3.0763
6	超淦贸易	3,213,800	2.8567	2.1425
7	彭卫红	2,050,700	1.8228	1.3671
8	邓峻	1,538,000	1.3671	1.0253
9	余忠	1,538,000	1.3671	1.0253
10	袁进	512,700	0.4557	0.3418
10	彭建均	512,700	0.4557	0.3418
合计		111,012,700	98.6780	74.0084

（三）前十名自然人股东及其在发行人处的任职情况

本次发行前，前十名自然人股东及其在发行人处担任职务的具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	在发行人任职情况
1	姜雪飞	77,688,300	69.0564	董事长、总经理
2	朱雪花	8,632,100	7.6730	董事
3	姜曙光	4,614,400	4.1017	副总经理，兼任大连崇达执行董事、总经理
4	彭卫红	2,050,700	1.8228	副总经理，兼任深圳崇达副总经理
5	邓峻	1,538,000	1.3671	副总经理，兼任江门崇达总经理
6	余忠	1,538,000	1.3671	董事、董事会秘书、财务总监
7	袁进	512,700	0.4557	深圳崇达设备部经理
8	彭建均	512,700	0.4557	监事、深圳崇达制造部高级经理
9	张庭主	153,900	0.1368	大连崇达工艺部经理
10	严安辉	153,900	0.1368	深圳崇达人力资源部副经理
10	杨林	153,900	0.1368	福永分公司工程部经理
10	白会斌	153,900	0.1368	福永分公司制造部经理
10	汪广明	153,900	0.1368	福永分公司设备部高级经理
10	刘保海	153,900	0.1368	崇达技术销售部经理
10	王俊浩	153,900	0.1368	大连崇达生产部经理

（四）股东中的战略投资者持股及其简况

本公司股东中无战略投资者。

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例

本次发行前，公司控股股东姜雪飞与第二大股东朱雪花为夫妻关系，姜雪飞与公司第五大股东姜曙光为兄弟关系。姜雪飞持有公司 69.0564%的股份，朱雪花持有公司 7.6730%的股份，姜曙光持有公司 4.1017%的股份。除此之外，本次发行前公司其他股东间不存在关联关系。

（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东和实际控制人姜雪飞、朱雪花承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东姜曙光、彭卫红、邓峻、余忠、袁进、彭建均、张庭主、严安辉、杨林、白会斌、汪广明、刘保海、王俊浩、尹建华、赵金秋、谢华、王剑峰承诺：自崇达技术股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东汇投投资、同威创业、超淦贸易承诺：自崇达技术股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事、监事、高级管理人员姜雪飞、朱雪花、余忠、彭建均、姜曙光、彭卫红、邓峻、汪姜维除分别遵守上述承诺外，还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过其所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占其所持有股份总数的比例不超过 50%。

九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况

本公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或委托持股的情况。

十、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工人数情况

报告期各期末，本公司员工人数及其构成情况如下：

2012 年 6 月 30 日	专业构成	人数	占比 (%)	学历构成	人数	占比 (%)	年龄构成	人数	占比 (%)
	管理人员	325	9.46	硕士及以上	23	0.67	50 岁以上	6	0.17
	技术人员	704	20.49	本科	361	10.51	41-50 岁	100	2.91
	财务人员	24	0.70	大专	855	24.89	31-40 岁	598	17.41
	生产人员	2,128	61.95	大专以下	2,196	63.93	30 岁以下	2,731	79.51
	销售人员	82	2.39	--	-	-	--	-	-
	后勤人员	172	5.01	--	-	-	--	-	-
	合计	3,435	100.00	合计	3,435	100.00	合计	3,435	100.00
2011 年 12 月 31 日	专业构成	人数	占比 (%)	学历构成	人数	占比 (%)	年龄构成	人数	占比 (%)
	管理人员	320	10.78	硕士及以上	28	0.94	50 岁以上	6	0.20
	技术人员	658	22.16	本科	319	10.74	41-50 岁	78	2.63
	财务人员	24	0.81	大专	673	22.67	31-40 岁	538	18.12
	生产人员	1,736	58.47	大专以下	1,949	65.64	30 岁以下	2,347	79.05
	销售人员	77	2.59	--	--	--	--	--	--
	后勤人员	154	5.19	--	--	--	--	--	--
	合计	2,969	100.00	合计	2,969	100.00	合计	2,969	100.00
2010 年 12 月 31 日	专业构成	人数	占比 (%)	学历构成	人数	占比 (%)	年龄构成	人数	占比 (%)
	管理人员	267	9.92	硕士及以上	7	0.26	50 岁以上	4	0.15
	技术人员	501	18.62	本科	257	9.55	41-50 岁	65	2.42
	财务人员	21	0.78	大专	536	19.92	31-40 岁	457	16.98
	生产人员	1,697	63.06	大专以下	1,891	70.27	30 岁以下	2,165	80.45
	销售人员	88	3.27	--	--	--	--	--	--

	后勤人员	117	4.35	--	--	--	--	--	--
	合计	2,691	100.00	合计	2,691	100.00	合计	2,691	100.00
2009 年 12 月 31 日	专业构成	人数	占比 (%)	学历构成	人数	占比 (%)	年龄构成	人数	占比 (%)
	管理人员	252	11.58	硕士及以上	9	0.41	50 岁以上	3	0.14
	技术人员	387	17.78	本科	149	6.84	41-50 岁	50	2.30
	财务人员	25	1.15	大专	518	23.79	31-40 岁	398	18.28
	生产人员	1,301	59.76	大专以下	1,501	68.95	30 岁以下	1,726	79.28
	销售人员	80	3.67	--	--	--	--	--	--
	后勤人员	132	6.06	--	--	--	--	--	--
	合计	2,177	100.00	合计	2,177	100.00	合计	2,177	100.00

本公司员工包括在册员工和劳务派遣员工，截至 2012 年 6 月 30 日，在册员工 3,435 人，其中劳务派遣员工 29 人。报告期内，大连崇达分别与大连锦绣职业中介有限公司和大连北江企业服务有限公司签署了《劳务派遣协议书》，聘请部分员工从事（临时性、辅助性、替代性）作业员工作。

（二）员工社会保障情况

本公司对在册员工实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。本公司及全资子公司深圳崇达、大连崇达为所有在册员工购买了养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、住房公积金等社会保险，具体缴费基数及缴费比例如下，江门崇达目前暂无员工在册。

1、本公司及深圳崇达的社会保险费缴纳基数及比例

	险种	缴费基数	公司缴费比例	员工缴费比例
深圳市 户口 的员工	养老保险	以员工月基本工资为缴费基数，且不高于深圳市上年度在岗职工月平均工资的 300%，且不低于深圳市上年度在岗职工平均工资的 60%。	11%	8%
	医疗保险		6.50%	2%
	生育保险		0.50%	--
非深圳 市户 口员 工	养老保险	以员工月基本工资为缴费基数，且不高于深圳市上年度在岗职工月平均工资的 300%，且不低于深圳市最低工资。	10%	8%
	医疗保险	固定金额	16.82 元/人	8.41 元/人
	生育保险	固定金额	8.41 元/人	-

所有员工	失业保险	深圳市上年度在岗职工月平均工资 $\times 1\% \times 40\%$	16.82 元/人	-
	工伤保险	以员工月基本工资为缴费基数，且不低于深圳市最低工资标准。	按实行浮动费率后的实际缴费费率缴交	-
	住房公积金	以上一年度的月平均工资作为缴费基数； 刚调入的员工或刚参加工作的员工以当月的工资作为缴费基数。	5%	5%

注：深圳 2010 年 11 月 30 日颁布《深圳市住房公积金管理暂行办法》，自 2010 年 12 月起，非深圳户籍员工须缴纳住房公积金。故本公司在 2010 年 12 月以前仅为深圳户籍员工缴纳了住房公积金，自 2010 年 12 月起为所有员工缴纳住房公积金。

2、大连崇达的社会保险费缴纳基数及比例

项目	险种	缴费基数	公司缴费比例	员工缴费比例
开发区户籍及开发区户籍以外非农业户口员工	养老保险	以员工月应发工资为缴费基数，且不高于大连市上年度在岗职工月平均工资的 300%，且不低于大连市上年度在岗职工月平均工资的 60%。	20.00%	8.00%
	失业保险		2.00%	1.00%（非大连城镇户籍不交）
	生育保险		0.80%	-
	工伤保险		1.30%	-
	医疗保险		8%	2%+2 元
非开发区户籍农民工	医疗保险	同开发区户籍员工	2.50%	2 元
	工伤保险	同开发区户籍员工	1.30%	-
所有员工	住房公积金	以员工月基本工资为缴费基数，低于 1100 元，按 1100 元为缴费基数，高于 16,115 元，按 16,115 元为缴费基数	18%	14%

注：2009 年 5 月—2010 年 12 月单位医疗保险比率为 1.5%，2008 年、2009 年工伤保险比率为 0.6%，2009 年 5 月-2010 年 12 月单位失业保险比率为 1.5%。

大连崇达依据大连开发区劳动人事与社会保障局于 2007 年 1 月 25 日发布的《关于规范企业职工社会保险缴费工作的通知》（大开劳人发【2007】8 号），对招用的大连市开发区户籍以外的农业户籍人员，办理招用农民工手续，参加医疗和工伤保险。

大连崇达的劳务派遣员工，由大连崇达通过劳务派遣公司为劳务派遣员工缴纳社会保险费。

根据深圳市社会保障基金管理局及大连经济技术开发区社会保险管理中心出具的证明，本公司、深圳崇达、大连崇达能够按时缴纳社会保险费，没有因违反社保相关法律法规而被处罚的情况。

根据深圳市住房公积金管理中心出具的证明，未发现本公司、深圳崇达存在违反深圳市住房公积金政策法规的行为。根据大连市住房公积金管理中心出具的证明，大连崇达能认真遵守国家、地方有关住房公积金管理方面的法律、法规和规章，并依据有关规定为员工按时、足额缴纳住房公积金，且未受到相关处罚。

本公司控股股东和实际控制人姜雪飞、实际控制人朱雪花已出具承诺函：若本公司及本公司全资子公司深圳崇达、大连崇达、江门崇达因社保费用问题，受到员工个人追偿或当地主管部门的处罚，姜雪飞、朱雪花同意以自身资产无条件连带承担，并承担公司及公司全资子公司因此产生的相关费用及损失。如本公司及子公司因住房公积金问题而遭受任何处罚、损失，或应有权部门要求需公司及子公司为员工补缴住房公积金，姜雪飞、朱雪花愿承担该等处罚、损失及相应责任。

十一、主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺

除前述有关股份流通限制和自愿锁定的承诺之外，本公司主要股东及关联方的重要承诺如下：

2011年2月12日，本公司的控股股东和实际控制人姜雪飞、实际控制人朱雪花分别以书面形式向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2011年2月12日，本公司的控股股东和实际控制人姜雪飞、实际控制人朱雪花，全体董事、监事和高级管理人员分别以书面形式向本公司出具了《关于规范和减少与深圳市崇达电路技术股份有限公司关联交易的承诺函》。

2011年2月12日，本公司的控股股东和实际控制人姜雪飞、实际控制人朱雪花分别以书面形式向公司出具了《关于不占用深圳市崇达电路技术股份有限公司资金的承诺函》。

2011年2月12日，本公司的控股股东和实际控制人姜雪飞、实际控制人朱雪花向公司出具了关于公司及其全资子公司在上市前享受的税收优惠被国家有权部门予以追缴，将承担因此给公司及其全资子公司造成的负担及损失的《承诺函》。

2011年2月12日，本公司的控股股东和实际控制人姜雪飞、实际控制人朱雪花向公司出具了关于公司及其全资子公司因社保和住房公积金问题受到员工个人追偿或有关主管部门的处罚，姜雪飞、朱雪花同意以自身资产无条件连带承担，并将承担公司及全资子公司因此产生的相关费用及损失的《承诺函》。

2011年2月12日，本公司的控股股东和实际控制人姜雪飞、实际控制人朱雪花向公司出具了关于租赁房产在租赁有效期内被强制拆迁或其他原因无法继续租用，将全额承担由此给发行人造成的损失《补偿承诺函》。

第五章 业务和技术

一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况

（一）主营业务

本公司的主营业务为小批量印制电路板的生产和销售。

本公司自设立以来，一直专注于小批量印制电路板的生产和销售，主营业务没有发生变化。

（二）主要产品

本公司主要产品为小批量印制电路板，产品类型覆盖HDI板、背板、厚铜板、软硬结合板、埋容板、高多层板、立体板、铝基板、高频板等，可一站式满足客户对小批量印制电路板的需求。

公司产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、航空航天等高科技领域，产品70%以上外销到欧洲、美洲、亚洲（除中国）等地区。

二、发行人所处行业的基本情况简介

根据国家统计局 2011 年颁布的《国民经济行业分类》，本公司所从事的行业归属于电子元件制造业（C397）下的印制电路板制造（C3972）。

（一）印制电路板简介

印制电路板（Printed Circuit Board，简称 PCB）是指在绝缘基材上，按预定设计形成点到点间连接导线及印制元件的印制板。

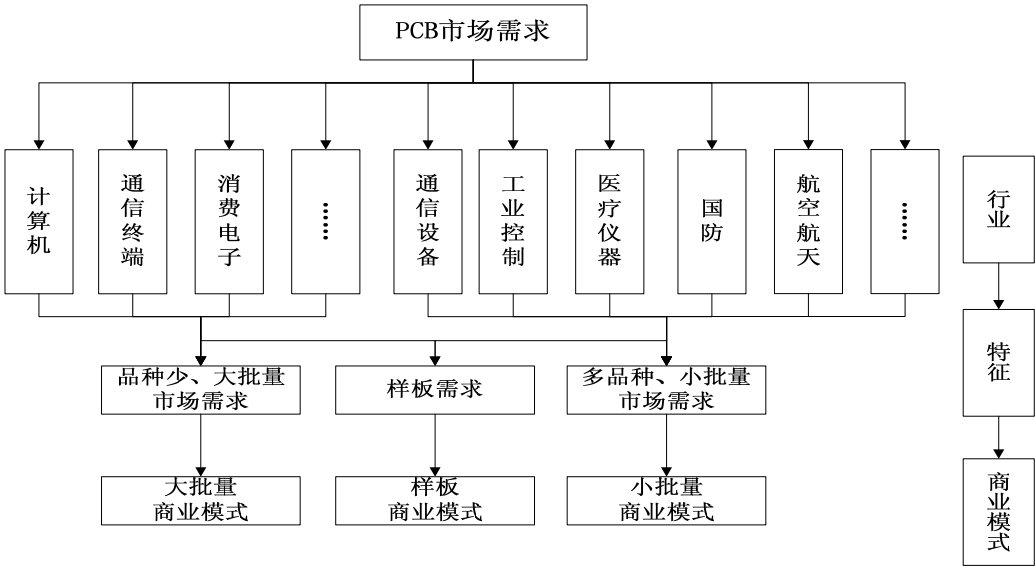
PCB的构成主要是绝缘基材和导体两类材料，在电子设备中起到支撑、互连部分电路元件的作用。集成电路与电阻、电容等电子元件作为单个个体是无法发挥作用的，只有在PCB上有了立足之地并有导线将其连通，才能在整体中发挥其功能。PCB是支撑元器件的骨架，连通电信号的管道，有“电子产品之母”之称。

凡是电子设备，无论是大型计算机或个人电脑，通信基站或手机，航天飞船或汽车，家用电器或电子玩具，均需要用到PCB。在信息化、数字化的发展趋势驱动下，PCB产业将有着广阔的市场空间和良好的发展前景。

（二）PCB 产业的市场细分与行业细分

PCB市场根据客户消费需求的差异性划分为样板市场、小批量市场和大批量市场，以该三类市场客户的不同需求倾向性为基础，PCB产业衍生出样板行业、小批量行业和大批量行业三个细分行业。

按照下游市场的需求和订单情况，样板、小批量PCB和大批量PCB的应用领域细分情况如下：



根据Prismark的估计，大批量PCB产值规模约占PCB整体市场规模的80%-85%，而小批量PCB产值规模约占PCB整体市场规模的10%-15%左右，PCB样板产值规模约占PCB整体市场规模的5%。

1、PCB 样板行业

随着电子技术和信息化、数字化技术的飞速发展，电子设备的更新换代极快，其制造商即PCB产业的下游客户在推出新产品前，必然要经过研究开发和试生产的阶段，获得成功之后方可量产推广。在其研究开发和试生产的过程中形成的对PCB小规模需求催生了PCB样板市场的产生与发展，由此出现了专注于生产PCB

样板的企业（代表企业如中国大陆的兴森科技，股票代码002436），并在整个PCB行业中逐渐形成一定的产业规模，约占整个PCB产业规模的5%左右。国际上将其称为Quick turn/proto-type，中国一般将其通称为样板行业。

PCB样板行业主要服务于下游客户产品定型前的研究、实验、开发与中试阶段（俗称“打样阶段”）。由于客户每次订购PCB的数量仅需满足研发、中试需求即可，单个订单的面积一般低于5平方米。PCB样板对制造商的快速交货能力和多品种生产能力要求较高。但是，由于国内目前PCB的专业化生产分工尚不显著，部分量产厂商也承接小部分样板订单。

2、PCB 批量板行业的发展与分化

PCB下游客户在产品研发试产成功后就会进入产品的规模化生产阶段，由此产生对PCB的批量需求。然而由于PCB下游行业领域的广泛性，不同行业之间最终产品的市场需求量和产量相差悬殊，因此其对PCB的需求量也有很大差别。

根据Prismark的市场报告，PCB下游行业一般可分为计算机、通信终端、消费电子、通信设备、工业控制、医疗仪器、国防、航天航空、安防电子等领域。

其中计算机、通信终端、消费电子等行业面向的主要是以个人消费者为主的终端客户（Business To Customer），其产品单价相对较低，市场需求量极大，年产量数以亿计。如根据国家统计局的数据显示，2009年我国共生产微型电子计算机1.8亿台，生产笔记本电脑1.5亿台。因此此类行业中的生产企业作为PCB的下游客户，对PCB的需求量是极大的，其向PCB生产企业下达的单笔采购订单一般在50平方米以上甚至几百或上千平方米，一般称之为大批量订单。

而通信设备、工业控制、医疗仪器、国防、航天航空、安防电子等行业面向的主要是企事业单位为主的终端客户（Business To Business），此类行业中的单个生产企业对PCB的需求种类繁多，每种类型PCB的需求量相对较低，其向PCB生产企业下达的单笔采购订单大多在50平方米以下，一般称之为小批量订单。

虽然不同的下游行业对PCB需求量和需求种类存在差异性，但在PCB行业发展初期，需求的差异性并未立即导致市场分化和细分行业的出现，绝大多数PCB企业既承接大批量订单也承接小批量订单。尽管大批量PCB和小批量PCB在生产

工序上基本相同，但是由于大批量PCB单笔订单面积较大，品种少，对制造商的研发能力和生产组织能力要求相对较低，而且，大批量PCB主要应用于通信终端、消费类电子、计算机等终端消费领域，单价和毛利空间相对较低，因此主要依靠量产赚取收入和利润。而以通信设备、工业控制、医疗仪器、国防、航天航空、安防电子等为主要应用领域的PCB，由于下游行业单笔订单需求量少、产品种类繁多、附加值高，要求制造商具有更高的研发能力和组织生产能力，单位售价和毛利也相对较高。

根据下游行业需求特性的不同，PCB批量厂商逐渐分化。部分PCB生产厂商（代表企业如中国大陆的超声电子、依顿电子，台湾的瀚宇博德股份有限公司）主要定位于终端消费领域电子产品PCB的生产，单个订单面积较大；而部分PCB生产企业则看准了在通信设备、工业控制、医疗仪器、国防、航天航空等小批量PCB应用领域蕴藏的商机，通过提升内部管理能力和研发技术水平，合理规划产能，构建柔性化的生产线，专注于满足上述领域客户的多品种、小批量PCB需求。目前，美国的DDi、德国的KSG、台湾的庆生电子、本公司等都是专注于小批量PCB市场的企业。

3、小批量和大批量 PCB 市场细分

国际上一般将从事大批量PCB生产的企业或整个批量行业定义为“High Volume”，而将从事小批量PCB生产的企业或小批量行业定义为“High Mix、Low Volume、Quick Turn”（中文译为“多品种、小批量、短交期”）。“多品种”的提法是相对于大批量企业而言的，因为小批量企业的客户数量和产品种类数都大大超过大批量企业，但相对于样板企业来说，小批量企业品种数一般少于样板企业。从面积上讲，一般单个订单面积在50平方米以上的PCB订单为大批量订单，单个订单面积在50平方米以下（含50平方米）的PCB订单为小批量订单，主要从事大批量订单生产的企业为大批量PCB企业，主要从事小批量订单生产的企业为小批量PCB企业。从应用领域来看，消费电子、通信终端和计算机等领域对PCB的需求以大批量订单为主，但是消费类电子领域也存在部分的小批量订单需求，如航空模型。通信设备、工业控制、医疗仪器等领域对PCB的需求以小批量为主，但是由于通信设备制造商集中度较高，以及工业控制、医疗仪器等行业

某些产品存在量产需求等因素，上述行业也会产生部分大批量需求。所以对于PCB的生产厂商而言，一般专业的大批量厂商收入结构中会包含少部分小批量PCB订单收入，而专业的小批量厂商收入结构中也会包含少部分大批量PCB订单收入。

4、小批量 PCB、样板 PCB、大批量 PCB 生产在技术工艺、原材料、设备等方面的差异

小批量PCB、样板PCB、大批量PCB生产在技术工艺、原材料、设备等方面基本相同，但在市场定位、管理及资源配置等方面存在较大差异，具体分析如下：

（1）市场定位差异

样板PCB定位于PCB的研发、测试阶段，要求交期快速，主要以国内市场为主。小批量PCB定位于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、航天航空等非消费类电子行业，这些行业属于高端制造业，品种多、订单面积小、技术难度大，产业保留在欧美日等发达国家，以出口为主，且国外小批量PCB客户在进行供应商认证时，非常强调“小批量”生产特征。大批量PCB更多是定位于消费电子市场，通过规模化生产实现盈利。

（2）管理差异

样板和小批量PCB的平均订单面积小，订单品种多，生产高度柔性化，在线各种工艺技术的产品众多，这就要求制造商要具有强有力的生产计划、组织与协调能力；大批量PCB单笔订单面积较大，品种少，对制造商的生产组织能力要求相对较低。

（3）技术、品质差异

小批量PCB品种多、订单小，产品的个性化程度高、工艺复杂、技术难度大，产品质量保证要求高，特别是一些高端领域如航天航空、精密医疗仪器等行业，要求PCB制造商具备较强的研发能力和品质保证能力；大批量PCB应用领域以个人消费为主，该类客户产品单一，同种类型产品需求非常大，技术难度相对较低，更新换代快，对PCB制造商的研发能力和品质保证能力的要求也相对较低。

（4）资源配置差异

相对于大批量PCB制造商，样板和小批量PCB制造商需配备数倍的工程制作、品质保证人员，以应对数量庞大、个性化强、工艺技术要求高的订单。在原材料供应选择方面，要求供应商必须提供多品种、小批量、短交期以及一些特种材料供应服务。在设备配置方面也存在一些差异，如样板和小批量PCB制造商多采用2轴或4轴钻孔机，以应对小批量订单的特点；而大批量PCB制造商主要配置6轴钻孔机，以实现规模化生产。

5、公司若向其他类型 PCB 生产转型不存在重大障碍

（1）技术方面

公司主要产品为小批量PCB，产品类型覆盖HDI板、背板、厚铜板、软硬结合板、埋容板、高多层板、立体板、铝基板、高频板等。公司目前具备和掌握的生产技术可以覆盖各种类型的PCB生产，向其他类型PCB生产转型不存在技术方面的重大障碍。

（2）设备方面

小批量PCB生产线在配置设备时，虽然个别工序的设备有一些差异化特征，但总体来说，各种类型的PCB生产工艺和主体设备配置基本类似，公司向其他类型PCB生产转型不存在设备方面的重大障碍。

（3）客户方面

小批量PCB产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、航天航空等高科技领域，这部分客户的市场需求特征就是以多品种、小批量为主。公司若向其它类型PCB生产转型，则面临较大的差异化市场客户，存在一定的障碍。

6、公司未来没有向其他类型 PCB 生产拓展的计划

（1）小批量PCB行业市场空间较大，公司未来发展空间广阔

根据Prismark的估计，小批量PCB产值规模约占PCB整体市场规模的10%-15%左右。2011年，中国PCB产值为219.38亿美元、全球PCB产值为554.09

亿美元，按照小批量PCB10%-15%的市场容量计算，国内小批量PCB市场规模为21.94亿美元32.91亿美元、全球小批量PCB的市场规模为55.41亿美元83.11亿美元。2011年度，公司产品在全球小批量PCB市场的占有率不足2%。随着小批量PCB下游领域的快速发展，小批量PCB的市场空间有望进一步增长，公司未来的市场空间较为广阔，无须向其他类型的PCB领域拓展。

（2）小批量PCB行业毛利相对较高，公司在该领域能够保持较高的利润率

由于小批量PCB的生产模式一般为“以销定产”，需要根据下游不同领域客户的需求快速作出反应，而且公司的产品多为定制产品，产品报价相对较高，且对客户具备一定的议价能力，因此毛利率一般高于大批量PCB生产企业，低于样板生产企业。

从国内同行业上市公司的比较来看，公司的毛利率高于除样板生产企业兴森科技之外的其他上市公司。由于小批量PCB行业利润率相对较高，公司在该领域可以保持较高的利润率，所以，公司没有向大批量PCB扩展的计划。

年度	兴森科技	天津普林	沪电股份	超声电子	超华科技	中京电子	崇达技术
2011 年	38.10%	8.67%	23.97%	18.80%	20.88%	16.89%	32.42%
2010 年	39.11%	6.68%	23.92%	17.47%	20.47%	23.34%	35.70%
2009 年	37.83%	9.71%	25.13%	18.81%	26.61%	23.22%	33.44%

数据来源：上市公司年报、招股说明书。超声电子和超华科技毛利率仅指印制电路板业务。

（3）公司在小批量PCB领域具有一定的竞争优势和知名度

经过多年的发展，公司在小批量PCB领域已经具备了较强的竞争优势，包括专注于小批量市场地位、高度柔性化的管理优势、生产技术和研发优势等。公司在境内外客户中的知名度不断提高，客户数量和销售收入不断增加。较多客户在采购方面比较注重公司专业的市场定位，如果公司向其他领域拓展，虽然可能开拓部分其他客户，但也将流失部分专业化程度要求较高的境外客户。

本公司一直将专业化市场定位作为公司的特色和竞争优势，未来几年内，公司仍将专注于小批量PCB的研发、生产与销售，继续在该领域内做精做强，没有向其他类型PCB生产拓展的计划。

（三）小批量 PCB 行业

1、小批量 PCB 行业介绍

本公司是专业的小批量PCB制造商，所属行业为PCB业的细分行业——小批量PCB行业。

小批量PCB行业的特点包括：

（1）应用领域：以通信设备、工业控制、医疗仪器、国防、航天航空、安防电子等行业为主要应用领域，也涉及消费类电子中的高端领域。下游行业主要面向企事业单位客户，该类客户产品类型多，同种类型产品的规模相对较小，产品的个性化程度较高。

（2）订单特征：订单数量多，品种多，单个订单面积小。小批量PCB的平均订单面积为10平方米左右，均单面积较小（如本公司报告期内均单面积分别为7.79平方米、8.33平方米、8.29平方米、7.28平方米），订单品种和数量较多。规模较大的制造商每天需要处理不同客户的数百个订单，并涉及不同的产品品种（如欧洲知名的PCB生产厂商WURTH，日均处理订单350个左右），要求制造商通过合理、有效的管理和组织调度，生产出各类批量小而品种繁杂的产品，以满足客户快速交货的需求。小批量PCB生产厂商一般都是根据订单组织生产，以销定产，存货周转效率较大批量PCB企业更高。

（3）交货期限：短交期，一般交货期限在10-20天。交货期限是小批量PCB制造企业竞争力的重要体现，客户下达订单后，要求制造商能够快速反应，组织生产。2009年，全球知名的小批量PCB生产商DDi交货时间在10天以内的订单比例约为45%。

（4）客户数量多，议价能力强。小批量PCB厂商客户数量较多，客户比较分散，不存在对单一客户的重大依赖（如DDi，2011年的客户数量超过1,000个）。同时由于小批量PCB生产厂商提供的产品个性化程度更高，因此对下游客户的议价能力更强。

（5）产品技术难度大。对于一些高端领域如航天航空，精密医疗仪器等行

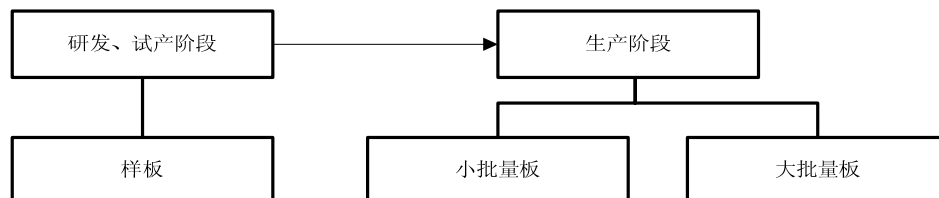
业，产品科技含量高，相应地对PCB的技术要求更高，技术难度更大，要求PCB制造商具备较强的研发能力和生产能力。

2、小批量 PCB 行业与样板行业的主要区别

样板与小批量板兼有平均订单面积小、订单品种多、生产高度柔性化等相似点，但二者也有区别，主要体现在产品使用阶段、订单持续性和市场规模等方面。

（1）产品阶段

两者的订单来源不同，样板订单主要来源于 PCB 下游行业的研发和试产阶段，小批量板订单主要来源于生产阶段。



（2）订单面积

由于在研发和试产阶段，PCB 的需求量不大，样板的单个订单面积一般不超过 5 平方米，平均在 1 平方米左右，如兴森科技 2009 年平均订单面积为 1.24 平方米。小批量板的订单面积一般在 50 平方米以下，平均订单面积在 10 平方米左右，如本公司 2011 年平均订单面积为 8.29 平方米。

（3）订单持续性

样板和小批量板在客户应用阶段的不同导致了二者在订单持续性上的差异。一种产品在完成研发试产进入生产阶段后，除非升级换代，否则将不再需要样板；而该产品无论升级换代与否对小批量板的需求仍将长期、持续存在。因此对小批量企业来说，其订单的持续性优于样板企业。

（4）市场规模

样板和小批量板在订单持续性上的差异也决定了二者在市场规模上的差异。由于样板需求是一次性或短暂性需求，而小批量板是长期性需求，因此小批量板的市场规模大于样板的市场规模。根据Prismark的估计，小批量板的市场规模约

占整个PCB行业市场规模的10-15%左右，而样板的市场规模约占整个PCB行业市场规模的5%左右。

3、小批量 PCB 行业与大批量 PCB 行业的主要区别

小批量 PCB 行业与大批量 PCB 行业有着明显的区别。小批量 PCB 行业下游应用领域以企事业单位消费为主；大批量 PCB 应用领域以个人消费为主。以企事业单位为主的产品年产量相对较低，但是单位价格相对较高，而以个人消费为主的产品年产量较高，一般数以亿计，但是单位价格较低。下游产品产量的差异，是小批量 PCB 行业 and 大批量 PCB 行业分化开来的基本原因。因下游产品产量少，小批量 PCB 的平均订单面积相对比较小，在实现同等销售额下，小批量 PCB 企业需要承接的订单数量和品种必然比大批量 PCB 多，生产管理复杂性和难度也相对较高，一般而言，小批量 PCB 的成本和单价均高于大批量 PCB，毛利率也高于大批量 PCB。

小批量PCB和大批量PCB的主要区别

项目	小批量 PCB	大批量 PCB
下游行业	通信设备、工业控制、医疗仪器、国防及航天航空、安防电子等	计算机、通信终端、消费电子等
平均订单面积	平均订单面积约在 10 平方左右	一般在 50 平方米以上
订单量	订单数量多、品种多	订单数量少、品种少
生产管理	管理要求高，生产柔性化要求高	大批量生产，柔性化要求低于小批量行业
交货周期	一般 10-20 天	一般 20 天以上
物流配送	快递或空运	一般物流方式
毛利率	较高	一般低于小批量 PCB

（四）PCB 的分类

PCB的分类方式有多种，一般可以按下游需求特征、技术发展方向、层数、柔软度等不同的角度进行区分。

1、按下游需求特征划分

按PCB下游需求特征，PCB可分为样板、小批量板和大批量板。

2、按技术方向划分

按技术发展方向，印制电路板可分为多层硬板、挠性板、高密度互连板和IC载板等。

多层硬板：硬板也称刚性板，是由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板。随着电子产品向功能更多、体积更小的方向发展，PCB 的需求也向高层化发展，目前多层板最高层数已经可以达到 80 层。

挠性板，也称柔性板，是一种利用挠性基材制成的具有图形的印刷电路板，由绝缘基材和导电层构成，绝缘基材和导电层之间可以有粘结剂。由于其具有重量轻、体积小、可挠性及可弹性改变形状等特性，被广泛应用于消费类电子如数码相机、笔记本电脑等领域。

高密度互连板（High Density Interconnection，简称 HDI）是从 PCB 线路互连密度高而言，通常指：线宽/线距 0.1mm 以下，小导通孔孔径 0.15mm 以下，含有盲孔和埋孔的多层板。也被称为层积（Build-Up）技术。采用 HDI 技术的产品孔径、盘径和线路都大大缩小，还具有更好的散热性能，实现和顺应了电子产品更多功能、更小体积的需求。按照 HDI 的工艺阶数，即埋盲孔的分布情况，可分为一阶 HDI 板、二阶 HDI 板、二阶以上 HDI 板。

IC 载板是用于装载集成电路芯片的印制电路板。这类载板按所载芯片集成度不同，有双面板、多层板、积层多层板和挠性板等。按照一块基板上装载芯片数的不同又有单芯片封装载板和多芯片封装载板。

3、按层数划分

按层数划分，印制电路板可分为单面印制电路板、双面印制电路板和多层印制电路板。

单面印制电路板是指只在绝缘基板的一面有导电图形的印制电路板。通常单面印制电路板是指刚性的基板。

双面印制电路板是指在绝缘基板的两面均有导电图形的印制电路板，可以有或无镀通孔。

多层印制电路板是指具有 4 层或更多层导电图形的印制电路板，层间有绝缘介质粘合，并有导通孔互连。多层印制电路板的层数通常为偶数。

4、按柔软度划分

按柔软度划分，印制电路板可分为刚性板、挠性板和刚挠结合板。

刚性板是指以刚性基材制成的印制电路板。

挠性板定义如前所述。

刚挠结合板是软板和硬板的结合，是指一块印制板上包含一个或多个刚性区和一个或多个挠性区，由刚性板和挠性板有序地层压在一起组成，并以金属化孔形成电气连接。刚挠印制板既有可以提供刚性印制板应有的支撑作用，又有挠性板的弯曲性，能够满足三维组装的要求。刚挠结合板广泛应用于军工、通信设备、计算机、医疗仪器、工业控制、消费电子等领域。

（五）行业主管部门、管理体制与行业政策

1、行业主管部门

PCB 行业的主管部门是工信部，其负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。负责制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

2、行业自律组织

中国印制电路行业协会（CPCA）是行业的自律组织，隶属工信部，是经中华人民共和国民政部批准成立的具有独立法人资格的国家一级行业协会，世界电子电路理事会（WECC）的成员之一，现有会员单位近 800 家。本公司是 CPCA 副理事长单位。

CPCA 发动广大企业参与制订 CPCA 标准和 WECC 标准，并与 IPC 和 JPCA

（日本印制电路行业协会）制订联合标准；参与海关用语和单耗的制订；编辑出版印制电路信息报刊和专业书籍；主办每年 3 月份 CPCA 展览会；每年春季、秋季国际 PCB 信息/技术论坛；开展职工技能培训和各类讲座；进行行业调查等。

3、产业政策

PCB 是现代电子设备中必不可少的基础元件，我国政府和行业主管部门推出了一系列产业政策对其进行扶持和鼓励：

时间	部门	政策名称	有关内容
2005 年 5 月	广东省人民政府	《广东省电子信息工业 2005-2010 年发展规划》	高密度、挠性 PCB、高性能、高品质基板，环保型绿色 PCB 等材料被列入电子元器件制造领域重点发展的产品和技术之一。
2006 年 9 月	信息产业部	《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》	发展印制电路板等新型元器件技术，并把多层、柔性、柔刚结合和绿色环保印制线路板技术列为重点技术之一。
2007 年 1 月	国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》	在高技术产业化重点领域第 17 项新型元器件中，明确提出要发展“高密度印制电路板和柔性电路板”。
2008 年 4 月	科技部、财政部、国家税务总局	《国家重点支持的高新技术领域》	刚挠结合板和 HDI 高密度积层板为国家重点支持的高新技术领域产品。
2009 年 4 月	国务院	《电子信息产业调整和振兴规划》	提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件、半导体照明、混合集成电路、新型锂离子电池、薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。
2011 年 4 月	国家发展改革委、财政部、商务部	《鼓励进口技术和产品目录（2011 年版）》	确定新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印制电路板和柔性电路板等）制造为鼓励进口的技术和产品。

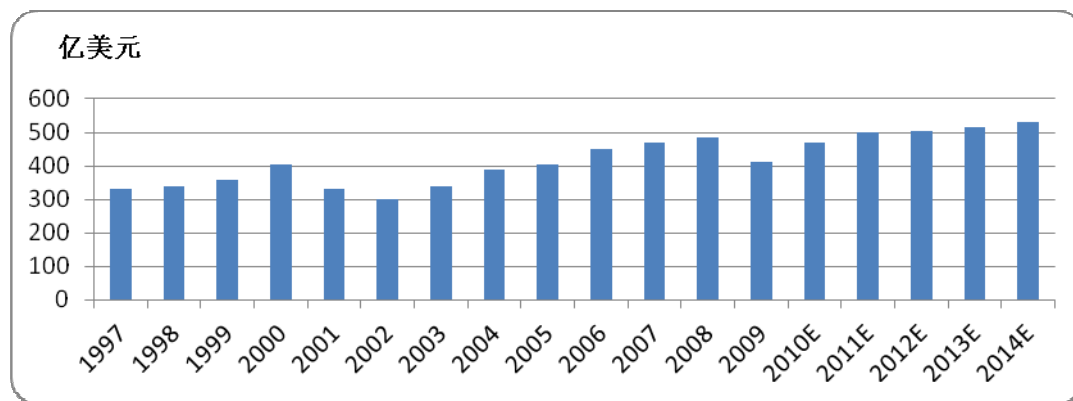
三、行业发展状况

（一）全球 PCB 行业发展状况

1、全球 PCB 行业总体上呈波浪式渐进向上发展的趋势

根据 PCB 行业著名市场调研公司 Prismark 的统计，近二十年来全球 PCB 市场规模及预计发展趋势如下图所示：

全球PCB市场规模



数据来源: Prismark

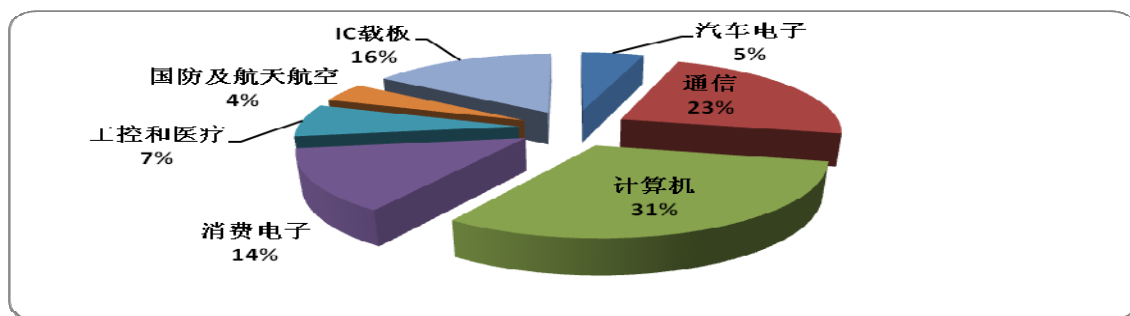
PCB 行业经过几十年的发展,已成为全球性大行业,总体上讲 PCB 行业周期性不明显,主要与宏观经济环境息息相关。从上图可以看出,在近二十年全球 PCB 行业的发展过程中出现了两个比较大的波谷,第一个波谷出现在 IT 泡沫破灭的 2002 年,PCB 全球产值从 2000 年的 405 亿美元锐减到 2002 年的 300 亿美元;第二个波谷的出现是由于 2008 年下半年,美国爆发次贷危机,并迅速席卷全球引发全球性的经济危机,PCB 行业再次出现了严重下滑,产值从 2008 年的 482 亿美元下降为 2009 年的 412 亿美元。但在每个波谷出现之后,随着整体经济形势的回暖,PCB 行业均能迅速得到复苏、并加速发展超越前一个峰值。在 2002 年出现第一个波谷后,2003 年随着全球经济的复苏以及新兴电子产品的出现和广泛应用,PCB 的市场需求再度出现快速增长,到 2007 年增长速度才开始放缓。2009 年经济危机爆发后,各国纷纷出台了稳定金融市场、刺激经济发展的政策和措施,到 2010 年,电子产品和 PCB 市场出现了较大规模的复苏和反弹,2010 年度,全球 PCB 的增长率为 23.6%。

据 Prismark 预测,随着整体大环境的逐渐转好,PCB 行业景气度将稳步向上回升,从 2010 年到 2015 年这 5 年间,全球 PCB 行业将保持 5.40% 的年均复合增长率,中国大陆的年复合增长率将保持在 8.10% 左右。

2、下游覆盖领域广泛

PCB 作为“电子产品之母”,其下游产业涵盖范围相当广泛,包括计算机、通信、消费电子、工业控制、医疗仪器、国防、航天航空等领域。由于 PCB 行业应用领域的广泛性起到了分散风险、降低周期性波动的作用。随着未来信息化、数字化、智能化的发展趋势,PCB 的应用领域还将不断得到深化和扩展。

全球 PCB 下游行业分布



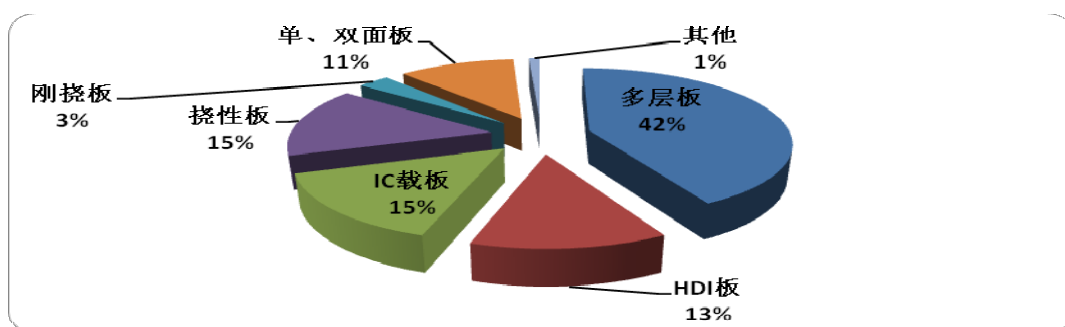
数据来源：Prismark 2011Q4 报告

根据 Prismark 统计的 2011 年全球 PCB 应用市场格局，在 PCB 下游行业中计算机占的产值比例最高，为 31%；其次是通信（包括通信设备和通信终端），占 23%；第三为 IC 载板，占 16%；第四为消费电子，占 14%；工业及医疗、国防及航天航空、汽车电子各占 7%、4%、5%。

3、PCB 技术发展迅速，高技术含量的 PCB 产品逐渐成为市场主流

2003 年以来世界电子电路行业技术迅速发展，元器件的片式化和集成化日益流行。下一代电子产品对 PCB 的要求，突出表现在更加高密度化。随着电子整机产品的多功能化、小型化、轻量化的发展，高端多层板、HDI、IC 载板、挠性板、刚挠结合板等高端 PCB 产品开始占据整个 PCB 市场的主导地位。

全球 PCB 产品构成



数据来源：2009 全球 PCB 市场总结以及未来发展预测（张家亮）

4、全球 PCB 生产基地逐渐完成从欧美向中国和亚洲其他地区的转移

在 2000 年以前，欧洲、美洲（主要是北美）、日本是全球主要的 PCB 生产基地，这三个地区 PCB 的产值占到全球产值的 70% 以上。但进入 21 世纪以来，欧美制造业的生产成本尤其是劳动力成本不断升高，电子产品进入微利时代，而亚洲尤其是中国大陆以其在劳动力、资源、政策等方面体现出的优越性，吸引了

全球制造业的转移，并在电子产品等相关产业链形成了巨大的配套市场和需求空间，欧美 PCB 制造企业也通过开设工厂、转移订单等形式将产值向中国和亚洲其他地区转移。

到经济危机爆发的 2008 年，美洲的 PCB 产值从 2000 年的 108.52 亿美元减少到 44.84 亿美元，欧洲的 PCB 产值从 2000 年的 67.02 亿美元减少到 32.08 亿美元，而中国大陆的 PCB 产值则由 2000 年的 33.68 亿美元猛增到 150.37 亿美元。中国大陆和亚洲其他地区（主要是韩国、中国台湾和东南亚）已取代欧美，和日本一起构成了全球 PCB 的主要生产基地。

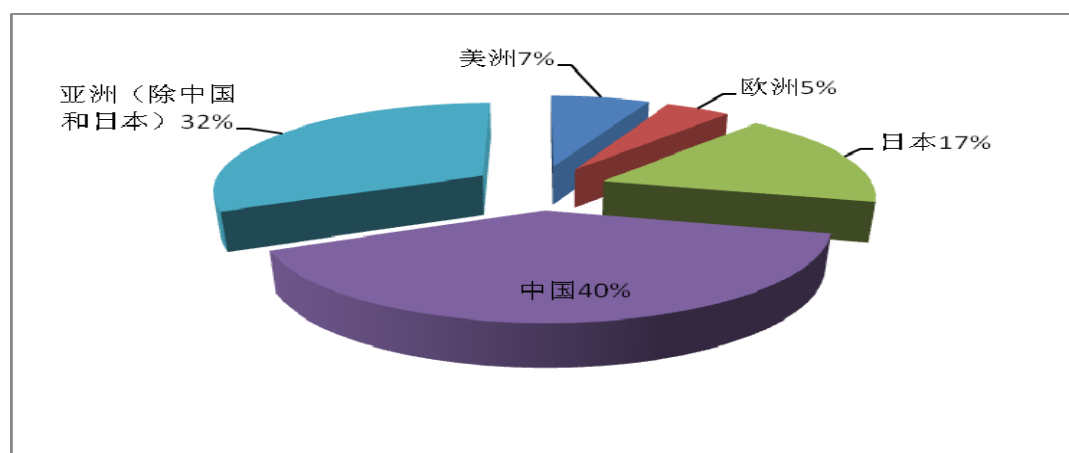
全球PCB市场产值分布及变化

单位：百万美元

地区/国家	2010 年	2011 年		2012 年 E		2010 年-2015 年复合增长率
	产值	增长率	产值	增长率	产值	
美洲	3,923	-2.50%	3,825	0.90%	3,859	-0.40%
欧洲	2,464	3.50%	2,550	0.70%	2,568	-2.00%
日本	10,235	-6.10%	9,611	2.50%	9,851	-2.80%
中国	19,971	9.80%	21,938	8.40%	23,778	8.10%
亚洲（除日本和中国）	15,875	10.10%	17,486	8.30%	18,940	7.60%
总计	52,468	5.60%	55,409	6.50%	58,996	5.40%

数据来源: Prismark 2011Q4 报告

根据 Prismark 的统计和预测，2011 年，全球 PCB 产值的区域分布情况如下图所示，并预测至 2015 年，中国的 PCB 产值占世界 PCB 总产值的比重将升至 44%。



数据来源: Prismark 2011Q4 报告

（二）中国 PCB 行业发展状况

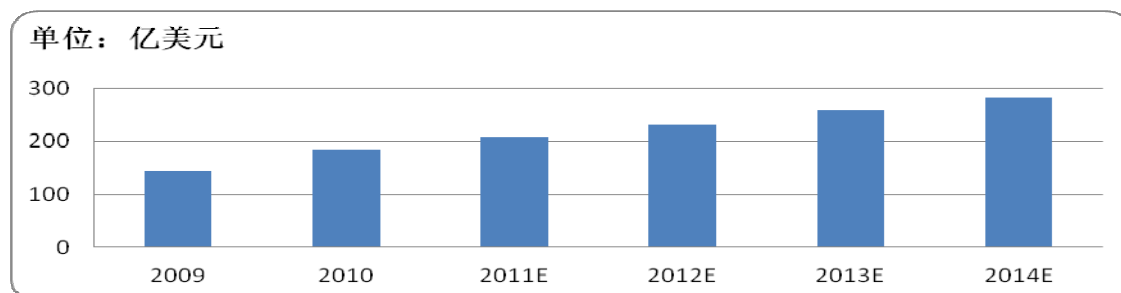
1、中国 PCB 行业整体发展迅猛，已成为全球 PCB 最大生产国

改革开放以来，中国由于在劳动力资源、市场、投资等方面的优惠政策，吸引了欧美制造业的大规模转移，大量的电子产品及制造商将工厂设立在中国，并由此带动了包括 PCB 在内的相关产业的发展。

据中国 CPCA 统计，2006 年我国 PCB 实际产量达到 1.30 亿平方米，产值达到 121 亿美元，占全球 PCB 总产值的 24.90%，超过日本成为世界第一。2000 年至 2006 年中国 PCB 市场年均增长率达 20%，远超过全球平均水平。

2008 年全球金融危机给 PCB 产业造成了巨大冲击，但没有给中国 PCB 产业造成灾难性打击，在国家经济政策刺激下 2010 年中国的 PCB 产业出现了全面复苏，2010 年中国 PCB 产值高达 199.71 亿美元。Prismark 预测 2010-2015 年间中国将保持 8.10% 的复合年均增长率，高于全球 5.40% 的平均增长率。

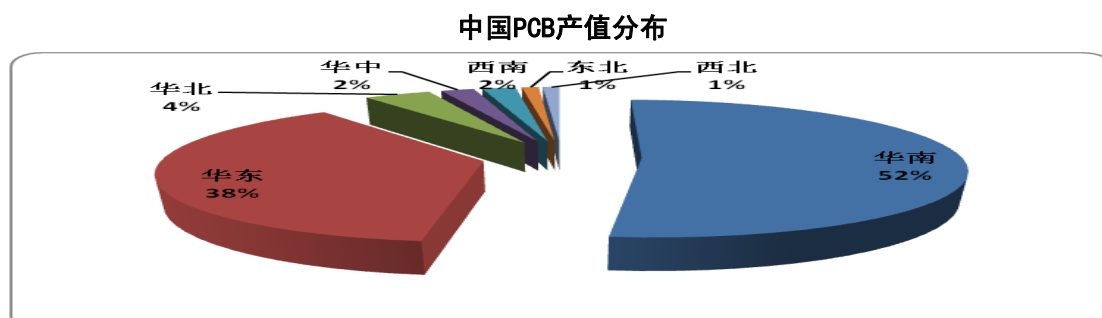
中国 PCB 市场规模



数据来源：Prismark 2011 Q4 报告

2、产业区域分布不均衡

根据中国印制电路行业协会发布的报告《2009 中国电子电路产业现状》，截至 2008 年底，我国的 PCB 产值区域分布如下图所示：



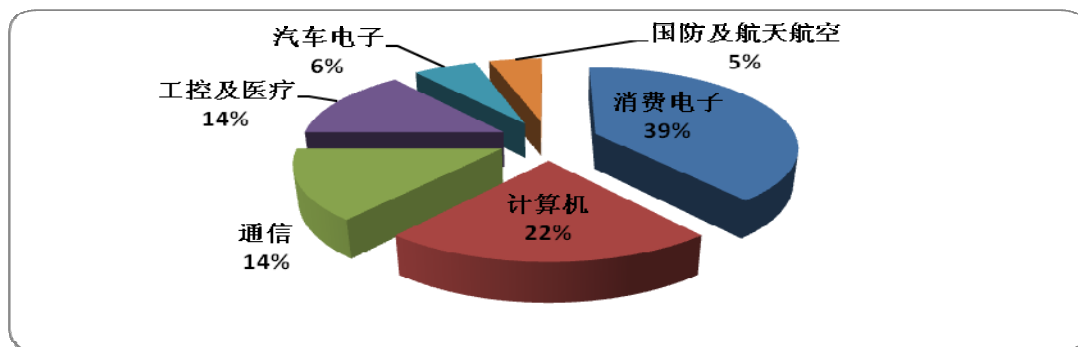
数据来源: CPCA 王龙基 《2009年中国电子电路产业现状》

中国的 PCB 产业主要分布于华南和华东地区，两者相加达到全国的 90%，产业聚集效应明显。此现象主要与中国电子产业的主要生产基地集中在珠三角、长三角有关。

3、中国 PCB 行业的下游应用分布

中国 PCB 行业下游应用分布如下图所示。消费电子占比最高，达到 39%；其次为计算机，占 22%；通信占 14%；工业控制/医疗仪器占 14%；汽车电子占 6%；国防及航天航空占 5%。

中国 PCB 行业下游应用分布

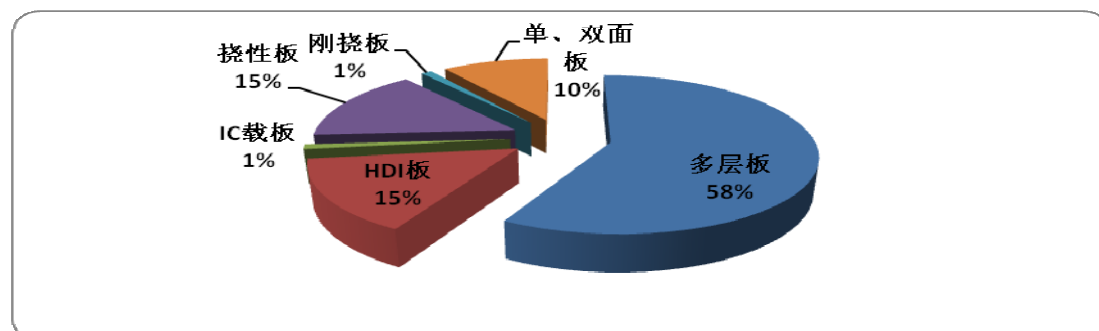


数据来源: CPCA 王龙基 《中国电子电路行业现状》

4、技术发展落后于世界先进水平，产品以中低端为主

中国目前虽然从产业规模来看已经是全球第一，但从 PCB 产业总体的技术水平来讲，仍然落后于世界先进水平。在产品结构上，多层板占据了大部分产值比例，但大部分为 8 层以下的中低端产品，HDI、挠性板等有一定的规模但在技术含量上与日本等国外先进产品存在差距，技术含量最高的 IC 载板在国内更是很少有企业能够生产。

中国 PCB 产品构成



数据来源: 2009 全球 PCB 市场总结以及未来发展预测 (张家亮)

(三) 全球小批量 PCB 行业发展状况

1、具有较大的市场规模和广阔的发展空间

小批量 PCB 行业的下游应用领域包括: 通信设备、工业控制、医疗仪器、国防、航天航空、安防电子等。这些行业主要面向企事业单位客户, 主导产品具有品种多、批量小的特征。

根据 Prismark 的统计数据整理, 通信设备、工业控制及医疗仪器、安防电子、国防及航天航空等产业 2011 年对应的 PCB 产值合计 189 亿美元。保守估计, 在总计 189 亿美元的产值中, 至少有 40%-60% 的订单采取小批量模式进行生产, 也即小批量 PCB 行业的市场空间在 75 亿美元左右, 占全球 PCB 总产值的比例在 10%-15% 之间, 是一个较大规模的市场。

从未来发展趋势来看, 相对于批量 PCB 行业主要的下游领域消费电子、计算机、通信终端的市场等基本已进入相对稳定的状态, 小批量 PCB 行业的下游行业如工业控制及医疗仪器、安防电子、国防及航天航空等发展空间更大 (详见本节 (十一) 小批量 PCB 行业与上下游业之间的关联关系)。因此小批量 PCB 行业的发展速度将高于全球平均 5.40% 的增长速度。

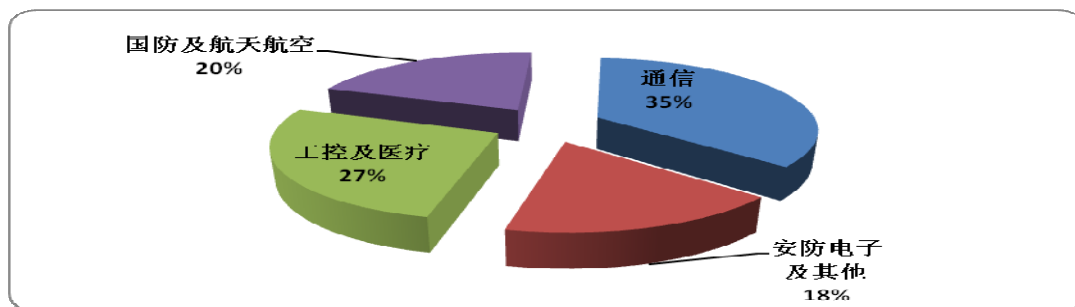
2、在 PCB 产业转移过程中, 欧美等地仍保留了小批量 PCB 产能

经过多年的产业调整, 全球批量 PCB 产能基本已转移到亚太地区, 主要是中国大陆。而小批量 PCB 由于毛利率较高, 成本压力小于大批量 PCB, 因此在欧美等发达国家仍保留了小批量 PCB 产能。美国 PCB 产值中大部分来源于小批量 PCB, 代表企业如 DDi; 欧洲与美国类似, 欧洲 PCB 产值中大部分来源于小批量 PCB, 代表企业有德国的 KSG。而在日本, PCB 产业特别重视盲孔板、挠性板和 IC 封装基板这些高成长、高利润领域的 PCB 的制造, 这也使得日本的 PCB 产业近年来一直处于全球领先地位。

3、小批量 PCB 应用领域分布

根据 Prismark 统计数据整理, 全球小批量 PCB 应用领域分布情况为: 通信设

备占35%、工业控制与医疗仪器占27%、国防及航天航空占20%、安防电子及其他占18%，如下图所示：



（四）中国小批量 PCB 行业发展状况

根据CPCA的统计数据，国内通信设备、工业控制及医疗仪器、安防电子、国防及航天航空等小批量需求产业2009年对应的产值合计44.65亿美元。如果按照其中60%为小批量生产模式测算，2009年度中国小批量PCB的市场规模大约在26亿美元左右。2010年度，中国PCB的产值较2009年增长29.60%，小批量PCB的市场规模进一步增长。

未来我国小批量PCB行业将快速发展，其速度将高于我国整体PCB行业的平均增长速度8.10%，主要原因是：

第一，下游行业的快速发展。具体参见本章“（十一）小批量PCB行业与上下游行业之间的关联性”之“3、下游行业的发展状况对本行业及其发展前景的影响”。

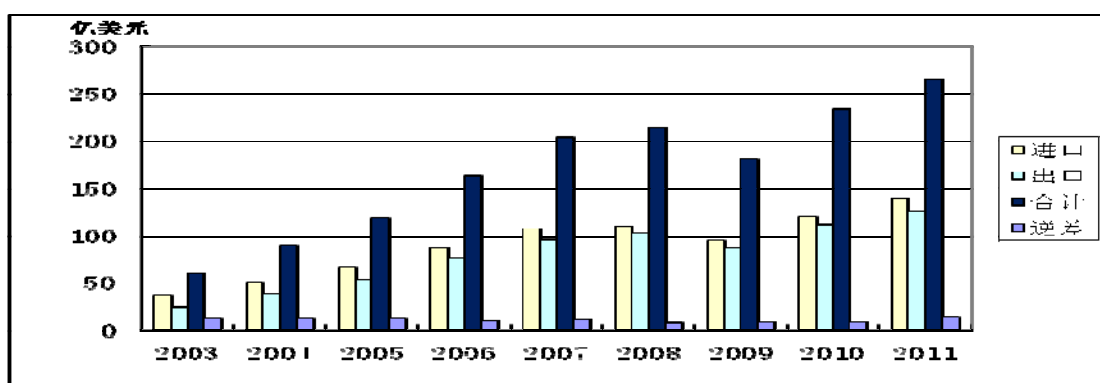
第二，欧美小批量 PCB 产业转移刚刚开始。

我国内资 PCB 企业中明确定位在小批量行业的不多，多数 PCB 厂商兼做大批量板、小批量板和样板。方正科技、超声电子等大批量 PCB 厂兼做小批量订单；样板领先企业兴森科技兼做小批量 PCB，其 2010 年销售额中的 35%来自小批量 PCB。本公司是明确定位于小批量的 PCB 企业，2010 年小批量 PCB 的销售收入占主营业务收入的 82.45%。与整个 PCB 行业一致，我国小批量 PCB 企业与产值也主要集中于珠江三角洲和长江三角洲一带。

（五）行业进出口情况

我国PCB进出口的发展状况与PCB整个行业的发展密切相关。2003-2008年我国PCB进出口保持约30%的快速增长，至2008年，进出口已双双突破100亿美元，进口为110.65亿美元，出口为103.04亿美元，合计213.69亿美元。2009年，受累于金融危机，我国PCB出口额为86.16亿美元，同比下降16.4%；进口额为94.61亿美元，同比下降14.5%。2010年，我国PCB出口额为112.12亿美元，进口额120.79亿美元，分别同比增长30.13%和27.68%。

中国PCB进出口情况



数据来源：国家信息中心中经网电子元器件行业分析报告

1999年开始我国PCB进出口一直保持逆差状况。从进出口的产品结构分析，出口的是中低档的产品，进口的多是中高档的产品，高技术含量的多层板、HDI板、柔性板等所占比例较大。这种趋势今后还会持续一段时间，这个矛盾表现在中国的产品供给与中国的整机电子产品需求之间不匹配或脱节。

小批量PCB行业的进出口尚无权威数据。由于小批量PCB的下游多为高技术领域，如通信设备、工业控制、医疗仪器、国防和航天航空、安防电子等，所需PCB技术难度大、质量要求高，进口比重相对较大。未来随着国内PCB技术水平的不断提升，我国小批量PCB行业进口替代的潜在市场相当可观。

（六）小批量 PCB 行业利润水平变化情况

行业利润水平主要取决于上下游行业的变动情况。小批量PCB行业的上游产业包括覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、油墨等，上游原材料价格水平决定小批量PCB的生产成本，下游通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、国防、航

天航空等行业的波动决定小批量PCB需求和价格水平。

原材料成本一般占小批量PCB成本的60%左右。2005年以来，原材料价格波动幅度较大，使整个PCB行业的生产成本和利润水平受到影响，但小批量PCB厂商由于客户数量多，均单面积小，议价能力较强，通常可以将原材料价格上涨等因素向下游传导。因此与大批量企业相比，小批量PCB厂商受宏观经济周期波动以及原材料价格波动等因素影响相对较小。

（七）影响小批量 PCB 行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）我国市场前景广阔

下游行业的发展变化直接决定小批量PCB行业的发展前景。小批量PCB的下游行业有通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、国防及航天航空等。这些行业在国内多数处于成长期，发展态势良好。例如医疗仪器行业，我国医疗仪器市场规模2006年为600亿元，2009年医疗仪器产值已达到1,000亿元规模，近几年平均增速15%以上，预计未来三年的复合年均增长率将超过25%。又如安防电子，根据IDC的报告，我国安防市场在2012年前，能够保持20%以上的复合年均增长率。小批量PCB产业受惠于下游产业的发展，增长趋势将长期持续。

（2）小批量产业转移刚刚开始

由于大批量 PCB 产品价格和毛利率水平低于小批量产品，大批量 PCB 企业承受的成本压力高于小批量 PCB 企业，因此欧美 PCB 产业大规模向中国和亚洲其他地区转移起始于大批量 PCB 企业。到目前为止，大批量 PCB 产品的产能转移已经接近尾声，欧美目前仅保留了部分高端、利润空间大的产品产能。欧美小批量 PCB 企业由于利润空间较大，产业转移的速度较慢，2008 年金融危机的爆发，迫使欧美企业更加重视成本，加速了小批量 PCB 产业向中国转移的进程。

小批量PCB的产能转移通过三种方式进入中国：一是终端客户直接把订单转移至中国；二是PCB设计、制造、贸易等企业的订单转移至中国；三是通过电子整机制造商或EMS公司转移到中国。

（3）中国电子产业链完整

中国电子产业一直保持了快速的发展势头，目前已成为世界最重要的电子制造基地，全球大部分 EMS 公司都在中国设立生产基地。中国的电子产业链已日趋完善，具有相当的规模和配套能力。完整的产业链使 PCB 企业既能快速采购原材料，又能快速地响应客户需求，呈现良好发展局面。

（4）个性化发展有利于小批量模式

以个人消费者为销售对象（B-C）的电子产品年产量数以亿计，适合大批量生产，但随着人们对个性化产品需求的增长，终端消费领域也呈现出小批量的趋势。例如在家电领域，家电购买趋势正从“有”向“好”转变。“好”是指适应现代家居的需求，希望家电产品的功能更符合个人需求。家电产品的个性化设计已经成为潮流，今后消费者对家电产品的需求将是人性化和功能多样化，这种需求是人们追求生活高品质的体现。现代社会崇尚个性消费，不同的地域、不同的性别、不同的年龄、不同的群体都有不同的消费需求，这种需求的不同，直接导致了定制型、大批量生产模式向个性化、差异化、小批量生产模式的转变，这个转变将使未来小批量PCB的市场空间大大拓展。

2、不利因素

（1）与发达国家的技术差距

从产业规模来看，中国已经是名副其实的PCB大国，但并不是PCB强国，与日本、欧美等发达国家相比，存在着一定的差距，小批量PCB行业也是如此。

如日本在HDI板、IC载板、挠性板的制造方面处于全球领先地位，而中国企业的产品水平多处于中低档，只有少数厂商能生产高端产品。近年来我国PCB产品的外贸逆差，集中反映在技术含量高的HDI和挠性板等功能多、附加值高的高端产品上。

（2）设备及原辅材料的配套能力不足

中国目前PCB生产所需的关键设备，如激光钻机、真空压机和AOI等检测设备绝大部分依赖进口。在PCB生产用化学品及辅助材料上，一些辅助性化学品如

干膜、阻焊油墨、挠性板的原辅材料大部分也需依赖进口。

（八）行业的技术水平

小批量PCB行业的技术水平与整个PCB行业的技术水平一致。

在电子设备不断升级和创新的带动下，印制电路板正走向高密度化和高性能化。所谓高密度化，主要是对印刷线路板孔径的大小、布线的宽窄、层数的高低等方面的要求，高性能化则是对焊接技术方面的要求。

高密度化可以从孔、线、层、面四方面概括。目前孔径可做到 $50\mu\text{m}$ ，甚至更小。线宽线距基本可做到 $50\mu\text{m}$ ，甚至 $25\mu\text{m}$ 。层厚可以做得更薄，最薄可以做到 $30\mu\text{m}$ ，甚至更低。表面方面，高多层PCB对翘曲度要求不断提高，从1%提高至0.5%，甚至更严。

高性能要求主要表现在无铅焊接、高散热、高频特性等方面。这不仅是对相关基材的要求，也对PCB生产工艺提出了更高挑战。这些特殊基材产品需要PCB企业采用不同生产设备、工艺流程、参数控制，并与企业生产能力相匹配，技术难度相对较高。

此外，由于绿色环保概念在业内已成为共识，全球印制电路板产业对环保材料、工艺及产品的要求会更严格和迫切，环保型印制电路板亦将是未来印制电路板企业的主要发展方向。

（九）行业特有的经营模式

1、生产模式

小批量PCB企业按订单采取柔性化生产模式，由于小批量PCB的种类多、均单面积小、交期短，生产线柔性化和管理复杂程度都较高，一般小批量PCB制造商需要建立高度柔性化的生产线，合理安排生产计划、物料供应等，定期对员工进行培训，使员工能胜任不同的岗位及不同的工艺流程。

2、销售模式

（1）国内一般采用直销的方式

小批量PCB交期短，为了快速响应下游客户需求，为客户提供更好、更快捷的服务，国内主要采用直销的方式。

（2）国外采用直销与经销相结合的方式

小批量PCB国外销售主要采用直销和经销相结合的方式，其中大型客户一般采用直销方式销售，小型客户主要通过贸易商采用经销方式销售。由于客户对产品交期要求严格，一般采用空运或快递的配送方式。

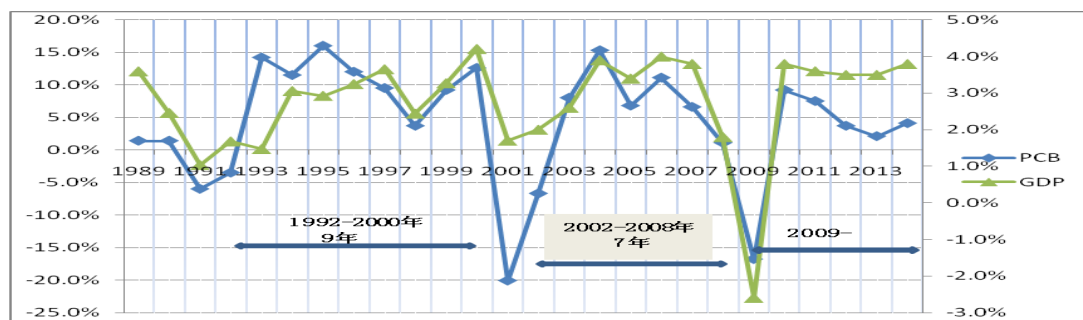
3、采购模式

小批量PCB企业一般根据客户订单情况进行原材料采购，由于产品种类多、均单面积小，原材料采购具有采购频率高、单次采购量小的特点。一般情况下，小批量PCB制造企业的主要原材料直接向国内原材料生产商采购，部分辅助材料从国外采购。计划性采购难度较大，对供应链管理的要求较高。

（十）行业的周期性、区域性和季节性特征

1、小批量 PCB 行业的周期性特征

小批量PCB行业与PCB行业周期性基本相同，总体上PCB行业周期性特征不明显，这是因为下游行业广泛，各下游行业波动不同，对PCB行业产生的影响会部分相互抵消，从而减少PCB行业的波动。PCB行业的周期性主要受到宏观经济影响。



资料来源：Prismark.Q2.2010

上图为PCB和GDP的增长趋势，从图中可以看出PCB增长周期与GDP增长周期相似。

2、地域特征

小批量PCB的客户分布在全球各地，应用领域集中在通信设备、工业控制、医疗仪器、国防科技、航天航空等行业，北美、欧洲、日本、中国等需求量较大。国内因为电子制造基地主要集中在珠江三角洲和长江三角洲，呈现出一定的区域性。

3、季节性特征

小批量PCB交货期较短，季节性特征不明显，主要受宏观经济的影响。因为PCB和电子类产品的需求呈正向关系，所以在季节性上也会出现轻微波动。

（十一）小批量 PCB 行业与上下游行业之间的关联性

1、与上下游行业的关联性

小批量PCB行业的上游行业为电子基础材料制造行业，主要包括：覆铜板、半固化片、油墨、铜球、铜箔、干膜及其他化工材料，下游主要为通信设备、工业控制、医疗仪器、国防、航空航天、安防电子等小批量PCB应用行业。小批量PCB行业与上游行业的关联度较高，而下游则由于应用行业比较广泛，单个下游行业的波动对小批量PCB行业的影响相对较小。



2、上游行业的发展状况及其对小批量 PCB 行业的影响

我国小批量PCB的上游配套产业发展成熟，供应充足，上游行业对小批量PCB行业的影响主要体现为价格波动影响其原材料成本，其中，覆铜板、半固化片的影响较大，其他原材料占小批量PCB的原材料成本比重较低，影响较小。

3、下游行业的发展状况对本行业及其发展前景的影响

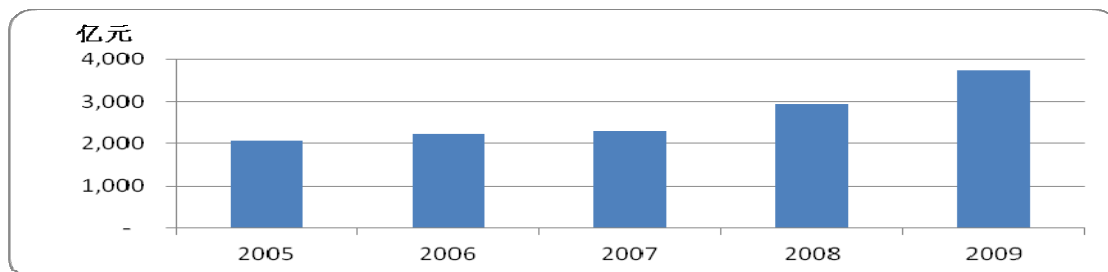
由于小批量PCB下游通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、国防、航天航空等行业快速发展，使小批量PCB市场需求稳步增大，未来前景广阔。

(1) 通信设备行业

通信设备行业是技术和资本密集型行业，全球通信设备市场主要由两类市场推动，发达国家和地区市场中通信用户数和话务量接近饱和，新业务和新技术推动运营商进行网络升级并带来相应的通信设备需求，主要包括无线宽带、固定宽带、下一代网络和多媒体服务等；新兴国家和地区市场中，移动通信2G网络扩容和3G网络启动建设对系统设备和终端的需求，以及宽带接入普及对固网设备的需求。

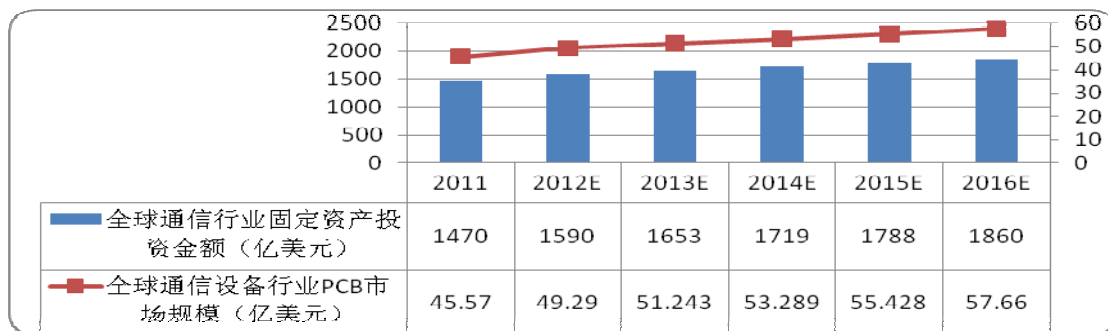
根据工信部数据显示，2002年至2009年，我国通信行业固定资产投资从2,106亿元增加到3,725亿元，复合年均增长率达到8.49%。未来几年通信设备行业将继续保持快速增长。

2002-2009 年中国通信行业固定资产投资



数据来源：工信部

根据Prismark统计，全球通信设备2011年实现销售额1,470亿美元，预计2012年为1,590亿美元，2011-2016年，复合年均增长率为4.8%。

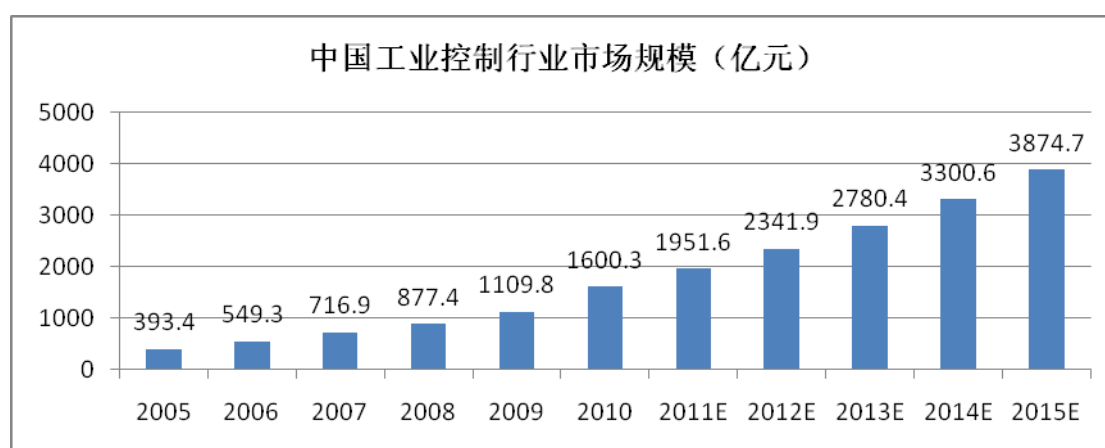


数据来源：Prismark Q4 2011

（2）工业控制与自动化行业

发展工业自动化是加快传统产业改造、提高企业整体素质、提高我国整体国力、调整工业结构、迅速搞活大中型企业的有效途径和手段，我国将继续推动工业自动化技术的进一步发展，加强技术创新，实现产业化，解决国民经济发展面临的深层问题，进一步提高国民经济整体素质和综合国力，实现跨越式发展。

根据OFWeek工控网的数据显示，中国2010年工业控制行业市场规模达到1,600亿元，过去5年间保持了32%的年均复合增长率。未来几年内仍将保持19%左右的年均复合增长率增长，预计2015年中国工业控制行业市场规模将达3,874亿元。



数据来源：OFWeek工控网

根据Prismark 2011年Q4季报，2011年，全球工业控制市场规模为1,200亿美元，预计2012年达到1,250亿美元，2016年高达1,620亿美元，年复合增长率为6.2%。

（3）医疗仪器

医疗仪器行业是一个国家综合医疗水平的体现，综合了各种高新技术成果，将传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术结合起来的行业。根据Prismark 2011年Q4季报，全球医疗仪器行业2011年实现销售额910亿美元，预计2012年为960亿美元，2011-2016年复合增长率为4.4%。医疗仪器用PCB占医疗仪器整机产值的比例约为1.67%，医疗仪器行业的发展将直接带动PCB的需求。

近几年来，伴随着中国经济的发展、相关医疗政策深入实施、医疗市场化竞

争逐步深化以及整体健康需求的快速释放，中国医疗仪器行业得以快速发展。根据中国《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2002），医疗仪器归类于医疗仪器设备及器械行业。国家信息中心中经网行业报告显示，2004-2009年，中国医疗仪器设备及器械行业销售额稳步增长，从2004年的249.73亿元增加到2009年的883.91亿元，复合年均增长率达到29%。据中国医疗器械行业官方网站统计，2010年我国医疗器械市场已跃升至世界第二位，首次突破1,000亿元大关。未来随着中国医疗体制改革的进一步深化、企业研发能力的进一步加强、整体健康需求的释放，中国医疗仪器行业将保持稳步快速的增长，有力带动医疗仪器用PCB的需求。

（4）安防电子

“9.11”事件以来，安防电子产业一直处于较快发展的态势，以美国为代表的各国政府纷纷加大了对公共安全防护建设的投入，各国政府防护产品采购规模持续增长。据中国电子信息产业发展研究院报告，2008年全球安防电子产业规模为601.9亿美元，2004-2008年的复合增长速度保持在10%以上。根据Prismark的统计数据，安防电子用PCB占安防电子整机产值的比例约为3.35%，安防电子行业的快速发展将直接刺激安防电子用PCB的需求。

据中国电子信息产业发展研究院预测，未来两年，中国安防电子行业将保持20%的速度增长，预计2011年中国安防电子产业规模将达到835.8亿元。

（5）国防、航天航空

国防及航天航空不仅仅是新的经济增长点，更是关系到国家安全的战略性新兴产业，并已成为政府重点支持的战略性新兴产业。根据Prismark 2011年Q4季报，全球国防及航天航空行业2011年实现销售额1,240亿美元，2011-2016年复合年均增长率为2.5%。根据Prismark统计数据计算，国防及航天航空用PCB占整体行业产值的比例约为1.75%。国家军事信息化程度的不断提高，必将促进相应PCB的需求。国家军事信息化程度的不断提高，必将促进相应PCB的需求。

四、小批量 PCB 行业的竞争情况

（一）小批量 PCB 行业竞争的基本情况分析

1、大批量 PCB 厂商与小批量 PCB 厂商的竞争

为满足客户不同需求以及出于价格和利润方面的考虑，部分大批量板厂商也承接少量小批量订单进行生产。大批量板厂商生产小批量板有两种途径：

一是直接利用现有闲置的产能和生产线进行小批量板生产。但其现有的生产线均是为实现规模化大批量生产而配备，操作流程和管理相对于小批量生产而言相对简单，要想机动灵活地从事多品种、小批量的生产，通常容易挤占其大批量生产的空间，而造成生产成本的增加，因此通常大批量板厂商不愿承接过多的小批量订单。

二是直接打造小批量生产线从事小批量板生产。但要实现小批量 PCB 规模化生产则需要长期的客户培养和积累以及管理模式的转变。

2、样板厂商与小批量 PCB 厂商的竞争

由于样板与小批量板均是品种繁多、订单面积小，其在生产线配置和组织管理上具有较大的相似性，因此样板厂商也会从事小批量板的生产。但由于样板的毛利较高，且对产品的交货期有非常高的要求，样板厂商必须保留部分空闲产能以应对随时可能出现的样板订单，样板厂商生产的小批量订单一般是为了满足其样板客户的后续需求。

样板企业对交货时间要求更高，样板企业一般需要空置部分生产设备，为快件订单生产作准备，确保能够及时交货。由于样板企业材料利用率和产能利用率一般低于小批量企业，因此样板企业的生产成本和单位售价均较高，小批量客户不一定能够接受如此高的成本。如兴森科技 2007~2009 年小批量板的平均单价和平均单位成本为 2,515.77 元/平方米和 1,951.19 元/平方米，而报告期内，本公司产品的平均单价为 1,539.58 元/平方米，平均成本为 1,022.52 元/平方米。

3、小批量行业内部企业之间的竞争

小批量行业内部之间的竞争主要是各企业之间技术水平和管理能力的竞争，如何通过合理、有效的管理和组织调度，保持各品种的生产能力和产品质量，满足客户快速交货的需求，赢得客户信赖从而大量积累客户是小批量企业从激烈的竞争中脱颖而出的关键。

（二）小批量 PCB 行业的进入壁垒

1、管理能力壁垒

小批量PCB生产模式对经营者的生产管理能力提出了很高的要求。在生产计划、物料供应、工程数据储备、生产品种切换和不确定管理上，小批量PCB厂商更加需要合理的运营管理以达到目标。在小批量制造中，不确定性因素出现的概率会更高，有效快速的进行调整和分配有限的资源是小批量生产企业有效运营必须具备的关键管理能力。

如何保证各个生产环节的优化和有序衔接，做好诸多产品的质量控制、保证产品的交货期等是小批量PCB生产企业的核心竞争力的体现。对新进入者而言，要打造一条高度柔性化管理的生产线必须经历一个长期的积累过程，这就构建了生产管理的高壁垒。

2、客户资源与销售网络壁垒

小批量PCB平均订单面积小，平均订单面积仅在10平方米左右，企业要实现较高的销售收入需要大量的订单和客户积累，如行业龙头DDi 2011年客户数量超过1,000家。大量的客户资源与销售网络的建立是一个渐进的过程，先进入的企业在这方面会形成明显的先发优势。另外，销售网络的建立成本较高，而维护成本相对较低，先进入的企业一旦和大客户建立起稳定的合作关系，新进入企业将较难争夺其市场份额。

3、资金壁垒

在PCB生产制造中，要满足客户对不同精度产品的需求，必须投入较多资金购置先进的生产设备，增强企业的生产和检测能力、柔性生产能力以及持续研发

能力。

PCB的生产工序有十几个，生产设备种类繁多，先进机器设备单位售价高，同时产品生产过程复杂，流动资金占用量大，因此存在较高的资金壁垒。例如一条PCB生产线需要曝光机、真空压机、自动光学测试机、激光钻孔机、图形蚀刻线等几十台贵重设备。昂贵的生产设备和复杂的工艺流程使固定资产投入巨大，对新进入者形成了较高的资金壁垒。

4、技术壁垒

PCB制造行业属于技术密集型行业，拥有较高的技术壁垒。PCB行业融合了电子、机械、计算机、光学、材料、化工等多学科来从事产品的制造服务，为此需要对相应学科具有全面的了解和综合的认识，并具有能将其综合运用与实际生产的能力。

从制造过程角度来看，随着PCB产品向高精度和高密度方向发展，各类PCB产品尤其是各种高端产品或特殊基材产品的生产，需要不同的工程组织和工艺调整，所涉及的专利技术、专有技术诀窍及特殊工艺也不尽相同，具有较强的柔性制造特征；其次，在产品制造过程中，企业需要具有从事各类PCB产品生产的各种能力（如电镀、蚀刻、钻孔、表面处理等），任何过程中的瑕疵都将导致最终产品成品率下降，从而影响企业所在整个供应链的运转。

从应用领域来看，小批量PCB行业的下游应用领域广泛，涉及工业控制、医疗仪器、安防电子、通讯设备、航空航天等众多行业，各行业客户对PCB产品需求不同，PCB产品具有品种繁多、工艺复杂，新工艺、新材料的应用层出不穷的特点，PCB制造企业需要具备为不同领域客户提供解决方案的能力。

随着行业的快速发展，PCB订单越来越向技术能力高、制造能力强的公司集中，能够快速为客户提供全面解决方案的大公司集中。而小规模公司受限于其自身技术能力，将出现订单量稀少，继而导致盈利空间越来越小的局面，这将增加行业新进入者的市场风险。

5、环保壁垒

面对自然环境日益恶化，国内外掀起了强劲的环保浪潮。欧盟颁布了《关于

在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（ROHS）、《报废电子电气设备指令》（WEEE）和《化学品注册、评估、许可和限制》（REACH）等指令，中国政府也发布了《电子信息产品污染控制管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产标准——印制电路板制造业》等一系列法律法规。目前PCB行业的环境和资源问题以及可持续发展被摆到了战略高度，中国PCB行业的发展，必须加强治理，使之走上清洁生产的轨道，成为资源节约型、环境友好型的行业。日益严格的环保要求提高了PCB企业的建设投入和运营成本，抬高了准入门槛，迫使乱排乱放的小企业淘汰出局，促进行业健康发展。

（三）主要产品进口国的有关进口政策以及进口国同类产品的竞争格局

1、主要产品进口国的有关政策

本公司产品主要出口地区为：欧洲、美洲、亚洲（不含中国）。由于环保意识的不断加强，欧盟制定了ROHS、WEEE、《包装和包装废物指令》、《关于限制全氟辛烷磺酸销售及使用的指令》和REACH法规。美洲和亚洲（不含中国）等国家没有制定明确的法规，参照执行欧盟的ROHS和《包装和包装废物指令》。本公司出口至上述地区产品符合各法规和指令的要求。

政策名称	公布时间	有关内容
ROHS	2003 年	该法规限制在电子产品中使用包括铅在内的六种有害成份，2008 年全面禁止使用含铅焊料产品进口，所有出口到欧盟的电子电气产品不得含有铅、镉、汞、六价铬、聚溴联苯和聚溴二苯醚等六种有害物质。
WEEE	2003 年	规定生产者必须重复利用或回收 2005 年 8 月 13 日以后在欧洲销售的商品，否则可能需要支付占销售额 2%的罚款，同时该法规还要求生产者回收上述日期以前产生的部分部分电气和电子废弃物。
《包装和包装废物指令》	2004 年	指令规定从 2006 年 12 月 27 日起投放欧盟的所有包装物和所有废弃包装物，铅、镉、汞、六价铬的总量不超过 100ppm。
《关于限制全氟辛烷磺酸销售及使用的指令》	2006 年	规定欧盟及其各成员国应于 2008 年 6 月 27 日起限制 PFOS 类产品的使用和市场投放，并不得销售以 PFOS 为构成物质或要素的、浓度或质量等于或超过 0.005%的物质。
REACH 法规	2007 年	该法规涉及约 3 万种在欧盟生产或销售的化学品及其配制品进行预防性管理的一项深化化学品管理

目前，本公司产品的主要进口国未对PCB进口设置关税、进口配额等贸易壁

全政策。其中，出口至欧盟和俄罗斯等国家需要开具产地证—提供普惠制证明，产品为免税进口；出口至美洲和亚洲（不含中国）的产品无需普惠制证明，产品即可免税进口。

2、主要产品进口国的竞争格局及公司地位

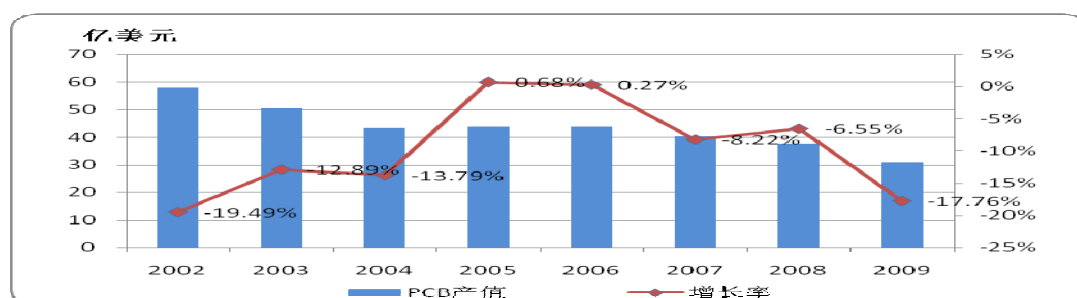
随着全球PCB产业向亚洲转移，欧美等地的PCB产业在逐渐萎缩，目前仅保留了部分样板、小批量板以及军工等特殊应用领域的PCB产能，其余PCB主要从亚洲采购。

公司产品的主要进口国为：美洲、欧洲和除中国之外的亚洲其他地区，主要进口国的竞争格局及公司地位如下：

（1）美洲市场的竞争格局及公司地位

美洲PCB市场大部分集中在美国。在20世纪90年代，美国曾是全球PCB行业最强盛的国家，鼎盛时期美国PCB企业多达2,000余家。网络泡沫过后，2004年开始PCB企业不断转移到亚洲等新兴市场，截至2009年底美国PCB企业减少到350家左右。在美国本土所存留的这些厂家，多为多品种、小批量、短交期及快件样板企业，主要生产国防、航天航空、医疗仪器、工业控制、通信设备、大型计算机等行业用PCB产品。

根据IPC统计，美国PCB业在2009年产值降到了30.91亿美元，与2002年PCB总产值相比，减少了26.89亿美元，下降了46.52%，具体如下图所示：



数据来源：IPC 2009 World PCB Report

根据PRISMARK的统计，2011年美洲地区PCB产值为38.25亿美元，占全球PCB总产值的6.90%。根据Prismak的预测，2010年至2015年美洲市场（包括美国）PCB行业的复合年均增长率为-0.40%。

公司在美洲地区的销售额呈明显的增长趋势，2011 年销售额约 4,700 万美元。公司与美国最大的 PCB 设计公司之一 Palpilot International Corp.、全球最大的小批量 PCB 生产企业 DDi 以及 PCB 贸易商 Suntech Circuits,Inc.、P.D. CIRCUITS, INC.合作不断深入。

报告期内，本公司与美洲主要客户的销售情况如下：

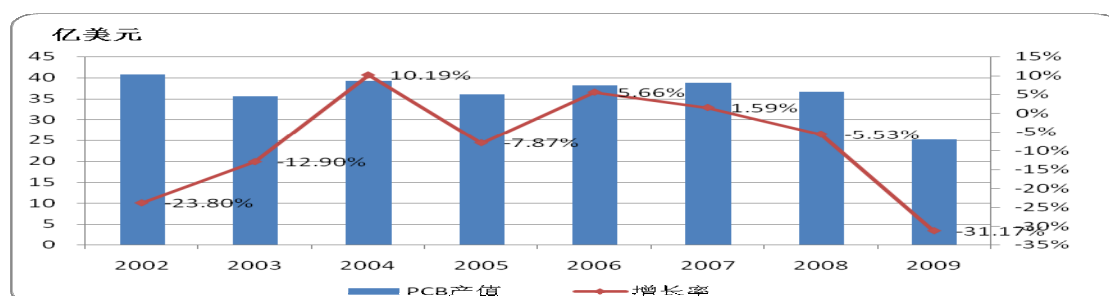
单位：万元

客户名称	2012年1—6月	2011年	2010年	2009年
Palpilot International Corp.	8,014.54	14,482.66	10,087.72	4,292.08
P.D. CIRCUITS, INC.	1,506.12	3,901.37	4,485.95	2,127.98
Suntech Circuits,Inc.	1,855.44	3,175.21	2,080.56	1,134.35
DDi	1,555.24	2,267.25	1,799.10	687.50

（2）欧洲市场竞争格局及公司地位

近年来，随着产业转移步伐的加快，欧洲PCB行业的总产值处于下降趋势，样板、多品种小批量板和高复杂板已逐渐取代大批量PCB的生产成为欧洲PCB市场主要驱动力量。目前欧洲保留的主要是样板、小批量板及高复杂板产能，主要应用在通信、工业控制、医疗仪器、国防、航天航空和安防电子等领域。

欧洲PCB业在2009年的产值较上年同期下降了31.17%，与2002年欧洲PCB总产值相比，下降了38.28%，如下图所示：



数据来源：IPC 2009 World PCB Report

根据PRISMARK的统计，2011年度，欧洲PCB产值为25.50亿美元，比2010年度增长3.5%，根据Prismark统计预测，2010年至2015年欧洲PCB行业复合年均增长率为-2.0%。欧洲PCB产值不断下降的原因主要是由于PCB产业逐渐向亚洲特别是中国市场转移。公司在欧洲地区的销售额约3,800万美元，公司与欧洲的

知名企业保持良好的合作关系，如英国贸易商Kestrel international circuits ltd、瑞典贸易商NCAB SWEDEN等。

报告期内，本公司与欧洲主要客户的销售情况如下：

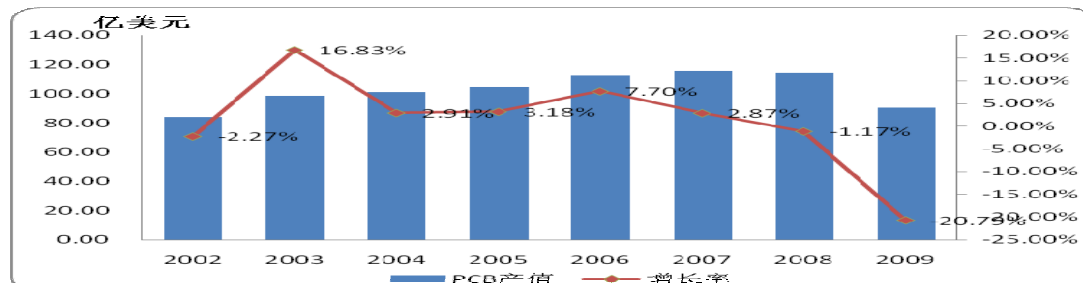
单位：万元

客户名称	2012年1—6月	2011年	2010年	2009年
Kestrel international circuits ltd.	1,440.57	3,913.96	3,926.94	648.52
NCAB SWEDEN	479.85	976.98	999.64	654.31

（3）亚洲市场竞争格局及公司地位

亚洲区（除中国以外）的PCB市场主要集中在日本、台湾和韩国。2006年以来，由于日本国内生产成本过高，难以与中国台湾和韩国竞争，因而纷纷将低阶PCB生产线向日本以外的工厂转移。日本本土企业以生产HDI板、IC载板及挠性板这些高技术含量的PCB为主。

根据IPC统计，日本PCB业在2009年产值比2008年下降了20.79%，2002年至2009年增长趋势如下图所示：



数据来源：IPC 2009 World PCB Report

2010年度，日本PCB产值为102.35亿美元，比2009年增长23.30%，根据Prismark统计预测，2010-2015年日本PCB行业的复合年均增长率为-2.80%。

除日本、韩国、台湾市场外，东南亚PCB市场是亚洲区一个新兴的PCB市场，主要分布在泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等国家，但主要是海外企业投资的PCB工厂，以大批量订单为主，小批量PCB市场还处于发展初期。泰国上市公司EMS服务商SVI PUBLIC COMPANY LIMITED（世纬电子）是公司在东南亚的重要客户，以色列上市公司PCB TECHNOLOGIES LTD也是公司在亚洲区的重要客户。

报告期内，公司与亚洲主要客户的销售情况如下：

单位：万元

客户名称	2012年1—6月	2011年	2010年	2009年
PCB TECHNOLOGIES LTD	3,238.43	6,471.71	5,467.46	2,591.83
SVI PUBLIC COMPANY LIMITED	1,298.65	2,267.65	1,998.93	875.99

（四）小批量 PCB 行业竞争格局的特征与展望

1、行业集中度不高、单个生产企业市场占有率低

PCB行业市场竞争充分，各类规模的生产企业众多，市场集中度较低。据Prismark的统计，2011年全球产值最大的PCB制造商Unimicron在全球的市场占有率仅为4.31%。而小批量行业因其订单面积小、客户数量和订单种类多的特征决定了其市场分散程度较大批量行业更高。以行业龙头DDi为例，其2011年的客户数量超过1,000个，但按照估算的全球小批量PCB市场容量70亿美元计，其份额仅约占整个小批量市场的2.26%。

2、国内市场逐渐成熟，专业化分工更加明显

目前，国内 PCB 厂商的分工和市场定位尚不明显，绝大多数企业兼做样板、小批量和大批量板。随着市场竞争愈加激烈，以及国际 PCB 产业向中国的转移，将迫使国内 PCB 市场逐渐成熟，PCB 厂商的市场定位和专业化分工更加明显。PCB 生产厂商需要在竞争中寻找差异化和专业化服务领域。由于小批量 PCB 服务行业持续快速发展，将会有更多的 PCB 生产企业涉足并专注于小批量 PCB 领域，小批量 PCB 行业的竞争将更加激烈，具有较强的订单处理能力和丰富客户资源、能够快速响应客户需求的小批量 PCB 生产企业，受益于下游行业的强劲需求，也将迅速脱颖而出。

3、国际市场产业转移加速

由于亚洲各国在劳动力资源、市场、投资等方面的优惠措施，近 10 年来，欧美一直把大批量 PCB 产能往亚太地区，特别是中国转移。目前批量 PCB 的产业转移已进入中后期，但小批量 PCB 的产能转移才刚刚开始。2008 年金融危机的爆发，迫使欧美等国 PCB 生产企业更加重视成本，加速了产业转移的速度。

小批量 PCB 的产能转移通过三种方式进入中国：一是终端客户直接把订单转移至中国；二是 PCB 设计、制造、贸易等企业的订单转移至中国；三是通过电子整机生产商或 EMS 公司转移到中国。

五、发行人的行业地位

（一）本公司在行业中的竞争地位

本公司是国内小批量PCB行业的领先企业。凭借独特、准确的市场定位以及长期、持续的专注，公司在满足客户多样化需求、快速交货方面，形成了独特、有效的服务模式和柔性化生产模式，在细分市场构建了较强的竞争力。

公司目前已经发展为多厂运营，产品类型覆盖HDI板、背板、厚铜板、软硬结合板、埋容板、高多层板、立体板、铝基板、高频板等线路板，可一站式满足客户对各种不同产品的需求。产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、国防、航天航空等高科技领域，报告期内，公司产品70%以上外销到欧洲、美洲、日本、亚太等地区。

根据Prismark的统计，2011年中国PCB产值为219.38亿美元，按照小批量PCB10%至15%的市场容量计算，国内小批量PCB市场规模为21.94亿至32.91亿美元；2011年，全球PCB产值为554.09亿美元，按照10%~15%的比例计算，全球小批量PCB的市场规模为55.41亿美元至83.11亿美元。2011年度，公司小批量PCB在全球小批量的市场占有率不足2%。

（二）主要竞争对手

1、国际竞争对手

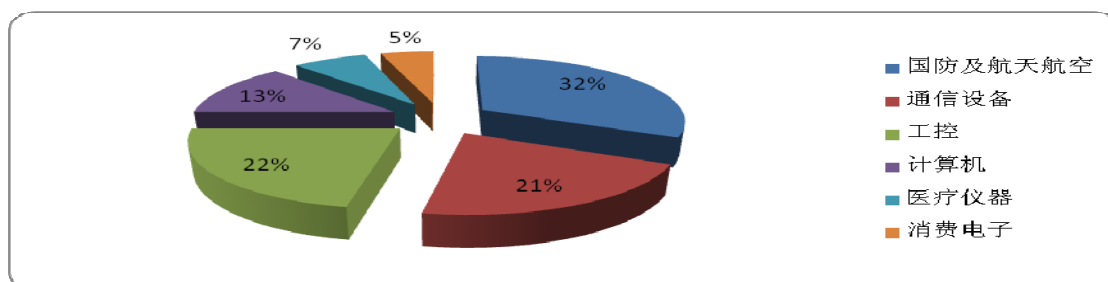
本公司国际竞争对手主要有：美国的DDi、德国的KSG。这两家公司生产的产品主要为高端产品，市场定位在其国内的小批量市场（如国防、航天航空、医疗仪器等领域）。与此类竞争对手相比，本公司具有成本优势。

（1）DDi

DDi Corp.（以下简称“DDi”）成立于1978年，是纳斯达克上市公司（NASDAQ

代码: DDIC), 其总部位于美国加利福尼亚阿纳海姆市, 是北美“多品种、小批量、短交期”细分行业的领导者。该公司2011年客户数量达1,000家, 应用行业主要包括: 国防及航天航空、通信设备、工业控制、计算机、医疗仪器、消费电子等。2007年、2008年、2009年、2010年, DDi前十大客户在该公司销售总额中所占的比重分别为33%、30%、30%、29%。2009年度, DDi 34%的产品销售给EMS公司。

2010 年 DDi 的 PCB 下游应用领域分布



数据来源: DDi 2010 年报

2009年12月31日, DDi完成收购加拿大最大的PCB制造商Coretec公司。该次收购使DDi提高了在整个北美地区的生产能力, 扩大其在国防、航天航空和医疗仪器等领域的市场占有率, 加强了DDi在挠性和刚挠板等产品上的制造能力。

DDi 2005~2011年的财务指标见下表:

单位: 万美元

项目\年份	2011 年	2010 年	2009 年	2008 年	2007 年	2006 年	2005 年
销售收入	26,339	26,778	15,800	19,080	18,110	19,810	18,460
毛利	5,726	5,940	2,920	3,880	3,490	3,790	2,670
毛利率	22%	22%	18%	20%	19%	19%	14%
净利润	2,184	2,074	178	-3,340	70	-720	-6,400
销售净利率	8%	8%	1%	-18%	0%	-4%	-35%

数据来源: DDi年报

目前DDi与本公司建立了战略协作关系, DDi迫于生产成本特别是人工成本的压力, 将部分附加值和利润空间相对而言较低的产品订单转移给本公司代为生产, 而其自身保留高端产品生产能力。随着本公司技术水平和竞争力的提升, 未来本公司将在高端市场与DDi形成直接竞争关系。

(2) KSG

KSG位于德国萨克森市，全称是Kundenfreundlich-Schnell-Gut，该公司定位于“多品种、小批量、短交期”细分市场领域。主要产品包括：双面板、多层板、HDI板、刚挠板、铝基板、厚铜箔基板等。

KSG 2007年的PCB销售额中，一般性工业领域占45.3%，EMS公司占30.8%，汽车电子占10.5%，消费型电子占8.2%，其他占1.5%。KSG客户数量2007年达到535家。

2、国内竞争对手

（1）台湾庆生电子股份有限公司（kintech）

台湾庆生电子成立于1984年，在台湾交易所上市，股票代码6210。该公司主要生产单层和2~24层板，产品应用领域包括：服务器、工业设备、计算机、通信、消费电子及其他。

台湾庆生电子 2007-2011 年主要财务数据

单位：新台币万元

项目\年份	2011 年	2010 年	2009 年	2008 年	2007 年
营业收入	97,300	97,148	64,024	74,623	80,961
毛利	27,250	33,258	16,968	14,798	17,198
毛利率	28.01%	34.23%	26.50%	19.83%	21.24%
税后净利	13,383	17,051	5,020	5,510	6,701
净利率	13.75%	17.55%	7.84%	7.38%	8.28%

数据来源：庆生电子年报相关资料

（2）兴森科技

兴森科技是国内印制电路样板行业的领先企业。主营业务为印制电路样板、小批量板的生产与销售，该公司产品为印制电路样板、小批量板，主要应用于通信设备、工业及医疗电子（工业控制和医疗电子等）、计算机（PC外设及安防、IC及板卡等）、国防等多个领域。

兴森科技2011年的主营业务销售额是94,471.56万元，小批量板销售额占总销售额的38.55%。

兴森科技 2009～2011 年销售数据

单位：万元

产品	2011 年			2010 年			2009 年		
	销售金额	销售占比	毛利率	销售金额	销售占比	毛利率	销售金额	销售占比	毛利率
样板	58,056.60	61.45%	41.00%	51,791.50	65.38%	43.01%	34,961.58	70.35%	43.78%
小批量板	36,414.96	38.55%	33.47%	27,425.11	34.62%	31.75%	14,733.16	29.65%	23.70%
合计	94,471.56	100%	38.10%	79,216.61	100.00%	39.11%	49,694.74	100.00%	37.83%

数据来源：兴森科技招股说明书及2010、2011年年度报告

(3) 其他

除台湾庆生电子和兴森科技外，2011年中国印制电路行业百强排名中，天津普林定位于多品种、中小批量的PCB生产，同时加强大批量订单的生产。产品主要为双面板和多层板，新建了HDI生产线。产品主要应用于通讯（手机、无线基站）、工业自动化控制、汽车电子、医疗设备等。此外，深圳市金百泽电子科技有限公司、深圳牧泰莱电路技术有限公司、上海嘉捷通电路科技有限公司也与本公司存在一定的竞争关系。根据各公司的网站介绍如下：

深圳市金百泽电子科技有限公司是一家专注于样板和中小批量板的高新技术企业，产品应用于通信、消费电子、测试工控、医疗仪器、电力能源、航空航天、国防应用和科教机构等领域。

深圳牧泰莱电路技术有限公司是一家样板、中小批量PCB加工制造企业。

上海嘉捷通电路科技有限公司位于上海嘉定工业区，该公司致力于高精密度中小批量和快速印制线路板的生产制造和研发服务，产品广泛应用于通信、工业控制、计算机应用、航空航天、军工、医疗仪器、测试仪器等各个领域。

(三) 本公司的竞争优势

1、相对于国内竞争对手的竞争优势

(1) 专注于小批量的市场定位

在欧美PCB行业，大批量和小批量PCB市场以及生产企业已经出现了明确的专业区分。通信设备、医疗仪器等领域存在小批量需求的客户往往会选择专业从

事小批量PCB生产的企业，因为专业从事小批量生产的企业能够更好的满足小批量客户对交货期、个性化等方面的需求。同样，在欧美PCB产业逐渐向亚洲、中国转移的过程中，欧美的小批量PCB生产企业、PCB设计企业、PCB贸易商等寻求的长期合作对象往往也是国内专业、优质的小批量PCB生产企业。

目前国内PCB生产企业众多，但绝大多数企业并没有明确、专业的针对小批量市场的定位，本公司凭借着专业的市场定位以及多年技术与经验的沉淀形成了独特、有效的服务模式和快速反应客户需求的能力。在PCB产业转移的背景下，本公司成功开拓了海外市场，成为了DDi、Palpilot等PCB著名企业在中国的最大合作伙伴。而在国内，随着医疗仪器、工业控制、安防电子等存在小批量PCB需求的下游行业的迅猛发展，本公司专业、专注的竞争优势将在未来得到充分体现。

（2）管理优势

相对于大批量生产模式，小批量模式最主要的特征表现为平均订单面积小，订单数量和订单品种多。按欧美的行业惯例，小批量PCB企业一般被表述为“多品种、小批量、短交期”（High Mix、Low Volume、Quik Turn），如何通过合理、有效的管理和组织调度，生产出各类量小而品种繁杂的产品，并能满足客户快速交货的需求是小批量PCB生产企业核心竞争力的重要体现。

本公司通过长期的积累，已经具备了合理安排生产系统、使公司的生产系统能够对客户纷繁多样的需求作出及时、快速反应的管理技术和能力，如：结合先进的ERP系统，通过制定生产WIP表（生产流程排划表）和LOT卡（产品生产批量管制卡），安排各种产品有序进线生产，保证繁多品种的排线生产；通过专业技能培训，让生产线操作人员熟练掌握2~3个相连工序的生产操作技术，便于方便机动调节人员配置，保证生产的衔接顺畅；通过对关键工序的集中质量控制并配合PQA（制程品质稽核），做好产品的质量控制工作；引进设备利用率监控软件提高设备利用率等。

报告期内，本公司平均订单面积基本维持在8平方米左右，订单数量增长较快。报告期内，本公司平均交货期分别为15天、17天、14天、14天。

公司报告期内均单面积、订单数和交货期

项目	2012 年 1—6 月	2011 年	2010 年	2009 年
均单面积（平方米）	7.28	8.29	8.33	7.79
订单数（个）	45,099	70,127	60,477	37,966
平均交货期（天）	14.30	14.04	17.12	15.40

2010年度，受到深圳崇达厂房搬迁的影响，公司在2010年3月至6月的交货期限有所延长，从而导致2010年平均交货期延长。扣除3月至6月的影响，2010年平均交货期为15.28天。2011年和2012年上半年，随着公司产能的释放，交货期有所缩短。

（3）成本优势

相比样板企业，本公司的主要竞争优势表现为成本优势。由于样板生产企业单个订单面积更小，订单数量更多，要求的交货期更短，样板企业一般需要空置部分生产设备，为快件订单生产作准备，确保能够及时交货。

由于样板企业材料利用率和产能利用率一般低于小批量企业，因此样板企业的生产成本和单位售价均较高。如兴森科技 2007 至 2009 年样板的平均单价和平均成本分别为 6,010 元/平方米和 3,579 元/平方米，小批量板的平均单价和平均成本分别为 2,515.77 元/平方米和 1,951.19 元/平方米。报告期内，本公司产品的平均单价为 1,539.58 元/平方米，平均成本为 1,022.52 元/平方米，与样板企业相比，本公司平均交货时间长于样板公司，但成本优势较为明显，对于那些对交货期限要求不是特别高的小批量客户具有较强的吸引力。

（4）生产技术优势、研发优势

本公司自创立以来，专注于小批量PCB的生产与销售，紧跟国际先进技术的发展，积累起庞大的工程技术数据库，以满足不同层次、不同品种的客户需求。在全面发展技术的同时，本公司在许多单项领域也取得了突破，取得了大量的PCB相关的专利技术，形成了自己的特色。截至本招股书签署之日，本公司已获得的专利共有288项。本公司的技术优势主要体现在：

①8层以上高层板的生产技术处于业界先进水平。本公司已成功开发出32层通讯背板、24层高频埋入平面电容板，该等技术在国内外PCB生产厂家中处于领先

水平。本公司拥有先进的高层板生产设备和多项核心技术，质量控制和管理处于业界领先水平。

②特种电金工艺线路板生产技术。本公司能生产具有长短金手指、断节金手指、局部电金等工艺的线路板，可以满足客户针对插拨式接触位设计及按键位设计的极复杂的个性化设计需求。

③ 厚铜板的生产制作技术处于业内先进水平，获得了多项发明专利和实用新型专利授权，能达到内层铜厚度达6盎司、外层铜厚度10盎司的技术标准，目前在国内拥有较大的厚铜板市场份额。

④ HDI产品拥有较高的技术水平。本公司2009年就已经开发出3阶HDI产品，并获得了多项专利授权，可以满足各种终端客户个性化的需求。

研发上的不断投入，使公司技术实力稳步前进。本公司于2010年被认定为“高新技术企业”。2011年10月，深圳崇达被科学技术部火炬高技术产业开发中心授予《国家火炬计划重点高新技术企业证书》。

（5）设备优势

先进的设备是保证产品质量的重要因素之一。本公司拥有先进的 PCB 生产设备。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司机器设备原值为 45,558.91 万元，其中 25,527.16 万元的设备为进口设备，主要包括全自动曝光机、真空热压机、AOI 测试机、激光钻孔机、真空蚀刻机等，本公司配备了先进的小批量 PCB 生产专用设备，如 LDI（激光直接成像技术）、字符打印机、静电喷涂机、两头钻机、两头锣机、飞针测试机，先进的专业化设备保障了公司具有较强的生产制造能力。

（6）客户优势

本公司的客户优势分别体现在客户的数量和质量上。

A、客户数量

由于小批量PCB均单面积小，单个订单销售金额小，企业要想实现较高的销售收入就必须拥有大量的订单和客户资源。而客户资源的建立是一个渐进累积的过程，本公司经过17年的发展，目前已在行业内拥有较高知名度，并与客户建立

了良好合作的关系，在客户资源方面已形成明显的先发优势。最近三年一期，公司客户数量分别为304个、360个、442个、452个。客户类型分为PCB贸易商、EMS公司、国外PCB生产企业（如DDi因成本因素向中国PCB生产商转移生产订单）、PCB设计公司和终端客户五类客户。

B、客户质量

目前与公司合作的大部分客户为PCB行业相关领域的国内外知名企业，客户质量优良，如终端客户中艾默生网络能源有限公司（以下简称“艾默生”）、Bosch、欧姆龙、Allied Telesis(HongKong)Ltd；PCB贸易商中的P.D.Circuits, Inc.和Kestrel International Circuits Ltd；PCB设计公司中的Palpilot和深圳汉普电子；PCB生产企业如PCB TECHNOLOGIES LTD和DDi；EMS公司如SVI PUBLIC COMPANY LIMITED和捷普电子有限公司等。该等客户经营稳健、管理规范、信誉卓著，本公司与该等优质客户的合作一方面保障了货款的及时回收，同时促进了本公司技术水平的不断提高、服务质量的不断改进，另一方面也使得本公司管理理念、管理模式、管理手段以及管理工具的运用水平得以提升，在同行业中达到较高的水平。

公司客户类型及行业地位

客户类型	主要客户	客户行业地位
PCB 设计公司	Palpilot	美国最大的 PCB 设计公司之一
	深圳汉普电子技术开发有限公司	国内知名的 PCB 设计公司之一
PCB 生产企业	PCB TECHNOLOGIES LTD	以色列 PCB 上市公司，为客户提供 PCB 设计、生产、销售的一站式服务。
	DDi	全球最大的“多品种、小批量”PCB 制造企业
	Schoeller-Electronics GmbH	欧洲领先的 PCB 制造企业
EMS 公司	SVI PUBLIC COMPANY LIMITED（世纬电子）	泰国知名 EMS 上市公司
	捷普电子有限公司	美国上市企业，EMS 公司全球排名第三位
PCB 贸易商	Kestrel international circuits ltd.	英国知名 PCB 代理公司，主要从事 PCB 样板和批量板的代理销售。是 Falcon PCB Group 旗下的 PCB 代理公司，由 PCB 工厂转型而来
	P.D. Circuits, Inc.	美国著名 PCB 代理公司之一。主要经营 PCB 板的供应，能提供从工程、设计到生产、品质、物流及仓储管理全套服务

终端客户	Allied Telesis(HongKong) Ltd	隶属于安奈特集团，该集团在世界以太网解决方案领域中占据领先地位
	欧姆龙	全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商
	艾默生网络能源有限公司	世界 500 强,主要生产各类高端电源产品，主要 PCB 需求为电源电子（厚铜板）
	武汉烽火通信科技股份有限公司	国内信息通信设备领域龙头企业之一
	Bosch GmbH（博世）	世界 500 强，全球著名汽车技术供应商
	瑞谷科技（深圳）有限公司	国内知名高端电源研发、制造企业

本公司十分重视与优质客户的长期战略合作关系，积极配合客户进行项目研发和产品设计，努力成为其供应链中重要一环。报告期内，本公司与各主要客户的订单金额实现了较大增长。

近三年主要客户的销售增长情况

单位：万元

客户类型	客户名称	首次合作时间	2009 年	2010 年		2011 年	
			销售金额	销售金额	增长比例	销售金额	增长比例
PCB 贸易商	Kestrel international circuits ltd	2004 年 12 月	648.52	3,926.94	505.52%	3,913.96	-0.33%
终端客户	ALLIED TELESIS (HONGKONG) LTD	2006 年 3 月	598.42	786.23	31.38%	1,249.08	58.87%
	欧姆龙	2004 年 7 月	42.16	367.27	771.13%	310.00	-15.59%
PCB 设计公司	Palpilot	2005 年 7 月	4,292.09	10,087.72	135.03%	14,482.26	43.56%
PCB 生产企业	DDi	2008 年 11 月	687.5	1,799.10	161.69%	2,267.25	26.02%
EMS 公司	SVI PUBLIC COMPANY LIMITED	2005 年 9 月	875.99	1,998.93	128.19%	2,267.65	13.44%

2、相对国外竞争对手的优势

（1）成本优势

与国外同行相比，本公司在成本方面有明显的优势，主要体现在人力成本和原材料采购成本上。

波士顿咨询公司的统计数据表明，欧美发达国家工人每小时的工资在15至30美元之间，而中国工人每小时的工资约1美元，工资的差距超过十倍。虽然近年来中国工人的工资不断上调，但中国和发达国家在劳动力成本上的巨大差距难以

在短期内消失。

2011年中国PCB产值219.38亿美元，占全世界总产值的39.60%，是PCB行业产值最大的地区，上游配套的原材料供应与欧美国家相比更完备、成本更低。波士顿咨询公司的研究数据表明，在中国进行原材料采购的跨国公司大约能实现20%~40%的成本节约。原材料低成本优势来自于几个因素：更低的人力成本、更低的资本投资成本、更低的本地采购成本、更大的经济规模以及政府的激励。

2009年~2011年，本公司营业成本占营业收入的比例为65%左右，而行业龙头DDi营业成本占营业收入的比例约为80%，两者相差15%，本公司成本优势十分明显。

（2）产业链完整

中国规模庞大、日趋完善的电子产品产业链是公司较之国外竞争对手的又一大优势。中国已成为全球最重要的电子制造基地，全球大部分EMS公司都在中国设立生产制造中心，连全球电子展览的重心也由欧美国家向中国转移。

产业链完整的优势主要表现在以下几个方面：一是原材料品种齐全，采购快捷且成本低；二是贴近下游客户，响应时间快；三是聚集了一大批富有创新能力的研发设计人员；四是销售渠道广阔，物流方便快捷；五是商业信息传播迅速，技术交流频繁，企业互生互惠。

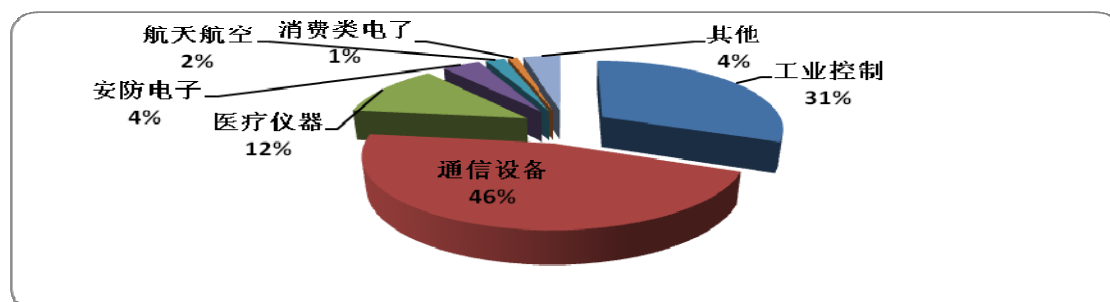
六、发行人的主营业务情况

（一）发行人的主要产品及用途

本公司主要产品为小批量PCB，产品类型覆盖HDI板、背板、厚铜板、软硬结合板、埋容板、高多层板、立体板、铝基板、高频板等，可一站式满足客户对多品种小批量PCB产品的需求。

本公司产品主要应用领域为通信设备、工业控制、电源电子、医疗仪器、安防电子、航天航空等高科技领域。本公司也有约1%的产品应用于消费类电子的高端产品，主要包括触摸屏、航空模型。

1、按照应用领域分类：



注：由于本公司产品约 20%销售给终端客户，约 80%通过 PCB 贸易商、PCB 设计公司、国外 PCB 生产企业、EMS 公司等方式销售，上图中的比例系根据销售人员在销售过程中的统计以及和客户的沟通估计得出，可能与实际应用比例存在一定差异。

2、按照技术档次分类

按产品技术档次分类，本公司产品分为高端板和中低端板，高端板包括高层板、特殊板、HDI 板，其中高层板是指层数在 8 层及 8 层以上的线路板产品；特殊板包括厚铜板、电厚金板、铝基板、高散热板、高频板、阶梯板、软硬结合板等，公司生产的特殊板中主要以厚铜板为主；中低端板是指层数在 8 层以下的线路板产品。

报告期内，本公司不同技术档次产品的构成如下：

单位：万元

产品类别	2012 年 1—6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一、高端板	28,768.59	55.55	50,307.44	53.65	38,809.80	50.69	21,822.46	50.95
二、中低端板	23,021.27	44.45	43,470.85	46.35	37,745.80	49.31	21,005.25	49.05
合计	51,789.86	100.00	93,778.29	100.00	76,555.60	100.00	42,827.71	100.00

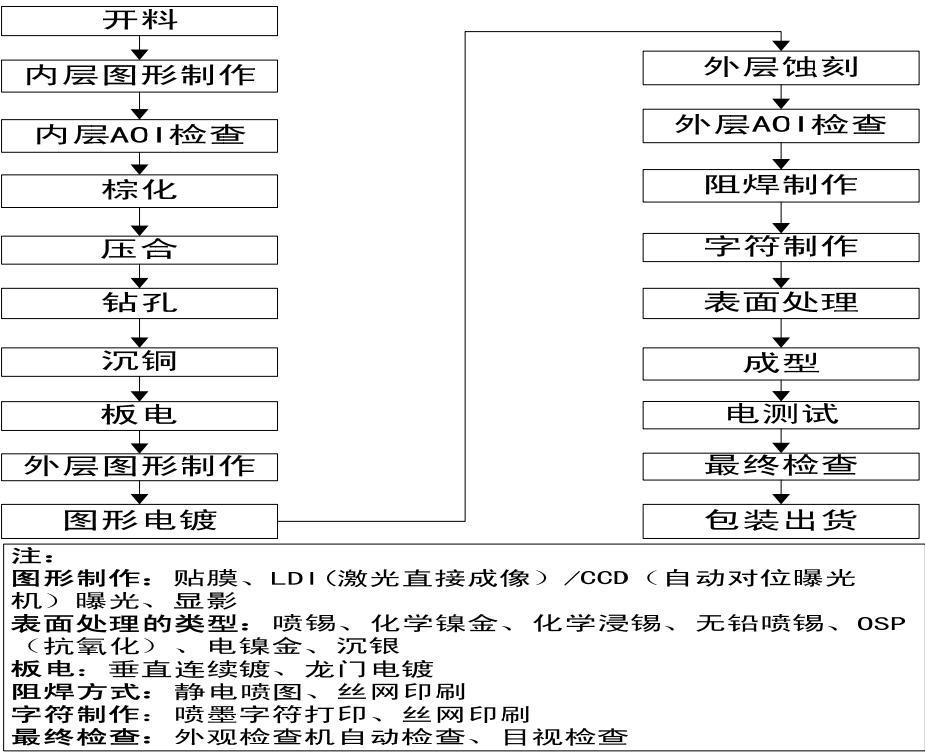
本公司根据客户需求和市场发展的趋势，不断加强产品的升级换代，提高产品的技术水平，优化产品结构。

（二）主要产品的工艺流程

PCB 行业由于产品的要求不同，生产工艺略有不同，但其主要的生产过程比较相似：开料—表面清洗—内层图形制作（贴膜、曝光、显影、蚀刻）—内层 AOI 检查—棕化—压合—钻孔—孔金属化—外层图形制作—图形电镀—外层蚀刻

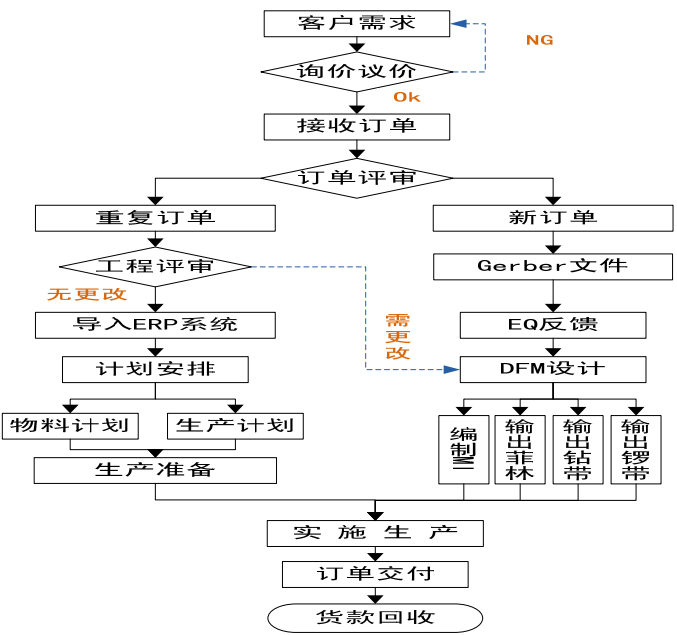
—外层 AOI 检查—阻焊制作—表面处理制作—成型加工—电测试—最终检查—包装出货。

本公司产品的工艺流程图如下：



（三）主要经营模式

公司的业务流程图



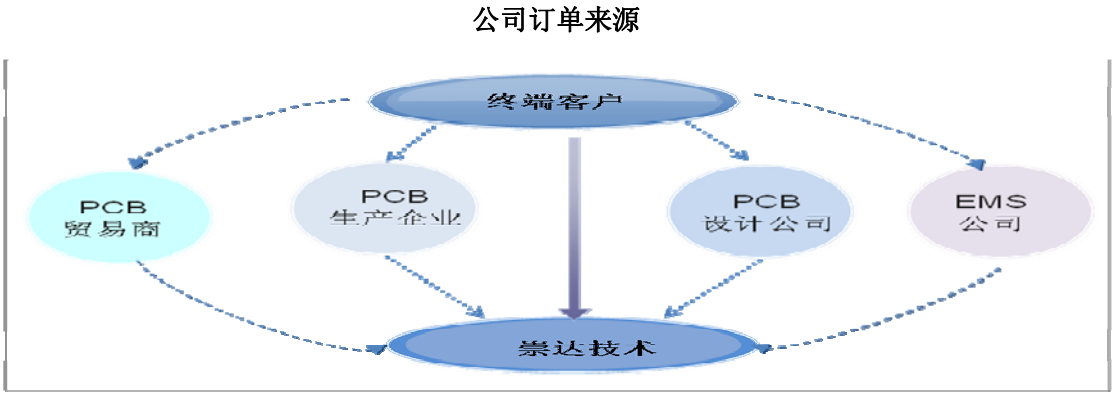
注：

- ① Gerber 文件：Gerber 的意思是：一种程序文件，包含了 PCB 所有的制作信息，它是一个 PCB 专业术语，通常就是客户所需要制作的板的资料。
- ② EQ 反馈：EQ (engineering query) feedback，EQ 的意思是：工程问答。
- ③ DFM 设计：DFM (Design For Manufacture) design, 为制造而设计。

1、销售模式

(1) 客户类型和销售渠道

本公司产品品种和客户数量较多，客户类型包括 PCB 贸易商、EMS 公司、PCB 生产企业、PCB 设计公司及终端客户等 5 类。



① PCB 贸易商

国外的几乎所有中小型终端客户和部分大型终端客户为了降低采购成本，往往将需求提交给国外PCB贸易商，PCB贸易商汇集需求后代理其向公司提交订单。

② EMS公司

EMS（Electronic Manufacturing Services），即电子制造服务，指为电子产品类客户提供包括产品设计、代工生产、产品维修等服务的厂商。EMS公司按其生产的产品不同，也存在对PCB大批量、小批量需求的区分。目前与公司合作的EMS公司主要从事小批量下游行业产品生产。

③ PCB生产企业

随着欧美小批量 PCB 生产利润空间的下降，欧美小批量板厂商逐渐开始在

中国寻找专业的小批量 PCB 生产企业开展合作，并将部分中低端产品订单转移到中国进行。全球最大的小批量 PCB 生产企业 DDi 在 2008 年与公司建立了合作关系，订单金额逐年上升。

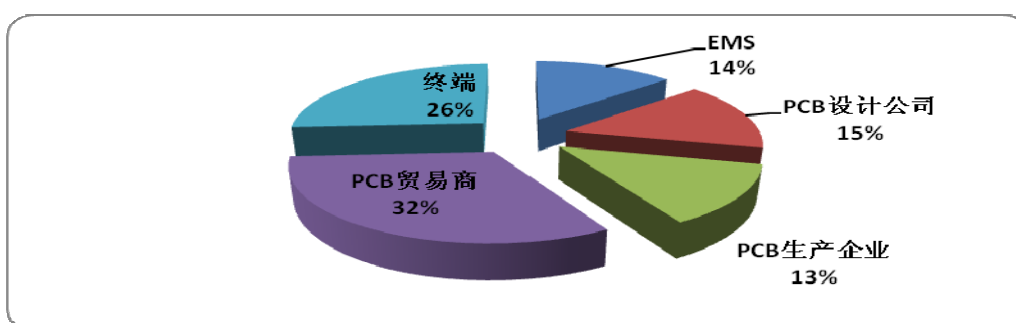
④ PCB设计公司

专门的 PCB 设计公司与客户直接关联，并与 PCB 生产厂商也建立一定的合作关系。大批量的 PCB 客户由于所需的 PCB 量大品种相对较少，客户一般自身会配备设计人员负责 PCB 的设计工作，而对于小批量 PCB 客户而言，由于需要的 PCB 品种较多，自己配备设计人员管理难度、生产成本极大，因此逐渐产生象美国的 Palpilot、中国的汉普电子等专业从事 PCB 设计并与小批量 PCB 客户进行合作的公司。这些 PCB 设计公司实际上并不仅仅负责 PCB 设计的任务，而兼具了 PCB 贸易商的功能，设计公司完成了 PCB 设计任务之后象 PCB 贸易商一样汇集客户的需求并向 PCB 生产企业提交订单，从而减少客户再重新寻找生产厂家的成本。

⑤ 终端客户

终端客户主要是在通信设备、工业控制、医疗仪器等行业中存在小批量 PCB 需求的用户。包括国内外大型终端客户和国内的中小型终端客户。

2011 年，不同类型客户采购金额占公司销售总额的比重如下：



(2) 销售模式

为了对客户和订单进行有效管理，本公司设立了销售部，采取统一对外销售的形式。销售部具有完整的销售业务体系。销售部下设国内销售部和国际销售部，分别负责国内外市场。

根据公司客户类型和国内外市场的特点，本公司采取直销和经销两种销售模式。直销模式是对国内外终端客户以及国外的PCB设计公司、EMS公司、PCB生产企业等直接客户进行销售，经销模式是通过国外PCB贸易商进行销售。销售部根据国内外客户作息时间的不同，实行24小时服务制，充分以客户为中心，满足客户需求。

报告期内，本公司营业收入按经销模式和直销模式划分如下：

销售类型	2012年1—6月		2011年		2010年		2009年	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
直销	35,591.20	68.72	63,393.59	67.60	50,406.03	65.84	29,536.14	68.97
经销	16,198.66	31.28	30,384.70	32.40	26,149.57	34.16	13,291.57	31.03
合计	51,789.86	100.00	93,778.29	100.00	76,555.60	100.00	42,827.71	100.00

从上表可以看出，公司直销收入占比保持在70%左右，经销收入占比保持在30%左右，公司销售模式在报告期内没有发生重大变化。

2、采购模式

本公司主营业务为小批量 PCB，产品需要的原材料品种较多，单次的需求量较小，为此公司制定了相配套的采购机制和库存标准，并且采用先进的物料应用系统进行自动化和流程化控制，以适应小批量生产模式的需要，及时有效地供给生产。

本公司的主要原材料包括：覆铜板、半固化片、铜箔、氰化金钾、磷铜球、油墨等，其中除覆铜板需要批量采购外，其他原材料多根据订单的品种和数量进行采购。原材料品种较多，采购和库存管理较为复杂，本公司经过多年的积累和创新，成功研发设计了拥有自主知识产权的物料应用系统。运用这一系统对种类繁杂的物料进行合理控制，方便统计每月物料入库金额、消耗金额、在库金额、物料申请、物料采购、供应商准时交货率及无纸化操作等，让管理者能及时了解物料库存金额、库存周转率、每月物料耗用量、物料采购周期、物料单价变动，从而达到对物料成本的精准控制。

3、生产模式

本公司根据小批量的市场定位，采取“以销定产”的生产模式，实行柔性化生产。

由于公司下游客户行业范围广、数量多，客户订单品种数量多，单个订单面积小，导致生产过程的订单连续性不强，经常交替生产，生产工具准备工作量大，生产管理较为繁琐，生产中的质量控制不易把控。因此如何安排繁多品种产品的排线生产，如何保证各个生产环节的衔接性，如何做好各个产品的质量控制等就成了生产所要解决的问题。本公司经过多年的积累创新，成功引入柔性化生产和管理，结合先进的 ERP 系统，通过制定生产 WIP 表（生产流程排划表）和 LOT 卡（产品生产批量管制卡），安排各种产品有序进线生产，保证繁多品种的排线生产；通过专业技能培训，让生产线操作人员熟练掌握 2~3 个相连工序的生产操作技术，便于方便机动调节人员配置，保证生产的衔接顺畅；通过对关键工序的集中质量控制并配合 PQA（制程品质稽核），做好产品的质量控制工作。

本公司通过对系统结构、人员组织、运作方式、市场营销、管理方式和软件等方面的优化改革，实行柔性化生产和管理，建立柔性化的生产线，合理规划生产组织方式及人员配备，根据客户产品的工艺需求，对生产流程和人员进行合理配置，使公司的整个生产系统能够对客户纷繁多样的需求作出及时、快速的响应。采用高柔性化的生产线和柔性管理方法灵活生产以适应市场变化的产品，满足各种客户的多样化需求。

本公司及深圳崇达、大连崇达两家子公司定位分工明确，能充分满足高、中、低端客户的需求。公司及深圳崇达、大连崇达的生产定位情况如下：

公司名称	生产定位
崇达技术	主要生产 4 层到 6 层的 PCB
深圳崇达	主要生产 6 层以上的 PCB、HDI 及特殊板
大连崇达	主要生产双面板

（四）主要产品的产销情况

1、产品的产能和产销情况

项目	2012年1—6月	2011年	2010年	2009年
产能（平方米）	372,000	660,000	612,000	374,220
产量（平方米）	330,286	576,905	508,696	300,724
产能利用率	88.79%	87.41%	83.12%	80.36%
销量（平方米）	328,233	581,470	503,508	295,925
销售收入（万元）	51,789.86	93,778.29	76,555.60	42,827.71
产销率	99.39%	100.79%	98.98%	98.40%

报告期内，本公司总体的产能利用率较高。2009年，受金融危机的影响，公司订单面积下降，产量下滑，从而导致产能利用率有所下降。2010年，本公司宝安区沙井生产线投产，产能相比2009年增加，基本能够满足2010年生产经营的需要。2011年产能利用率达到87.41%，随着公司订单的大量增加，未来几年内本公司仍面临着产能不足的困境；同时，作为小批量PCB制造企业，产能利用率过高不利于公司进一步缩短交货期。虽然报告期内，本公司已经购置了部分生产设备，扩大现有产能，但是受到场地面积、资金压力等因素的影响，公司现有产能的进一步扩张受到制约。

报告期内，本公司平均产销率为99.39%，与公司的经营模式相适应，由于公司采用“以销定产”的生产模式，在接到客户订单后再组织生产，因此，公司库存商品保持在较低水平，产销率较高。

2、订单情况分析

按客户订单面积划分，报告期内，本公司的订单情况如下：

单位：个

订单面积	2012年1—6月		2011年		2010年		2009年	
	个数	比例(%)	个数	比例(%)	个数	比例(%)	个数	比例(%)
0—50平方米	44,332	98.30	68,438	97.59	59,141	97.79	37,126	97.79
其中：5平方米以下	29,594	65.62	42,725	60.93	36,062	59.63	24,403	64.28
5-10平方米	7,467	16.56	12,559	17.91	11,568	19.13	6,360	16.75

10-20 平方米	4,556	10.10	8,185	11.67	7,306	12.08	4,078	10.74
20-50 平方米	2,715	6.02	4,969	7.09	4,205	6.95	2,285	6.02
50 平方米以上	767	1.70	1,689	2.41	1,336	2.21	840	2.21
合计	45,099	100.00	70,127	100.00	60,477	100.00	37,966	100.00

报告期内，本公司单个订单面积在 50 平方米以下的订单数量分别为 37,126 个、59,141 个、68,438 个、44,332 个，分别占公司订单总数的 97.79%、97.79%、97.59%、98.30%。报告期内，公司订单的均单面积分别为 7.79 平方米、8.33 平方米、8.29 平方米、7.28 平方米，与公司专注于小批量的业务定位相符。

3、产品按照技术档次分类

报告期内，本公司不同技术档次产品的销售构成如下：

单位：万元

产品类别	2012 年 1—6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一、高端板	28,768.59	55.55	50,307.44	53.65	38,809.80	50.69	21,822.46	50.95
二、中低端板	23,021.27	44.45	43,470.85	46.35	37,745.80	49.31	21,005.25	49.05
合计	51,789.86	100.00	93,778.29	100.00	76,555.60	100.00	42,827.71	100.00

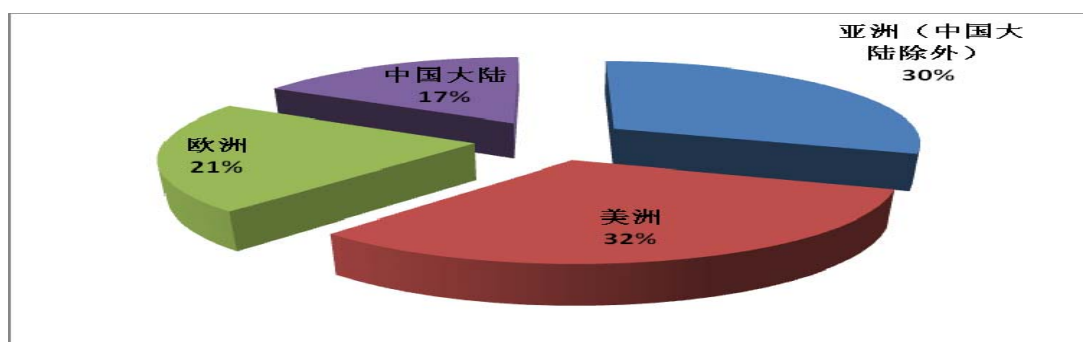
报告期内高端板的销售比重持续上升。

4、销售收入地区分布

本公司主要产品按销售区域列示如下：

区域	2012 年 1—6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
内销	8,710.66	16.82	16,043.72	17.11	12,808.62	16.73	12,474.05	29.13
外销	43,079.20	83.18	77,734.57	82.89	63,746.98	83.27	30,353.66	70.87
合计	51,789.86	100.00	93,778.29	100.00	76,555.60	100.00	42,827.71	100.00

报告期内，公司外销收入比例保持在 70%以上，外销比重较大。2011 年销售区域分布情况如下：



本公司外销区域主要集中在欧洲、美洲和除中国之外的亚洲其他地区。

5、前五名客户销售情况

（1）报告期内，本公司向前五名客户的销售情况如下表所示：

年份	客户名称	销售金额 (万元)	占当期销售总额 的比例
2012 年 1—6 月	Palpilot International Corp.	8,014.54	15.08%
	PCB TECHNOLOGIES LTD	3,238.43	6.09%
	Suntech Circuits, Inc.	1,855.44	3.49%
	DDI	1,555.24	2.93%
	P.D. Circuits, Inc.	1,506.12	2.83%
	合 计	16,169.78	30.42 %
2011 年	Palpilot International Corp.	14,482.26	14.99%
	PCB TECHNOLOGIES LTD	6,471.71	6.70%
	Kestrel International Circuits	3,913.96	4.05%
	P.D. Circuits, Inc.	3,901.37	4.04%
	SUNTECH CIRCUITS INC.	3,175.21	3.29%
	合 计	31,944.51	33.07%
2010 年	Palpilot International Corp.	10,087.72	12.89%
	PCB TECHNOLOGIES LTD	5,467.46	6.98%
	P.D. Circuits, Inc.	4,485.95	5.73%
	Kestrel International Circuits	3,926.94	5.02%
	SUNTECH CIRCUITS INC.	2,080.56	2.66%
	合 计	26,048.63	33.27%
2009 年	Palpilot International Corp.	4,292.09	9.84%
	艾默生网络能源有限公司	3,933.29	9.02%
	PCB TECHNOLOGIES LTD	2,591.83	5.94%
	P.D. Circuits, Inc.	2,127.98	4.88%

	瑞谷科技（深圳）有限公司	2,117.15	4.86%
	合 计	15,062.34	34.54%

注： Palpilot International Corp 的销售金额包括 Palpilot International Corp 与 Palpilot International Corp (S) 两家公司合计数据，两公司为同一集团控制下的公司，本表将其合并列示。

艾默生网络能源有限公司（以下简称“艾默生”）向公司购买的主要产品为厚铜板，属于特殊板，其主要用于通讯基站电源板。艾默生 2010 年和 2011 年退出前五大客户的原因主要是：艾默生于 2010 年对自身业务进行了重新整合，通讯电源业务减少，因此对公司的厚铜板需求减少。而与艾默生同受美国艾默生公司（Emerson Electric Co.）控制下的其他公司雅达电子有限公司、雅达电源制品（深圳）有限公司、Astec Power (Phi) Inc.及 Artesyn Technologies Asia-Pacific Ltd 电源业务发展较快，对公司的厚铜板需求相应增加。报告期内，若将艾默生及受同一集团控制下的其他公司合并统计，销售情况如下：

单位：万元

客户	2012 年 1—6 月	2011 年	2010 年	2009 年
雅达电子有限公司	48.16	1,031.16	714.78	428.26
Astec	620.12	705.47	585.07	242.82
Artesyn Technologies Asia-Pacific Ltd	285.86	406.31	157.53	38.24
雅达电源制品（深圳）有限公司	3.13	35.98	-	-
小计	957.27	2,178.93	1,457.37	709.32
艾默生网络能源有限公司	129.7	525.61	1,809.76	3,933.29
合计	1,086.97	2,704.53	3,267.13	4,642.61

综上，艾默生 2010 年、2011 年与公司业务减少，系艾默生内部业务调整所致，公司对艾默生及受同一集团控制下其他公司的销售金额较为稳定。

公司对艾默生及同受美国艾默生公司（Emerson Electric Co.）控制下的雅达电子有限公司、雅达电源制品（深圳）有限公司、Astec Power (Phi) Inc.及 Artesyn Technologies Asia-Pacific Ltd 销售额未合并披露，主要原因为上述公司虽与艾默生同受美国艾默生公司控制，但采购计划、采购渠道和管理人员相互独立，均与公司单独签订采购合同，独立下单、独立付款，不受集团的统一控制，故未对上述公司的销售合并列示。

（2）报告期内，本公司外销业务经销商前五大客户的销售情况如下：

序号	客户名称	收入金额（万元）	占外销收入比重
2012 年 1—6 月			
1	Suntech Circuits, Inc.	1,855.44	4.31%
2	P.D. Circuits, Inc.	1,506.12	3.50%
3	Kestrel international circuits ltd	1,440.57	3.34%
4	EPEC LLC	1,006.45	2.34%
5	Prodigy Electronics Ltd.	953.01	2.21%
	合计	6,761.59	15.70%
2011 年			
1	Kestrel international circuits ltd	3,913.96	5.04%
2	P.D. CIRCUITS, INC.	3,901.37	5.02%
3	Suntech Circuits, Inc.	3,175.21	4.08%
4	EPEC LLC	2,224.75	2.86%
5	PCB Vision LTD	1,971.80	2.54%
	合计	15,187.09	19.54%
2010 年			
1	P.D. CIRCUITS, INC.	4,485.95	7.04%
2	Kestrel international circuits ltd	3,926.94	6.16%
3	Suntech Circuits, Inc.	2,080.56	3.26%
4	EPEC LLC	1,859.19	2.92%
5	PCB VISION LTD	1,780.92	2.79%
	合计	14,133.56	22.17%
2009 年			
1	P.D. Circuits, Inc.	2,127.98	7.01%
2	PCB VISION LTD	1,157.73	3.81%
3	Suntech Circuits, Inc.	1,134.35	3.74%
4	EPEC LLC	1,014.84	3.34%
5	NCAB SWEDEN	654.31	2.16%
	合计	6,089.21	20.06%

① 英国 KESTREL International Circuits 成为公司前五大客户的说明

KESTREL International Circuits（以下简称“KESTREL”）是一家英国知名的 PCB 贸易商，成立于 1997 年 1 月 21 日，主要经销中小批量 PCB 板。KESTREL 隶属于 Falcon PCB Group，Falcon PCB Group 是一家英国领先的 PCB 提供商，其子公司 Merlin Circuit 是英国知名的 PCB 制造商，而 KESTREL 主要从事 PCB

板的采购和销售。

KESTREL 自 2004 年 11 月开始与企业合作，历年销售金额如下：

年度	销售金额（万元）	年度	销售金额（万元）
2005 年	742.05	2009 年	648.52
2006 年	898.99	2010 年	3,926.94
2007 年	1,239.27	2011 年	3,913.96
2008 年	1,479.39	2012 年 1—6 月	1,440.57

从上表可以看出，KESTREL 与企业合作保持良好的合作关系，除 2009 年销售金额减少外，其他年份的销售额一直呈增长趋势，2011 年与 2010 年基本保持平稳。2009 年，KESTREL 采购金额减少，主要原因为受全球金融危机影响，PCB 下游需求萎缩。

由于金融危机的影响，欧洲 PCB 行业也经历了优胜劣汰，KESTREL 通过收购兼并，客户资源增加，贸易规模快速扩张。随着全球经济逐步复苏，KESTREL 对 PCB 产品的需求增长迅速，企业凭借优异的产品质量及与 KESTREL 的长期良好合作关系，2010 年，从 KESTREL 承接的订单增长迅速，销售金额分别达到 3,926.94 万元，KESTREL 成为企业的前五大客户。从经销商客户口径看，2010 年、2011 年和 2012 年 1—6 月，KESTREL 为企业前五大经销商客户。

② 美国 Suntech Circuits,Inc.成为企业前五大客户的说明

Suntech Circuits,Inc.位于美国亚利桑那州，成立于 1991 年。该企业前身是美国中部的一家 PCB 制造商，随着美国 PCB 产业向海外的转移，该工厂转型成为 PCB 贸易商，提供从工程、设计到生产、品质、物流及仓储管理的全程 PCB 贸易服务。

Suntech Circuits,Inc.自 2008 年 5 月开始与企业合作，历年销售金额如下：

年度	销售金额（万元）	年度	销售金额（万元）
2008 年	73.26	2011 年	3,175.21
2009 年	1,134.35	2012 年 1—6 月	1,855.44
2010 年	2,080.56		

从上表可以看出，Suntech Circuits,Inc.自 2008 年 5 月与企业合作以来，业务

量一直呈现上升趋势，2010 年及 2011 年成为前五大客户。从经销商口径看，Suntech Circuits, Inc. 2009 年、2010 年、2011 年和 2012 年 1—6 月均为公司前五大经销商客户。

③ Prodigy Electronics Ltd. 成为公司前五大客户的说明

Prodigy Electronics Ltd. 是一家以印度客户为中心的香港贸易公司，终端客户以通讯、工控产品为主，与本公司合作已有近十年时间，报告期内交易金额逐年上升，一直为公司前十大经销商客户。最近三年一期与本公司交易金额如下：

年度	销售金额（万元）	年度	销售金额（万元）
2009 年	953.16	2011 年	1,339.63
2010 年	1,251.82	2012 年 1—6 月	953.01

报告期内，外销业务经销前五大客户的基本情况介绍

序号	主要经销客户	客户基本情况
1	Kestrel international circuits ltd	英国知名 PCB 代理公司，主要从事 PCB 样板和批量板的代理销售。是 Falcon PCB Group 旗下的 PCB 代理公司，由 PCB 工厂转型而来
2	P.D. CIRCUITS, INC.	美国著名 PCB 代理公司之一。主要经营 PCB 板的供应，能提供从工程、设计到生产、品质、物流及仓储管理全套服务
3	Suntech Circuits, Inc.	该公司前身是美国中部的一家 PCB 制造商，随着美国 PCB 产业向海外的转移，该工厂转型成为 PCB 贸易商，提供从工程、设计到生产、品质、物流及仓储管理的全程 PCB 贸易服务
4	EPEC LLC	该公司是美国的一家 PCB 贸易商，拥有行业领先的物流供应平台和技术队伍全面为客户产品的生命周期管理服务。
5	PCB Vision LTD	PCB VISION 是一家香港 PCB 贸易商，在中国有超过 10 年的 PCB 贸易经验，其为不同行业提供专业的 PCB 设计、制造及外包服务。
6	Prodigy Electronics Ltd.	一家以印度客户为中心的香港贸易公司，终端客户以通讯、工控产品为主

（3）报告期内，本公司外销业务直销前五大客户的销售情况如下：

序号	客户名称	收入金额（万元）	占外销收入比重
2012 年 1—6 月			
1	Palpilot International Corp.	8,014.54	18.60%
2	PCB TECHNOLOGIES LTD	3,238.43	7.52%
3	DDi	1,555.24	3.61%
4	SVI PUBLIC COMPANY LIMITED	1,298.65	3.01%
5	PartnerTech China Limited	482.35	1.12%

	合计	14,589.22	33.87%
2011 年			
1	Palpilot International Corp.	14,482.26	18.63%
2	PCB TECHNOLOGIES LTD	6,471.71	8.33%
3	SVI PUBLIC COMPANY LIMITED	2,267.65	2.92%
4	DDi	2,267.25	2.92%
5	Allied Telesis(HongKong) Ltd	1,249.08	1.61%
	合计	26,737.94	34.40%
2010 年			
1	Palpilot International Corp.	10,087.72	15.82%
2	PCB TECHNOLOGIES LTD	5,467.46	8.58%
3	SVI PUBLIC COMPANY LIMITED	1,998.93	3.14%
4	DDi	1,799.10	2.82%
5	BOSCH GmbH	1,066.22	1.67%
	合计	20,419.42	32.03%
2009 年			
1	Palpilot International Corp.	4,292.08	14.14%
2	PCB TECHNOLOGIES LTD	2,591.83	8.54%
3	SVI PUBLIC COMPANY LTD	875.99	2.89%
4	Allied Telesis(HongKong) Ltd	598.42	1.97%
5	DDi	687.50	2.26%
	合计	9,045.82	29.80%

报告期内，外销业务直销前五大客户的基本情况介绍

客户类型	外销业务 主要直销客户	客户行业地位	PCB 业务增值环节
PCB 设计公司	Palpilot International Corp.	美国最大的 PCB 设计公司之一	PCB 设计公司接到终端客户的电路图后，按照客户需求设计 PCB 板，完成设计工作后交由崇达技术进行生产，经其检验检测后交付给终端客户
PCB 生产企业	PCB TECHNOLOGIES LTD	以色列 PCB 上市公司，为客户提供 PCB 设计、生产、销售的一站式服务。	PCB 生产企业将自身获得的订单转交给崇达技术生产，以获取成本优势，或者弥补调节自身产能的利用率，但 PCB 生产企业收到崇达技术交付的产品后，会通过自身的标准进行检验、检测或再加工（通常是附加值最高或技术难度最大的环节）。
	DDi	全球最大的“多品种、小批量”PCB 制造企业	
EMS 公司	SVI PUBLIC COMPANY LIMITED（世纬电子）	泰国知名 EMS 上市公司	EMS 即是电子制造服务商，通过代工模式帮助客户实现增值需求。PCB 是 EMS 制造工程中所需要的众多的元器件或元部件之一，EMS 公司将购置的 PCB 与其他元器件进行组合或加工，为客户提供代工服务。
	PartnerTech China	瑞典上市公司	

	Limited		
终端客户	Bosch GmbH (博世)	世界 500 强，全球著名汽车技术供应商	崇达技术直接按照客户需求进行生产。
	Allied Telesis(HongKong) Ltd	隶属于安奈特集团，该集团在世界以太网解决方案领域中占据领先地位	

报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过 50%或严重依赖少数客户的情况。本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东未在上述客户中拥有权益。

（五）原材料和能源供应情况

1、主要原材料供应情况

本公司生产 PCB 所需的主要原材料包括：覆铜板、半固化片、铜箔、氰化金钾、铜球和油墨等。

报告期内，本公司原材料的主要采购情况以及占原材料采购总额的比重如下：

原材料	2012 年 1—6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	采购金额 (万元)	比例 (%)	采购金额 (万元)	比例 (%)	采购金额 (万元)	比例 (%)	采购金额 (万元)	比例 (%)
覆铜板	9,323.96	36.83	15,303.31	34.17	13,803.41	36.45	7,006.61	36.19
半固化片	2,664.05	10.52	4,910.15	10.96	4,070.31	10.75	2,261.90	11.68
铜球	1,316.73	5.20	2,593.81	5.79	1,863.46	4.92	835.94	4.32
氰化金钾	2,611.29	10.31	4,480.43	10.00	3,048.14	8.05	1,306.81	6.75
铜箔	1,470.33	5.81	2,468.45	5.51	2,226.48	5.88	1,055.89	5.45
油墨	880.41	3.48	1,411.29	3.15	1,106.08	2.92	724.74	3.74
其他	7,052.30	27.85	13,624.35	30.42	11,753.79	31.04	6,169.32	31.86
合计	25,319.07	100.00	44,791.79	100.00	37,871.67	100.00	19,361.21	100.00

2、原材料的进口情况

报告期内，本公司进口原材料采购情况如下：

单位：万元

原材料	2012 年 1—6 月	2011 年	2010 年	2009 年
覆铜板	5,230.45	8,324.50	9,996.32	4,219.94

半固化片	1,983.75	3,179.63	2,467.34	1,592.48
铜箔	595.36	1,454.98	1,421.10	128.55
油墨	535.90	865.44	751.29	326.19
铜球	-	-	-	49.98
其他	8.67	12.03	17.62	7.52
合计	8,354.13	13,836.57	14,653.66	6,324.66
占原材料采购总额的比例	33.00%	30.89%	38.69%	32.67%

3、主要原材料和能源的价格占销售成本的比重情况

报告期内，本公司单位销售成本中耗用原材料与能源的金额和比重如下：

单位：万元

项目	2012 年 1—6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	666.55	62.92%	714.93	65.60%	633.16	64.77%	584.11	60.63%
其中：覆铜板	261.28	24.67%	270.34	24.80%	243.41	24.90%	218.82	22.71%
半固化片	79.94	7.55%	83.28	7.64%	78.2	8.00%	76.58	7.95%
铜球	35.28	3.33%	42.00	3.85%	35.50	3.63%	27.88	2.89%
铜箔	41.19	3.89%	44.94	4.12%	37.09	3.79%	33.42	3.47%
氰化金钾	80.16	7.57%	74.66	6.85%	57.55	5.89%	42.72	4.43%
油墨	23.20	2.19%	22.91	2.10%	20.69	2.12%	17.43	1.81%
干膜	22.70	2.14%	25.37	2.33%	21.66	2.22%	24.53	2.55%
其他	122.79	11.59%	151.43	13.89%	139.06	14.23%	142.73	14.82%
水电费	67.03	6.33%	64.76	5.94%	62.56	6.40%	65.63	6.81%
合计	733.58	69.25%	779.69	71.54%	695.72	71.17%	649.74	67.44%

4、前五名供应商采购情况

报告期内，本公司向前五名供应商的采购情况如下表所示：

年份	供应商名称	采购材料名称	采购金额(万元)	占当期采购总额比例
2012 年 1—6 月	东莞联茂电子科技有限公司	覆铜板/半固化片	6,386.39	25.22%
	深圳富骏材料科技有限公司	氰化金钾	2,446.16	9.66%
	佛山市承安铜业有限公司	磷铜球	1,316.73	5.20%
	中山台光电子材料有限公司	覆铜板/半固化片	1,524.49	6.02%

	台耀科技（中山）有限公司	覆铜板/半固化片	1,062.82	4.20%
	合计		12,736.59	50.30%
2011 年	东莞联茂电子科技有限公司	覆铜板/半固化片	9,623.51	21.48%
	中山台光电子材料有限公司	覆铜板/半固化片	4,300.47	9.60%
	深圳富骏材料科技有限公司	氰化金钾	4,022.28	8.98%
	佛山市承安铜业有限公司	磷铜球	2,442.66	5.45%
	广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂	覆铜板/半固化片	1,723.80	3.85%
	合计		22,112.72	49.37%
2010 年	东莞联茂电子科技有限公司	覆铜板/半固化片	8,424.71	22.25%
	中山台光电子材料有限公司	覆铜板/半固化片	4,073.26	10.76%
	深圳富骏材料科技有限公司	氰化金钾	2,884.00	7.62%
	香港汕头华发展有限公司	覆铜板/半固化片	1,685.59	4.45%
	江门建滔积层板有限公司	覆铜板/半固化片	1,628.34	4.30%
	合计		18,695.90	49.37%
2009 年	广东生益科技股份有限公司	覆铜板/半固化片	2,905.80	15.01%
	东莞联茂电子科技有限公司	覆铜板/半固化片	2,515.71	12.99%
	香港汕头华发展有限公司	覆铜板/半固化片	984.01	5.08%
	中山台光电子材料有限公司	覆铜板/半固化片	865.19	4.47%
	广东汕头超声电子股份有限公司	覆铜板/半固化片	763.33	3.94%
	合计		8,034.04	41.50%

注：向广东生益科技股份有限公司采购金额为广东生益及其关联方香港生益的合计金额；向东莞联茂电子科技有限公司的采购金额为东莞联茂及其关联方香港联茂的合计金额；向中山台光电子材料有限公司采购金额为中山台光和香港台光的合计金额。

本公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况。本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中拥有权益。

（六）安全生产及环保情况

1、安全生产制度建设

安全生产制度建设是安全工作的重要内容，也是安全工作科学化的重要保证，本公司在安全生产制度建设中一直贯彻落实“三用”原则。

一是“可用”原则，“可用”是安全生产制度建设的基础。公司根据《中华

《中华人民共和国安全生产法》等国家、地方安全生产相关法律法规要求，并结合企业的生产经营特点、职工队伍状况制定了各项安全生产管理制度，主要包括：《安全生产责任制》、《安全检查制度》、《事故隐患排查治理制度》、《安全教育培训制度》、《工伤/事故管理规定》、《消防安全管理制度》、《安全生产奖惩制度》、《用电安全管理制度》、《设备维修保养制度》、《危险化学品管理制度》、《职业卫生管理规定》、《宿舍安全管理办法》、《劳保用品管理办法》等一系列规章制度。同时本公司还建立了安全生产检查及整改档案、安全教育培训档案、消防安全管理档案、工伤/事故管理档案、特种设备及特种作业人员管理档案、危险源管理档案、危险化学品管理档案、职业卫生健康管理档案、环境保护管理档案等安全档案，为顺利开展安全生产工作，杜绝事故隐患提供了理论依据和管理保障。

二是“好用”原则，增强制度可操作性。公司注重制度设计上力求细节具体化，力求刚性及量化原则，避免弹性过大，力戒讲空话，从而避免了为制度而制度的形式主义；公司更注重制度的程序设计，有完善的检查程序《安全检查制度》、民主监督程序《员工监督奖励制度》、奖励惩处程序《安全奖惩制度》。依据《安全教育培训制度》新员工入职后要经过三级安全培训方可上岗，从而形成了全员有意识，现场有人查，违规有人管，隐患早排除的良好氛围。

三是“管用”原则，提高制度的执行力。本公司组建了由总经理为第一责任人的安全管理委员会，设三名安全主任主持全公司安全管理工作，同时由专职安全全员负责日常的制度建设及信息收集、安全巡查、跟进整改、体系维护等工作，并将安全生产列入相关部门的绩效考核中，这样责任明确，有具体的部门和具体的人对各项制度的执行具体负责，行政部作为安全生产主管部门，督导各项规章制度的贯彻与落实，避免了制度执行中可能出现的“宽严不一”现象，使各项规章制度具有普遍的约束力。

在完善制度的同时，公司严格执行《危险化学品安全管理条例》的有关规定，聘请有危险化学品评价资质的安全评价机构，每年对所属各企业危险化学品使用、储存场所进行安全现状评价，每两年对危险化学品的使用、储存情况进行一次安全现状评价，并按报告上的安全对策措施与建议进行整改和管理提升。

深圳崇达于 2010 年被深圳市宝安区安全生产监督管理局授予“安全生产标杆企业机械安全生产三级企业”；2011 年荣获深圳市宝安区安全生产监督管理局“安全管理标杆企业”。

2、职业安全

(1) 防火防爆

本公司遵照《中华人民共和国消防法》和《建筑灭火器配置设计规范》要求，结合所属各企业防火防爆工作实际情况，贯彻“以防为主，防消结合”的方针，制订了《防火防爆管理制度》、《动火管理制度》、《危险化学品存储及使用制度》及《特种设备管理控制程序》等制度，全面强调健全消防组织，严格控制火源，妥善管理易燃物品，加强对压力容器设备的管理。在制定防火防爆措施时主要从四个方面考虑：

① 预防措施：各生产厂区道路畅通，形成消防环道，建筑时设置了室内外水道消防系统和消防栓，车间内隔断材料均选用的是甲级防火材料，顶部及天花板设置了消防喷淋头，地面按国家消防法规定配置了足够的灭火器，同时对火灾危险性较大的车间、化学品仓库均安装了烟感报警器，在使用和储存易燃易爆化学品的车间和仓库均安装了气体感应报警器，控制器安装在24小时值班的保安值班室，确保在发现易燃易爆气体浓度超标时做出及时反映，杜绝事故的发生。同时，易燃液体仓库的电气线路全部采用镀锌钢管套管敷设，使用防爆型灯具，将电气开关安装在室外，做到整体防爆；仓库内严禁使用铁制、钢制工具，严禁敲、打、碰、撞。在使用易燃液体的车间，严格控制每天领用量，严禁大面积使用易燃液体擦拭设备和地面。定期维修保养通风设备设施，确保正常运行，防止可燃气体混合物的积聚。公司还配有专职有资质的安全管理人员每天在线巡察，发现安全隐患及时通知相关部门排除整改。

② 限制措施：为在生产区内严格控制火种，实施全厂禁烟，同时依据《防火防爆管理制度》和《动火管理制度》相关规定，对企业内部和外来供应商施工动火程序严格监管，并要求现场必须配置足量的灭火器，同时保安实施密切监控。

③ 消防措施：公司制定了《事故应急处理预案》，同时成立了事故应急小

组，总经理为总指挥，两位安全主任为副总指挥，由各部门负责人担任各小组组长，按照《事故应急处理预案》程序分工明确，应变能力强，保安和车间中基层管理者作为防火防爆的主力队员，在事故发生时积极配合事故应急小组做好灭火和组织疏散工作，确保事故发生时可将损失和危害程度控制在最小范围。

④ 疏散措施：公司在生产和生活区域均配置了消防器械和各种防烟和吸氧式防毒面具，同时安装了应急灯和LED安全出口标识，确保在事故发生时能有效控制及人员的安全撤离。同时，公司每年组织不少于两次的消防和危化品泄漏演习，熟悉基本消防常识及各岗位逃生路线，确保应急预案的可操作性和提高全员的安全意识。

本公司及子公司均取得了当地消防局发放的消防验收合格报告。

（2） 电气安全

本公司电气安全工作分为两方面：一方面是根据各种电气事故的机理、原因、构成、特点、规律制定防护措施；另一方面是运用电气方法，即电气监测、电气检查和电气控制等方法来评价电力系统的安全性和解决生产中用电的安全问题，从而达到不因电气事故引起人员伤亡、设备损坏、财产损失及环境损害。

本公司在新建和改造中严把电气设计安全关，除满足生产需要外，还从设备选型，线路布置等方面结合生产特点全面保证生产安全用电，包括在生产过程中防止人身触电，电气防火防爆，防静电及防雷等方面的技术措施等等，厂房及其他辅助建筑物按三类防雷建筑物设置防雷接地装置，进出建筑物的各种金属管线均应与防雷接地装置相连。低压配电系统接地形式为 TN-S 系统，所有用电设备正常不带电的外露可导电部分均与 PE 线连接，所有电力设备均采用接零保护，以防止操作人员触电事故的发生，同时公司按相关法规要求取得了防雷证书。

（3） 防机械伤害

公司防机械伤害从两方面开展工作：

第一、保护操作者和有关人员安全：（1）员工上岗前都须通过三级安全培训，并通过考核持证上岗，提高了员工辨别危险的能力和避免伤害的能力；

（2）设备部制定了每一台设备的安全操作指引；（3）危险部位张贴醒目的警

示标志，时时刻刻提醒员工；（4）提供员工劳保用品及保护装置，监督员工，强制使用；（5）采取必要的行动增强避免伤害的自觉性；（6）生产车间在工艺设备布置上按安全规范留足安全防护间距，设备与建筑物之间也考虑了满足操作检修的安全距离和通道。

第二、消除机械的不安全状态，实现机械本质安全：（1）定期保养及检查机械完好状态；（2）消除产生危险的原因；（3）减少或消除接触机器的危险部件的次数；（4）危险机械部位均设置了安全防护装置，使员工难以接近机器的危险部位或接近这些部位也不会导致受伤害。

3、职业卫生

公司非常重视职业卫生健康工作，坚持“预防为主，防治结合，分类管理，综合治理”的方针，建立了以下职业危害防治制度和操作规程：

① 职业危害防治责任制度：“总经理监督、安全主任负责、专人管理，定期检测”的管理原则；

② 职业危害告知制度：新员工上岗前，都会阅读岗位危害说明，并签字确认已被告知；

③ 职业健康宣传教育培训制度；

④ 从业人员防护用品管理制度：《劳保用品管理办法》；

⑤ 职业危害日常监测管理制度：公司每年主动邀请当地卫生监督部门进厂对全厂工作环境进行监测，如发现有不合格项目会立即实施整改；

⑥ 从业人员职业健康监护档案管理制度：公司每年定期组织一次员工职业健康体检，由卫生监督部门根据不同工作环境制定不同岗位的体检项目，因公司长期以来注重改善工作环境，避免了由于环境中存在的危害因素可能给员工健康带来的危害，为每一位员工建立职业健康档案，并自公司成立至今无一例职业病发生。

本公司于2008年6月通过了OHSAS18001（2007）职业健康安全管理体系认证，2008年被深圳市南山区疾病防治中心树为职业健康管理先进单位，2009年获

得了由深圳社保局、市政府应急管理办公室颁发的“年度工伤管理与预防先进单位”称号。

4、环保情况

本公司十分重视环境保护，在环保方面，公司已经配备比较完善的环保设施，及成熟的污染物控制技术和熟练的具有上岗资质的操作员工；在生产过程中“三废”处理上严格按照环保要求的流程进行规范操作，对于生产工艺过程中污染源的控制落实到部门，建立生产线排废联动制度，并引进具有环境污染治理设施运营甲级资质的东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”）负责本公司环保设施的日常运营工作，同时配备完善的检测仪器；具有运营商、公司、市环保检测站三级检控体系，以保证运营过程达标。经过多年的努力和不断完善，公司在环境保护各面积积累了丰富的经验和深厚的实力，并获得诸多认证和荣誉。

（1）环境保护的措施和方案

为达到环境保护的各项指标要求，本公司在污染治理上，从规划设计到设备选型、设施运营都做了大量考评，最后确定并邀请中国环保行业的领先企业东江环保（具有环境保护工程技术废水甲级资质、废气乙级资质）为公司设计、建设、运营污水站等环保设施，通过引进先进的工艺流程、提高设备自动化控制程度、配备完善的检测仪器、分类处理废弃物等手段，最终使废水、废气达标排放。

本着环境保护优先于发展生产的原则，按照环保要求对生产进行全过程控制，优化生产工艺，控制生产单耗，购置环保设备，最大限度降低生产过程中产生的“三废”排放总量。本公司所使用的原材料、半成品、成品及涉及到的辅助材料均符合 ROHS 指令及客户对环境有害物质方面的要求，公司对产品及其辅助材料中可能含有的环境有害物质进行严格总量管控，并按《清洁生产促进法》的标准制定单耗目标值，以使废水、废气达标排放，满足环保法规要求。此外公司还执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《建设项目环境保护管理条例》国务院（98）第 253 号令、《建设项目环境保护设计规定》、《污水综合排放标准》(GB8978—1996)、《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)、《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)、《清洁生产促进法》等法规。

污染物主要处理措施

内容类型	污染物名称	处理措施
水污染物	生活污水	排入市政污水管网
	清洗废水	通过超滤及二级反渗透处理后回用于车间再生产
	综合废水	破络、沉淀、砂滤、生化、回用或排放
	有机废水	酸化、混凝、助凝、沉淀至综合废水
大气污染物	酸性气体、碱性气体、有机废气	各种废气分别收集到不同的废气净化吸收塔处理，然后高空排放
	氮氧化物	
固体废物	生活垃圾	分类收集、交环卫部门统一处理
	边角余料及钻屑	交由有资质的单位回收处理
	危险废物：浓废液、含铜污泥等	交由有资质的单位回收处理
噪声	设备运转时产生的噪声	噪声设备采取基础减振、加装隔声罩等措施

(2) 环保投入情况

报告期内，本公司环保的投入情况：

项目	2012 年 1—6 月	2011 年	2010 年	2009 年
环保设备和工程投入（万元）	63.57	535.72	2,549.99	489.07
环境保护服务费（万元）	227.32	415.87	341.69	277.17
合计	290.89	951.59	2,891.69	766.24

深圳市人居环境委员会出具了证明，证明本公司及子公司深圳崇达自 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日未发生环境污染事故和环境违法行为，现阶段未对环境造成污染，已达到国家和地方规定的环保要求。

大连市环境保护局出具证明，证明本公司全资子公司大连崇达能够遵守国家及地方环境保护法律法规和规章，自 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日，自觉执行环境影响评价和“三同时”制度，对所排放的污染物进行综合治理，其生产经营活动符合相关环境保护、法规和规范性文件要求，未出现环境违法现象，无环境污染方面的投诉。

2011 年 7 月 8 日，广东省环境保护厅出具《关于深圳市崇达电路技术股份有限公司上市环保核查情况的函》（粤环函【2011】783 号），认为本公司核查范围内企业基本符合上市公司环保要求，原则同意本公司通过上市环保核查。

（3）清洁生产情况

根据环境保护部 2008 年 11 月 21 日发布的《中华人民共和国国家环境保护标准》之印制电路板制造业清洁生产指标要求和《清洁生产促进法》精神，公司积极组织落实。公司聘请了外部专家团队进行指导，在公司内部细化单耗目标，全面推行节水、省电措施；清洗水采取多极溢流回用，提高原材料利用率；优化工艺流程、提高设备自动化控制程度；隔音降噪，分类处理废弃物，完善应急方案和措施；物料区别存放、标示清楚、整洁无泄漏。公司在生产过程中所产生的生产废水、废气、固体废弃物、噪声的影响均可控制到最低程度，符合国家清洁生产的要求。

本公司于 2010 年分别荣获广东省“清洁生产企业”和深圳市“鹏城减废先进企业”称号。深圳崇达于 2009 年、2012 年荣获深圳市“清洁生产企业”称号，2008—2010 年连续两届荣获深圳市“鹏城减废先进企业”称号。

（七）公司文化

本公司把“为世界电子信息产业提供高品质的线路板和及时、满意的服务”作为使命，以“成长为世界一流的线路板制造企业，为客户、员工、股东、社会创造最大价值”为愿景，在公司内部建立起“诚信互助、进步分享”的核心价值观和“以客户为中心，以市场为导向”的核心管理原则。

在文化建设方面，公司制定了标准的企业形象识别系统，建立了规范的制度体系，并开展一系列的企业文化活动。公司每年都组织开展丰富多彩的文化和体育活动，培养员工的团队精神和凝聚力，引导员工建立和谐健康、积极向上生活方式。

本公司通过利用多种宣传设施和工具，如：企业内刊《崇达人》、大型 LED 电子显示屏、内部和外部网站、网络教室、电视、图书室、室外宣传栏等，宣传公司的管理理念和发展战略，在内部组织开展关于“诚信、互助”等价值观的探讨，加强对员工德行的教育，让员工学习传统文化思想，结合公司的实际情况，深入理解并奉行公司的核心价值观，树立高度的主人翁责任意识，并通过意见箱、合理化建议、员工代表座谈会等平台，在内部建立了良好的内部沟通体系，及时

了解公司各层面员工的意见和心声。通过这一系列的活动，在公司建立起超强的凝聚力和忠诚度，为公司快速、稳定发展奠定了坚实的基础。

本公司积极营造学习氛围，为员工提供学费资助，支持鼓励员工参加国家职业资格及技术职称评定，与西北工业大学合作开展员工学历提升教育；与华中科技大学建立产学研合作，积极推进企业技术进步。

七、发行人的主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

序号	固定资产类别	原值	累计折旧	净值	减值准备	净额	成新率
1	机器设备	45,558.91	11,847.06	33,711.85	-	33,711.85	74.00%
2	运输设备	1,073.24	567.04	506.20	-	506.20	47.17%
3	电子及其他设备	3,054.15	1,702.73	1,351.42	-	1,351.42	44.25%
4	环保设备	1,637.66	600.73	1,036.93	-	1,036.93	63.32%
	合计	51,323.97	14,717.56	36,606.40	-	36,606.40	71.32%

本公司固定资产目前使用状态良好，总体成新率为 71.32%，无需计提资产减值准备。

（二）主要生产设备情况

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司使用中的主要生产设备情况如下表：

固定资产名称	数量（台）	原值（万元）	累计折旧（万元）	净值（万元）
钻孔机	120	8,051.78	2,067.34	5,984.44
曝光机	51	3,938.22	535.33	3,402.90
测试机	59	2,659.79	870.05	1,789.74
检测机	40	2,994.68	821.80	2,172.88
压板机	9	2,091.42	496.73	1,594.69
电镀机	9	2,465.27	615.94	1,849.32
蚀刻机	15	1,865.65	631.62	1,234.03
发电机	12	1,703.09	314.01	1,389.08

成型机	44	1,463.76	429.37	1,034.39
静电喷涂隧道炉机	1	890.48	80.14	810.34
表面处理机	28	856.04	267.47	588.56
检修机	37	757.23	234.43	522.79
垂直连续式电镀铜机	1	660.36	54.48	605.88
冲孔机	7	631.46	150.60	480.87
沉铜板电机	3	559.02	106.96	452.07
贴膜机	13	758.11	110.55	647.56
镭射直接成像机	2	1,025.73	63.25	962.48
光绘机	5	499.07	88.92	410.15
文字喷印机	3	397.30	53.64	343.67
丝印机	46	442.61	165.99	276.62
总计	505	34,711.08	8,158.62	26,552.46

本公司建立《固定资产管理控制程序》、《设备操作和保养指引》、《设备维护规程》、《设备定期维护和保养计划》，对公司生产设备进行规范化、体系化管理。同时建立《关键流程设备配件一览表》、《设备日常运行和维护记录表》、《机器设备维修通知单》、《设备检修记录表》，对设备的维修保养进行管理。

本公司成立专门的设备部，负责机械设备、电子仪器仪表和水、电、气等公用设施的管理，由各生产部门负责本部门生产设备的日常维护保养。

设备维护工作分为日常维护、计划检修和设备异常处理三种模式，将设备使用者、设备维护者以及专业修理人员有机结合，共同保障设备的正常运行。

（三）房屋及建筑物

1、公司拥有的房产

截至本招股说明书签署日，本公司无自有房产。

2、公司租赁的房产

截至本招股说明书签署日，本公司及控股子公司租赁的主要房产情况如下：

位置	出租方	承租方	面积 (平方米)	月租金 (元)	租赁期限	租赁用途	合同备案号
深圳市宝安区福永街道塘尾南坡大道东侧	深圳市塘尾股份合作公司	集锦线路板	5,500	55,000	2010.8.1 至 2012.11.30	厂房	深圳市宝安区房屋租赁管理办公室宝CA037724(备)

深圳市宝安区福永街道塘尾南玻大道东侧	深圳市塘尾股份合作公司	福永分公司	1,835	29,360	2011.1.20至2012.12.19	厂房	深圳市宝安区房屋租赁管理办公室宝CC039445(备)
深圳市宝安区福永街道塘尾南玻大道东侧	深圳市塘尾股份合作公司	福永分公司	2,922	41,706	2011.1.20至2012.12.19	住宅	深圳市宝安区房屋租赁管理办公室宝CC039444(备)
深圳市宝安区福永街道塘尾南玻大道东侧	深圳市塘尾股份合作公司	福永分公司	1,653	54,903.28	2011.1.20至2012.12.19	办公楼	深圳市宝安区房屋租赁管理办公室宝CC039443(备)
宝安区沙井新桥新玉路横岗下工业区宝恒源工业园B幢二至六楼	深圳市宝恒源实业有限公司	深圳崇达	6,140	2008.7.30至2010.12.31为61,400元;从2011.1.1起为89,030元	2008.5.1至2016.4.30	住宅	深圳市宝安区房屋租赁管理办公室宝DA022907(备)
宝安区沙井新桥新玉路横岗下工业区宝恒源工业园B幢一楼	深圳市宝恒源实业有限公司	深圳崇达	1,700	2008.5.1至2010.12.31为17,000元;2011.1.1为24,650元	2008.5.1至2023.4.30	商业	深圳市宝安区房屋租赁管理办公室宝DA022906(备)
宝安区沙井新桥新玉路横岗下工业区新玉路3栋	深圳市宝恒源实业有限公司	深圳崇达	27,000	2010.5.1至2010.12.31为270,000元;2011.1.1起为391,819元	2010.5.1至2025.4.30	工业	深圳市宝安区房屋租赁管理办公室宝DF024687(备)
宝安区沙井新桥横岗下工业区第一排5号厂房一楼、四楼	深圳市新全物业管理有限公司	深圳崇达	3,400	58,208	2011.04.01至2017.11.30	工业	深圳市宝安区房屋租赁管理办公室宝DF025433(备)
宝安区沙井街道芙蓉工业区新大工业园前面第1排第1栋3楼-11楼	深圳市宝恒源实业有限公司	深圳崇达	10,800	182,925	2011.6.1至2019.5.30	住宅	深圳市宝安区房屋租赁管理办公室宝DF025907(备)
大连开发区淮河中路3号	大连华隆奥欣生物科技发展有限公司	大连崇达	6,422.60	87,909.34	2008.3.1至2018.12.30	厂房、办公等	房产证号:大房权证开字第A70795号
大连开发区淮河中路3号	大连华隆奥欣生物科技发展有限公司	大连崇达	2,069	37,255.85	2011.5.1至2014.4.30	厂房	房产证号:大房权证开字第A70796号

目前,本公司位于深圳福永、沙井的生产厂房及员工宿舍均为租赁方式取得,

由于该部分厂房所在的土地为集体用地，因深圳市历史遗留问题原因未取得房屋产权证书。该部分租赁合同均已根据《深圳经济特区房屋租赁条例》在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室办理了备案登记，且该部分物业均已取得深圳市宝安区城中村（旧村）改造办公室出具的证明，证明该等物业迄今为止尚未纳入拆迁改造范围，且在未来 3-5 年内暂无拆迁计划；同时出租方深圳市塘尾股份合作公司、深圳市宝恒源实业有限公司及深圳市新全物业管理有限公司均承诺，未来 5 年内不主动拆迁。

本公司实际控制人姜雪飞、朱雪花出具了《补偿承诺函》，承诺如在本公司与出租方深圳市塘尾股份合作公司、深圳市宝恒源实业有限公司、深圳市新全物业管理有限公司签署的租赁合同有效期内，因租赁厂房拆迁或其他原因无法继续租用，将全额承担由此给本公司造成的损失。

（四）土地使用权

截至本招股说明书签署日，本公司的子公司江门崇达拥有土地使用权 1 宗，具体情况如下：

土地使用权证号	取得方式	位置	用途	面积（平方米）	终止日期
江国用（2011）第 304399 号	出让	江海区连海路 363 号	工业	131,266.70	2060 年 9 月 16 日

（五）商标

截至本招股说明书签署日，本公司已注册登记的商标如下：

序号	名称	商标图形	注册公告时间	申请号	类号	所有人
1	崇达		2010.7.7	6626831	9	发行人

（六）专利与著作权

截至本招股说明书签署日，本公司及子公司共获得专利 288 项（其中发明专利 11 项），软件著作权 18 项。

1、已获得专利权的专利

序号	名称	申请日期	专利类型	专利号	专利权人	法律状态
1	PCB生产用半固化片放置架	2009年5月13日	实用新型	ZL200920150595.3	发行人	授权
2	薄PCB板生产用夹具	2009年5月13日	实用新型	ZL200920150593.4	发行人	授权
3	PCB板生产用销钉定位模	2009年5月13日	实用新型	ZL200920150596.8	发行人	授权
4	PCB生产用喷锡挂架	2009年5月13日	实用新型	ZL200920154504.3	发行人	授权
5	PCB生产用铆合定位器	2009年5月13日	实用新型	ZL200920150594.9	发行人	授权
6	PCB板生产用捞板钩	2009年5月13日	实用新型	ZL200920150597.2	发行人	授权
7	一种印刷线路板基板与光绘底片对位用的曝光对位光台	2009年8月14日	实用新型	ZL200920134825.7	发行人	授权
8	一种印刷线路板丝印用的通用定位钉床	2009年8月14日	实用新型	ZL200920134821.9	发行人	授权
9	一种多层印刷线路板压合叠板定位装置	2009年8月14日	实用新型	ZL200920134822.3	发行人	授权
10	一种装载印刷线路板基板的可伸缩的插板架	2009年8月14日	实用新型	ZL200920134824.2	发行人	授权
11	一种印刷线路板的防氧化车	2009年11月13日	实用新型	ZL200920260417.6	发行人	授权
12	一种印刷线路板专用插板架	2009年11月13日	实用新型	ZL200920260418.0	发行人	授权
13	一种印刷线路板菲林装载交置架	2009年11月13日	实用新型	ZL200920260419.5	发行人	授权
14	一种马达消音器	2009年11月13日	实用新型	ZL200920260420.8	发行人	授权
15	一种印刷线路板丝印用网框的放置架	2009年11月27日	实用新型	ZL200920260831.7	发行人	授权
16	一种印刷线路板的可转向拆板装置	2009年11月27日	实用新型	ZL200920260830.2	发行人	授权
17	一种多层印刷线路板	2009年11月27日	实用新型	ZL200920260829.X	发行人	授权
18	一种插板架	2010年1月8日	实用新型	ZL201020056423.2	发行人	授权
19	一种裁切台	2010年2月5日	实用新型	ZL201020113896.1	发行人	授权
20	一种印刷线路板的烘板车	2010年2月5日	实用新型	ZL201020113908.0	发行人	授权
21	一种斜边机	2010年2月5日	实用新型	ZL201020113900.4	发行人	授权
22	一种转板车	2010年2月5日	实用新型	ZL201020113879.8	发行人	授权
23	一种用于药水浸泡处理的印刷线路板放置架	2010年9月3日	实用新型	ZL201020518499.2	发行人	授权
24	对位台	2010年9月3日	实用新型	ZL201020518455.X	发行人	授权

25	吸水海绵的自动加压装置	2010年9月3日	实用新型	ZL201020518487.X	发行人	授权
26	消泡装置	2010年9月3日	实用新型	ZL201020518530.2	发行人	授权
27	斜角刮刀	2010年9月3日	实用新型	ZL201020518496.9	发行人	授权
28	搁板架	2010年9月3日	实用新型	ZL201020518482.7	发行人	授权
29	空气过滤装置	2010年9月3日	实用新型	ZL201020518436.7	发行人	授权
30	过滤装置	2010年9月3日	实用新型	ZL201020518526.6	发行人	授权
31	丝印刮刀柄及丝印刮刀	2010年9月3日	实用新型	ZL201020518497.3	发行人	授权
32	丝印刮刀放置架	2010年9月3日	实用新型	ZL201020518489.9	发行人	授权
33	具有过滤器的喷嘴	2010年9月3日	实用新型	ZL201020518510.5	发行人	授权
34	子母挂具	2010年9月3日	实用新型	ZL201020518450.7	发行人	授权
35	印刷线路板浸泡用的挂具	2010年9月17日	实用新型	ZL201020535168.X	发行人	授权
36	药液取用装置	2010年9月17日	实用新型	ZL201020535226.9	发行人	授权
37	印刷线路板的插板车	2010年9月17日	实用新型	ZL201020535170.7	发行人	授权
38	工具浸泡容器	2010年9月17日	实用新型	ZL201020535228.8	发行人	授权
39	一种PCB生产工具	2010年10月15日	实用新型	ZL201020564107.6	发行人	授权
40	一种用于板内金手指倒角的盲斜刀具	2010年10月15日	实用新型	ZL201020564106.1	发行人	授权
41	一种干膜存放架	2010年10月15日	实用新型	ZL201020563973.3	发行人	授权
42	一种假性软硬结合板的柔韧性测试模具	2010年10月15日	实用新型	ZL201020564095.7	发行人	授权
43	一种PCB专用挂钩	2010年10月15日	实用新型	ZL201020564054.8	发行人	授权
44	一种湿板运输车	2010年11月24日	实用新型	ZL201020623412.8	发行人	授权
45	U形放板车	2010年12月3日	实用新型	ZL201020642160.3	发行人	授权
46	返洗架	2010年12月3日	实用新型	ZL201020642195.7	发行人	授权
47	水洗槽	2010年12月3日	实用新型	ZL201020642190.4	发行人	授权
48	一种假性软硬结合板的柔韧性测试工具	2010年12月3日	实用新型	ZL201020642178.3	发行人	授权
49	一种高纵横比的 PCB 产品外层线路蚀刻方法	2010 年 11 月 9 日	发明专利	ZL201010537344.8	大连崇达	授权
50	薄印刷线路板电镀用的夹板架	2010年12月17日	实用新型	ZL201020670047.6	发行人	授权
51	丝印刮刀的清洗装置	2010年12月17日	实用新型	ZL201020670067.3	发行人	授权

52	印刷线路板的放板架	2010年12月17日	实用新型	ZL201020670035.3	发行人	授权
53	印刷线路板的烤板架	2010年12月17日	实用新型	ZL201020670086.6	发行人	授权
54	运输轨道车	2010年12月17日	实用新型	ZL201020670031.5	发行人	授权
55	钻孔撬板器	2010年12月21日	实用新型	ZL201020672082.1	发行人	授权
56	沉铜架螺丝的松紧工具	2010年12月31日	实用新型	ZL201020694765.7	发行人	授权
57	可调喷洒式节水装置	2010年12月31日	实用新型	ZL201020694758.7	发行人	授权
58	化学铜缸药水自动添加设备	2010年12月31日	实用新型	ZL201020694762.3	发行人	授权
59	印刷线路板的夹板工具	2010年12月31日	实用新型	ZL201020694761.9	发行人	授权
60	具有隔热层的真空热压机	2010年12月31日	实用新型	ZL201020694695.5	发行人	授权
61	具有过滤装置的真空热压机	2010年12月31日	实用新型	ZL201020694756.8	发行人	授权
62	印刷线路板生产用的过滤装置	2010年12月31日	实用新型	ZL201020694759.1	发行人	授权
63	电镀V形座	2010年12月31日	实用新型	ZL201020694760.4	发行人	授权
64	简易玻璃器皿存放架	2010年12月31日	实用新型	ZL201020694694.0	发行人	授权
65	具有保护装置的手动开料机	2010年12月31日	实用新型	ZL201020694766.1	发行人	授权
66	挂具	2011年1月25日	实用新型	ZL201120023933.4	发行人	授权
67	携带式潜水泵保护箱	2011年1月25日	实用新型	ZL201120023948.0	发行人	授权
68	线路板测试机防错装置	2011年1月25日	实用新型	ZL201120023958.4	发行人	授权
69	一种水洗系统	2011年1月25日	实用新型	ZL201120023937.2	发行人	授权
70	过滤系统	2011年1月25日	实用新型	ZL201120023939.1	发行人	授权
71	具有定位功能的打靶机	2011年1月25日	实用新型	ZL201120023949.5	发行人	授权
72	简易手动切料机	2011年1月25日	实用新型	ZL201120023954.6	发行人	授权
73	牵引装置	2011年1月25日	实用新型	ZL201120023934.9	发行人	授权
74	放板台面及放板台	2011年1月25日	实用新型	ZL201120023952.7	发行人	授权
75	返洗系统	2011年1月28日	实用新型	ZL201120029376.7	发行人	授权
76	一种具有气顶装置的垂直电镀设备	2011年3月11日	实用新型	ZL201120063553.3	发行人	授权
77	吸尘管	2011年3月11日	实用新型	ZL201120063574.5	发行人	授权
78	一种印刷线路板喷锡用的夹具	2011年3月11日	实用新型	ZL201120063561.8	发行人	授权
79	一种印刷线路板成型加工用的卸板工具	2011年3月11日	实用新型	ZL201120063562.2	发行人	授权

80	一种具有生产防错装置的水平机	2011年3月11日	实用新型	ZL201120063570.7	发行人	授权
81	一种具有玻璃盖放置装置的水平机	2011年3月11日	实用新型	ZL201120063572.6	发行人	授权
82	行轱清洁装置	2011年3月11日	实用新型	ZL201120063564.1	发行人	授权
83	一种具有标识结构的行轱	2011年3月11日	实用新型	ZL201120063551.4	发行人	授权
84	一种成品检板台	2011年3月21日	实用新型	ZL201120075307.X	发行人	授权
85	一种喷淋管的拆装工具	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128597.X	发行人	授权
86	一种印刷线路板的接板装置	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128591.2	发行人	授权
87	一种喷淋摇摆装置	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128607.X	发行人	授权
88	一种多层线路板的铆合模具	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128588.0	发行人	授权
89	一种减震装置	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128592.7	发行人	授权
90	切片及哈氏槽片的存放柜	2010年12月17日	实用新型	ZL201020670049.5	发行人	授权
91	放板架	2010年12月17日	实用新型	ZL201020670111.0	发行人	授权
92	一种微切片胶模模具	2011年1月5日	实用新型	ZL201120002794.7	发行人	授权
93	具有脱模机构的切片采样机	2011年3月11日	实用新型	ZL201120063554.8	发行人	授权
94	节水的清洗装置	2011年3月11日	实用新型	ZL201120063573.0	发行人	授权
95	一种用于垂直化铜线的振动装置	2011年3月11日	实用新型	ZL201120063560.3	发行人	授权
96	一种方便取样的药水缸	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128590.8	发行人	授权
97	折叠式手柄	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128624.3	发行人	授权
98	一种封网注胶工具	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128587.6	发行人	授权
99	网版固定架	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128589.5	发行人	授权
100	一种印刷线路板的转移接板车	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128618.8	发行人	授权
101	一种印刷线路板的吸水装置	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128593.1	发行人	授权
102	一种具有标识结构的存放框	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128608.4	发行人	授权
103	一种印刷线路板的目视检验辅助台	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128602.7	发行人	授权
104	一种涂布轮存放架	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128601.2	发行人	授权
105	一种印刷线路板的压板模具	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128622.4	发行人	授权
106	一种过滤泵滤芯的拆装工具	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128585.7	发行人	授权
107	一种分板作业台	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128613.5	发行人	授权

108	磨刷的辅助拆卸装置	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128626.2	发行人	授权
109	一种菲林打孔机	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128600.8	发行人	授权
110	一种用于印刷线路板检查的辅助支架	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128617.3	发行人	授权
111	一种金属取样模具	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128625.8	发行人	授权
112	一种半开式研磨刷	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128627.7	发行人	授权
113	垂直支撑装置	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128629.6	发行人	授权
114	一种防焊油墨的返洗台	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128612.0	发行人	授权
115	一种涂布轮清洗机	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128594.6	发行人	授权
116	一种具有过滤网的水平生产线	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128605.0	发行人	授权
117	一种清洗装置	2011年4月27日	实用新型	ZL201120128611.6	发行人	授权
118	一种行车轨道装置	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163285.2	发行人	授权
119	药水回流装置	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163286.7	发行人	授权
120	一种曝光膜	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163308.X	发行人	授权
121	一种多层运输车	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163302.2	发行人	授权
122	一种油墨搅拌机	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163299.4	发行人	授权
123	一种丝印底板	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163300.3	发行人	授权
124	扁线滑轮装置	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163279.7	发行人	授权
125	一种镀膜刀具	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163280.X	发行人	授权
126	一种具有侧面粘尘效果的清洁机	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163282.9	发行人	授权
127	网版显影台	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163291.8	发行人	授权
128	一种水过滤装置	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163292.2	发行人	授权
129	一种可视玻璃窗的支撑装置	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163296.0	发行人	授权
130	一种应急冲洗装置	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163309.4	发行人	授权
131	一种药水添加装置	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163284.8	发行人	授权
132	喷盘的悬挂装置	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163294.1	发行人	授权
133	一种板边包胶装置	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163288.6	发行人	授权
134	管道铺垫架	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213074.5	发行人	授权
135	振动强度监测仪	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213076.4	发行人	授权

136	金属均匀性测量的简易定位片	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213077.9	发行人	授权
137	带有开窗感应报警装置的药水缸	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213067.5	发行人	授权
138	防紫外线照射的照明装置	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213063.7	发行人	授权
139	印刷线路板的叠板台	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213059.0	发行人	授权
140	一种行车安全防护装置	2011年7月27日	实用新型	ZL201120075308.4	发行人	授权
141	自动控制碳处理设备	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213070.7	发行人	授权
142	磨板机	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213060.3	发行人	授权
143	一种线路板金属化半孔制作工艺	2010年9月17日	发明专利	ZL201010286572.2	发行人	授权
144	印刷线路板的快速上板夹紧装置及其电镀设备	2010年12月17日	发明专利	ZL201010596805.9	发行人	授权
145	一种网版运输车	2011年5月20日	实用新型	ZL201120163295.6	发行人	授权
146	印刷线路板的插板架	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213051.4	发行人	授权
147	药液添加装置	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213055.2	发行人	授权
148	覆铜板磨边后的清洁装置	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213062.2	发行人	授权
149	吸水海绵的清洁装置	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213069.4	发行人	授权
150	零配件存放盒	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213052.9	发行人	授权
151	防锈放板台	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213073.0	发行人	授权
152	卷式铜箔的简易存放架	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213065.6	发行人	授权
153	具有液位识别装置的液体缸	2011年6月22日	实用新型	ZL201120213056.7	发行人	授权
154	一种具有长短金手指电路板的生产方法	2008年7月8日	发明专利	ZL200810068472.5	深圳崇达	授权
155	一种阻焊磨点处理的方法	2008年9月28日	发明专利	ZL200810216661.2	深圳崇达	授权
156	一种检测多层线路板切片的模具装置	2008年7月8日	实用新型	ZL200820095389.2	深圳崇达	授权
157	一种放板车台装置	2008年10月31日	实用新型	ZL200820212799.0	深圳崇达	授权
158	一种千层架装置	2008年10月31日	实用新型	ZL200820212800.X	深圳崇达	授权
159	一种PCB板的存板架	2008年10月31日	实用新型	ZL200820212798.6	深圳崇达	授权
160	一种电路板加工过程中的冲洗阻焊剂装置	2008年10月31日	实用新型	ZL200820212796.7	深圳崇达	授权
161	一种卡槽式放板架	2008年10月31日	实用新型	ZL200820212859.9	深圳崇达	授权
162	一种网版检修台装置	2008年10月31日	实用新型	ZL200820212797.1	深圳崇达	授权

163	一种电路板固定支架	2009年1月9日	实用新型	ZL200920129175.7	深圳崇达	授权
164	一种垫板	2009年1月9日	实用新型	ZL200920129177.6	深圳崇达	授权
165	耐压测试装置	2009年1月9日	实用新型	ZL200920129176.1	深圳崇达	授权
166	一种制作印刷线路板内层图形的菲林	2009年8月14日	实用新型	ZL200920134819.1	深圳崇达	授权
167	一种用于印刷线路板检测的自动光学检修仪	2009年9月22日	实用新型	ZL200920204945.X	深圳崇达	授权
168	一种印刷线路板	2009年9月22日	实用新型	ZL200920204946.4	深圳崇达	授权
169	一种具有隔离阻焊区域的印刷线路板	2009年9月22日	实用新型	ZL200920204947.9	深圳崇达	授权
170	线路板电镀装置及电镀方法	2009年10月16日	发明专利	ZL200910110650.0	深圳崇达	授权
171	一种印刷线路板阻焊层的生产工艺	2009年9月22日	发明专利	ZL200910190375.8	深圳崇达	授权
172	线路板定位装置	2010年8月6日	实用新型	ZL201020286026.4	深圳崇达	授权
173	一种印刷电路板用菲林	2010年10月21日	实用新型	ZL201020569674.0	深圳崇达	授权
174	一种垫条装载装置	2010年10月21日	实用新型	ZL201020569686.3	深圳崇达	授权
175	一种薄板夹具	2010年12月24日	实用新型	ZL201020679344.7	深圳崇达	授权
176	一种半固化片存储架	2010年12月24日	实用新型	ZL201020679336.2	深圳崇达	授权
177	半固化片冲孔机的辅助装置	2010年11月4日	实用新型	ZL201020592680.8	深圳崇达	授权
178	线路板电镀校正系统及方法	2009年7月24日	发明专利	ZL200910108842.8	深圳崇达	授权
179	线路板半固化片的锣空位方法	2009年11月20日	发明专利	ZL200910109784.0	深圳崇达	授权
180	具有标识靶标的印刷线路板	2010年12月24日	实用新型	ZL201020679343.2	深圳崇达	授权
181	一种高效的半固化片钻孔机	2011年1月7日	实用新型	ZL201120003983.6	深圳崇达	授权
182	可提高质量和效率的电镀手套清洁装置	2011年1月7日	实用新型	ZL201120003985.5	深圳崇达	授权
183	干膜显影新型工作台	2011年1月7日	实用新型	ZL201120003987.4	深圳崇达	授权
184	具有防错作用的印刷线路板生产模具	2011年1月7日	实用新型	ZL201120003989.3	深圳崇达	授权
185	一种利于取放的印刷线路板多层存放架	2011年1月7日	实用新型	ZL201120003998.2	深圳崇达	授权
186	一种具有防滑块的压合底盘	2011年1月7日	实用新型	ZL201120003996.3	深圳崇达	授权
187	用于印刷线路板烤板的抽屉架	2011年1月7日	实用新型	ZL201120003992.5	深圳崇达	授权
188	一种提高效率和质量的返工放置架	2011年1月7日	实用新型	ZL201120003993.X	深圳崇达	授权

189	可节约成本的PCB沉金生产用倾斜挂板装置	2011年1月7日	实用新型	ZL201120003997.8	深圳崇达	授权
190	新型的化验分析取样手提篮	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004000.0	深圳崇达	授权
191	分析取样用的新型药水取样装置	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004001.5	深圳崇达	授权
192	用于静电喷涂机的新型油墨刮刀	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004005.3	深圳崇达	授权
193	一种新型手推放板车	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004006.8	深圳崇达	授权
194	新型容量瓶放置柜	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004007.2	深圳崇达	授权
195	可节约成本的PCB沉金生产金盐自动添加装置	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004008.7	深圳崇达	授权
196	可提高效率的线路板孔金属化后养板槽	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004009.1	深圳崇达	授权
197	检测厚铜小电源板锣板尺寸的模具	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004010.4	深圳崇达	授权
198	可提高质量的半固化片预排台新型装置	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004013.8	深圳崇达	授权
199	新型万能可调放板架	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004014.2	深圳崇达	授权
200	新型移液管的放置架	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004016.1	深圳崇达	授权
201	可防止除油剂分解的新型加热装置	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004017.6	深圳崇达	授权
202	一种用于化验分析的新型实验台面	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004020.8	深圳崇达	授权
203	一种新型线路板阻焊绿油菲林	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004021.2	深圳崇达	授权
204	线路板电镀自动生产线供水用新型装置	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004022.7	深圳崇达	授权
205	一种半自动曝光机绿油菲林	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004023.1	深圳崇达	授权
206	一种新型贴膜架	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004027.X	深圳崇达	授权
207	一种利于查询文件的通用型文件归档标签夹	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004028.4	深圳崇达	授权
208	可提高效率的印刷线路板电镀用新型夹具	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004043.9	深圳崇达	授权
209	用于提高印刷线路板沉金生产效率的挂篮	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004041.X	深圳崇达	授权
210	用于印刷线路板挂镀上板的新型防错装置	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004035.4	深圳崇达	授权
211	用于高纵横比印刷线路板电镀生产的气顶装置	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004034.X	深圳崇达	授权
212	用于提高印刷线路板沉金生产效率的挂具	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004033.5	深圳崇达	授权

213	可节约成本的用于印刷线路板电厚金生产的挂具	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004032.0	深圳崇达	授权
214	新型钢板运输车	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004030.1	深圳崇达	授权
215	多槽位的新型运板车	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004029.9	深圳崇达	授权
216	可提高效率的沉铜设备清洗装置	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004004.9	深圳崇达	授权
217	用于改善工作环境的印刷线路板除胶渣缸抽风装置	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004042.4	深圳崇达	授权
218	PCB板面披锋新型打磨台	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004025.0	深圳崇达	授权
219	一种可提高效率的铜球添加新型装置	2011年1月7日	实用新型	ZL201120004003.4	深圳崇达	授权
220	用于印刷线路板塞孔的治具	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078818.7	深圳崇达	授权
221	印刷线路板的塞孔垫板	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078811.5	深圳崇达	授权
222	一种具有蚀刻测试结构的印刷线路板	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078812.X	深圳崇达	授权
223	无定位孔的印刷线路板	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078809.8	深圳崇达	授权
224	印刷线路芯板的棕化收板放置装置	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078810.0	深圳崇达	授权
225	印刷线路板的包装装置	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078827.6	深圳崇达	授权
226	印刷线路板的存放架	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078828.0	深圳崇达	授权
227	一种薄板沉铜的快速插板架	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078789.4	深圳崇达	授权
228	一种粘尘装置	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078793.0	深圳崇达	授权
229	一种防止铜粒沉积的沉铜缸	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078816.8	深圳崇达	授权
230	一种具有挡板的电镀设备	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078815.3	深圳崇达	授权
231	一种防止阳极泥污染的电镀设备	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078814.9	深圳崇达	授权
232	垂直电镀线行车吊空的侦错装置	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078808.3	深圳崇达	授权
233	印刷线路板的磨边机	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078806.4	深圳崇达	授权
234	电镀板的防吊装置	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078797.9	深圳崇达	授权
235	一种可旋转的干膜存放支架	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078790.7	深圳崇达	授权
236	用于印刷线路板电镀生产的放板车	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078792.6	深圳崇达	授权
237	一种方便卸载的废料搬运车	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078817.2	深圳崇达	授权
238	印刷线路板的热应力实验装置	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078819.1	深圳崇达	授权
239	印刷线路板的斜边机	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078813.4	深圳崇达	授权

240	塞孔垫板	2011年3月29日	实用新型	ZL201120087288.2	深圳崇达	授权
241	一种对线路板导电孔进行树脂塞孔的制造工艺	2010年4月30日	发明专利	ZL201010167676.1	深圳崇达	授权
242	去除印刷线路板毛刺的磨床	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078825.7	深圳崇达	授权
243	用于金属回收和节水的装置	2011年3月23日	实用新型	ZL201120078807.9	深圳崇达	授权
244	一种印刷线路板的曝光菲林	2011年6月3日	实用新型	ZL201120186708.2	深圳崇达	授权
245	一种移动式盛放液体的防泄漏架	2011年6月3日	实用新型	ZL201120186715.2	深圳崇达	授权
246	一种印刷线路板的三角支架式插板架	2011年6月3日	实用新型	ZL201120186698.2	深圳崇达	授权
247	一种用于流水线保养的喷水装置	2011年6月3日	实用新型	ZL201120186704.4	深圳崇达	授权
248	一种除静电装置及棕化生产线	2011年6月3日	实用新型	ZL201120186706.3	深圳崇达	授权
249	一种印刷线路板成型后的快速拆卸装置	2011年6月3日	实用新型	ZL201120186705.9	深圳崇达	授权
250	一种半固化片粉尘的粘尘板	2011年6月3日	实用新型	ZL201120186717.1	深圳崇达	授权
251	一种可调节角度的薄板放板架	2011年6月3日	实用新型	ZL201120186701.0	深圳崇达	授权
252	样品切割机	2011年7月6日	外观设计	ZL201130212709.5	深圳崇达	授权
253	收板架（H型）	2011年7月6日	外观设计	ZL201130212705.7	深圳崇达	授权
254	可移动式台阶	2011年7月6日	外观设计	ZL201130212710.8	深圳崇达	授权
255	填孔电镀上板架	2011年7月7日	外观设计	ZL201130214071.9	深圳崇达	授权
256	压合工序载板车	2011年7月7日	外观设计	ZL201130214075.7	深圳崇达	授权
257	线路板胶筐放置架	2011年7月7日	外观设计	ZL201130214076.1	深圳崇达	授权
258	线路板返洗架	2011年7月7日	外观设计	ZL201130214080.8	深圳崇达	授权
259	线路板搬运车	2011年7月7日	外观设计	ZL201130214057.9	深圳崇达	授权
260	线路板捡板分类架	2011年7月7日	外观设计	ZL201130212961.6	深圳崇达	授权
261	内层芯板树脂塞孔的线路板制作方法	2009年11月20日	发明专利	ZL200910109783.6	深圳崇达	授权
262	一种含有阶梯形盲孔的线路板	2010年4月30日	发明专利	ZL201010167716.2	深圳崇达	授权
263	一种层叠式放板架	2011年6月3日	实用新型	ZL201120186696.3	深圳崇达	授权
264	多功能运板车	2011年7月6日	外观设计	ZL201130212691.9	深圳崇达	授权
265	可滑动式运输车	2011年7月7日	外观设计	ZL201130214060.0	深圳崇达	授权
266	一种存放导气条的放置台	2011年7月11日	实用新型	ZL201120242478.7	深圳崇达	授权

267	一种挡点菲林	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242480.4	深圳崇达	授权
268	埋入平面电容的多层线路板	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242474.9	深圳崇达	授权
269	可内层互连的多层线路板	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242464.5	深圳崇达	授权
270	一种线路板的放板架	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242466.4	深圳崇达	授权
271	一种靶标位加挡油块的挡点菲林	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242473.4	深圳崇达	授权
272	一种样品储存架	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242468.3	深圳崇达	授权
273	一种网版运输车	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242465.X	深圳崇达	授权
274	一种真空吸嘴及自动放板机	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242471.5	深圳崇达	授权
275	一种字符菲林	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242481.9	深圳崇达	授权
276	一种可存放及清洁菲林的放置台	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242477.2	深圳崇达	授权
277	一种网框存放台	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242476.8	深圳崇达	授权
278	具有盘中孔的多层线路板	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242475.3	深圳崇达	授权
279	一种线路板静电喷涂油墨的过滤装置	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242463.0	深圳崇达	授权
280	一种线路板的熔合装置	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242461.1	深圳崇达	授权
281	一种双层水槽式保养车	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242472.X	深圳崇达	授权
282	一种专用于切片制作的实验台	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242462.6	深圳崇达	授权
283	一种胶纸的裁切工具	2011 年 7 月 11 日	实用新型	ZL201120242467.9	深圳崇达	授权
284	一种用于切割内凹式金手指斜边板的装置	2011 年 8 月 12 日	实用新型	ZL201120292849.2	深圳崇达	授权
285	一种绿油菲林边对位检测装置	2011 年 8 月 12 日	实用新型	ZL201120292863.2	深圳崇达	授权
286	一种用于砂带磨板的砂带架装置	2011 年 9 月 14 日	实用新型	ZL201120344159.7	深圳崇达	授权
287	一种三维立体线路板外层贴膜垫片结构	2011 年 9 月 14 日	实用新型	ZL201120344121.X	深圳崇达	授权
288	一种全自动曝光菲林检查清洁台	2011 年 10 月 17 日	实用新型	ZL201120394479.3	深圳崇达	授权

2、已获得的软件著作权

序号	软件名称	登记号	首次发表日期	著作权人	取得方式
1	集锦计算机管理系统 V1.0	2009SR032284	2009 年 3 月 20 日	发行人	原始取得
2	集锦题目录入试卷生成系统 V1.0	2009SR032285	2009 年 3 月 30 日	发行人	原始取得
3	坐标文件自动转换系统 V1.0	2009SR032286	2009 年 3 月 31 日	发行人	原始取得
4	集锦设备检修管理软件 V1.0	2010SR051708	2010 年 5 月 20 日	发行人	原始取得

5	崇达电路技术考勤补卡申请系统 V1.0	2011SR010023	2010 年 7 月 22 日	发行人	原始取得
6	崇达设计 TGZ 资料自动备份自动化程序软件 V1.0	2011SR027920	2011 年 1 月 11 日	发行人	原始取得
7	崇达设计 genesis 菲林输出自动化程序软件 V1.0	2011SR027923	2011 年 1 月 14 日	发行人	原始取得
8	崇达设计 genesis 钻孔输出自动化程序软件 V1.0	2011SR055851	2010 年 11 月 20 日	发行人	原始取得
9	崇达设计 genesis 锣带输出自动化程序软件 V1.0	2011SR087024	2010 年 11 月 25 日	发行人	原始取得
10	崇达物料应用系统 V1.0	2009SR08754	2007 年 8 月 23 日	深圳崇达	原始取得
11	崇达 PCB 成型系统 V1.0	2009SR013009	2008 年 4 月 1 日	深圳崇达	原始取得
12	崇达报价应用系统 V1.0	2009SR08755	2008 年 4 月 20 日	深圳崇达	原始取得
13	崇达 PCB 钻孔系统 V1.0	2009SR013010	2008 年 5 月 8 日	深圳崇达	原始取得
14	崇达 PCB 板料自动拼板开料系统 V1.0	2009SR013011	2008 年 6 月 25 日	深圳崇达	原始取得
15	崇达 PCB 金手指管理系统 V1.0	2009SR013019	2008 年 8 月 2 日	深圳崇达	原始取得
16	报价管理系统 V1.0.0.136	2010SR017127	2008 年 12 月 25 日	深圳崇达	原始取得
17	崇达工程 genesis 套大铜皮自动化程序软件 V1.0	2010SR067753	2009 年 7 月 28 日	深圳崇达	原始取得
18	改特殊周期自动化程序软件 V1.0	2010SR067754	2010 年 7 月 30 日	深圳崇达	原始取得

八、发行人的研究开发情况

（一）公司的核心技术及其应用

本公司拥有多项自主研发的核心技术，涉及高多层、HDI等高端产品及其先进材料、先进制造工艺、电学参数设计和控制及质量管控技术，技术水平国内领先。核心技术及其应用如下表所示：

公司的核心技术及其应用

产品类别	技术名称	技术来源	应用	技术水平	熟练程度
高多层厚铜网络电源模组 PCB 基板（内层铜厚 2~6 盎司）	1、网络模组 PCB 耐电压 $\geq 3000V$ 技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	2、网络模组 PCB 电容，电感，电阻匹配技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	3、内层厚铜的线路蚀刻、层间对准制作技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	4、厚铜 PCB 高密度化设计技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
高多层局部电	1、厚金电镀工艺	自主研发	量产	国内领先	熟练

金、长短金手指 PCB 产品	2、选择性电金工艺	自主研发	量产	国内领先	熟练
	3、断截金手指工艺	自主研发	量产	国内领先	熟练
HDI（盲埋孔） 高多层 PCB 产 品	1、机械钻盲孔的层间对准技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	2、多次压合的材料涨缩管控技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	3、盲孔的电镀铜厚管控技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	4、埋孔树脂塞孔技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
高频阻抗 HDI PCB 产品	1、+/-5%的阻抗匹配技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	2、多层次，多组阻抗的设计和控制技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	3、不同特性板料混压技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	4、混压设计及非对称结构设计 PCB 的板曲控制技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	5、Low DK 材料的 PCB 制作技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
高多层(14 层以 上)PCB 产品	1、高层板的层间对准度控制	自主研发	量产	国内领先	熟练
	2、高层数 PCB 产品的压合固化技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	3、高纵横比 15:1PCB 电镀控制技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	4、超小的孔到孔间距钻孔控制技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	5、内层漏电、微短的控制技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	6、超薄芯板的制作技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
高多层高散热 PCB 产品	1、铜浆、银浆塞孔技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	2、散热材料的应用和控制技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	3、金属基材料的制作技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
HDI 背钻盲孔 产品	1、深度钻孔的设计和控制技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	2、高精度深度钻孔控制技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	3、盲钻孔电镀技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
HDI 产品	1、3/3mil 线宽线间的线路制作技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	2、电镀填平技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	3、超微小孔激光钻孔技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	4、大型盲孔激光钻孔技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	5、叠孔的设计和制作技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
高多层超长背 板产品（长度， ≤900mm）	1、超长背板的曝光技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	2、超长背板的压合技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	3、孔径公差+/-0.05mm 的技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	4、超长背板内层开短路控制技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	5、超厚背板正反对接钻孔技术	自主研发	量产	国内领先	熟练

软硬结合板产品	1、FR4 与 PI 材料混压技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	2、不同材料的孔内相接界面残胶清洁技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	3、软板披锋去除技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
埋入平面电容产品	1、超薄介质（14 微米厚）芯板图形制作技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	2、超薄介质（14 微米厚）芯板压合技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	3、混合材料等离子除胶技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	4、埋孔 Via-in-PAD 制作技术	自主研发	量产	国内领先	熟练
	5、埋入电容 PCB 电性测试技术	自主研发	量产	国内领先	熟练

（二）公司正在从事的研发项目及其进展情况

产品类别	核心技术	所处研发阶段	拟达到的目标	先进程度
高多层 HDI 阶梯板产品	具有立体结构的 PCB 设计制作技术 内层基铜可贴件安装技术 镂空位压合技术	样品阶段	制作出多重阶梯结构的 PCB,实现电子元器件镶嵌贴装和更高密度化制作	国内领先
高阶 HDI 产品（高阶）	4 次及以上激光盲孔的叠加技术 任意层盲孔互连技术	样品阶段	4 次及以上激光盲孔叠加，实现更高的布线密度	国内领先
高多层极超长背板产品（长度>900mm）	极超长背板的制作技术 埋入电阻制作技术 超厚板电镀技术 极超长背板的制作电性测试技术	样品阶段	长度 900mm 以上，厚度大于 8mm 的背板可大批量生产 埋入无源元器件 PCB 产品的批量生产	国内领先
超级厚铜板（内、外层铜厚 7~12 盎司厚度）	内层 7~12 盎司厚铜的图形制作技术 内层 7~12 盎司厚铜压合技术 内、外层 7~12 盎司厚铜机械钻孔技术	样品阶段	实现 7~12 盎司超级厚铜板的批量生产，满足市场须求	国内领先
18:1 高纵横比 HDI 产品研发产品	超厚板钻孔控制技术 低浓度光剂电镀技术 电镀喷流技术 脉冲电镀技术	样品阶段	实现最大板厚 10mm,纵横比 18:1 产品的电镀,同时孔内铜厚 $\geq$ 时孔内铜厚	国内领先
埋入元器件线路板产品	埋入电阻图形制作技术 埋入电阻电性能测试技术 同时埋入电阻与电容的制作技术 埋入分立元器件制作技术	设计阶段	实现埋入元器件线路板产品的批量生产，突破国外的技术封锁和产品垄断	国内领先
芯片封装（Substrate）产品	超精细线路（线宽 10~50 微米）制作技术 高温压合技术 超精细线路电镀技术 超细焊盘电性测试技术	设计阶段	实现用于芯片封装的线路板的批量生产，突破国外的技术封锁和产品垄断	国内领先

（三）研发机构设置与研发人员情况、研发制度安排

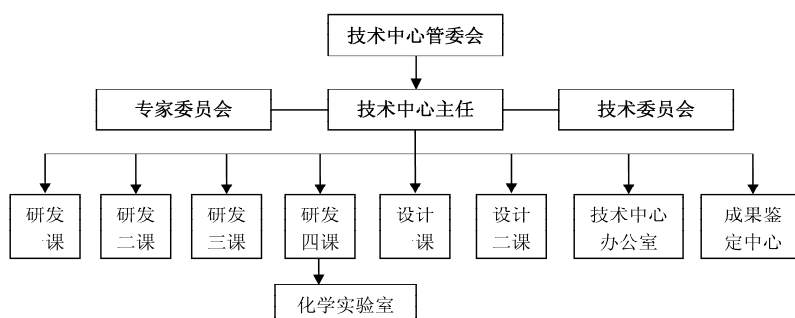
本公司的企业技术中心成立于2004年3月，从成立之初，就以“加快企业技

术进步和新产品开发速度、加强部门间沟通和外部合作、提高公司综合竞争力”作为技术中心的宗旨。为此，技术中心配备了高水平的研发队，建立了完善的组织结构和运行机制。2011年5月，深圳崇达技术中心被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合认定为“深圳市市级研究开发中心（技术中心类）”。

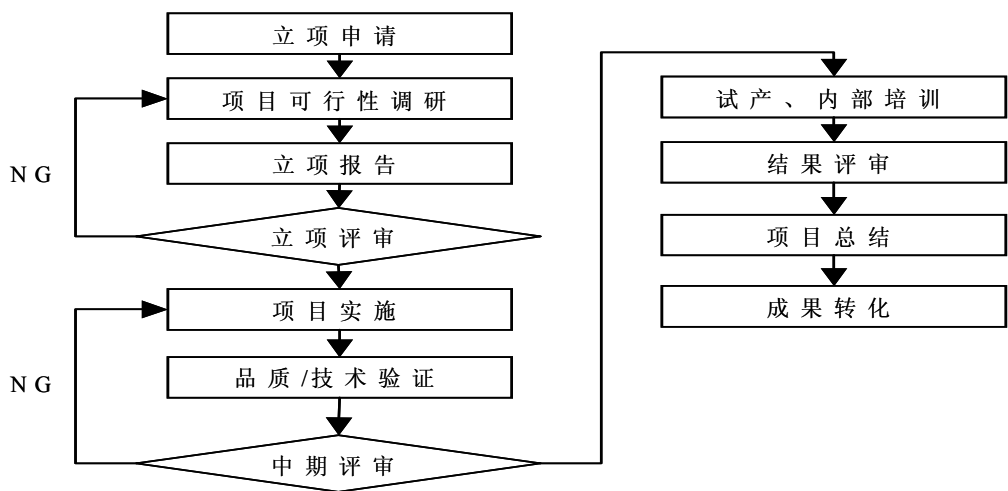
目前技术中心共有研发人员390人。公司还计划每年从高校吸纳优秀人才充实研发团队。

在组织结构方面，本公司建立了完善的研发组织架构，通过设立技术中心，下设研发部、设计部。技术中心细化研发内容，使每个研发人员得以深入研究，并可以通过市场和下游客户信息进行收集分析，产品的测试、转产，对研发项目进行技术规划、项目预算、监控、制定技术标准，确保项目的有效实施。

本公司的研发组织机构设置如下：



在运行机制方面，本公司通过建立完善的研究开发组织管理制度，制定了规范的公司研发项目开展程序以及研发项目管理办法，加强公司对于研发项目和研发成果的管理，充分整合公司的资源，推动公司研发项目成果的产业化，同时，进行定期评估、考核和研讨，进而全面保障研发工作的有序、有效进行。项目的研发流程如图所示：



（四）与高校、科研院所合作

本公司通过与高等院校及相关研究机构建立密切联系，实现“产、学、研”相结合，指导生产、引领技术变革。

本公司与华中科技大学就“产、学、研结合”项目成立战略联盟，签订《产、学、研结合项目合作框架协议》，实现资源共享、节约资源、互利互助。

本公司技术中心本着开放的态度，广泛吸纳国内外先进的科技成果和高水平的科技人才，与同行进行经验的交流；同时还聘请高校教授、专家组成顾问委员会，并亲临现场进行指导。企业技术中心运用华中科技大学、西北工业大学等国内高校的技术和智力资源，在内短、板材涨缩、菲林涨缩等多项研发项目中开展技术交流与合作，并与高等院校建立长期稳定的合作关系，与高等院校联合设立开发设计机构，大大提高技术中心的研发能力与水平。

（五）研发管理及技术创新机制

本公司的技术创新机制是以市场和客户的需求为导向，采用健全的绩效激励机制和有效的沟通机制，引导全体员工进行技术创新。

（1）定期与重要客户进行沟通 and 访问，实时了解客户的需求，参与客户的产品研发设计，在帮助客户解决产品研发难题的同时，自身的技术水平也得到了提升，同时赢得后续的产品订单；

（2）定期参加行业技术交流合作，深入了解行业发展趋势，制定产品发

展路线图，推动内部所生产的线路板产品的产品升级和技术水平的提升；

（3）与高等院校进行产、学、研合作项目，引入外部智力资源，以加快技术进步和发展的步伐；

（4）鼓励全体员工参与技术创新，对获得专利授权、发表论文的员工进行奖励和表彰；

（5）建立学习氛围和提倡以人为本的理念，鼓励和帮助员工提高学历，使得员工的素质不断提高并与企业一起进步发展。

（六）研发费用占主营业务收入的比例

单位：万元

年 度	2012 年 1—6 月	2011 年	2010 年	2009 年
研发费用	2,494.31	4,088.36	3,949.29	2,689.63
主营业务收入	51,789.86	93,778.29	76,555.60	42,827.71
占主营业务收入比例	4.82%	4.36%	5.16%	6.28%

九、发行人的质量控制情况

（一）质量控制标准

本公司建立了“健全良好管理体系，提供客户满意产品，遵纪守法善用资源，持续改进质量环境”的质量管理方针，产品质量根据客户的需求，严格遵照国际和行业的先进标准实施生产和检验，具体包括如下国家标准、客户标准、IPC的行业相关标准、欧洲的PERFAG相关标准、日本的J-STD-001C相关标准、有害物质的RoHS和Reach标准。

（二）质量控制体系

本公司贯彻“让客户放心是一切质量管理工作的出发点和落脚点，1%的缺陷可能带给用户100%的灾难”的质量观，大力推行全员质量管理，建立了以客户满意为中心的原材料质量检验、生产过程控制、产品质量终检等质量控制体系和专业的售后服务体系，从而在生产各个环节均建立了严格的质量控制制度。公

司目前已获得多个国际质量管理体系的认证，包括ISO9001：2008版质量管理体系、ISO/TS16949：2009版汽车产品质量管理体系、AS9100B航空航天质量管理体系、美国UL认证。

在关键工序，本公司采用SPC控制方法和先进的质量检验检测设备来确保产品的品质稳定和持续改善。目前SPC重点控制的工序有：内层图形转移工序、外层图形转移工序、机械钻孔工序、层压工序、沉铜电镀工序、表面处理工序、成型工序。

本公司于2008年全面导入精益六西格玛项目管理模式推动品质持续改善并取得了较好的经济效益，包括：群策群力项目、精益项目、六西格玛绿带项目、精益六西格玛黑带项目、精益六西格玛领航员项目。

为了更好地推动品质持续改善，从内部上，本公司加强对员工培训。主要包括两个方面：一方面，对员工进行质量意识培训，让每个员工都能把良好的质量意识带到工作中，让全员都参与管理；另一方面，对员工进行技能培训，力争使员工的技能能够在短时间内达到工作要求。在外部，开始大力引进人才，包括技术人才和管理人才，全面提高公司员工的综合素质。

（三）出现的质量纠纷

本公司一直遵循有关质量的法律法规，出口产品符合相关国家关于产品质量、标准和技术监督的要求，未受到任何质量方面的行政处罚。

本公司的产品质量得到了客户的高度认可，被国际和国内多家大型电子信息产业类企业认可和高度评价，并与之建立了长期稳定的合作关系。近三年获得客户颁发的优秀奖包括：08年度优秀供应商---艾默生网络能源有限公司、Supplier Appreciation Award---SVI、2010年度优秀供应商---深圳大族激光、Excellent Performance Award--- NCAB group、Excellent Supplier Award---Palpilot。

本公司凭借良好的产品质量和品牌优势，2010 年被评为第七届“深圳知名品牌”，2011 年被评为第二届“优秀民族品牌”。截至目前，本公司未发生过重大产品质量纠纷。

第六章 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）发行人与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

截至本招股说明书签署日，本公司的控股股东、实际控制人姜雪飞、朱雪花夫妇除持有本公司 76.73%股权外，目前未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

（二）相关关联方关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来发生同业竞争，控股股东、实际控制人姜雪飞、朱雪花于 2011 年 2 月 12 日分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，两人均承诺：“将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与崇达技术构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与崇达技术产品相同、相似或可能取代崇达技术产品的业务活动。”

二、关联交易

（一）发行人的关联方及关联关系

根据《公司法》及《企业会计准则》的有关规定，截至本招股说明书签署日，本公司的主要关联方包括：

1、控股股东及实际控制人

关联方名称	与本公司的关系
姜雪飞	控股股东、实际控制人，持股比例 69.0564%
朱雪花	实际控制人，姜雪飞的配偶，持股比例 7.6730%

2、本公司的子公司

关联方名称	与本公司的关系
深圳崇达	全资子公司
大连崇达	全资子公司
香港崇达	全资子公司
江门崇达	全资子公司

3、最近三年内曾经为发行人关联方的关联法人

关联方名称	成立时间	主营业务	与本公司的关系	截至招股说明书签署日状态
大连电子	2004 年 2 月 5 日	印制电路板的设计、生产加工	自该公司成立至 2009 年 3 月，姜雪飞及其配偶朱雪花通过香港汇锦间接持有大连电子 38.16%的股权。	已转让给非关联方
香港崇达线路板	1999 年 9 月 20 日	无实际运营	同一实际控制人，姜雪飞持有香港崇达线路板 50%股权，香港汇锦持有其 50%股权。	已于 2011 年 4 月 15 日注销
香港乐蔚	1996 年 8 月 8 日	无实际运营	2005 年 8 月至 2010 年 12 月 3 日期间，姜雪飞持有香港乐蔚 55%的股权。	已于 2010 年 12 月 3 日注销
香港汇锦	2003 年 9 月 5 日	无实际运营	同一实际控制人，姜雪飞持有 90%股权，朱雪花持有 10%股权。	已于 2011 年 6 月 24 日注销

大连电子是香港汇锦与大连多层于 2004 年 2 月 5 日投资设立的中外合资经营企业（台港澳与境内合资），注册地址为大连高新技术产业园区七贤岭高新街 2 号，注册资本 25 万美元，法定代表人为孙利刚，经营范围为印刷线路板的设计、生产加工。

自大连电子设立至 2009 年 3 月 27 日止，香港汇锦持有大连电子 38.16%的股权，大连电子的董事为孙利刚、王秀桂、姜雪飞，其中孙利刚担任董事长。大连电子主要从事单面板的生产，与本公司产品存在较大差异，同时，由于香港汇锦仅拥有 38.16%的股权，无法形成控制，香港汇锦于 2008 年 12 月 18 日将其持有的大连电子 38.16%的股权按出资额作价 9.54 万美元转让给香港永达，并签署了《股权转让协议》，大连高新技术产业园区管理委员会出具了大高管外企字【2009】024 号的《关于大连崇达电子有限公司股权转让的批复》，同意上述股

权转让事宜。2009年3月27日，大连电子在大连市工商行政管理局办理相应的工商变更登记，姜雪飞不再担任董事职务，至此，大连电子与发行人已不存在关联关系。

目前大连电子的股权架构为：

股东名称	注册资本（万美元）	持股比例（%）
大连多层	15.46	61.84
香港永达	9.54	38.16
合 计	25.00	100.00

大连多层是大连电子法定代表人孙利刚和王秀桂于2000年4月11日共同出资设立的有限责任公司，注册资本为200万元，经营范围为线路板、集成电路技术开发、技术服务及销售，电子元器件批发兼零售，其中孙利刚任执行董事兼总经理，王秀桂任监事。目前大连多层的股权结构如下：

股东姓名	注册资本（万元）	持股比例（%）
孙利刚	160.00	80.00
王秀桂	40.00	20.00
合 计	200.00	100.00

王秀桂与孙利刚为母子关系，本公司与大连多层不存在任何关联关系。

香港永达是肖艳于2008年2月20日在香港注册成立的有限公司，其注册资本为10万港币，股东为肖艳，其唯一董事为肖艳，肖艳为孙利刚的配偶，本公司与香港永达不存在任何关联关系。

5、其他关联自然人

本公司的关联自然人包括：公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，其中关系密切的家庭成员包括：配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

（二）发行人最近三年的关联交易事项

1、经常性关联交易

报告期内，大连电子委托大连崇达进行部分产品的表面处理，包括镀锡和防氧化处理，交易金额占公司销售收入总额的比例不足 0.1%，双方按照市场公允价格协商定价，资金按时结算，对本公司当期经营成果、利润和主营业务没有重大影响。报告期内，大连电子与公司的关联交易统计如下表所示：

单位：万元

关联方名称	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
大连电子	-	-	-	13.42
占当期加工费收入比重	-	-	-	5.54%

2、偶发性关联交易

（1）出资设立及收购大连崇达 30%股权

2008 年 3 月 21 日，集锦线路板与大连多层、关联自然人姜曙光共同出资设立大连崇达，注册资本为 1,000 万元。其中集锦线路板认缴出资 600 万元，占注册资本的 60%，姜曙光认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%，大连多层认缴出资 100 万元，占注册资本的 10%。

本公司与关联方姜曙光、非关联方大连多层出资设立大连崇达经公司股东会决议通过，各方出资完全按照出资额公允确定出资比例，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2009 年 4 月 16 日，姜曙光与集锦线路板签署《股权转让协议》，姜曙光将其持有的大连崇达 30%股权转让给集锦线路板，本次股权转让以大连崇达截至 2009 年 3 月 31 日经审计的净资产 4,283,491.73 元对应的净资产作价转让，姜曙光持有的 30%股权对应的净资产计 1,285,047.52 元作为转让价格。大连市工商行政管理局依法对本次股权变更进行了备案登记，并于 2009 年 5 月 8 日向大连崇达核发了变更后的《企业法人营业执照》。集锦线路板于 2009 年 6 月 29 日向姜曙光支付了全部股权转让款。

本次股权转让价格依据大连崇达经审计的净资产对应的股权比例确定，不存

在股权转让价格显失公允的情况。

（2）收购深圳崇达股权

截至 2008 年 9 月 30 日，深圳崇达注册资本为 6,350 万元，其中集锦线路板出资额 3,175 万元，占注册资本的 50%，香港汇锦出资额 3,175 万元，占注册资本的 50%。

2008 年 10 月 6 日，深圳崇达召开董事会，同意将注册资本从 6,350 万元增加至 7,937.5 万元。本次所增加注册资本 1,587.5 万元，全部为集锦线路板以货币出资，香港汇锦自愿不增资。2008 年 11 月 14 日，深圳大公会会计师事务所出具了深大公所验字【2008】158 号《验资报告》对本次增资进行了验证。本次增资完成后，深圳崇达的股权比例变更为集锦线路板占 60%，香港汇锦占 40%。

2009 年 11 月 30 日，香港汇锦与集锦线路板签订《股权转让协议》，香港汇锦将其持有的深圳崇达 40%股权转让给集锦线路板，本次股权转让以深圳崇达截至 2009 年 9 月 30 日经审计的净资产 126,132,346.85 元对应的 40%净资产份额计 50,452,938.74 元作为转让价格，定价公允，上述股权转让所涉税款已缴纳完毕；2010 年 3 月 19 日，集锦线路板已支付全部相关股权转让款，深圳崇达成为本公司的全资子公司。

本公司本次股权收购经转让双方内部有效决策，转让价格依据标的股权所对应的经审计的净资产确定，不存在转让价格显失公允的情况，亦不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

（3）关联担保

报告期内，本公司未给除子公司之外的其他关联方提供担保，但关联方为本公司提供借款担保，且均为无偿担保；截至本招股说明书签署日，未发生要求关联方履行担保义务的情形。

报告期内，关联方为本公司银行借款提供担保及反担保的事项如下：

借款方	关联担保方	担保方式	借款银行	主债权本金（万元）	借款期限	备注
集锦线路板	深圳中小担保为集锦线路板提供保证担保，姜雪飞、	保证（反担保）	工商银行新沙支行	400	2008.04.25-2009.04.24	履行完毕

	朱雪花向深圳中小担保提供反担保。					
	朱雪花向深圳中小担保提供反担保。	抵押（反担保）				
集锦线路板	姜雪飞、朱雪花	保证	华夏银行 振华支行	500	2008.09.25- 2010.09.25	履行完 毕
	朱雪花	抵押				
集锦线路板	深圳中小担保为集锦线路板提供保证担保，姜雪飞、朱雪花夫妇向深圳中小担保提供反担保。	保证（反担保）	工商银行 新沙支行	500	2009.05.20- 2010.05.19	履行完 毕
	朱雪花向深圳中小担保提供反担保。	抵押（反担保）				
集锦线路板	姜雪飞、朱雪花	保证	招商银行 福田支行	2,000	2010.02.11- 2011.02.11	履行完 毕
集锦线路板	姜雪飞	保证	工商银行 福永支行	1,745	2010.01.27- 2011.01.26	履行完 毕
				1,255	2011.01.01- 2012.01.01	履行完 毕
深圳崇达	深圳市高新投为深圳崇达提供保证担保，香港崇达线路板为深圳市高新投提供反担保。	保证（反担保）	建设银行 深圳分行	1,000	2008.08.27- 2009.08.26	履行完 毕
	姜雪飞	保证				
深圳崇达	姜雪飞	保证	兴业银行 振华支行	500	2008.07.16- 2009.07.16	履行完 毕
深圳崇达	姜雪飞、朱雪花	保证	平安银行 新洲支行	1,000	2008.06.03- 2009.06.02	履行完 毕
	深圳中小担保为深圳崇达提供保证担保，姜雪飞、朱雪花提供反担保。	保证（反担保）				
	姜雪飞向深圳中小担保提供房产抵押反担保	抵押（反担保）				
深圳崇达	姜雪飞、朱雪花	保证	平安银行 新洲支行	500	2008.06.25- 2010.06.25	履行完 毕
深圳崇达	姜雪飞、朱雪花	保证	平安银行 新洲支行	800	2009.02.13- 2010.02.12	履行完 毕
	深圳中小担保向深圳崇达提供保证担保，姜雪飞、朱雪花向深圳中小担保提供保证反担保。	保证（反担保）				
深圳崇达	姜雪飞、朱雪花	保证	平安银行 深圳分行	1,000	2009.09.22- 2010.09.21	履行完 毕
	深圳中小担保提供保证担保，姜雪飞、朱雪花、集锦线路板向深圳中小担保提供保证反担保。	保证（反担保）				
	姜雪飞	抵押（反				

		担保)				
深圳崇达	姜雪飞、朱雪花	保证	平安银行 深圳分行	1,500	2009.10.19- 2010.10.19	履 行 完 毕
	深圳市高新投为深圳崇达提供连带责任担保，由姜雪飞、朱雪花分别向深圳市高新投提供保证反担保。	保证（反担保）				
深圳崇达	姜雪飞	保证	中国银行 深圳分行	3,500（授 信额度）	2009.02.12- 2010.02.12	履 行 完 毕
深圳崇达	姜雪飞	保证	花旗银行 深圳分行	等 值 345 万 美 元 （ 授 信 融 资 ）	2008 年 5 月 起，应收账 款融资 4 个 月，应付账 款融资 5 个 月，结算前 风险 12 个 月	履 行 完 毕
深圳崇达	姜雪飞	保证	中国银行 深圳分行	3,000（授 信额度）	2009.05.21- 2010.05.21	履 行 完 毕
深圳崇达	姜雪飞	保证	中国银行 深圳分行	10,000(授 信额度)	2009.05.21- 2014.05.21	未 履 行 完毕
深圳崇达	姜雪飞	保证	中信银行 深圳分行	3,500	2011.5.24-2 011.11.24	履 行 完 毕
深圳崇达	姜雪飞	保证	中信银行 深圳分行	1,500	2011.5.27-2 011.11.27	履 行 完 毕
深圳崇达	姜雪飞	保证	工商银行 福永支行	4,500（授 信额度）	2011.07.01- 2012.6.30	履 行 完 毕
深圳崇达	姜雪飞	保证	中信银行 深圳分行	10,000(授 信额度)	2011.08.31- 2012.8.31	未 履 行 完毕
深圳崇达	姜雪飞	保证	兴业银行 深圳振华 支行	7,000（授 信额度）	2011.09.01- 2014.09.1	未 履 行 完毕
深圳崇达	姜雪飞	保证	中国银行 深圳南头 支行	5,000（授 信额度）	2012 年 3 月 12日至2013 年3月9日	未 履 行 完毕
崇达技术	姜雪飞、朱雪花	保证	兴业银行 振华支行	5,000（授 信额度）	2010. 12. 21 -2011. 12. 2 1	履 行 完 毕
崇达技术	姜雪飞、朱雪花	保证	招商银行 福田支行	7,000(授 信额度)	2011. 01. 05 -2012. 01. 0 5	履 行 完 毕
崇达技术	姜雪飞	保证	民生银行 深圳分行	10,000(授 信 额 度)	2012 年 3 月 23日至2013 年3月23日	未 履 行 完毕
崇达技术	姜雪飞	保证	工商银行 深圳福永 支行	3,000（授 信额度）	2012年3月1 日-2013年2 月28日	未 履 行 完毕

崇达技术	姜雪飞、朱雪花	保证	招商银行 深圳福田 支行	10,000 (授信额 度)	2012年3月 28日至2013 年3月27日	未履行 完毕
江门崇达	姜雪飞	保证	兴业银行 深圳振华 支行	30,000 (授信额 度)	2012年1月 17日-2017 年1月17日	未履行 完毕

3、关联资金往来

(1) 代收销售货款

① 代收货款背景及约定

本公司及子公司深圳崇达产品以外销为主，部分境外客户要求公司提供香港账户用以结算，本公司在2008年11月以前在香港没有设立分支机构，故本公司及子公司深圳崇达使用香港汇锦和香港崇达线路板的银行账户代收部分海外客户的货款。

本公司主要生产设备及部分原材料从国外进口，供应商经常会要求公司在短期内付款，由于通过香港公司支付货款的审批流程较短，为了提高采购货款的支付效率，保持公司在境外供应商中良好的商业信用和资信水平，公司部分原材料和设备的采购货款由香港汇锦和香港崇达线路板代为支付。

2008年11月，本公司对上述事项进行了规范，报告期内，本公司不存在通过香港汇锦、香港崇达线路板代收货款和代付采购款的行为。

② 代收货款具体情况

本公司通过香港汇锦、香港崇达线路板代收货款情况如下：

单位：万元

报告期	会计科目	款项内容	关联方名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
2009年至2011年	应收账款	代收货款	香港汇锦	-	-	-	-
2011年	应收账款	代收货款	香港崇达线路板	-	-	-	-
2010年	应收账款	代收货款	香港崇达线路板	1,484.21	-	1,484.21	-
2009年	应收账款	代收货款	香港崇达线路板	5,199.27	-	3,715.06	1,484.21

注：香港汇锦已于2011年6月24日注销，香港崇达线路板已于2011年4月15日注销。

截至 2008 年 12 月 31 日,深圳崇达应收回香港崇达线路板代收货款 5,199.27 万元,深圳崇达于 2009 年收回 3,715.06 万元、2010 年收回 1,484.21 万元,截至 2010 年 3 月 31 日,深圳崇达收回香港崇达线路板代收的全部货款。

③ 香港汇锦和香港崇达线路板主要财务数据

报告期内,香港汇锦的主要财务数据如下:

币种: 港币 单位: 万元

项目	2011.05.30/ 2011 年 1-5 月	2010.12.31/ 2010 年	2009.12.31/ 2009 年
总资产	57.12	58.16	58.10
净资产	57.12	58.16	58.10
销售收入	-	-	-
净利润	-1.00	0.02	0.00

注:香港汇锦于 2011 年 6 月 24 日注销,以上数据未经审计。

报告期内,香港崇达线路板的主要财务数据如下:

币种: 港币 单位: 万元

项目	2011.03.30/ 2011 年 1-3 月	2010.12.31/ 2010 年	2009.12.31/ 2009 年
总资产	32.46	308.21	1,721.90
净资产	32.46	33.96	36.21
销售收入	-	-	-
净利润	-1.50	-2.25	-14.90

注:香港崇达线路板于 2011 年 4 月 15 日注销,以上数据未经审计。2009 年总资产金额较大,主要系深圳崇达委托香港崇达线路板向客户代收的款项。

④ 香港汇锦和香港崇达线路板注销情况

自 2008 年 11 月开始,香港汇锦和香港崇达线路板不再实际经营,但由于至 2010 年 3 月,香港崇达线路板与深圳崇达的往来余额方清理完毕;同时,香港汇锦和香港崇达线路板已无实际业务,是否注销对本公司及深圳崇达不构成影响,因此,本公司未及时办理两家公司的注销手续。至 2010 年 10 月,香港汇锦和香港崇达线路板开始申请注销,由于注销时间较长,至 2011 年 4 月 15 日和 6 月 24 日,香港崇达线路板和香港汇锦分别依法注销。

香港汇锦、香港崇达线路板除代收、代付货款外,未实际经营业务,因此没

有经营性资产，不涉及对相关资产的处置。

（2）其他关联往来

报告期内，公司与关联自然人发生的偶发性关联往来明细如下：

单位：万元

年度	会计科目	款项内容	关联方名称	期初余额	累计借方发生额	累计贷方发生额	期末余额
2010 年	其他应付款	垫付款	朱雪花	-	353.00	353.00	-
2010 年	其他应收款	差旅费等	姜曙光	-	13.13	13.13	-
2010 年	其他应付款	差旅费等	姜曙光	1.08	1.93	0.85	-
2009 年	其他应收款	差旅费等	姜曙光	1.00	5.55	6.55	-
2009 年	其他应付款	差旅费等	姜曙光	10.00	12.07	3.15	1.08
2009 年	其他应付款	差旅费等	姜雪飞	11.59	16.39	4.80	-

根据上海众华出具的审计报告（沪众会字(2012)第 2792 号），截至 2010 年 12 月 31 日本公司与关联方之间的关联往来余额为零，2011 年、2012 年 1-6 月公司未与上述关联自然人发生资金往来。

（三）关联交易的批准情况

本公司制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》以及《对外担保管理制度》等制度对关联交易予以规范。

本公司第一届董事会第六次会议通过《关于公司 2008-2010 年关联交易情况的议案》，认为本公司 2008-2010 年最近三年的关联交易事项定价公允，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

本公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于公司 2011 年关联交易情况的议案》，并确认了该等关联交易的公允性，同时关联董事回避了表决。独立董事出具了《独立董事关于发行人关联交易公允性等问题的意见》，确认了本公司 2011 年发生的重大关联交易公允，不存在损害本公司及其他股东利益的情况，本公司 2011 年发生的重大关联交易已经履行了法定批准程序。

本公司第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司 2012 年 1—6 月关联交易情况的议案》，同时独立董事出具了《独立董事关于发行人关联交易

公允性等问题的意见》，确认了本公司 2012 年 1—6 月发生的重大关联交易公允，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

（四）关联交易决策权利和程序的规定

1、《公司章程》对于关联交易的规定

《公司章程》第三十九条规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

《公司章程》第四十一条：“对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议通过。”

《公司章程》第七十九条：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”且“关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过；关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避的，股东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。”

《公司章程》第一百一十条规定：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

《公司章程》第一百一十九条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

2、三会议事规则对关联交易的规定

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平和公正，公司股东大会、董事会、监事会根据《公司章程》及相关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，对关联交易的决策权力与程序进行了详细的规定。

3、《独立董事工作条例》的规定

《独立董事工作条例》第二十一条规定：“重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。”

《独立董事工作条例》第二十二条规定：“独立董事应当对公司重大事项向董事会或股东大会发表独立意见”，其中包括“公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款”。

4、《关联交易管理制度》的规定

《关联交易管理制度》对关联人、关联关系、关联交易的审批程序和披露都进行了详细的规定。

《关联交易管理制度》第二条规定：“公司关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则；

（二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；

（三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表决；

（四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避；

（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问出具意见。”

《关联交易管理制度》第十二条，关于“关联交易价格的管理”规定：

“（一）交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，并按关联交易协议当中约定的支付方式和时间支付进行结算。

（二）公司财务管理机构应对公司关联交易的市场价格及成本变动情况进行跟踪，并将变动情况报董事会备案。”

《关联交易管理制度》第十三条，关于“关联交易决策权限”规定：

“（一）除与董事长本人或与由董事长本人控股的关联法人发生的关联交易外，下列关联交易由公司董事长审批，并报董事会备案：1、与关联自然人发生的金额低于 30 万的关联交易；2、与关联法人发生的金额低于 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。

（二）下列关联交易由公司董事会审议决定：1、与关联自然人发生的金额在 30 万元以上、低于 300 万元的关联交易；2、与关联法人发生的金额在 300 万元以上及占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、且低于 3000 万元或者低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易；3、与董事长本人发生的金额低于 30 万的关联交易，或与由董事长本人控股的关联法人发生的金额低于 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。

（三）下列关联交易由公司董事会审议通过后，提交股东大会，由股东大会审议决定：1、与关联自然人发生的金额在 300 万元以上的关联交易；2、与关联法人发生的金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；3、根据本制度第十五条规定，因关联董事回避后董事会不足法定人数时，该关联交易由公司股东大会审议决定。”

《关联交易管理制度》第十四条关于“关联交易决策权限”规定：

“公司与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易应由全体独立董事的 1/2 以上认可后，提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断依据。”

除上述条款之外，《关联交易管理制度》还对关联法人、关联自然人的概念、关联交易范围、关联交易的审议及实施权限、关联交易的审议程序、关联人的回避表决、关联交易的披露及其他相关事项作出明确具体的规定。

（五）减少关联交易的措施

1、自 2008 年 11 月以来，控股股东、实际控制人姜雪飞、朱雪花夫妇对其控制的除发行人以外的其他企业通过转让、注销等方式进行了清理，通过减少关联企业的方法来减少关联交易。

2、本公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《内部控制制度》、《关联交易管理制度》。今后，公司将严格执行《公司章程》、三会议事规则、《独立董事工作条例》、《关联交易管理制度》、《内部控制制度》、《对外担保管理制度》中关于关联交易的规定，减少不必要的关联交易。

2011 年 2 月 12 日，公司控股股东、实际控制人姜雪飞、朱雪花，全体董事、监事和高级管理人员分别以书面形式向本公司出具了《关于规范和减少与深圳市崇达电路技术股份有限公司关联交易的承诺》；控股股东、实际控制人姜雪飞、朱雪花向公司出具了《关于不占用深圳市崇达电路技术股份有限公司资金的承诺函》。

第七章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况

（一）董事

本公司第一届董事会由 7 名成员组成，其中包括 3 名独立董事，上述董事由公司股东大会选举产生，任期三年。

1、姜雪飞先生，中国国籍，无境外居留权，现年 43 岁，毕业于东北财经大学对外经济贸易专业，厦门大学在读 EMBA，中国印制线路行业协会（CPCA）副理事长，深圳市线路板协会（SPCA）副会长。1988 年至 1992 年任职于大连太平洋多层线路板有限公司；1993 年至 1994 年任深圳恩达电子来料加工厂厂长；1995 年至 2010 年任集锦线路板执行董事、总经理；1999 年起至今任深圳崇达董事长、总经理；2010 年起至今任江门崇达执行董事。现任本公司董事长、总经理，任期自 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。

2、朱雪花女士，中国国籍，无境外居留权，现年 43 岁，东北财经大学在读 EMBA。1989 年至 1994 年先后就职于深圳市辉煌电子厂、深圳市侨力电子厂；1995 年至 2009 年任集锦线路板财务经理；2005 年起至今任深圳崇达副董事长；2008 年起至今任大连崇达监事。现任本公司董事，任期自 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。

3、余忠先生，中国国籍，无境外居留权，现年 38 岁，毕业于西南民族学院计算机应用专业，厦门大学在读 EMBA，中级经济师。1995 年至 1998 年历任申瓯通信设备有限公司车间主任、部门经理；1998 年至 2000 年任中国平安保险集团珠海支公司业务经理；2000 年至 2004 年历任大鹏证券经纪业务总部市场专员、投资培训师；2004 年至 2009 年历任深圳市三三得玖科技有限公司总经理助理、投资经理、监事；2009 年至 2010 年任集锦线路板财务总监；2009 年至今任深圳崇达董事。现任本公司董事、董事会秘书、财务总监，任期自 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。

4、汪姜维先生，中国国籍，无境外居留权，现年 35 岁，毕业于清华大学国际会计专业，加拿大注册会计师。1999 年至 2001 年任康佳集团股份有限公司综合会计主管；2001 年至 2005 年历任《新财富》杂志社研究员、主编助理、副主编、常务副主编、副总编辑等职；2006 年至 2007 年任《证券市场周刊》执行主编；2007 年至 2008 年任北京金弘润投资顾问有限公司合伙人、董事总经理；2008 年至今任深圳市同威创业投资有限公司董事；2010 年至今任上海宏壮矿业投资管理有限公司执行董事、云南江城泰裕钾肥有限公司董事、深圳市同安资本管理有限公司董事、2011 年至今任石河子同威创业股权投资管理有限公司监事等。现任本公司董事，任期自 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。

5、何为先生，中国国籍，无境外居留权，现年 55 岁，重庆大学化学系应用化学专业硕士。1987 年至 1990 年，任电子科技大学讲师、化学教研室副主任；1990 年至 1992 年，赴意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室访问学习；1992 年至 2000 年，历任电子科技大学副教授、教授、化学系主任；2000 年至 2001 年，任意大利佛罗伦萨大学化学系客座教授；2001 年 12 月至今，任电子科技大学微电子与固体电子学院教授、博导、系主任。现任本公司独立董事，任期自 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。

6、苏启云先生，中国国籍，无境外居留权，现年 48 岁，武汉大学法学博士。1985 年至 1991 年，任安徽省庐江县矾山中学教师；1994 年至 1995 年，任中国平安保险集团公司投资部高级主任；1995 年至 2002 年，任职于深圳市工商行政管理局法规处；2002 年至今，北京市德恒（深圳）律师事务所律师；目前担任深圳市通产丽星股份有限公司、深圳市金洋电子股份有限公司、江门市蒙德电气股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，任期自 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。

7、林涛先生，中国国籍，无境外居留权，现年 40 岁，厦门大学管理学博士。1999 年至今，历任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授、教授。目前担任贵州茅台酒股份有限公司、福建三元达通讯股份有限公司、福建火炬电子科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，任期自 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。

（二）监事

本公司第一届监事会由三名成员组成，其中包括一名职工代表。徐嘉辰和吴群华由公司股东大会选举产生，彭建均由公司职工代表大会选举产生。

1、徐嘉辰先生，中国国籍，无境外居留权，现年 33 岁，中国人民大学工商管理硕士，国际注册管理咨询师。2002 年 12 月至 2005 年 7 月，任赛格集团深爱半导体有限公司工艺主管；2005 年 8 月至 2008 年 12 月，任深圳市清溢和衡管理咨询有限公司常务副总经理；2009 年 1 月至 2009 年 11 月，任深圳市国信卓越绩效开发中心有限公司副总经理；2009 年 12 月至 2010 年 10 月，任深圳市国信卓越管理咨询有限公司总经理（期间曾担任深圳崇达“人力资源管理咨询项目”总监）；2010 年 11 月至今，任本公司人力资源总监。现任本公司监事会主席，任期自 2011 年 2 月至 2013 年 8 月。

2、吴群华先生，中国国籍，无境外居留权，现年 36 岁，毕业于湖南大学会计专业，注册会计师。1997 年 1 月至 1998 年 12 月，任湖南省桂阳县工商局科员；1999 年 1 月至 2002 年 12 月，任联颖电线电缆（深圳）有限公司会计；2003 年 1 月至 2006 年 11 月，任天职国际会计师事务所有限公司审计师；2006 年 11 月至 2007 年 6 月，任深圳天华会计师事务所有限公司项目经理；2007 年 7 月至 2008 年 6 月，任中美资本控股集团有限公司项目经理；2008 年 7 月至今，任汇投投资有限公司投资经理。现任本公司监事，任期自 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。

3、彭建均先生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西北工业大学网络教育学院工商管理专业，现年 40 岁。1993 年 3 月至 1997 年 12 月任东莞生益电子有限公司生产部领班；1998 年 3 月至 2001 年 4 月任深圳欣强科技有限公司阻焊课课长；2001 年 4 月至 2001 年 11 月任深圳崇达工程部工程师；2001 年 11 月至 2002 年 8 月任东莞茶山中德电子有限公司生产部主任；2002 年 8 月至今，历任深圳崇达工艺工程师、计划课主管、制造部副经理、制造部高级经理、监事。现任本公司职工代表监事，任期自 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。

（三）高级管理人员

本公司高级管理人员由公司第一届董事会聘任，任期三年。

1、总经理姜雪飞先生，简历同上。

2、彭卫红女士，中国国籍，无境外居留权，现年 38 岁，毕业于湖南省资江化学工业学校精细化工专业，湖南大学在读 EMBA。1995 年 9 月至 1999 年 1 月就职于湖南省青山硫铁矿化工厂，历任技术员、车间主任；1999 年 5 月至 1999 年 12 月，任东莞谢岗旗利得电子（东莞）有限公司工程师；2000 年 1 月至今，就职于深圳崇达，历任工程师、工艺课主管、制造部副经理、制造部经理、制造总监、副总经理兼任技术中心主任，具有多年的新产品研发工作经验，所带领的团队至今已申请几十项专利，被聘为 CPCA 科学技术委员会副会长及标准化委员会副会长。现任本公司副总经理，任期自 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。

3、姜曙光先生，中国国籍，无境外居留权，现年 45 岁，东北财经大学在读 EMBA。1990 年 10 月至 1997 年 9 月，任大连市星海机械刀片有限公司课长；1998 年—2008 年初，就职于集锦线路板，2008 年 3 月至今，任大连崇达执行董事、总经理。现任本公司副总经理，任期自 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。

4、邓峻先生，中国国籍，无境外居留权，现年 44 岁，毕业于江汉大学机械制造专业，东北财经大学在读 EMBA。1990 年至 1996 年，就职于铁道部大桥工程局三处一公司，历任机械管理员、机械管理主任；1996 年至 1998 年任科惠线路板有限公司 QA 工程师；1998 年至 1999 年任柏拉图电子有限公司品质课长；1999 年至 2003 年任深圳崇达品保部经理；2003 年至 2005 年任世运电子有限公司品保经理；2005 年至 2010 年 8 月，就职于集锦线路板，历任品保部经理、制造部经理副总经理；2010 年至今，任江门崇达总经理。现任本公司副总经理，任期自 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。其具有多年的生产及研发工作经验，所带领的团队至今已申请几十项专利。

5、董事会秘书、财务总监余忠先生，简历同上。

（四）核心技术人员

1、彭卫红女士，简历见（三）高级管理人员

2、邓峻先生，简历见（三）高级管理人员

3、刘东先生，中国国籍，无境外居留权，现年 40 岁，国家级高级工程师和线路板行业高级工程师，毕业于哈尔滨船舶工程学院，现任深圳崇达研发部经理。从事 13 年线路板工艺技术和研发工作，有丰富的线路板研发和技术管理经验，精通各线路板工艺流程和制作方法，并有出色的创新能力和新产品开发能力。工作期间，带领团队取得了多项专利。带领团队成员撰写论文并在“中日电子电路国际 PCB 技术/信息论坛”、“世界电子电路大会论坛”、“国际电子封装技术学术研讨会”等杂志上获得发表，团队共已有 30 篇论文获得发表，其中个人以第一作者名义发表 5 篇。

（五）董事、监事的提名和选聘情况

1、董事提名和选聘情况

2010 年 8 月 14 日，本公司创立大会暨第一次股东大会选举姜雪飞、朱雪花、余忠、汪姜维、何为、苏启云、林涛等 7 人为公司第一届董事会成员，其中何为、苏启云、林涛三人为公司独立董事。第一届董事会成员任期均为三年。

2010 年 8 月 14 日，本公司第一届董事会第一次会议选举姜雪飞为公司董事长。

姜雪飞、朱雪花、余忠 3 名董事的提名人为姜雪飞，董事汪姜维由汇投投资、同威创业和超淦贸易联合提名，独立董事何为、苏启云、林涛的提名人为姜雪飞。

2、监事提名和选聘情况

2010 年 8 月 14 日，本公司创立大会暨第一次股东大会选举严安辉和吴群华为公司第一届监事会成员，另一位监事彭建均由公司职工代表大会民主选举产生。第一届监事会成员任期均为三年。

2010 年 8 月 14 日，本公司第一届监事会第一次会议选举严安辉为公司监事

会主席。

2011年1月7日，严安辉因个人原因申请辞去公司监事会主席和监事职务。
2011年2月8日，本公司2011年第一次临时股东大会选举徐嘉辰为公司监事。
同日，本公司第一届监事会第四次会议选举徐嘉辰为公司监事会主席。

徐嘉辰监事的提名人为姜雪飞，吴群华监事由汇投投资、同威创业和超淦贸易联合提名，彭建均监事由公司职工代表大会选举产生。

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属报告期内直接持有公司股份情况如下表：

股份单位：股

姓名	职务	2009. 12. 31	2010. 12. 31	2011. 12. 31	发行前	质押或冻结情况
姜雪飞	董事长、总经理	20,700,000	77,688,300	77,688,300	77,688,300	无
朱雪花	董事	2,300,000	8,632,100	8,632,100	8,632,100	无
余忠	董事、董事会秘书、财务总监	0	1,538,000	1,538,000	1,538,000	无
汪姜维	董事	0	0	0	0	-
何为	独立董事	0	0	0	0	-
苏启云	独立董事	0	0	0	0	-
林涛	独立董事	0	0	0	0	-
徐嘉辰	人力资源总监、监事会主席	0	0	0	0	-
吴群华	监事	0	0	0	0	-
彭建均	高级经理、监事	0	512,700	512,700	512,700	无
彭卫红	副总经理	0	2,050,700	2,050,700	2,050,700	无
姜曙光	副总经理	0	4,614,400	4,614,400	4,614,400	无
邓峻	副总经理	0	1,538,000	1,538,000	1,538,000	无

董事汪姜维通过持有同威创业 2.44%的股份间接持有发行人 0.1162%的股份。除汪姜维外，上表所列其他人员均未间接持有公司股份。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况如下：

姓名	本公司职务	投资企业	投资额	所占比例
汪姜维	董事	芜湖同安股权投资基金	3,400 万基金份额	6.739%
		同威创业	100 万元	2.44%
		深圳市润和天泽环境科技发展有限公司	6 万元	3%
		东莞同威松山湖创业投资合伙企业（有限合伙）	800 万基金份额	7.77%
		石河子同威创业股权投资管理有限公司	60 万元	30%

上表所列董事、监事及高级管理人员的对外投资与本公司不存在利益冲突。其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在对外投资情况。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况

2011 年，本公司向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付薪酬情况如下：

姓名	职务	2011 年薪酬（万元）
姜雪飞	董事长、总经理	130
朱雪花	董事	113
余忠	董事、董事会秘书、财务总监	98
汪姜维	董事	0
何为	独立董事	6
苏启云	独立董事	6
林涛	独立董事	6
徐嘉辰	监事会主席、人力资源总监	73
吴群华	监事	0
彭建均	监事、高级经理	48
姜曙光	副总经理	30

彭卫红	副总经理	112
邓峻	副总经理	63
刘东	经理	36

截至本招股说明书签署日，本公司不存在其他特殊的待遇和退休金计划。本公司也未制订董事、监事及高级管理人员认股权计划。

五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况

姓名	在本公司任职	在其他单位任职情况	其他任职单位与本公司的关系
姜雪飞	董事长、总经理	深圳崇达董事长兼总经理	全资子公司
		江门崇达执行董事	全资子公司
		香港崇达董事	全资子公司
朱雪花	董事	深圳崇达副董事长	全资子公司
		大连崇达监事	全资子公司
余忠	董事、董事会秘书、财务总监	深圳崇达董事	全资子公司
汪姜维	董事	同威创业董事	本公司股东，持有本公司4.7609%的股份
		上海宏壮矿业投资管理有限公司执行董事	无
		云南江城泰裕钾肥有限公司董事	无
		芜湖同安股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人	无
		合肥同安创业投资基金行（有限合伙）执行事务合伙人委派代表	无
		深圳市同威成长创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表	无
		深圳市同威双盈投资企业（有限合伙）执行事务合伙人	无
		深圳市同安资本管理有限公司董事	无
		东莞同威松山湖创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表	无
		新疆同威之选股权投资有限合伙企业执行事务合伙人	无
		新疆同威昆仑股权投资有限合伙企业执行事务合伙人	无
		石河子同威创业股权投资管理有限公司监事	无
何为	独立董事	电子科技大学微电子与固体电子学院系主任、教授	无

苏启云	独立董事	北京市德恒（深圳）律师事务所律师	无
		深圳市通产丽星股份有限公司独立董事	无
		深圳市金洋电子股份有限公司独立董事	无
		江门市蒙德电气股份有限公司独立董事	无
林涛	独立董事	厦门大学管理学院会计系教授	无
		贵州茅台酒股份有限公司独立董事	无
		福建三元达通讯股份有限公司独立董事	无
		福建火炬电子科技股份有限公司独立董事	无
徐嘉辰	监事会主席	深圳崇达监事会主席	全资子公司
吴群华	监事	汇投投资投资经理	本公司股东，持有本公司4.7609%的股份
彭建均	监事	深圳崇达制造部高级经理、监事	全资子公司
彭卫红	副总经理	深圳崇达副总经理	全资子公司
姜曙光	副总经理	大连崇达执行董事、总经理	全资子公司
邓峻	副总经理	江门崇达总经理	全资子公司

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中，除姜雪飞与朱雪花为夫妻、姜雪飞与姜曙光为兄弟外，其余人之间不存在亲属关系。

七、本公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的协议情况

本公司董事、监事均与公司签订了《聘用合同》，高级管理人员、核心技术人员与公司签订了《劳动合同》。同时，公司与高级管理人员、核心技术人员签订了《保密协议》，对上述人员的诚信义务，特别是知识产权和商业秘密方面的义务进行了严格的规定。

本公司董事、监事、高级管理人员均已出具声明：本人及本人直系亲属不直接或间接从事或发展或投资与崇达技术经营范围相同或相类似的业务或项目，亦不会代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与崇达技

术进行直接或间接的竞争，或以任何其他形式从事损害崇达技术利益的活动。

八、董事、监事及高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事及高级管理人员符合法律法规规定的任职资格。

九、董事、监事及高级管理人员最近三年一期的变动情况

（一）董事变动情况

变动时间	变动依据	变动前人员	变动情况	变动原因	变动后人员
2010年8月14日	创立大会决议	姜雪飞为执行董事	姜雪飞、朱雪花、余忠、汪姜维、何为、苏启云、林涛7人组成董事会	完善公司法人治理结构	姜雪飞、朱雪花、余忠、汪姜维、何为、苏启云、林涛

（二）监事变动情况

变动时间	变动依据	变动前人员	变动情况	变动原因	变动后人员
2010年8月14日	创立大会决议、职工代表大会决议	朱雪花	严安辉、吴群华、彭建均（其中彭建均为职工代表监事）	完善公司法人治理结构	严安辉、吴群华、彭建均
2011年2月8日	临时股东大会决议	严安辉、吴群华、彭建均	监事严安辉变更为徐嘉辰	严安辉因个人原因辞去监事职务，补选徐嘉辰为监事	徐嘉辰、吴群华、彭建均

（三）高级管理人员变动情况

变动时间	变动依据	变动前人员	变动情况	变动原因	变动后人员
2009年5月9日	执行董事决议	姜雪飞、姜曙光	增加邓峻为副总经理	生产经营需要	姜雪飞、姜曙光、邓峻
2010年8月14日	董事会决议	姜雪飞、姜曙光、邓峻	彭卫红、余忠增加为高级管理人员	进一步加强公司经营管理能力	姜雪飞、邓峻、彭卫红、姜曙光、余忠

第八章 公司治理

2010年8月14日，公司召开创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会、监事会成员，并审议通过了《深圳市崇达电路技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。2010年8月14日，公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，任命了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，审议通过了《内部控制制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》。公司建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理结构。

上述各项制度对公司治理做出了制度上的规定，公司目前严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责。

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会运作及履行职责情况

公司法人治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会各专门委员会依法规范运作、履行职责，未出现违法违规现象，公司法人治理结构不断得到完善。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案等。

本公司设立以来，已经召开了9次股东大会会议，会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议记录完整规

范，股东大会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》所赋予的权利和义务。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会对股东大会负责，负责执行股东大会的决议，决定公司的经营计划和投资方案，制订公司的年度财务预算方案、决算方案，制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案，决定公司内部管理机构的设置，制订公司的基本管理制度，管理公司信息披露事务等。

本公司设立以来共召开了 13 次董事会会议，会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司监事会对公司的经营管理活动以及董事会、高级管理层履行职责的情况进行监督，监事会向股东大会负责。

本公司设立以来共召开了 9 次监事会会议，会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，监事会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职责。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

2010 年 8 月 14 日，公司创立大会暨第一次股东大会选举何为、苏启云、林涛为第一届董事会独立董事，并审议表决通过了《独立董事工作条例》。公司独立董事人数超过董事会总人数的三分之一，其中林涛为会计方面的专业人士。上述人士自担任独立董事以来，按照《公司章程》和《独立董事工作条例》的规定认真履行职责，对进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作发挥了积极作用。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本公司设立以来共召开了 13 次董事会会议，公司独立董事依据《公司章程》、

《独立董事工作条例》等工作要求，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席各次董事会会议，为本公司的重大决策提供专业及建设性的意见，认真监督管理层的工作，对本公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的促进作用。本公司独立董事参与了本次股票发行方案、本次发行募集资金运用方案的制订，并对本次股票发行方案和募集资金投资方案提出了独立意见。

（五）董事会秘书制度建立健全及运行情况

董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下主要职责：

1、组织筹备股东大会和董事会会议，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认。

2、负责保管公司股东名册、董事会名册，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等。

3、积极为独立董事履行职责提供协助，介绍情况、提供资料，并做好独立董事与董事会其他董事、董事会专门委员会之间的沟通工作。

4、在公司公开发行股票并上市后，董事会秘书应一并履行如下职责：

（1）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性；

（2）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（3）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并公告；

（4）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所所有问询；

（5）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、上市规则及交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（6）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、上市规则、交易所其

他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向交易所报告；

(7) 公司法、证券法、中国证监会及交易所要求履行的其他职责。

自公司董事会聘请董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司章程》、《董事会秘书工作制度》有关规定筹备董事会和股东大会，认真做好会议记录，并积极配合独立董事履行职责。

(六) 审计委员会制度建立健全及运行情况

本公司制定了《审计委员会议事规则》，经第一届董事会第一次会议审议通过由林涛（独立董事）、苏启云（独立董事）、朱雪花为审计委员会委员，其中林涛担任主任委员。

公司审计委员会主要职责包括：向董事会提出选聘或解聘会计师事务所的建议；审定、完善公司的内部审计制度并监督实施；审查、批准和调整年度审计计划并监督实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；检查审计工作和听取重大审计项目的情况汇报；考核、评价公司内部审计部门的工作并出具书面意见；考察公司内部审计负责人并向提名委员会提出任命或解聘的意见；审核公司的财务信息及其披露；解决和协调审计工作中遇到的问题，确保审计部门履行监督与评价职能；检查、监督公司存在或潜在的各种风险；检查公司遵守法律、法规的情况等。

本公司审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他独立董事委员主持。审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及《审计委员会议事规则》的规定；出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

审计委员会自成立以来召开了七次例会，审阅了公司财务部编制的 2010 年度财务报表和 2011 年第一季度报表、2011 年半年度财务报表、2011 年第三季度报表、2011 年度财务报表、2012 年一季度财务报表、2012 年半年度财务报表，并对其中的问题与会计师事务所进行了沟通；对公司各部门、控股子公司与财务报告和信息披露事务

相关的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对公司各部门、控股子公司的会计资料及其它有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行了监督和检查。审计委员会拟定了《内部审计工作制度》并已经公司董事会审议通过。

（七）战略委员会设置情况

本公司制定了《战略委员会议事规则》，经第一届董事会第一次会议审议通过由姜雪飞、汪姜维、何为（独立董事）为公司战略委员会委员，其中姜雪飞担任主任委员。

（八）薪酬与考核委员会设置情况

本公司制定了《薪酬与考核委员会议事规则》，经第一届董事会第一次会议审议通过由何为（独立董事）、林涛（独立董事）、余忠为公司薪酬与考核委员会委员，其中何为担任主任委员。

（九）提名委员会设置情况

本公司制定了《提名委员会议事规则》，经第一届董事会第一次会议审议通过由苏启云（独立董事）、何为（独立董事）、姜雪飞为公司提名委员会委员，其中苏启云担任主任委员。

二、发行人最近三十六个月违法违规行为情况

公司已依法建立健全股东大会制度、董事会制度、监事会制度、独立董事制度和董事会秘书制度，严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营。

深圳市规划和国土资源委员会、深圳市宝安区安全生产监督管理局、深圳市宝安区劳动监察大队、深圳市社会保险基金管理局、深圳市住房公积金管理中心、深圳市地方税务局、深圳市国家税务局、国家外汇管理局深圳市分局、中华人民共和国深圳海关、中华人民共和国深圳出入境检验检疫局、深圳市市场监督管理局、深圳市人居环境委员会、深圳市宝安区城市管理行政执法局、江门市工商行政管理局、江门市地方税务局、江门市国家税务局、江门市质量技术监督局、大连经济技术开发区国家税

务局、大连经济技术开发区地方税务局、大连市环境保护局、大连经济技术开发区社会保险管理中心、大连市住房公积金管理中心开发区办事处、大连金州新区人力资源和社会保障局、大连经济技术开发区质量技术监督局、大连金州新区安全生产监督管理局、大连市工商行政管理局开发区分局等机关为本公司出具了无违法违规的证明文件。

最近三十六个月，本公司不存在重大违法违规行为，也未受到过重大处罚。

三、发行人最近三年资金被占用和对关联方担保情况

（一）最近三年资金被实际控制人、控股股东及其控制的企业占用情况

各报告期末，本公司与关联方资金往来余额如下：

单位：万元

关联方名称	2012. 6. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31
一、应收账款				
香港崇达线路板	-	-	-	1,484.21
二、其他应收款				
姜曙光	-	-	-	-
三、其他应付款				
姜曙光	-	-	-	1.08
姜雪飞	-	-	-	-

截至 2010 年底，本公司与关联方之间的关联资金往来全部清理完毕，2011 年未再发生关联资金往来。本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关规章制度的规定，结合公司的实际情况，制定了有效的防止关联方占用公司资金行为的内部控制制度。本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》以及《对外担保管理制度》等制度均对关联交易予以规范，防止关联方占用公司资金行为。

（二）最近三年为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

报告期内，本公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

本公司成立后，《公司章程》、《对外担保管理制度》已明确规定对股东、实际控制人及其关联人提供担保的审批权限和审议程序，从制度上进一步规范了公司对股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为，切实保护公司以及全体股东的利益；规定了对外担保的审批权限和审议程序，从制度上保证公司对外担保行为的规范性。

四、发行人内部控制制度情况

（一）内部控制完整性、合理性和有效性的自我评估意见

公司管理层认为：“公司通过不断的建立、健全和执行各项内部控制制度，及依照上市公司标准严格要求，开展自查、整改、提高活动，现行的内部控制制度较为健全、合理、有效。本公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了有效的控制与防范作用，维护了股东，特别是中小股东和公司利益。公司将不断加强内部控制，并随着外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率和效益”。

（二）注册会计师的评价意见

2012年8月1日，上海众华出具了《深圳市崇达电路技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（沪众会字(2012)第2793号），对发行人内部控制设计的合理性和执行的有效性进行了审核，结论意见为：“崇达技术按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2012年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制”。

第九章 财务会计信息

本章的财务会计数据和相关的分析说明反映了公司报告期内经审计的财务状况、经营成果及现金流量。引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自上海众华[沪众会字(2012)第 2792 号]《审计报告》。投资者如需详细了解公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，请阅读本招股说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、财务报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2012.06.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：				
货币资金	72,562,468.51	82,723,876.87	86,693,735.30	60,114,328.29
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	2,023,981.29	78,599.70	-	200,000.00
应收账款	236,733,435.21	205,488,085.47	168,701,031.06	138,170,494.33
预付款项	28,168,781.62	6,910,698.04	11,527,008.67	11,832,201.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	10,211,523.25	12,564,674.80	16,719,135.58	11,839,083.08
存货	95,026,965.58	64,264,302.90	66,688,887.56	31,340,161.95
一年内到期的非流动资产	1,435,176.20	334,546.00	114,302.32	1,999,401.24
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	446,162,331.66	372,364,783.78	350,444,100.49	255,495,670.12
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-

投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	366,064,042.29	371,340,704.90	245,509,214.80	175,889,835.42
在建工程	117,231,891.79	108,414,666.71	43,275,679.89	37,586,066.55
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	51,173,888.39	52,192,712.22	45,783,535.17	52,842.34
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	48,072,476.24	52,516,853.59	45,045,552.85	4,321,838.40
递延所得税资产	4,447,932.08	2,434,592.53	2,200,734.69	2,065,241.59
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	586,990,230.79	586,899,529.95	381,814,717.40	219,915,824.30
资产总计	1,033,152,562.45	959,264,313.73	732,258,817.89	475,411,494.42

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2012.06.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动负债：				
短期借款	211,000,000.00	220,000,000.00	122,450,000.00	69,757,264.35
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	7,121,447.01	4,326,307.97	5,504,325.45	-
应付账款	177,028,517.97	170,190,809.71	166,501,788.61	121,396,928.73
预收款项	1,528,498.65	1,548,817.76	1,214,519.47	727,946.36
应付职工薪酬	19,078,635.66	12,255,920.52	19,019,462.35	13,606,482.80
应交税费	4,213,632.72	-10,418,453.96	-7,126,867.46	130,288.12
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	8,224,305.96	7,788,507.63	5,973,508.91	4,507,598.27
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	428,195,037.97	405,691,909.63	313,536,737.33	210,126,508.63
非流动负债：	-			
长期借款	132,005,000.00	106,120,000.00	53,000,000.00	38,565,760.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	15,493,625.00	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-

递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	4,442,000.00	4,334,000.00	1,518,000.00	1,702,000.00
非流动负债合计	136,447,000.00	110,454,000.00	70,011,625.00	40,267,760.00
负债合计	564,642,037.97	516,145,909.63	383,548,362.33	250,394,268.63
股东权益：				
股本	112,500,000.00	112,500,000.00	112,500,000.00	23,000,000.00
资本公积	106,071,517.26	106,071,517.26	106,071,517.26	6,434,929.48
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	10,410,205.90	10,410,205.90	4,719,511.81	11,406,436.26
未分配利润	239,528,801.32	214,136,680.94	125,419,426.49	130,812,586.40
归属于母公司股东权益合计	468,510,524.48	443,118,404.10	348,710,455.56	171,653,952.14
少数股东权益	-	-	-	53,363,273.65
股东权益合计	468,510,524.48	443,118,404.10	348,710,455.56	225,017,225.79
负债和股东权益总计	1,033,152,562.45	959,264,313.73	732,258,817.89	475,411,494.42

2、合并利润表

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
一、营业总收入	531,515,279.53	966,096,611.40	782,863,008.26	436,048,151.46
其中：营业收入	531,515,279.53	966,096,611.40	782,863,008.26	436,048,151.46
减：营业总成本	448,943,165.19	814,187,165.68	658,657,658.81	375,796,761.83
其中：营业成本	348,229,881.68	635,195,536.83	492,297,554.98	287,325,969.14
营业税金及附加	4,867,922.85	6,093,924.30	2,972,362.27	339,944.39
销售费用	20,564,723.31	37,299,500.45	33,307,873.02	16,250,430.93
管理费用	60,873,117.85	110,950,349.86	113,640,393.52	66,644,369.08
财务费用	10,611,989.74	22,640,222.80	12,512,261.86	8,246,692.66
资产减值损失	3,795,529.76	2,007,631.44	3,927,213.16	-3,010,644.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,572,114.34	151,909,445.72	124,205,349.45	60,251,389.63
加：营业外收入	2,335,081.59	4,576,942.86	2,443,923.32	2,306,054.07
减：营业外支出	406,330.15	546,687.17	3,351,601.29	156,297.32
其中：非流动资产处置损失	159,047.63	464,273.67	3,064,091.45	143,322.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,500,865.78	155,939,701.41	123,297,671.48	62,401,146.38

减：所得税费用	18,608,745.40	24,406,752.87	19,906,738.11	8,995,596.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,892,120.38	131,532,948.54	103,390,933.37	53,405,549.73
归属于母公司所有者的净利润	65,892,120.38	131,532,948.54	96,116,316.26	40,950,660.36
少数股东损益	-	-	7,274,617.11	12,454,889.37
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.59	1.17	0.85	-
（二）稀释每股收益	0.59	1.17	0.85	-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	65,892,120.38	131,532,948.54	103,390,933.37	53,405,549.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,892,120.38	131,532,948.54	96,116,316.26	40,950,660.36
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	7,274,617.11	12,454,889.37

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	476,990,433.86	911,295,561.88	770,399,420.57	442,709,013.96
收到的税费返还	26,605,905.00	67,417,061.93	28,620,565.13	7,980,135.69
收到其他与经营活动有关的现金	4,125,367.18	13,009,115.08	8,411,324.49	5,656,071.64
经营活动现金流入小计	507,721,706.04	991,721,738.89	807,431,310.19	456,345,221.29
购买商品、接受劳务支付的现金	259,878,188.33	502,980,252.57	443,650,144.81	228,338,941.63
支付给职工以及为职工支付的现金	98,533,006.69	170,979,131.38	114,385,331.09	64,822,574.46
支付的各项税费	17,915,080.17	55,389,362.88	39,702,318.15	16,083,219.30
支付其他与经营活动有关的现金	29,708,799.97	83,688,694.02	66,832,807.03	34,547,500.75
经营活动现金流出小计	406,035,075.16	813,037,440.85	664,570,601.08	343,792,236.14
经营活动产生的现金流量净额	101,686,630.88	178,684,298.04	142,860,709.11	112,552,985.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	150,000.00	563,087.28	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	60,000.00	150,000.00	563,087.28	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,995,445.35	276,218,923.07	172,930,678.09	58,343,996.46
投资支付的现金	-	-	50,452,938.74	1,714,570.39

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	75,995,445.35	276,218,923.07	223,383,616.83	60,058,566.85
投资活动产生的现金流量净额	-75,935,445.35	-276,068,923.07	-222,820,529.55	-60,058,566.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	75,900,000.00	-
取得借款收到的现金	113,885,000.00	400,670,000.00	152,450,000.00	170,882,742.18
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	113,885,000.00	400,670,000.00	228,350,000.00	170,882,742.18
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	250,000,000.00	85,304,819.01	150,983,622.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,798,913.55	54,494,902.22	34,252,874.07	41,692,793.80
支付其他与筹资活动有关的现金	670,000.00	1,030,000.00	-	953,695.56
筹资活动现金流出小计	150,468,913.55	305,524,902.22	119,557,693.08	193,630,111.58
筹资活动产生的现金流量净额	-36,583,913.55	95,145,097.78	108,792,306.92	-22,747,369.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	671,319.66	-1,730,331.18	-2,253,079.47	-587,211.56
五、现金及现金等价物净增加额	-10,161,408.36	-3,969,858.43	26,579,407.01	29,159,837.34
加：期初现金及现金等价物余额	82,723,876.87	86,693,735.30	60,114,328.29	30,954,490.95
六、期末现金及现金等价物余额	72,562,468.51	82,723,876.87	86,693,735.30	60,114,328.29

4、合并股东权益变动表

2012 年 1-6 月合并股东权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	112,500,000.00	106,071,517.26	-	-	10,410,205.90	-	214,136,680.94	-	-	443,118,404.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	112,500,000.00	106,071,517.26	-	-	10,410,205.90	-	214,136,680.94	-	-	443,118,404.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	25,392,120.38	-	-	25,392,120.38
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	65,892,120.38	-	-	65,892,120.38
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	65,892,120.38	-	-	65,892,120.38
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-40,500,000.00	-	-	-40,500,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-40,500,000.00	-	-	-40,500,000.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	112,500,000.00	106,071,517.26	-	-	10,410,205.90	-	239,528,801.32	-	-	468,510,524.48

2011 年合并股东权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	112,500,000.00	106,071,517.26	-	-	4,719,511.81	-	125,419,426.49		-	348,710,455.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	112,500,000.00	106,071,517.26	-	-	4,719,511.81	-	125,419,426.49		-	348,710,455.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	5,690,694.09	-	88,717,254.45	-	-	94,407,948.54
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	131,532,948.54	-	-	131,532,948.54
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	5,690,694.09	-	-42,815,694.09	-	-	-37,125,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,690,694.09	-	-5,690,694.09	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-37,125,000.00	-	-	-37,125,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	112,500,000.00	106,071,517.26	-	-	10,410,205.90	-	214,136,680.94			443,118,404.10

2010 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	23,000,000.00	6,434,929.48	-	-	11,406,436.26		130,812,586.40	-	53,363,273.65	225,017,225.79
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	23,000,000.00	6,434,929.48	-	-	11,406,436.26	-	130,812,586.40	-	53,363,273.65	225,017,225.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	89,500,000.00	99,636,587.78	-	-	-6,686,924.45	-	-5,393,159.91	-	-53,363,273.65	123,693,229.77
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	96,116,316.26	-	7,274,617.11	103,390,933.37
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	96,116,316.26	-	7,274,617.11	103,390,933.37
（三）所有者投入和减少资本	6,975,400.00	100,964,787.16	-	-	-	-	-	-	-60,637,890.76	47,302,296.40
1．所有者投入资本	6,975,400.00	68,924,600.00	-	-	-	-	-	-	-60,637,890.76	15,262,109.24
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	21,855,235.14	-	-	-	-	-	-	-	21,855,235.14
3．其他	-	10,184,952.02	-	-	-	-	-	-	-	10,184,952.02
（四）利润分配	-	-	-	-	4,719,511.81	-	-31,719,511.81	-	-	-27,000,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	4,719,511.81	-	-4,719,511.81	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-27,000,000.00	-	-	-27,000,000.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	82,524,600.00	-1,328,199.38	-	-	-11,406,436.26	-	-69,789,964.36	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	11,406,436.26	-	-	-	-11,406,436.26	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	71,118,163.74	-1,328,199.38	-	-	-	-	-69,789,964.36	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	112,500,000.00	106,071,517.26	-	-	4,719,511.81	-	125,419,426.49	-	-	348,710,455.56

2009 年合并股东权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	23,000,000.00	6,756,871.88			7,094,330.78		94,174,031.52		60,499,838.57	191,525,072.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	23,000,000.00	6,756,871.88	-	-	7,094,330.78	-	94,174,031.52	-	60,499,838.57	191,525,072.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-321,942.40	-	-	4,312,105.48	-	36,638,554.88	-	-7,136,564.92	33,492,153.04
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	40,950,660.36	-	12,454,889.37	53,405,549.73
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	40,950,660.36	-	12,454,889.37	53,405,549.73
（三）所有者投入和减少资本	-	-321,942.40	-	-	-	-	-	-	-1,391,454.29	-1,713,396.69
1．所有者投入资本	-	-321,942.40	-	-	-	-	-	-	-1,391,454.29	-1,713,396.69
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,312,105.48		-4,312,105.48	-	-18,200,000.00	-18,200,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	4,312,105.48		-4,312,105.48	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-		-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-		-	-		-18,200,000.00	-18,200,000.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	23,000,000.00	6,434,929.48			11,406,436.26		130,812,586.40		53,363,273.65	225,017,225.79

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2012.06.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：				
货币资金	8,965,184.30	11,936,609.23	24,017,450.07	26,712,913.80
交易性金融资产		-	-	-
应收票据	20,000,000.00	-	-	200,000.00
应收账款	90,711,010.64	76,609,223.20	92,597,440.25	42,028,246.02
预付款项	2,249,468.84	1,428,978.49	185,293.06	184,435.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	40,000,000.00	30,000,000.00	-
其他应收款	105,553,183.99	102,955,874.95	3,533,457.49	4,323,779.22
存货	22,179,688.91	14,472,889.97	17,162,202.56	11,108,312.70
一年内到期的非流动资产	239,380.00	-	114,302.32	-
其他流动资产		-	-	-
流动资产合计	249,897,916.68	247,403,575.84	167,610,145.75	84,557,687.03
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	156,672,685.43	156,672,685.43	156,672,685.43	56,219,746.69
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	57,075,260.65	60,503,366.27	56,320,338.72	50,166,567.27
在建工程	3,868,157.88	3,309,330.88	947,933.07	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	5,241,246.90	5,212,613.82	175,000.00	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	701,441.10	789,522.45	-	382,949.32

递延所得税资产	779,576.27	721,309.16	809,123.63	1,069,555.05
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	224,338,368.23	227,208,828.01	214,925,080.85	107,838,818.33
资产总计	474,236,284.91	474,612,403.85	382,535,226.60	192,396,505.36

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2012.06.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动负债：				
短期借款	91,000,000.00	100,000,000.00	72,450,000.00	2,900,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	65,442,813.23	58,762,932.91	52,596,232.95	37,927,464.47
预收款项	16,693.64	16,648.75	165,426.51	30,764.15
应付职工薪酬	6,956,177.39	4,797,187.12	5,828,187.71	4,734,781.78
应交税费	-56,415.68	347,230.32	-1,134,192.05	2,141,563.30
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	73,668,898.17	40,425,710.03	1,964,817.62	938,400.58
一年内到期的非流动负债		-	-	-
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计	237,028,166.75	204,349,709.13	131,870,472.74	48,672,974.28
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	5,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	1,242,000.00	1,334,000.00	1,518,000.00	1,702,000.00
非流动负债合计	1,242,000.00	1,334,000.00	1,518,000.00	6,702,000.00
负债合计	238,270,166.75	205,683,709.13	133,388,472.74	55,374,974.28
股东权益：				
股本	112,500,000.00	112,500,000.00	112,500,000.00	23,000,000.00

资本公积	89,451,635.76	89,451,635.76	89,451,635.76	-
减：库存股		-	-	-
专项储备			-	-
盈余公积	10,410,205.90	10,410,205.90	4,719,511.81	11,406,436.26
未分配利润	23,604,276.50	56,566,853.06	42,475,606.29	102,615,094.82
股东权益合计	235,966,118.16	268,928,694.72	249,146,753.86	137,021,531.08
负债和股东权益总计	474,236,284.91	474,612,403.85	382,535,226.60	192,396,505.36

2、母公司利润表

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
一、营业收入	178,891,174.10	319,541,542.43	291,582,606.55	163,272,016.33
减：营业成本	140,485,354.67	242,603,227.89	208,036,099.18	117,089,955.44
营业税金及附加	1,183,304.72	2,146,656.49	1,408,012.69	135,766.51
销售费用	7,092,393.44	10,935,241.66	11,435,976.08	5,569,171.80
管理费用	18,924,832.22	38,108,396.47	50,712,147.78	15,874,483.15
财务费用	3,295,274.80	7,544,190.32	3,084,175.35	429,561.14
资产减值损失	480,447.40	-130,521.67	1,299,937.35	-1,628,003.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	40,000,000.00	30,000,000.00	21,550,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,429,566.85	58,334,351.27	45,606,258.12	47,351,081.88
加：营业外收入	1,568,261.43	2,134,265.51	1,467,645.94	859,795.67
减：营业外支出	203,718.83	468,402.07	193,921.65	43,669.84
其中：非流动资产处置损失	1,628.83	431,716.95	186,768.08	43,669.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,794,109.45	60,000,214.71	46,879,982.41	48,167,207.71
减：所得税费用	1,256,686.01	3,093,273.85	5,509,994.77	5,046,152.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,537,423.44	56,906,940.86	41,369,987.64	43,121,054.75
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	7,537,423.44	56,906,940.86	41,369,987.64	43,121,054.75

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	138,617,249.78	337,712,304.85	260,034,919.52	148,388,802.51
收到的税费返还	2,190,222.29	7,734,293.27	5,509,103.66	2,771,068.71
收到其他与经营活动有关的现金	96,445,635.00	249,844,670.53	118,420,073.68	18,938,141.21
经营活动现金流入小计	237,253,107.07	595,291,268.65	383,964,096.86	170,098,012.43
购买商品、接受劳务支付的现金	113,718,842.12	199,764,057.18	199,969,732.61	90,876,743.31
支付给职工以及为职工支付的现金	32,163,860.11	57,994,633.10	34,532,866.53	20,590,920.74
支付的各项税费	2,671,730.48	8,390,099.26	10,637,461.48	5,986,099.29
支付其他与经营活动有关的现金	74,525,113.08	282,051,572.47	134,596,614.01	29,642,474.18
经营活动现金流出小计	223,079,545.79	548,200,362.01	379,736,674.63	147,096,237.52
经营活动产生的现金流量净额	14,173,561.28	47,090,906.64	4,227,422.23	23,001,774.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	30,000,000.00	-	21,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	34,500.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	30,000,000.00	34,500.00	21,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,570,635.92	21,991,473.22	17,614,182.58	17,206,331.25
投资支付的现金	-	-	100,452,938.74	2,589,220.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	49,741,588.74	-	-
投资活动现金流出小计	3,570,635.92	71,733,061.96	118,067,121.32	19,795,551.88
投资活动产生的现金流量净额	36,429,364.08	-41,733,061.96	-118,032,621.32	1,754,448.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	75,900,000.00	-
取得借款收到的现金	41,000,000.00	157,550,000.00	72,450,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	41,000,000.00	157,550,000.00	148,350,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	130,000,000.00	7,900,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,048,103.11	43,559,992.27	28,825,963.71	182,122.50
支付其他与筹资活动有关的现金	670,000.00	1,030,000.00	-	100,000.00
筹资活动现金流出小计	94,718,103.11	174,589,992.27	36,725,963.71	4,282,122.50
筹资活动产生的现金流量净额	-53,718,103.11	-17,039,992.27	111,624,036.29	717,877.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	143,752.82	-398,693.25	-514,300.93	-140,837.88
五、现金及现金等价物净增加额	-2,971,424.93	-12,080,840.84	-2,695,463.73	25,333,262.65
加：期初现金及现金等价物余额	11,936,609.23	24,017,450.07	26,712,913.80	1,379,651.15
六、期末现金及现金等价物余额	8,965,184.30	11,936,609.23	24,017,450.07	26,712,913.80

4、母公司股东权益变动表

2012 年 1-6 月母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	112,500,000.00	89,451,635.76	-	-	10,410,205.90	-	56,566,853.06	268,928,694.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	112,500,000.00	89,451,635.76	-	-	10,410,205.90	-	56,566,853.06	268,928,694.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-32,962,576.56	-32,962,576.56
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	7,537,423.44	7,537,423.44
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	7,537,423.44	7,537,423.44
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-40,500,000.00	-40,500,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-40,500,000.00	-40,500,000.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	112,500,000.00	89,451,635.76	-	-	10,410,205.90	-	23,604,276.50	235,966,118.16

2011 年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	112,500,000.00	89,451,635.76	-	-	4,719,511.81	-	42,475,606.29	249,146,753.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	112,500,000.00	89,451,635.76	-	-	4,719,511.81	-	42,475,606.29	249,146,753.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	5,690,694.09	-	14,091,246.77	19,781,940.86
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	56,906,940.86	56,906,940.86
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-		
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-		
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-		
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-		
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-		
3．其他	-	-	-	-	-	-		
（四）利润分配	-	-	-	-	5,690,694.09	-	-42,815,694.09	-37,125,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	5,690,694.09	-	-5,690,694.09	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-		
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-37,125,000.00	-37,125,000.00
4．其他	-	-	-	-	-	-		
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-		
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-		
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-		
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-		
4．其他	-	-	-	-	-	-		
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-		
1．本期提取	-	-	-	-	-	-		
2．本期使用	-	-	-	-	-	-		
（七）其他	-	-	-	-	-	-		
四、本期期末余额	112,500,000.00	89,451,635.76	-	-	10,410,205.90		56,566,853.06	268,928,694.72

2010 年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	23,000,000.00	-	-	-	11,406,436.26		102,615,094.82	137,021,531.08
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	23,000,000.00	-	-	-	11,406,436.26	-	102,615,094.82	137,021,531.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,500,000.00	89,451,635.76	-	-	-6,686,924.45	-	-60,139,488.53	112,125,222.78
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	41,369,987.64	41,369,987.64
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	41,369,987.64	41,369,987.64
（三）所有者投入和减少资本	6,975,400.00	90,779,835.14	-	-	-	-	-	97,755,235.14
1．所有者投入资本	6,975,400.00	68,924,600.00	-	-	-	-	-	75,900,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	21,855,235.14	-	-	-	-	-	21,855,235.14
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,719,511.81	-	-31,719,511.81	-27,000,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	4,719,511.81	-	-4,719,511.81	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-27,000,000.00	-27,000,000.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	82,524,600.00	-1,328,199.38	-	-	-11,406,436.26	-	-69,789,964.36	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	11,406,436.26	-	-	-	-11,406,436.26	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	71,118,163.74	-1,328,199.38	-	-	-	-	-69,789,964.36	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	112,500,000.00	89,451,635.76	-	-	4,719,511.81	-	42,475,606.29	249,146,753.86

2009 年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	23,000,000.00				7,094,330.78		63,806,145.55	93,900,476.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	23,000,000.00				7,094,330.78		63,806,145.55	93,900,476.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,312,105.48		38,808,949.27	43,121,054.75
（一）净利润	-	-	-	-			43,121,054.75	43,121,054.75
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	43,121,054.75	43,121,054.75
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,312,105.48		-4,312,105.48	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	4,312,105.48		-4,312,105.48	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	23,000,000.00	-	-	-	11,406,436.26	-	102,615,094.82	137,021,531.08

二、审计意见

本公司已聘请上海众华对公司截至 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日和 2012 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度、2010 年度、2011 年度和 2012 年 1-6 月的利润表和合并利润表，2009 年度、2010 年度、2011 年度和 2012 年 1-6 月的现金流量表和合并现金流量表，2009 年度、2010 年度、2011 年度、2012 年 1-6 月所有者权益变动表和合并所有者权益变动表进行了审计。上海众华对上述报表出具了标准无保留意见的《审计报告》（沪众会字(2012)第 2792 号）。

本章引用的相关财务数据，非经特别说明均引自经上海众华审计的合并会计报表。

三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

（一）会计报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）合并报表范围及变化情况

1、合并财务报表的合并范围

被投资单位名称	注册地	经营范围	注册资本	所占权益比例
深圳崇达	深圳	双面电路板、多层电路板、多层柔性电路板、HDI 电路板、多层刚柔结合型电路板的生产与销售、货物及技术进出口	人民币 7,937.50 万元	100%
大连崇达	大连	印刷电路板加工、设计和销售	人民币 1,000 万元	100%
香港崇达	香港	贸易	港币 100 万元	100%
江门崇达	江门	双面线路板、多层线路板、柔性线路板的设计、生产和销售；货物进出口、技术进出口	人民币 5,000 万元	100%

2、合并范围的变化情况

报告期内，本公司的合并报表范围变化情况如下：

公司名称	2011 年、2012 年 1-6 月		2010 年		2009 年	
	持股比例	是否合并	持股比例	是否合并	持股比例	是否合并
深圳崇达	100%	是	1-3 月：60% 4-12 月：100%	是	60%	是
大连崇达	100%	是	100%	是	1-6 月：60% 7-12 月：100%	是
香港崇达	100%	是	100%	是	-	-
江门崇达	100%	是	100%	是	-	-

2009 年 11 月 30 日，香港汇锦与集锦线路板签订股权转让协议，香港汇锦将其持有的深圳崇达 40%股权转让给集锦线路板，本次股权转让以深圳崇达截至 2009 年 9 月 30 日经审计的净资产 126,132,346.85 元对应的 40%净资产份额计 50,452,938.74 元作为转让价格。2009 年 12 月 15 日，深圳崇达完成工商变更登记。按照协议约定集锦线路板于 2010 年 3 月 19 日向香港汇锦支付了全部股权转让款，集锦线路板对深圳崇达的收购完成日应确定为 2010 年 3 月 19 日。

2009 年 4 月 16 日，姜曙光、大连多层分别与集锦线路板签署股权转让协议，姜曙光、大连多层分别将其持有的大连崇达 30%股权、10%股权转让给集锦线路板，本次股权转让以大连崇达截至 2009 年 3 月 31 日经审计的净资产 4,283,491.73 元对应的净资产作价转让，姜曙光、大连多层分别以净资产对应的份额计 1,285,047.52 元、428,349.17 元作为转让价格。2009 年 5 月 8 日，完成工商变更登记，大连崇达成为公司全资子公司。集锦线路板于 2009 年 6 月 29 日向姜曙光、大连多层支付了全部股权转让款，集锦线路板对大连崇达的收购完成日应确定为 2009 年 6 月 29 日。

2009 年 1 月 21 日，本公司新设香港全资子公司香港崇达，登记证号码 50221111-000-01，自设立之日起纳入合并报表范围。

2010 年 7 月 9 日，本公司新设全资子公司江门崇达，自设立之日起纳入合并报表范围。

四、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认和计量的具体方法

1、销售商品

（1）收入确认的总体原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）收入确认的具体原则

国内销售：本公司国内销售在货物交付到买方指定地点，客户验收并与公司核对后确认收入；

国外销售：公司出口销售90%以上采用FOB的方式，少量采用DDU贸易方式。

①采用FOB的贸易方式：货物在指定装运港装运时确认收入；②采用DDU贸易方式，本公司在货物交付到客户指定的地点，并由客户签收货运提单时确认收入的实现。

2、提供劳务

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权

公司让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二）金融工具的核算方法

本公司的金融资产主要为应收款项。

应收款项包括应收账款、其他应收款。应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对于预付账款、应收股利、应收利息等应收款项，期末如有客观证据表明其发生减值，则将其转入其他应收款，并进行减值测试计提坏账准备。

其他应收款--押金、保证金以及应收出口退税款不计提坏账准备。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额为 100 万元以上的应收账款和其他应收款；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	期末余额为 100 万元以上，经单独测试未减值的应收款项；100 万元以下、账龄 3 年以下的应收款项；
按组合计提坏账准备的计提方法	采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

本公司将未划分为单项金额重大的应收款项，划分为单项金额不重大的应收款项。对单项金额不重大的应收款项，以及经单独测试后未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大），以账龄为信用风险特征划分为若干组合，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明该等应收款项难以收回，期末余额为 100 万元以下、账龄 3 年以上的应收款项；
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

（三）存货的核算方法

1、存货的分类

存货分为原材料、库存商品、发出商品、在产品、低值易耗品等五大类。

2、存货的计价方法

本公司存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料（包括辅助材料）、低值易耗品在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价，库存商品发出时亦按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

（1）本公司的产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）本公司需要加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）本公司在资产负债表日，同一项存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提和转回的金额。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

4、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

（四）长期股权投资

本公司长期股权投资分为对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

1、投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

① 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

a、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c、购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

d、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认

(1) 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值

损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（五）投资性房地产的核算方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

1、投资性房地产按照成本进行初始计量

（1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

2、后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

3、折旧及减值准备

折旧和减值准备比照固定资产的折旧和减值准备执行。

（六）固定资产的核算方法

1、固定资产的确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

2、固定资产的折旧方法

类 别	折旧年限	残值率	年折旧率
-----	------	-----	------

房屋及建筑物	50 年	10%	1.8%
机器设备	10 年	10%	9%
运输设备	5 年	10%	18%
电子及其他设备	5 年	10%	18%
环保设备	5 年、10 年	10%	18%、9%

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

5、固定资产后续支出

固定资产的后续支出，如与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

（七）在建工程的核算

1、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、

溢折价摊销、汇兑损益等)，在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

2、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：①在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，②所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（八）无形资产的核算

1、无形资产的核算方法

无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、土地使用权等。无形资产在取得时按照实际成本计价。

2、无形资产的摊销

无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司无形资产具体摊销年限如下：

资产类别	摊销年限
软件	3年
土地使用权	剩余受益年限

本公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

3、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分

使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

4、研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准

（1）研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。

对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

（2）开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。

公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

（九）长期待摊费用的核算

长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者孰低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（十）借款费用

1、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（十一）外币业务核算方法

1、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期

近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

2、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（十二）政府补助

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（十三）递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产的确认

（1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；

（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（十四）本公司主要税种及适用税率

1、流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率
----	---------	-------

营业税	应纳税营业额	5%
增值税	应纳税销售收入	17%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%

(1) 根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府（1988）232 号）规定：“对特区企业生产、经营的收入，统一征收产品税、增值税、营业税和城市维护建设税。城市维护建设税以纳税人实际缴纳的产品税、增值税、营业税的税额为计税依据，税率为 1%”。

根据《深圳市地方税务局关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的公告》第三项规定：自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市城市维护建设税税率由 1%调整至 7%。

(2) 根据深府办[2011]60 号、深地税告[2011]6 号规定，从 2011 年 1 月 1 日起，深圳市行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人，按实际缴纳增值税、营业税、消费税税额的 2%缴纳地方教育费附加。

2、企业所得税税率

公司名称	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
崇达技术	15%	15%	15%	20%
深圳崇达	25%	15%	15%	15%
大连崇达	25%	25%	25%	25%
江门崇达	25%	25%	25%	-
香港崇达	16.5%	16.5%	16.5%	16.5%

(1) 根据《广东省经济特区条例》（1980 年 8 月 26 日第五届全国人民代表大会常务委员会第十五次批准施行），特区企业所得税税率为 15%。根据《关于宝安、龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》规定，设在宝安、龙岗两区的所有企事业单位，按照深圳经济特区的规定，一律按 15%的税率征收企业所得税。

根据《深圳市自行制定企业所得税优惠政策实行“即征即退”工作方案》规定，原适用 15%税率的企业，从 2008 年至 2012 年，按照适用税率（18%、20%、22%、24%、25%）计算实际应缴企业所得税税额。根据上述法规，崇达技术 2009 年企业所得税税率为 20%。

(2) 2010 年 9 月 6 日，崇达技术取得由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书；2009 年 6 月 27 日，深圳崇达取得由深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）之规定，崇达技术自 2010 年-2012 年享受该企业所得税优惠政策，减按 15%税率缴纳企业所得税；深圳崇达自 2009 年-2011 年享受该企业所得税优惠政策，减按 15%税率缴纳企业所得税。

(3) 根据 2011 年第 4 号《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。深圳崇达原高新技术企业证书有效期至 2012 年 6 月 27 日，其高新技术企业复审申请已于 2012 年 5 月 31 日被深圳市科技创新委员会受理。出于谨慎性原则，2012 年 1-6 月深圳崇达企业所得税税率暂按 25%计算。

五、分部报告信息

本公司经营产品类别单一，仅生产 PCB 产品，因此，公司无需按照经营分部划分业务分部。

六、最近一年收购兼并情况

无

七、非经常性损益明细表

上海众华对本公司报告期内的非经常性损益进行了鉴证，并出具了《关于深圳市崇达电路技术股份有限公司三年一期非经常性损益明细表的鉴证意见》（沪众会字(2012)第 2794 号），认为本公司“非经常性损益明细表及其说明符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》的规定”。本公司报告期内的非经常性损益发生额情况如下：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	16,808.94	-307,476.39	-2,993,111.86	-91,843.70
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	-	-	1,318,715.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,728,282.00	3,585,154.00	1,983,495.84	2,157,469.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,660.50	752,578.08	101,938.05	84,131.45
计入管理费用中的股份支付成本	-	-	-21,855,235.14	-
小 计	1,928,751.44	4,030,255.69	-22,762,913.11	3,468,472.56
减：所得税影响额	345,733.60	617,738.32	-128,232.14	366,154.74
减：少数股东权益影响额（税后）	-	-	-192,150.81	447,231.89

合 计	1,583,017.84	3,412,517.37	-22,442,530.16	2,655,085.93
-----	--------------	--------------	----------------	--------------

八、最近一期末固定资产、在建工程和对外投资情况

（一）固定资产

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

固定资产类别	折旧年限	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	-	-	-	-	-	-
机器设备	10 年	45,558.91	11,847.06	-	33,711.85	74.00%
运输设备	5 年	1,073.24	567.04	-	506.20	47.17%
电子及其他设备	5 年	3,054.15	1,702.73	-	1,351.42	44.25%
环保设备	5、10 年	1,637.66	600.73	-	1,036.93	63.32%
合计	-	51,323.97	14,717.56	-	36,606.40	71.32%

本公司固定资产主要由机器设备构成。由于本公司目前生产办公用房均为租赁方式取得，报告期内本公司无自有房屋和建筑物。报告期各期末，本公司无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无持有待售的固定资产，本公司固定资产不存在减值情形。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司原值为 18,414.86 万元的机器设备因融资而抵押给第三方。

（二）在建工程

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司在建工程账面价值 11,723.19 万元，列示如下：

单位：万元

项目	账面余额	减值准备	账面净值
大连工厂生产车间改造工程	44.93	-	44.93
江门--小批量 PCB 生产基地工程	10,204.63	-	10,204.63
待安装生产设备	1,134.13	-	1,134.13
Oracle 系统	339.50	-	339.50
合计	11,723.19	-	11,723.19

（三）对外投资

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司子公司已全部纳入合并报表，除此之外，本公司无其它对外投资情况。

九、最近一期末无形资产情况

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无形资产账面原值为 5,647.22 万元，账面价值为 5,117.39 万元，具体情况如下表：

单位：万元

资产类别	取得方式	初始金额	摊销年限	账面价值	剩余摊销年限
土地使用权	出让	4,569.35	50 年	4,401.81	48.17 年
软件	外购	1,077.87	3 年	715.58	2.01 年
合 计		5,647.22		5,117.39	

其中，土地使用权具体情况如下：

土地使用权证号	用途	面积（平方米）	座落	使用年限	终止日期
江国用（2011）第 304399 号	工业	131,266.70	江海区连海路 363 号	50 年	2060 年 9 月 16 日

十、最近一期末的主要债项

（一）短期借款

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司短期银行借款余额为 21,100 万元，具体情况如下：

单位：万元

贷款单位	期限	年利率	币种	金额	类别
兴业银行深圳振华支行	2011-12-20 至 2012-12-20	7.216%	人民币	5,000.00	保证
招商银行深圳福田支行	2012-4-16 至 2013-04-16	****	人民币	2,000.00	保证
工商银行深圳福永支行	2012-03-30 至 2013-03-27	**	人民币	100.00	保证
工商银行深圳福永支行	2011-07-15 至 2012-07-14	**	人民币	1,500.00	保证
工商银行深圳福永支行	2011-11-23 至 2012-11-14	**	人民币	500.00	保证
中信银行深圳分行	2011-09-07 至 2012-09-07	***	人民币	1,000.00	保证
中信银行深圳分行	2011-11-15 至 2012-11-15	***	人民币	3,000.00	保证
中信银行深圳分行	2011-11-11 至 2012-11-11	***	人民币	2,000.00	保证

贷款单位	期限	年利率	币种	金额	类别
中信银行深圳分行	2011-12-20 至 2012-12-20	***	人民币	2,000.00	保证
民生银行深圳分行	2012/6/26 至 2012/12/26	5.85%	人民币	2,000.00	保证
中国银行南头支行	2012/6/27 至 2013/6/27	*****	人民币	2,000.00	保证
合计				21,100.00	

**借款利率为借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率上浮 10%，基准利率每三个月为一浮动周期，一期一调整，分段计息。

***借款利率为借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率上浮 10%，基准利率随中国人民银行基准利率调整。

****以定价日适用的中国人民银行公布的 6-12 个月/一年金融机构人民币贷款基准利率为基准利率，基准利率每三个月为一浮动周期。

*****以实际提款日为起算日，每 3 个月为一个浮动周期，重新定价一次。首期利率为实际提款日中国人民银行公布施行的 6 个月至一年期贷款基准利率。

报告期内本公司未出现逾期未偿还银行借款的情况。

（二）应付账款

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司的应付账款余额为 17,702.85 万元，主要为应付供应商的货款。应付账款期末余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

截至 2012 年 6 月 30 日，应付账款账龄分析如下：

账龄	金额（万元）	比例
1 年以内	17,591.15	99.37%
1-2 年	109.78	0.62%
2-3 年	0.93	0.01%
3 年以上	1.00	0.01%
合 计	17,702.85	100.00%

（三）应付职工薪酬

截至 2012 年 6 月 30 日，公司应付职工薪酬为 1,907.86 万元。

本公司应付职工薪酬中不存在拖欠性质的金额。本公司职工当月工资下月支付，期末工资余额为计提的尚未发放的工资。

（四）其他应付款

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司其他应付款金额为 822.43 万元，其他应付

款中不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

（五）长期借款

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司长期借款本金 13,200.50 万元。

深圳崇达向中国银行深圳分行借款 6,000 万元，期限至 2014 年 5 月 25 日。2009 年 5 月 21 日，深圳崇达与中国银行深圳分行签署《人民币借款合同（中/长期）》，中国银行深圳分行向深圳崇达授予额度为 10,000 万元的贷款，借款期限 60 个月，深圳崇达可按照实际资金需求在 2 年内提清借款。该笔贷款目前处于还款期，每季度还款金额为 1,000 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，深圳崇达借款本金为 6,000 万元。该笔贷款由本公司、姜雪飞分别提供连带责任担保；深圳崇达以原值为 9,778.43 万元的机器设备提供抵押担保。

深圳崇达向兴业银行深圳振华支行借款 3,298.50 万元，根据深圳崇达与兴业银行深圳振华支行签署的《基本额度授信合同》，兴业银行深圳振华支行给予深圳崇达 7,000 万元的授信额度，期限至 2014 年 9 月 1 日，该笔贷款分别由本公司、姜雪飞提供连带责任担保，深圳崇达以机器设备提供抵押担保。

2011 年 12 月 20 日，江门崇达与兴业银行深圳振华支行签署《项目融资借款合同》，兴业银行深圳振华支行给予江门崇达 30,000 万元的授信额度，期限至 2017 年 1 月 17 日，该笔贷款由本公司、姜雪飞提供连带责任担保，江门崇达以土地、在建工程提供抵押担保。截至 2012 年 6 月 30 日，江门崇达在兴业银行的长期借款本金为 3,902.00 万元，尚未到期。

十一、发行人所有者权益情况

报告期内本公司各个会计期末股东权益情况如下：

单位：万元

项目	2012.06.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
股本	11,250.00	11,250.00	11,250.00	2,300.00
资本公积	10,607.15	10,607.15	10,607.15	643.49
盈余公积	1,041.02	1,041.02	471.95	1,140.64
未分配利润	23,952.88	21,413.67	12,541.95	13,081.26
归属于母公司股东权益合计	46,851.05	44,311.84	34,871.04	17,165.39

少数股东权益	-	-	-	5,336.33
股东权益合计	46,851.05	44,311.84	34,871.04	22,501.72

（一）股本

报告期内本公司股本变化情况如下：

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
期初股本金额	11,250.00	11,250.00	2,300.00	2,300.00
所有者投入股本	-	-	697.54	-
所有者权益内部结转	-	-	8,252.46	-
期末股本金额	11,250.00	11,250.00	11,250.00	2,300.00

1、2010 年 4 月 23 日，集锦线路板股东会决议由公司员工姜曙光、彭卫红、邓峻、余忠、袁进、彭建均、张庭主、严安辉、杨林、白会斌、汪广明、刘保海、王俊浩、尹建华、赵金秋、谢华、王剑峰等 17 人对公司进行增资。17 名公司员工合计投入 2,390 万元，增加注册资本 326.49 万元，溢价 2,063.51 万元计入公司资本公积。鹏城会计师事务所出具深鹏所验字【2010】193 号《验资报告》对本次增资进行了审验。

2、2010 年 6 月 10 日，集锦线路板股东会决议引进汇投投资、同威创业、超淦贸易等 3 名股东。其中，汇投投资投入 2,000 万元，增加注册资本 142.71 万元；同威创业投入 2,000 万元，增加注册资本 142.71 万元；超淦贸易投入 1,200 万元，增加注册资本 85.63 万元。3 名股东合计投入 5,200 万元，增加注册资本 371.05 万元，溢价 4,828.95 万元计入资本公积。鹏城会计师事务所出具深鹏所验字【2010】220 号《验资报告》对本次增资进行了审验。

3、2010 年 7 月 30 日，经集锦线路板股东会决议同意，决定以截至 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产折股，整体变更为股份公司，变更后注册资本为 11,250 万元。2010 年 8 月 14 日，鹏城会计师事务所出具深鹏所验字【2010】304 号《验资报告》对本次增资进行了审验。

（二）资本公积

报告期内，本公司的资本公积明细如下：

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
期初数	10,607.15	10,607.15	643.49	675.69
本期增加	-	-	10,096.48	-32.20
其中：收购深圳崇达 10%股权	-	-	-	-
收购大连崇达 40%股权	-	-	-	-32.20
收购深圳崇达 40%股权	-	-	1,018.50	-
姜曙光等 17 位新股东入股	-	-	2,063.51	-
同威创业等三位股东入股	-	-	4,828.95	-
股份支付	-	-	2,185.52	-
本期减少	-	-	132.82	-
其中：改制	-	-	132.82	-
期末数	10,607.15	10,607.15	10,607.15	643.49

1、2009 年 4 月 16 日，姜曙光、大连多层分别与集锦线路板签署股权转让协议，集锦线路板收购姜曙光、大连多层持有的大连崇达合计 40%的股权，收购完成后集锦线路板持有大连崇达 100%股权。本次股权转让以大连崇达截至 2009 年 3 月 31 日经审计的净资产 428.35 万元对应的净资产作价转让，转让价款计 171.34 万元。2009 年 6 月 29 日，集锦线路板支付全部相关股权转让款，本次股权收购形成资本公积-32.20 万元。

2、2009 年 11 月 30 日，香港汇锦与集锦线路板签订股权转让协议，香港汇锦将其持有的深圳崇达 40%股权转让给集锦线路板，本次股权转让以深圳崇达截至 2009 年 9 月 30 日经审计的净资产 12,613.23 万元对应的 40%净资产份额计 5,045.29 万元作为转让价格。2010 年 3 月 19 日，集锦线路板已支付全部相关股权转让款，本次股权收购形成资本公积 1,018.50 万元。

3、新股东投入资本溢价

2010 年 4 月 23 日，公司员工姜曙光、彭卫红、邓峻、余忠、袁进、彭建均、张庭主、严安辉、杨林、白会斌、汪广明、刘保海、王俊浩、尹建华、赵金秋、谢华、王剑峰等 17 人对公司进行增资。17 名公司员工合计投入 2,390 万元，增加注册资本 326.49 万元，溢价 2,063.51 万元计入公司资本公积。

2010 年 6 月 10 日，本公司新增汇投投资、同威创业、超淦贸易等 3 名法人股东，该 3 名股东合计投资 5,200 万元，其中 371.05 万元计入注册资本，其余 4,828.95 万元计入公司资本公积。

4、股份支付

2010年4月23日,公司员工姜曙光等17人合计以货币资金出资2,390万元,每元注册资本作价7.32元;2010年6月10日,汇投投资、同威创业、超淦贸易合计以货币资金出资5,200万元,每元注册资本作价14.01元。根据《企业会计准则第11号—股份支付》及应用指南相关规定,公司17名员工增资适用股份支付,应按照权益结算的股份支付进行会计处理。公司在评估每元注册资本的公允价值时,以相近时间与公司无关联关系的第三方的出资作价作为参考依据,即每元注册资本作价14.01元。公司17名员工的实际出资额与相应注册资本公允价值的差额2,185.52万元计入2010年管理费用,同时确认相应的资本公积。

5、变更为股份有限公司

根据2010年7月30日公司股东会决议,集锦线路板以整体变更的方式共同发起设立深圳市崇达电路技术股份有限公司。根据鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字【2010】1372号《审计报告》,公司截止2010年6月30日的净资产为20,195.16万元,各发起人同意将前述净资产全部投入股份公司,其中11,250万元折为股份公司的股本,余额8,945.16元计入股份公司资本公积(集锦线路板原账面资本公积为10,739.97万元,本次改制减少资本公积132.82万元)。

(三) 盈余公积

报告期内盈余公积明细情况如下:

单位: 万元				
项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
期初数	1,041.02	471.95	1,140.64	709.43
本期增加	-	569.07	471.95	431.21
本期减少	-	-	1,140.64	-
期末数	1,041.02	1,041.02	471.95	1,140.64

报告期内增加数均系根据公司章程和公司法的规定按净利润的10%提取的法定盈余公积。

2010年法定盈余公积减少数系2010年公司整体变更相应转增股本而减少1,140.64万元。

（四）未分配利润

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
上年末未分配利润	21,413.67	12,541.94	13,081.26	9,417.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,589.21	13,153.29	9,611.63	4,095.07
减：提取法定盈余公积	-	569.07	471.95	431.21
向投资者分配的利润	4,050.00	3,712.50	2,700.00	-
转增资本	-	-	6,979.00	-
期末未分配利润	23,952.88	21,413.67	12,541.94	13,081.26

历年未分配利润增加均系当期净利润转入。

（1）2010 年利润分配情况

2010 年 6 月 23 日，集锦线路板股东会决议通过公司 2009 年度分红的议案，向截至 2010 年 6 月 23 日公司登记在册的全体股东分配股利 2,700 万元。

（2）2010 年整体变更

2010 年 8 月集锦线路板整体变更设立股份有限公司。集锦线路板 6,979.00 万元未分配利润转为股份公司股本和资本公积。

（3）2011 年利润分配情况

2011 年 2 月 12 日，本公司 2010 年度股东大会审议通过了关于公司 2010 年度利润分配的议案，以 2010 年 12 月 31 日股本 11,250 万股为基数，向发行前的老股东每股派发现金 0.33 元（含税），合计派发现金股利 3,712.50 万元。截至 2011 年 3 月 17 日，本次股利分配实施完毕。

（4）2012 年利润分配情况

2012 年 3 月 8 日，崇达技术 2011 年度股东大会决议通过 2011 年度利润分配议案，以 2011 年 12 月 31 日股本 11,250 万股为基数，向发行前的老股东派发现金股利 4,050.00 万元。截至 2012 年 3 月 9 日，上述利润分配实施完毕。

十二、报告期内现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响

报告期内，本公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
经营活动产生的现金流量净额	10,168.66	17,868.43	14,286.07	11,255.30
投资活动产生的现金流量净额	-7,593.54	-27,606.89	-22,282.05	-6,005.86
筹资活动产生的现金流量净额	-3,658.39	9,514.51	10,879.23	-2,274.74
汇率变动对现金的影响	67.13	-173.03	-225.31	-58.72
现金及现金等价物净增加额	-1,016.14	-396.99	2,657.94	2,915.98

报告期，本公司未发生不涉及现金收支的重大投资和筹资活动事项。

十三、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项

（一）期后事项

本公司没有重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司未结清保函余额为 90 万美元。

（三）承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺为基建及装修工程支出合计 13,983.33 万元。

（四）其他重要事项

本公司无其他重大事项。

十四、主要财务指标

（一）主要财务指标

财务指标	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动比率（倍）	1.04	0.92	1.12	1.22
速动比率（倍）	0.82	0.76	0.91	1.07

资产负债率（合并报表）	54.65%	53.81%	52.38%	52.67%
资产负债率（母公司）	50.24%	43.34%	34.87%	28.78%
无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权）	1.53%	1.74%	0.11%	0.02%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	4.16	3.94	3.10	-
财务指标	2012 年 1-6 月 /2012.06.30	2011 年 /2011.12.31	2010 年 /2010.12.31	2009 年 /2009.12.31
应收账款周转率（次）	-	4.81	4.76	2.90
存货周转率（次）	-	9.70	10.04	11.58
利息保障倍数（倍）	8.16	9.98	18.55	12.08
息税折旧摊销前利润（万元）	12,981.34	22,559.94	16,729.57	9,535.10
归属于发行人股东的净利润（万元）	6,589.21	13,153.29	9,611.63	4,095.07
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	6,430.91	12,812.04	11,855.88	3,829.56
每股经营活动现金流量（元）	0.90	1.59	1.27	-
每股净现金流量（元）	-0.09	-0.04	0.24	-

上述主要财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=期末流动资产 / 期末流动负债
- 2、速动比率=（期末流动资产-期末存货） / 期末流动负债
- 3、资产负债率=期末总负债 / 期末总资产
- 4、无形资产占净资产的比例=期末无形资产 / 期末净资产
- 5、归属于发行人股东的每股净资产=期末净资产 / 期末总股本
- 6、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款期初期末平均余额
- 7、存货周转率=营业成本 / 存货期初期末平均余额
- 8、利息保障倍数=（净利润+所得税+利息支出） / 利息支出
- 9、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 10、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本
- 11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（或减少）额 / 期末总股本

（二）净资产收益率与每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），本公司报告期内的净资产收益率、每股收益如下：

报告期利润		加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009 年	27.06	-	-
	2010 年	36.04	0.85	0.85
	2011 年	34.02	1.17	1.17
	2012 年 1-6 月	14.46	0.59	0.59

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2009 年	25.30	-	-
	2010 年	44.45	1.05	1.05
	2011 年	33.14	1.14	1.14
	2012 年 1-6 月	14.11	0.57	0.57

上述指标的计算公式如下：

(1) 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

(2) 每股收益

$$\text{① 基本每股收益} = P_0 \div S \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股

份次月起至报告期期末的累计月数。

②稀释每股收益= $P_1/(S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k+\text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

十五、发行人盈利预测及披露情况

本公司未制作盈利预测报告。

十六、发行人设立时及报告期内资产评估情况

在本公司改制设立时，国友大正以 2010 年 6 月 30 日作为评估基准日，对本公司资产负债情况进行了评估，并出具了国友大正（2010）第 173 号《资产评估报告》。本次评估采用资产基础法进行评定估算，此次评估值仅作股本验证的参考，本公司未根据评估值调帐。

根据评估结果，本公司的净资产增值 42.22%，主要由于长期股权投资的评估增值所致。资产评估结果汇总表如下：

单位：万元				
项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	17,037.29	17,383.73	346.44	2.03
非流动资产	16,151.77	24,331.75	8,179.98	50.64
其中：长期股权投资	10,667.27	18,897.17	8,229.91	77.15
固定资产	5,347.60	5,409.89	62.29	1.16
长期待摊费用	24.47	27.54	2.71	10.95
递延所得税资产	112.16	-2.76	-114.92	-102.46
资产总计	33,189.06	41,715.48	8,526.42	25.69
流动负债	12,832.89	12,832.89	-	-
非流动负债	161.00	161.00	-	-

负债总计	12,993.89	12,993.89	-	-
净资产	20,195.17	28,721.59	8,526.42	42.22

除此之外，公司无其他资产评估情况。

十七、发行人历次验资情况

公司成立以来共进行了 9 次验资，根据验资机构出具的验资报告，历次资本变动的资本金均足额到位。

序号	验资报告日期	验资机构	验资报告书编号	变更后注册资本 (万元)	出资方式	验资事由
1	1995.04.20	深圳市民孚审计师事务所	深民审所验字 (1995) 298 号	200.00	货币资金	有限公司设立
2	2002.07.04	深圳广信会计师事务所	深广信所验字 (2002) 第 237 号	400.00	货币资金	增资
3	2004.01.08	深圳广信会计师事务所	深广信所验字 (2004) 第 005 号	700.00	货币资金	增资
4	2004.03.18	深圳广信会计师事务所	深广信所验字 (2004) 第 42 号	1,300.00	货币资金	增资
5	2004.10.21	深圳广信会计师事务所	深广信所验字 (2004) 第 738 号	1,500.00	货币资金	增资
6	2008.11.13	深圳毅华会计师事务所	深毅华所验字 【2008】第 428 号	2,300.00	货币资金	增资
7	2010.05.12	鹏城会计师事务所	深鹏所验字 【2010】193 号	2626.49	货币资金	增资
8	2010.06.13	鹏城会计师事务所	深鹏所验字 【2010】220 号	2997.54	货币资金	增资
9	2010.08.14	鹏城会计师事务所	深 鹏 所 验 字 (2010) 第 304 号	11,250.00	净资产折股	股份公司设立

历次验资的具体内容详见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“四、发行人历次验资情况”相关内容。

第十章 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

（一）资产构成情况分析

1、主要资产的构成及其变化

随着业务规模的不断扩大，本公司资产规模也不断增大。最近三年一期，本公司资产总额分别为 47,541.15 万元、73,225.88 万元、95,926.43 万元和 103,315.26 万元，其中：2010 年末资产总额较上年末增长 54.03%；2011 年末资产总额较上年末增长 31.00%；2012 年 6 月末资产总额较上年末增长 7.70%。

报告期内，由于公司生产规模的不断扩大及江门崇达的建设工作逐步推进，固定资产规模逐年增加，非流动资产比重呈上升趋势，公司产能也因此得到有效扩充。本公司流动资产与非流动资产结构如下表：

单位：万元

资产	2012. 06. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31		2009. 12. 31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动资产	44,616.23	43.18	37,236.48	38.82	35,044.41	47.86	25,549.57	53.74
非流动资产	58,699.02	56.82	58,689.95	61.18	38,181.47	52.14	21,991.58	46.26
资产总计	103,315.26	100.00	95,926.43	100.00	73,225.88	100.00	47,541.15	100.00

2、流动资产分析

最近三年一期，本公司流动资产明细及结构如下表：

单位：万元

项 目	2012. 06. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31		2009. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
货币资金	7,256.25	16.26	8,272.39	22.22	8,669.37	24.74	6,011.43	23.53
应收票据	202.40	0.45	7.86	0.02	-	-	20	0.08
应收账款	23,673.34	53.06	20,548.81	55.18	16,870.10	48.14	13,817.05	54.08
预付款项	2,816.88	6.31	691.07	1.86	1,152.70	3.29	1,183.22	4.63

其他应收款	1,021.15	2.29	1,256.47	3.37	1,671.91	4.77	1,183.91	4.63
存货	9,502.70	21.30	6,426.43	17.26	6,668.89	19.03	3,134.02	12.27
一年内到期的非流动资产	143.52	0.32	33.45	0.09	11.44	0.03	199.94	0.78
流动资产合计	44,616.23	100.00	37,236.48	100.00	35,044.41	100.00	25,549.57	100.00

本公司的流动资产主要由应收账款、存货和货币资金构成，报告期内上述资产合计占流动资产的比重分别为 89.88%、91.91%、94.66%和 90.62%。本公司主要流动资产具体分析如下：

（1）应收票据

报告期内，公司接受部分信誉较高的客户通过银行承兑汇票的方式进行结算。应收票据的具体内容如下：

单位：万元

客户	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	收到票据金额	余额	收到票据金额	余额	收到票据金额	余额	收到票据金额	余额
成都金之川电子有限公司	706.44	50.00	451.05	-	-	-	-	-
烽火通信科技股份有限公司	471.00	-	1,626.38	-	1,468.31	-	1,306.20	20.00
深圳雅图数字视频技术有限公司	401.70	62.65	819.27	-	-	-	-	-
惠州华阳通用电子有限公司	258.55	50.74						
武汉烽火网络有限责任公司	232.87	39.01	397.86	-	-	-	-	-
威科电子模块（深圳）有限公司	61.13	-	84.17	-	-	-	-	-
深圳华北工控股份有限公司	60.00	-	178.15	-	17.25	-	-	-
深圳市景阳科技股份有限公司	45.96	-	32.68	-	-	-	-	-
瑞谷科技（深圳）有限公司	40.23	-	-	-	212.83	-	905.40	-
深圳市海光电子有限公司	30.60	-	134.40	7.86	-	-	-	-
深圳麦逊电子有限公司	10.00	-	37.10	-	-	-	-	-
深圳市欧曼特微显示科技有限公司	-	-	48.68	-	202.00	-	-	-
四川泛华航空仪表电器厂	-	-	30.00	-				
北京力源兴达科技有限公司	-	-	9.19	-				
青岛大星电子有限公司	-	-	158.64	-				
北京益弘泰科技发展有限责任公司	-	-	27.58	-				
深圳市兴森快捷电路技术股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳拓邦股份有限公司	-	-	-	-	67.29	-	-	-
合计	2,318.47	202.40	4,035.15	7.86	1,967.68	-	2,211.60	20.00

(2) 应收账款

最近三年一期，公司应收账款净额占流动资产的比重分别为 54.08%、48.14%、55.18%、53.06%，是公司占比最大的流动资产。

① 应收账款变动情况分析

报告期各期末，本公司应收账款变动情况如下表：

单位：万元				
项 目	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31
应收账款余额	25,536.20	22,032.12	18,179.74	14,731.77
其中：应收关联方账款	-	-	-	1,484.21
坏账准备	1,862.86	1,483.31	1,309.64	914.72
应收账款净额	23,673.34	20,548.81	16,870.10	13,817.05
余额占主营业务收入比例（%）	49.31	23.49	23.75	34.40

2009年末，公司存在应收关联方香港崇达线路板的款项，金额为1,484.21万元，主要是由于2008年11月份前香港崇达线路板为深圳崇达代收货款形成，平均账龄超过1年。截至2010年3月，深圳崇达已全额收回上述款项。

2010年末，公司应收账款余额为18,179.74万元，较2009年末增长23.41%，主要原因是2010年全球PCB行业发展形势持续向好，公司订单数量大幅上升，销售额大幅度增加所致。2010年公司营业收入较上年增长79.54%。

2011年末，公司应收账款余额为22,032.12万元，较2010年末增长21.19%。主要原因为公司销售规模较2010年继续保持较快增长，2011年公司营业收入较上年收入增长23.41%。

2012年6月30日，公司应收账款余额为25,536.20万元，较2011年末增长15.90%，主要原因是由于公司2012年第二季度收入增长较快导致应收账款余额较大。2012年6月30日应收账款余额中的91.82%账龄保持在3个月以内，属于公司正常信用期内款项。

② 应收账款账龄分析

报告期各期末，本公司应收账款余额的账龄结构如下表：

单位：万元				
账 龄	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,121.70	98.38	21,630.32	98.18	17,730.63	97.53	12,942.35	87.86
其中:3 个月以内	23,448.32	91.82	20,177.01	91.58	16,905.83	92.99	11,799.55	80.10
1-2 年	7.37	0.03	-	-	186.17	1.02	1,760.94	11.95
2-3 年	-	-	150.12	0.68	234.46	1.29	28.48	0.19
3 年以上	407.13	1.59	251.67	1.14	28.48	0.16	-	-
合 计	25,536.20	100.00	22,032.11	100.00	18,179.74	100.00	14,731.77	100.00

公司销售产品采取月结方式或预收款方式进行结算。其中，对于大部分客户，公司均采取月结的方式进行结算，公司一般根据客户的资信情况和采购数量授予客户一定信用期限，平均在 90 天左右；对于小客户和首次合作的客户，公司多数采取预收款方式进行结算。

报告期内，公司账龄在 3 个月以内的应收账款的比例分别为 80.10%、92.99%、91.58%、91.82%。

2009 年，公司账龄在 3 个月以内的应收账款占比相对较低，主要是受应收关联方香港崇达线路板大额逾期应收账款的影响。如剔除该因素，报告期内，公司账龄在三个月内的应收账款比例分别为 89.07%、92.99%、91.58%、91.82%，账龄在一年以内的比例分别为 97.70%、97.53%、98.18%、98.38%，与公司结算政策相符。

本公司非常重视应收款项的安全，采取建立销售和货款回收的内部控制制度、建立客户信用评级及考核制度、建立货款回收的考核制度、购买应收账款保险等多种方式，提高资产整体质量、保证资产的安全。目前公司的应收账款整体质量较高，与生产经营规模相适应。

③ 应收账款主要客户分析

公司与主要客户均保持长期的业务合作关系，形成一种稳定持续的业务关系，粘度较强。公司的客户群分布广泛，包括 PCB 设计公司、PCB 生产企业、EMS 公司、PCB 贸易商、终端客户，主要客户大多数在行业内处于领先地位。报告期内，公司未发生过大客户流失的情况。

报告期内应收账款前五名客户情况

年度	排名	客户名称	金额（万元）	比重
----	----	------	--------	----

2012年6月30日	1	Palpilot International Corp.	4,571.77	17.90%
	2	PCB TECHNOLOGIES LTD	1,709.07	6.69%
	3	SUNTECH CIRCUITS INC.	1,067.46	4.18%
	4	武汉烽火通信科技股份有限公司	690.31	2.70%
	5	SVI PUBLIC COMPANY LIMITED	591.68	2.32%
	应收账款前五名客户合计		8,630.29	33.80%
2011年12月31日	1	Palpilot International Corp.	4,486.40	20.36%
	2	PCB TECHNOLOGIES LTD	1,845.98	8.38%
	3	SUNTECH CIRCUITS INC.	931.93	4.23%
	4	P.D. Circuits INC.	822.42	3.73%
	5	捷普电子（广州）有限公司	648.31	2.94%
	应收账款前五名客户合计		8,735.03	39.65%
2010年12月31日	1	Palpilot International Corp.	3,257.75	17.92%
	2	PCB TECHNOLOGIES LTD	1,245.24	6.85%
	3	P.D. Circuits INC.	901.10	4.96%
	4	Kestrel international circuits ltd	691.55	3.80%
	5	SUNTECH CIRCUITS INC.	543.49	2.99%
	应收账款前五名客户合计		6,639.13	36.52%
2009年12月31日	1	Palpilot International Corp.	1,800.94	12.22%
	2	PCB TECHNOLOGIES LTD	930.58	6.32%
	3	艾默生网络能源有限公司	908.31	6.17%
	4	P.D. Circuits INC.	707.83	4.80%
	5	Kestrel international circuits ltd	434.97	2.95%
	应收账款前五名客户合计		4,782.63	32.46%

注：前五大客户统计中不包括应收关联方香港崇达线路板代本公司收取客户款项而产生的应收账款。

主要应收账款客户的行业地位

主要客户	开始合作时间	客户行业地位
Palpilot International Corp.	2005.07	美国最大的 PCB 设计公司之一
PCB TECHNOLOGIES LTD	2005.10	以色列 PCB 上市公司，为客户提供 PCB 设计、生产、销售的一站式服务
P.D. Circuits, Inc.	2007.05	美国著名 PCB 代理公司之一。主要经营 PCB 板的供应，能提供从工程、设计到生产、品质、物流及仓储管理全套服务
Kestrel international circuits ltd	2004.11	英国知名 PCB 代理公司，主要从事 PCB 样板和批量板的代理销售。是 Falcon PCB Group 旗下的 PCB 代理公司，由 PCB 工厂转型而来
艾默生网络能源有限公司	2007.05	世界 500 强，主要生产各类高端电源产品，主要 PCB 需求为电源电子（厚铜板）
SUNTECH CIRCUITS INC.	2008.05	由美国中部知名的 PCB 厂转型成代理公司，能提供从工程、设计到生产、品质、物流及仓储管理全套服务
捷普电子（广州）有限公司	2007.11	著名美资企业，隶属于美国上市公司 Jabil Circuit

		， Jabil Circuit 是全球电子合约制造服务商(EMS)
武汉烽火通信科技股份有限公司	2004.4	1999 年 12 月 25 日成立，是国内优秀的信息通信设备与网络解决方案提供商。

报告期内，本公司应收账款前五大客户合计占本公司应收账款总额的比重分别为 32.46%、36.52%、39.65%、33.80%，公司应收前五大客户基本保持稳定，未形成对单一客户的依赖。

④ 应收账款期后回款情况

公司前十大欠款方于 2012 年 6 月 30 日的欠款情况及截至 2012 年 7 月 31 日的回款情况如下表：

序号	客户名称	应收账款金额 (万元)	期后收款金额 (万元)	回款比率	未回款原因
1	Palpilot International Corp.	4,571.77	1,384.48	30.28%	尚未到期
2	PCB TECHNOLOGIES LTD	1,709.07	704.69	41.23%	尚未到期
3	Suntech Circuits, Inc	1,067.46	349.67	32.76%	尚未到期
4	武汉烽火通信科技股份有限公司	690.31	230.00	33.32%	尚未到期
5	SVI PUBLIC COMPANY LIMITED	591.68	199.64	33.74%	尚未到期
6	EPEC LLC	546.43	63.76	11.67%	尚未到期
7	Dynamic Details, inc	497.10	249.80	50.25%	尚未到期
8	P.D. Circuits, Inc.	472.36	298.71	63.24%	尚未到期
9	Kestrel international circuits ltd	458.77	200.86	43.78%	尚未到期
10	捷普电子（广州）有限公司	437.79	198.65	45.38%	尚未到期
	合计	11,042.74	3,880.26	35.14%	

(3) 预付款项

公司的预付款项主要为预付原材料和工程及机器设备采购款。最近三年一期，公司预付款项期末余额分别为 1,183.22 万元、1,152.70 万元、691.07 万元、2,816.88 万元。

2012 年 6 月 30 日，公司预付账款分类列示如下：

单位：万元

项目	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31
预付工程、设备采购款	2,784.44	609.65	661.95	986.44
预付海关进口设备税款	9.57	44.56	465.73	-
预付材料采购款	22.87	36.86	25.02	196.78

合计	2,816.88	691.07	1,152.70	1,183.22
----	----------	--------	----------	----------

2012 年 6 月 30 日，公司预付账款余额较 2011 年 12 月 31 日大幅增加，主要原因系江门崇达预付的工程款、设备款增加所致。截至 2012 年 06 月 30 日，公司大额工程及设备采购预付款及对应采购合同情况如下：

供应商名称	采购内容	合同总价 (万元)	预付比例	预付金额 (万元)
中国电子系统工程第四建设有限公司	江门崇达 1#厂房暖通项目	3,210.00	20%	642.00
深圳市湛艺装饰设计工程有限公司	江门崇达一期宿舍楼内部装修工程	690.00	54.12%	437.60
	江门崇达食堂装饰工程	118.00		
竞铭机械股份有限公司	江门崇达电镀机及碳处理系统	111.19 万 美元	30%	212.69
深圳市展耀科技有限公司	江门崇达 BURKLE 多层线路板压机	951.21	20%	190.24
昆山巨阙机械科技有限公司	半自动迭合拆解回流系统	410.00	30%	123.00
江门繁华输配电设备有限公司	江门崇达厂房配电一期工程设备	267.44	40%	106.97
合计				1,712.50

(4) 其他应收款

最近三年一期，公司其他应收款主要由保证金、应收出口退税款、押金构成，具体情况如下表：

单位：万元

项 目	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31
其他应收款余额	1,021.15	1,256.47	1,671.91	1,186.14
其中：厂房租赁保证金	500.00	500.00	500.00	500.00
应收出口退税	-	-	756.02	351.13
押金及其他	521.15	756.47	415.89	335.01
其他应收款净额	1,021.15	1,256.47	1,671.91	1,183.91
占总资产比例 (%)	0.99	1.31	2.28	2.49

最近三年一期，公司其他应收款期末余额分别为 1,186.14 万元、1,671.91 万元、1,256.47 万元、1,021.15 万元。

① 厂房租赁保证金

厂房租赁保证金系深圳崇达租赁深圳市宝恒源实业有限公司厂房所支付的保证金款项。根据深圳崇达与深圳市宝恒源实业有限公司于 2008 年 5 月 6 日签

署的《厂房、宿舍建造及租赁协议书》，深圳市宝恒源实业有限公司按照深圳崇达的要求建造厂房，深圳崇达向其支付 500 万元的保证金，保证金在起租之日起第六年第一个月开始转为租金逐月全额扣除。该笔款项自 2013 年 1 月 1 日开始，可以开始转为租金。

② 应收出口退税系根据国家相关政策法规，可以享受的增值税出口退税款。

③ 期末押金系深圳崇达、崇达技术和大连崇达厂房租赁押金 85.09 万元。其他应收款其他项目主要系向江门市城乡规划局等部门缴纳的基础建设配套设施保证金 223.07 万元。

(5) 存货

最近三年一期，公司存货由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成，具体情况如下表：

单位：万元

项 目	2012. 06. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31		2009. 12. 31	
	账面净值	跌价准备	账面净值	跌价准备	账面净值	跌价准备	账面净值	跌价准备
原材料	4,220.88	-	3,352.85	-	3,243.12	-	1,201.14	-
在产品	2,836.14	-	1,767.60	-	1,864.76	-	1,193.84	-
发出商品	1,377.45	-	674.36	-	163.52	-	98.94	-
库存商品	1,068.23	-	631.62	-	1,397.49	-	640.10	-
合计	9,502.70	-	6,426.43	-	6,668.89	-	3,134.02	-

① 存货期末余额变动总体分析

公司的生产模式为以销定产，根据订单情况制定生产计划，通过 ERP 系统合理安排原材料采购，以保证正常生产、及时交货，并保持原材料的合理储备。

2009 年末，公司存货余额较 2008 年末增加 1,306.24 万元，增长幅度为 71.47%。其中：原材料余额较上年增加 448.42 万元，在产品较上年增加 619.61 万元。主要原因是：受国际金融危机影响，自 2008 年 11 月开始，公司订单和销量逐月下滑，因此，在 2008 年第四季度，公司减少了原材料的采购，在产品期末余额也相应减少。2009 年 7 月开始，随着全球经济逐步复苏，公司订单快速增加，并相应增加了原材料的采购，在产品期末余额也相应提高。

2010 年末，公司存货余额较 2009 年增加 3,534.87 万元，增长幅度 112.79%。

其中：原材料金额较上年增加 2,041.98 万元，在产品较上年增加 670.92 万元，库存商品较上年增加 757.39 万元。主要原因是：2010 年整个 PCB 行业需求强劲，本公司订单数量快速增长，与此同时，深圳崇达新建生产基地于 2010 年初达到预定可使用状态，使公司产能较 2009 年提高了 63.54%，产能的大幅扩张和订单的增加，使得公司生产规模迅速扩大，原材料储备和期末在产品金额相应增加。2010 年末库存商品金额较上年末增加 757.39 万元，主要原因为根据 P.D.CIRCUITS,INC.、Kestrel International Circuits Ltd、Suntech Circuits,Inc.、EPEC LLC 等客户订单备货较多所致。

2011 年公司存货余额与 2010 年基本保持平稳，其中库存商品较上年减少 756.87 万元，而发出商品较上年增加 510.84 万元，主要是由于 2011 年末向国内部分客户发出存货尚未取得客户验收所致。

2012 年 6 月 30 日公司存货余额较 2011 年底增加 3,076.27 万元，增长幅度 47.87%。其中：原材料金额较上年增加 868.03 万元，在产品较上年增加 1,068.54 万元，发出商品较上年增加 703.09 万元，库存商品较上年增加 436.61 万元。公司期末存货增长较快，主要是由于公司第二季度订单较多，公司根据订单情况安排采购与生产，因此期末原材料、在产品、库存商品较上年末均有较大增长。其中发出商品分析详见本节之“② 发出商品变动分析”。

公司及同行业上市公司期末存货余额占主营业务成本的比重如下表所示：

存货占销售成本的比重	兴森科技	沪电股份	超声电子	超华科技	天津普林	中京电子	平均值	崇达技术
2011 年	6.18%	11.35%	18.81%	54.17%	21.59%	28.87%	23.50%	10.14%
2010 年	8.69%	10.16%	18.85%	54.87%	10.73%	24.78%	21.35%	13.55%
2009 年	13.34%	14.20%	20.07%	42.50%	10.11%	25.12%	20.89%	10.99%

最近三年末，本公司存货占当年主营业务成本的比重分别为 10.99%、13.55%、10.14%，低于同行业存货占主营业务成本的平均比重，主要与本公司“以销定产”的生产模式有关。本公司专业定位于小批量 PCB 的生产和销售，在接到客户订单后开始作出采购计划、采购原材料，生产完毕后，产品及时交给客户，存货周转速度较快，不存在原材料和产成品积压的情形，因此期末存货余额占营业成本的比重相对较低。

② 发出商品变动分析

报告期各期末，公司发出商品金额分别为 98.94 万元、163.52 万元、674.36 万元、1,377.45 万元，主要系发出商品尚未取得客户验收以及未与客户对账确认所致。国内销售是以货物交付到买方指定地点，并经客户验收、月末与公司核对后作为确认收入的标准，因此，公司对于该部分已发出但未经客户验收或未与公司对账的商品计入发出商品；国外客户如以 FOB 贸易方式，则货物在指定装运港装运时确认收入，如以 DDU 贸易方式，则在货物交付到客户指定的地点，并由客户签收货运提单时确认收入的实现。由于交期要求短且与客户对账及时，本公司各期末发出商品金额总体较低。

公司发出商品余额呈逐年增加趋势，主要与公司国内销售规模增长相关，2009 年、2010 年、2011 年末公司发出商品余额占收入的比重分别为 0.23%、0.21%、0.70%。

2011 年末较 2010 年末发出商品余额增加较大的主要原因系对捷普科技（广州）有限公司、捷普科技（上海）有限公司、成都金之川电子有限公司、欧姆龙（上海）有限公司、武汉烽火通信科技股份有限公司、苏州市易德龙电器有限公司等客户的发出商品增加所致。

2012 年 6 月 30 日发出商品较 2011 年末余额增大。主要原因：一是由于公司在 2012 年 6 月底根据客户要求发出商品，但由于货物在途而未经客户验收（国内客户）或发出货物客户尚未在指定装运港装运（国外客户），因此未确认收入；二是有部分货物虽经客户签收，但尚未与客户对账确认（国内客户），公司遵循谨慎性原则未对该部分确认收入。

③ 存货减值情况

本公司为小批量 PCB 企业，原材料采购频率高、单次采购量少、周转较快，平均库龄不超过 1 个月，不存在过期、报废等减值情况；本公司的生产模式为以销定产，因此其库存商品、发出商品和在产品均有订单对应，不存在减值情况。

本公司与同行业 PCB 上市公司存货跌价准备占存货余额的比重如下：

年度	崇达技术	兴森科技	超华科技	中京电子	超声电子	沪电股份	天津普林
2011 年	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	2.37%	1.33%	4.40%

2010 年	0.00%	0.00%	0.00%	0.29%	0.56%	2.61%	18.11%
2009 年	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	2.25%	5.44%	5.94%

从上表可以看出，本公司、兴森科技、超华科技期末均未对存货计提跌价准备，而超声电子、沪电股份和天津普林对库存商品、原材料计提了一定金额的跌价准备。

本公司和兴森科技未计提存货跌价准备，与行业特点相关。本公司和兴森科技分别属于小批量和样板生产企业，主要生产定制化产品且要求交期短，因此本公司的原材料周转速度较快，库存商品、发出商品及在产品有订单对应，存货不存在减值迹象，无需计提减值准备。而同行业其他公司由于产品大多是非定制化生产，且一般而言客户较为集中，订单可标准化生产，并且一般不要求短交期，因此存货周转速度较慢、期末材料的库龄相对样板和小批量而言较长，存货存在滞销的可能，因此可能需计提一定的存货减值准备。

本公司存货跌价准备的计提状况符合行业状况及公司实际状况。

3、非流动资产分析

报告期内，公司非流动资产结构如下表：

单位：万元

项 目	2012. 06. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31		2009. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
固定资产	36,606.40	62.36	37,134.07	63.27	24,550.92	64.30	17,588.98	79.98
在建工程	11,723.19	19.97	10,841.47	18.47	4,327.57	11.33	3,758.61	17.09
无形资产	5,117.39	8.72	5,219.27	8.89	4,578.35	11.99	5.28	0.02
长期待摊费用	4,807.25	8.19	5,251.69	8.95	4,504.56	11.80	432.18	1.97
递延所得税资产	444.79	0.76	243.46	0.41	220.07	0.58	206.53	0.94
非流动资产合计	58,699.02	100.00	58,689.96	100.00	38,181.47	100.00	21,991.58	100.00

公司的非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用构成。

(1) 固定资产

公司产品生产过程复杂，产品精度高，对生产设备要求较高，因此公司的固定资产投入较大。报告期内，本公司固定资产净值分别为 17,588.98 万元、

24,550.92 万元、37,134.07 万元、36,606.40 万元，占非流动资产的比重分别为 79.98%、64.30%及 63.27%、62.36%。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司固定资产的具体情况如下表：

单位：万元

资产类别	原值	净值	折旧年限	综合成新率	使用状态
机器设备	45,558.91	33,711.85	10 年	74.00%	正常使用
环保设备	1,637.66	1,036.93	5 年、10 年	63.32%	正常使用
运输工具	1,073.24	506.20	5 年	47.17%	正常使用
电子及其他设备	3,054.15	1,351.42	5 年	44.25%	正常使用
合 计	51,323.97	36,606.40		71.32%	-

报告期内，公司的固定资产以机器设备、环保设备、电子及其他设备为主。为满足日益增长的订单需求，公司不断增加对固定资产的投入，以扩大生产能力，提高产能。

报告期内，公司机器设备的采购情况如下：

单位：万元

原值	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
期初余额	43,892.83	29,122.57	20,725.23	18,906.67
本期增加	2,122.17	14,940.53	9,058.27	2,288.03
本期减少	456.09	170.26	660.93	469.47
期末余额	45,558.91	43,892.83	29,122.57	20,725.23

按设备工序分类，报告期内本公司采购的主要机器设备按工序列示如下：

单位：万元

设备类别	2012 年 06 月 30 日	2011 年	2010 年	2009 年
钻孔	138.39	2,584.63	1,524.23	496.17
内层	54.49	2,023.48	845.89	4.08
阻焊	206.15	1,953.04	728.43	61.51
压合	432.49	1,522.02	268.35	207.9
外层	161.74	1,507.82	187.09	168.9
图电	564.54	1,349.98	313.41	189.59
AOI	-	842.87	963.84	-
成型	55.91	435.57	464.99	282.66
实验室	57.28	260.65	2.22	90.12
测试	93.87	194.28	499.31	414.61
品检	28.35	135.46	-	-

菲林	144.78	129.60	8.97	243.53
表面处理	77.75	117.57	97.23	44.33
开料	-	33.05	48.04	1.52
蚀刻	-	22.33	500.96	0.82
包装	-	-	21.99	-
沉铜板电	62.53	-	243.06	82.29
其他	43.90	1,828.19	2,340.26	-
总计	2,122.17	14,940.53	9,058.27	2,288.03

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司账面原值计 18,414.86 万元的机器设备因融资而抵押予银行。

(2) 在建工程

各报告期末，本公司在建工程金额分别为 3,758.61 万元、4,327.57 万元、10,841.47 万元、11,723.19 万元。

2009 年末，公司在建工程主要系当年购入或在建的待安装设备、制冷系统和大连崇达环保工程。2009 年末，公司在建工程包括：待安装设备 2,722.05 万元、制冷系统 211.50 万元，厂房装修工程 635.95 万元和环保工程 189.11 万元。

2010 年，为了满足公司日益增长的订单需求，公司进一步扩大产能，增加了机器设备，期末在建工程增加。2010 年末，公司在建工程包括：待安装设备 4,021.32 万元、车间改造工程 191.17 万元和江门崇达土建工程 115.08 万元。

2011 年，随着销售规模的扩大，公司进一步购置了机器设备以满足新增订单需求；同时，子公司江门崇达开始筹建。截至 2011 年末，公司在建工程主要包括：江门崇达土建工程 8,419.96 万元、待安装设备 2,089.60 万元和 ERP 系统及报表开发 327.73 万元等项目。

2012 年 6 月 30 日，在建工程余额较 2011 年末增加 881.72 万元，主要系江门崇达基建工程支出增加所致。截至 2012 年 6 月 30 日，公司在建工程明细如下：

单位：万元

项目	2012. 06. 30		
	账面余额	减值准备	账面净值
1、大连工厂生产车间改造工程	44.93	-	44.93
2、江门--小批量 PCB 生产基地工程	10,204.63	-	10,204.63
3、待安装生产设备	1,134.13	-	2,215.06

其中：内层蚀刻机	550.77	-	550.77
日立钻孔机	170.00	-	170.00
PCB 成型机	123.08	-	123.08
其他待验收设备	290.28	-	290.28
4、ERP 系统及报表开发	339.50	-	339.50
合计	11,723.19	-	12,804.12

(3) 无形资产

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无形资产账面原值为 5,647.22 万元，账面价值为 5,117.39 万元，具体情况如下表：

单位：万元

资产类别	取得方式	初始金额	摊销年限（年）	账面价值
土地使用权	出让	4,569.35	50	4,401.81
软件	外购	1,077.87	3	715.58
合 计		5,647.22		5,117.39

公司拥有的土地使用权情况如下表：

土地使用权证号	用途	面积（平方米）	座落	终止日期
江国用（2011）第 304399 号	工业	131,266.70	江海区连海路 363 号	2060 年 9 月 16 日

(4) 长期待摊费用

报告期各期末，长期待摊费用明细项目如下：

单位：万元

项 目	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31
经营租入厂房装修、改造及环保工程支出	4,763.15	5,206.54	4,445.75	363.58
其他	44.10	45.15	58.81	68.60
合 计	4,807.25	5,251.69	4,504.56	432.18

2012 年 6 月 30 日，本公司长期待摊费用为 4,807.25 万元，主要系经营租入厂房装修、改造及环保工程支出。公司长期待摊费用按 5 年摊销。

单位：万元

项目	初始金额	摊销年限	账面价值	剩余摊销年限
生产工程	2,485.87	5 年	1,660.35	3.34
装饰工程	1,422.95	5 年	820.75	2.88
环保工程	1,828.39	5 年	1,124.39	3.07
供电工程	960.98	5 年	621.76	3.24

公共工程	610.89	5 年	437.60	3.58
消防工程	167.80	5 年	97.50	2.91
其他	193.53	5 年	44.90	1.16
合 计	7,670.41		4,807.25	

（5）递延所得税资产

报告期各期末，递延所得税资产明细项目如下：

单位：万元

项 目	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31
坏账准备暂时性差异	426.16	223.45	197.30	172.48
递延收益暂时性差异	18.63	20.01	22.77	34.05
合 计	444.79	243.46	220.07	206.53

报告期内，本公司的递延所得税资产主要是应收款项计提坏账准备而导致账面价值与计税基础不同，进而产生的可抵减暂时性差异。

（6）资产减值准备提取情况

报告期内，本公司计提各项资产减值准备的情况如下：

单位：万元

项 目	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31
一、坏账准备	1,862.86	1,483.31	1,309.64	916.95
其中：应收账款	1,862.86	1,483.31	1,309.64	914.72
其他应收款	-	-	-	2.23
二、存货跌价准备	-	-	-	-
三、固定资产减值准备	-	-	-	-
合 计	1,862.86	1,483.31	1,309.64	916.95

本公司已按《企业会计准则》的规定，制订了计提资产减值准备的会计政策，符合谨慎性和公允性的要求；报告期内本公司已足额计提了相应的减值准备，主要资产减值准备计提情况与资产质量实际状况相符，不存在潜在资产损失及未予计提减值准备而导致的财务风险。

本公司计提资产减值的具体情况请见本章“二、盈利能力分析”之“（四）资产减值损失分析”。

（二）负债构成情况分析

公司负债主要包括银行借款和其他经营性负债，最近三年一期，公司负债的

具体构成情况如下表：

单位：万元

项 目	2012. 06. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31		2009. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动负债：	42,819.50	75.83	40,569.19	78.60	31,353.67	81.75	21,012.65	83.92
短期借款	21,100.00	37.37	22,000.00	42.62	12,245.00	31.93	6,975.73	27.86
应付票据	712.14	1.26	432.63	0.84	550.43	1.44	-	-
应付账款	17,702.85	31.35	17,019.08	32.97	16,650.18	43.41	12,139.69	48.48
预收款项	152.85	0.27	154.88	0.30	121.45	0.32	72.79	0.29
应付职工薪酬	1,907.86	3.38	1,225.59	2.37	1,901.95	4.96	1,360.65	5.43
应交税费	421.36	0.75	-1,041.85	-2.02	-712.69	-1.86	13.03	0.05
应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-
其他应付款	822.43	1.46	778.85	1.51	597.35	1.55	450.76	1.81
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-	-	-	-
非流动负债：	13,644.70	24.17	11,045.40	21.40	7,001.16	18.25	4,026.78	16.08
长期借款	13,200.50	23.38	10,612.00	20.56	5,300.00	13.82	3,856.58	15.40
长期应付款	-	-	-	-	1,549.36	4.04	-	-
其他非流动负债	444.20	0.79	433.40	0.84	151.80	0.39	170.20	0.68
负债合计	56,464.20	100.00	51,614.59	100.00	38,354.84	100.00	25,039.43	100.00

报告期内，公司处于快速扩张期，随着生产规模和总资产规模的逐步扩大，公司负债总额也相应上升。受融资渠道的限制，银行借款一直是公司筹集资金的重要渠道。公司银行借款包括短期借款和长期借款，报告期内，银行借款占负债总额的比例分别为 43.26%、45.75%、63.18%、60.75%。除此之外，随着商业信用和品牌形象的不断提高，公司积极利用经营性负债融资以减少资金占用和融资成本。报告期内，公司应付账款和预收账款合计占负债总额的比例分别为 48.77%、43.73%、33.27%、31.62%。

1、短期借款

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司短期银行借款余额为 21,100 万元，具体情况如下：

单位：万元

贷款单位	期限	年利率	币种	金额	类别
兴业银行深圳振华支行	2011-12-20 至 2012-12-20	7.216%	人民币	5,000.00	保证

贷款单位	期限	年利率	币种	金额	类别
招商银行深圳福田支行	2012-4-16 至 2013-04-16	****	人民币	2,000.00	保证
工商银行深圳福永支行	2012-03-30 至 2013-03-27	**	人民币	100.00	保证
工商银行深圳福永支行	2011-07-15 至 2012-07-14	**	人民币	1,500.00	保证
工商银行深圳福永支行	2011-11-23 至 2012-11-14	**	人民币	500.00	保证
中信银行深圳分行	2011-09-07 至 2012-09-07	***	人民币	1,000.00	保证
中信银行深圳分行	2011-11-15 至 2012-11-15	***	人民币	3,000.00	保证
中信银行深圳分行	2011-11-11 至 2012-11-11	***	人民币	2,000.00	保证
中信银行深圳分行	2011-12-20 至 2012-12-20	***	人民币	2,000.00	保证
民生银行深圳分行	2012/6/26 至 2012/12/26	5.85%	人民币	2,000.00	保证
中国银行南头支行	2012/6/27 至 2013/6/27	*****	人民币	2,000.00	保证
合计				21,100.00	

**借款利率为借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率上浮 10%，基准利率每三个月为一浮动周期，一期一调整，分段计息。

***借款利率为借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率上浮 10%，基准利率随中国人民银行基准利率调整。

****以定价日适用的中国人民银行公布的 6-12 个月/一年金融机构人民币贷款基准利率为基准利率，基准利率每三个月为一浮动周期。

*****以实际提款日为起算日，每 3 个月为一个浮动周期，重新定价一次。首期利率为实际提款日中国人民银行公布施行的 6 个月至一年期贷款基准利率。

报告期内本公司未出现逾期未偿还银行借款的情况

2、应付票据

报告期内，本公司为了充分利用自身的商业信用及降低财务费用，部分采购采用银行承兑汇票的方式与供应商进行结算。报告期内，应付票据的具体情况如下：

单位：万元

供应商	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年	
	开具票据金额	票据余额	开具票据金额	票据余额	开具票据金额	票据余额
广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂	525.84	57.59	225.10	225.10	105.41	105.41
东莞联茂电子科技有限公司	331.13	-	-	-	-	-
深圳市超淦科技有限公司	258.42	67.70	-	-	-	-
番禺南沙殷田化工有限公司	206.07	-	366.84	71.69	190.62	190.62
大船科技(东莞)有限公司	198.90	198.90	439.92	-		

广东建滔积层板销售有限公司	155.08	-	-	-	-	-
深圳市柯怡电路技术有限公司	152.01	-	211.57	-	61.76	61.76
深圳市深乐健化工有限公司	98.02	71.56	138.30	-	-	-
新野鼎泰电子精工科技有限公司	92.25	-	63.33	-	32.70	32.70
苏州贺泰化学材料有限公司	79.27	22.43	-	-	-	-
深圳市正天伟科技有限公司	73.57	36.88	11.51	11.51		
广东中晨实业集团有限公司	73.13	19.49	132.78	23.51	19.28	19.28
泉镒兴电子科技(深圳)有限公司	70.00	-	118.55	-	-	-
深圳市励高表面处理材料有限公司	63.33	34.94	-	-	-	-
云南锡业股份有限公司深圳经销分公司	62.85	36.77	59.50	-	-	-
珠海金德泰电子材料有限公司	50.29	31.81	58.20	-	-	-
深圳市金洲精工科技股份有限公司	30.78	-	187.97	-	-	-
深圳市板明科技有限公司	29.77	-	29.31	-		
深圳市思维特电源设备有限公司	28.80	28.80	-	-	-	-
深圳市欣源科技有限公司	25.16	25.16	-	-	-	-
东莞市健升安装工程有限公司	22.05	22.05	-	-	-	-
深圳市惠普斯电子有限公司	21.84	-	27.57	27.57	-	-
志圣科技(广州)有限公司	16.10	16.10	-	-	-	-
东莞市文丰刀具有限公司	14.99	14.99	-	-	-	-
联致互应科技(深圳)有限公司	13.81	13.81	-	-	-	-
广东迪奥技术工程有限公司	13.16	13.16	-	-	-	-
东莞市名豪机电有限公司	-	-	649.00	-	-	-
佛山市承安铜业有限公司	-	-	-	-	87.87	87.87
广东南方特种铜材有限公司	-	-	-	-	37.73	37.73
广州市殷丰电子材料有限公司	-	-	52.83	-	-	-
贺泰科技（深圳）有限公司	-	-	152.88	-	-	-
深圳市宝安区福永楚云天文具办公设备中心	-	-	16.18	-	-	-
深圳市宝安区沙井金慧科技经销店	-	-	14.75	-	-	-
深圳市超淦贸易有限公司	-	-	424.60	73.26	15.07	15.07
深圳市德瑞勤科技有限公司	-	-	77.23	-	-	-
深圳市金海通电子科技有限公司	-	-	10.91	-	-	-
深圳市新社实业有限公司	-	-	57.82	-	-	-
深圳市鑫隆祥科技有限公司	-	-	29.26	-	-	-
珠海镇东有限公司	-	-	102.38	-	-	-
总计	2,706.62	712.14	3,658.28	432.63	550.45	550.45

3、应付账款

报告期各期末，本公司应付账款情况如下表：

单位：万元

项 目	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31
应付账款金额	17,702.85	17,019.08	16,650.18	12,139.69
占总负债比例（%）	31.35	32.97	43.41	48.48

应付账款余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

公司应付账款主要为应付供应商的货款，包括采购原材料、机器设备等。报告期内，随着公司销售规模的扩大，原材料的采购金额相应增加，应付账款的金额呈上升趋势。

4、预收账款

报告期各期末，本公司预收账款金额分别为 72.79 万元、121.45 万元和 154.88 万元、152.85 万元，维持在较低的水平，这与 PCB 行业市场竞争状况及行业收款政策密切相关，符合行业的实际情况。

同行业 PCB 上市公司预收账款占营业收入的比重如下表：

单位：万元

项目	2009. 12. 31						
	崇达技术	超华科技	天津普林	兴森科技	超声电子	中京电子	沪电股份
预收账款	72.79	335.27	26.51	742.60	889.27	0.00	1,097.57
营业收入	43,604.82	19,253.79	36,778.29	50,243.09	229,451.89	25,600.17	228,426.16
比例	0.17%	1.74%	0.07%	1.48%	0.39%	0.00%	0.48%

单位：万元

项目	2010. 12. 31						
	崇达技术	超华科技	天津普林	兴森科技	超声电子	中京电子	沪电股份
预收账款	121.45	331.37	0.51	534.10	823.81	29.26	165.86
营业收入	78,286.30	20,876.92	56,076.34	80,388.67	298,334.53	32,693.77	299,510.10
比例	0.16%	1.59%	0.00%	0.66%	0.28%	0.09%	0.06%

单位：万元

项目	2011. 12. 31						
	崇达技术	超华科技	天津普林	兴森科技	超声电子	中京电子	沪电股份
预收账款	154.88	954.03	0.97	388.83	748.89	46.28	1540.06
营业收入	96,609.66	41,714.66	48,249.56	95,789.07	329,311.30	40,846.97	313,694.31
比例	0.16%	2.29%	0.00%	0.41%	0.23%	0.11%	0.49%

从上表可以看出，PCB 行业预收账款较低是行业内的普遍情况。

由于 PCB 行业竞争较为激烈，因此 PCB 生产企业与大部分客户一般采用信用赊销的方式进行结算，采用预收方式结算的较少。公司的结算模式也主要以信用赊销为主，公司一般根据客户的资信情况和采购数量授予客户一定信用期限，平均在 90 天左右，收款政策与行业内基本保持一致。本公司预收账款长期较低系行业市场竞争状况和收款政策所决定，并不表明公司产品议价能力较低，同时公司的收款政策与行业保持一致。

5、应交税费

本公司应交税费主要由应交增值税和应交所得税构成。

2012 年 6 月 30 日，本公司应交税金期末余额为 421.36 万元，其中应交增值税-1,507.25 万元，应交所得税金额为 1,753.85 万元。本公司应交增值税期末借方余额较大，主要系尚未经税务局核定的出口退税款和待抵扣的进项税款。本期应交所得税期末金额较大，主要原因为深圳崇达本年度暂按 25%税率计提企业所得税。

6、其他应付款

公司其他应付款主要系应付水电费、运杂费等。报告期内具体情况如下表：

单位：万元

项 目	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31
其他应付款金额	822.43	778.85	597.35	450.76
其中：应付水电费	376.10	291.57	186.81	144.65
应付运杂费	152.13	111.99	182.39	131.17

7、长期借款

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司长期借款余额为 13,200.50 万元。长期借款明细如下：

贷款人	借款人	贷款金额 (万元)	贷款年利率	合同贷款期限	备注
中国银行 深圳分行	深圳崇达	300.00	提款当日/重新定价 日中国人民银行公 布的 5 年期贷款基 准利率上浮 10%	2009.05.25-2014.05.24	正在履行
	深圳崇达	500.00		2010.08.04-2014.05.25	正在履行
	深圳崇达	500.00		2010.09.10-2014.05.24	正在履行

	深圳崇达	4,700.00		2011.01.14-2014.05.24	正在履行
兴业银行 深圳振华 支行	深圳崇达	3,298.50	提款当日/重新定价 日中国人民银行公 布的 5 年期贷款基 准利率上浮 10%	2011.09.01-2014.09.01	正在履行
	江门崇达	3,902.00	一年一定，年利率为 同期同档次国家基 准利率上浮 10%	2012.01.17-2017.01.17	正在履行

2009 年 5 月 21 日，深圳崇达与中国银行深圳分行签署《人民币借款合同（中/长期）》，中国银行向深圳崇达发放额度为 10,000 万元的贷款，借款期限 60 个月，深圳崇达可按照实际资金需求在 2 年内提清借款。该笔贷款目前处于还款期，2013 年 6 月 30 日以前每季度还款金额为 1,000 万元，2013 年 6 月 30 日以后每季度还款 500 万元。该笔贷款由集锦线路板、姜雪飞分别提供连带责任担保；深圳崇达提供机器设备抵押担保。截至 2012 年 6 月 30 日，深圳崇达在中国银行的长期借款本金为 6,000 万元，尚未到期。

2011 年 8 月 20 日，深圳崇达与兴业银行深圳振华支行签署《基本额度授信合同》，兴业银行深圳振华支行给予深圳崇达 7,000 万元的授信额度，期限至 2014 年 9 月 1 日，该笔贷款分别由本公司、姜雪飞提供连带责任担保，深圳崇达以机器设备提供抵押担保。截至 2012 年 6 月 30 日，深圳崇达在兴业银行的长期借款本金为 3,298.50 万元，尚未到期。

2011 年 12 月 20 日，江门崇达与兴业银行深圳振华支行签署《项目融资借款合同》，兴业银行深圳振华支行给予江门崇达 30,000 万元的授信额度，期限至 2017 年 1 月 17 日，该笔贷款由本公司、姜雪飞提供连带责任担保，江门崇达以土地、在建工程提供抵押担保。截至 2012 年 6 月 30 日，江门崇达在兴业银行的长期借款本金为 3,902.00 万元，尚未到期。

8、长期应付款

2010 年 12 月 31 日，本公司长期应付款为 1,549.36 万元，该款项系深圳崇达应付东江环保的设备工程款。

2008 年 5 月 26 日，深圳崇达与东江环保签署《设备买卖合同书》，购买回用水设备 374 万元，废水处理设备 626 万元，设备及税款总金额 1,000 万元（含 17%增值税），合同约定：在设备安装完成即竣工之日起，深圳崇达在三年内按

月等额付款。2008年5月26日，深圳崇达与东江环保工程服务分公司签署《环境污染治理工程承包合同书》，东江环保工程服务分公司通过带资建设、包工包料的方式承包深圳崇达废水处理工程及回用工程，工程总造价1,246.63万元，深圳崇达在工程竣工之日起三年内按月等额偿还。

上述设备及工程款累计金额为2,246.63万元。2010年2月，东江环保完成所有工程及设备的安装并达到可使用状态，2010年深圳崇达按合同约定累计支付697.27万元，截至2010年末长期应付款余额为1,549.36万元。2011年3月，深圳崇达与东江环保工程服务分公司签署《补充协议》，深圳崇达提前支付相关设备及工程款项，东江环保工程服务分公司同意减免货款中包括的利息85.20万元。截至2011年4月底，相关款项全部支付完毕。

9、其他非流动负债

报告期内，本公司其他非流动负债分别为170.20万元、151.80万元和433.40万元、444.20万元，系本公司收到的环境保护专项资金及深圳市市级技术中心建设资助金，具体情况如下：

单位：万元				
项 目	2012.06.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
环境保护专项资金	124.20	133.40	151.80	170.20
技术中心建设资助金	300.00	300.00	-	-
混埋容阻高多层PCB制造 技术产学研专项补助	20.00	-	-	-
合 计	444.20	433.40	151.80	170.20

根据2009年3月20日深圳市环境保护局与集锦线路板签订的《深圳市环境保护专项资金使用合同书》（类别：无偿资助），2009年集锦线路板收到环境保护专项资金拨款184万元，用于废水处理系统改造工程和回用水处理工程，目前该工程已经验收，本公司将其计入递延收益，并按照资产使用年限10年进行摊销。

根据2011年12月19日深圳市科技工贸和信息化委员会与深圳崇达签订的《深圳市产业技术进步资金使用合同书》（类别：资助），2011年12月27日深圳崇达收到市级技术中心建设资助金300万元，用于建设深圳崇达技术中心。

根据2011年12月30日深圳市科技工贸和信息化委员会、广东省教育部产

学研结合协调领导小组办公室与深圳崇达签订的《广东省教育部产学研结合项目合同书》（类别：省部产学研结合项目），2012年3月28日深圳崇达收到资金20万元，用于混埋容阻高多层PCB制造技术产学研项目。

10、或有负债

截至2012年6月30日，本公司无或有负债。

（三）偿债能力分析

报告期末，本公司的资本结构和偿债能力指标如下表所示：

项 目	2012. 06. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31
流动比率（倍）	1.04	0.92	1.12	1.22
速动比率（倍）	0.82	0.76	0.91	1.07
资产负债率（合并报表）	54.65%	53.81%	52.38%	52.67%
资产负债率（母公司）	50.24%	43.34%	34.87%	28.78%
项 目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
息税折旧摊销前利润（万元）	12,981.34	22,559.94	16,729.57	9,535.10
利息保障倍数（倍）	8.16	9.98	18.55	12.08
经营活动现金流量净额（万元）	10,168.66	17,868.43	14,286.07	11,255.30
每股经营活动现金流量净额（元）	0.90	1.59	1.27	-
净利润（万元）	6,589.21	13,153.29	10,339.09	5,340.55

1、与 PCB 行业上市公司财务指标比较

本公司所属行业为电子元件制造业下的印制电路板制造业。公司选择可比上市公司的标准是将目前所有已上市的印制电路板制造行业公司纳入选择范围，由于丹邦科技（002618）明确定位于生产柔性线路板、搭载芯片的柔性基板等产品，与本公司及其他 PCB 上市公司的产品存在较大差异，不具有可比性，因此，未将其纳入比较范围。

本公司与 PCB 行业上市公司流动比率、速动比率以及资产负债率比较如下：

指标名称		兴森科技	沪电股份	超声电子	超华科技	中京电子	平均值	崇达技术
流动比率	2011 年末	4.43	2.97	1.98	1.29	2.91	2.72	0.92
	2010 年末	5.07	3.29	1.38	1.86	1.03	2.53	1.12
	2009 年末	0.76	1.63	1.24	3.97	1.02	1.72	1.22
速动比率	2011 年末	4.22	2.67	1.43	0.86	2.42	2.32	0.76

	2010 年末	4.85	3.03	1.06	1.33	0.68	2.19	0.91
	2009 年末	0.64	1.35	0.94	3.4	0.7	1.41	1.07
资产负债率(合并)	2011 年末	11.87	24.02	38.33	45.46	25.55	29.05	53.81
	2010 年末	13.24	24.45	42.39	29.93	48.38	31.68	52.38
	2009 年末	61.51	40.49	40.97	17.88	48.24	41.82	52.67
利息保障倍数	2011 年度	46.43	40.02	10.68	4.69	9.54	22.27	9.98
	2010 年度	12.26	41.67	10.18	6.92	10.39	16.28	18.55
	2009 年度	7.03	21.01	5.63	7.76	11.77	10.64	12.08

注：①上述财务数据系根据各公司公开披露的财务报告及招股说明书计算所得。

②超华科技于 2009 年 8 月公开发行 2,200 万 A 股，募集资金 2.43 亿元；兴森科技 2010 年 6 月公开发行 2,793 万 A 股，募集资金 9.67 亿元；沪电股份 2010 年 8 月公开发行 8,000 万 A 股，募集资金 12.28 亿元。

③天津普林 2009 年利息保障倍数为负数，不合同行业比较，因此上述指标的平均值计算均不包含天津普林。

2、偿债能力指标分析

（1）公司资产负债率、流动比率和速动比率处于合理水平

报告期各期末，公司资产负债率分别为 52.67%、52.38%、53.81%、54.65%，处于合理水平，公司具有较强的长期偿债能力。报告期内，借款是公司战略扩张的重要融资渠道，因此公司保持了一定水平的资产负债率。公司资产负债率高于同行业上市公司的水平，主要原因是上市公司完成 IPO 融资后资产负债率大幅下降。

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.22、1.12、0.92、1.04，速动比率分别为 1.07、0.91、0.76、0.82，流动比率和速动比率指标基本平稳，保持在合理水平，公司具有较强的短期偿债能力。与同行业上市公司相比，2009 年、2010 年公司的流动比率和速动比率均处于中等偏低水平，2011 年处于较低水平，主要原因是上市公司完成 IPO 融资后流动资产大幅上升，导致同行业上市公司的流动比率和速动比率相对较高。

（2）较高的利息保障倍数、较好的经营活动现金净流量及盈利能力为公司还本付息提供了良好的保障

得益于公司持续增长的盈利能力，公司息税前利润保持相对较高水平并逐年增长。2009 年、2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月，公司息税前利润分别为 6,803.10 万元、13,032.38 万元、17,330.96 万元、9,630.65 万元。公司利息保障倍数分别为 12.08、18.55、9.98、8.16，为借款的到期还本付息提供了有效的利润支持。

公司 2009 年、2010 年利息保障倍数与可比上市公司水平基本持平，2011 年低于可比上市公司水平，主要是由于上市公司完成 IPO 融资后利息支出大幅减少。

2009 年、2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月，公司经营活动实现的现金流量净额分别为 11,255.30 万元、14,286.07 万元、17,868.43 万元、10,168.66 万元，累计实现经营活动现金流量净流入金额 53,578.46 万元，累计实现净利润 35,422.16 万元，经营活动产生的现金流量净额高于净利润 18,156.30 万元，累计实现经营活动现金流量净流入金额是净利润的 1.51 倍，说明公司盈利能力状况良好，回款能力较强，现金流量充足，为借款的到期还本付息提供了良好的现金保障。

3、公司的银行资信状况分析

报告期内，本公司与多家银行保持良好的合作关系，具有良好的资信等级。具体情况如下：

2009 年，本公司被鹏元资信评估有限公司评审为*A+*资信等级，并颁发鹏信评（2009）第 X20090088 号资信评级证书。

2010 年 6 月，深圳崇达被鹏元资信评估有限公司评审为*AA—*资信等级，并颁发鹏信评（2010）第 X20100647 号资信评级证书。

2011 年 7 月，本公司与深圳崇达均被鹏元资信评估有限公司评审为*AA—*资信等级，并分别颁发鹏信评（2011）第 X20111019 号、鹏信评（2011）第 X20111090 号资信评级证书。

2012 年 4 月，本公司与深圳崇达均被鹏元资信评估有限公司评审为*AA+*资信等级，并分别颁发鹏信评（2012）第 X20121052 号、鹏信评（2011）第 X20121071 号资信评级证书。

（四）资产周转能力分析

2009 年至 2011 年，本公司资产周转能力如下表所示：

项目	2011 年	2010 年	2009 年
应收账款周转率（次）	4.81	4.76	2.90
存货周转率（次）	9.70	10.04	11.58

总资产周转率（次）	1.14	1.30	1.01
-----------	------	------	------

1、与 PCB 行业上市公司财务指标比较

本公司与 PCB 行业上市公司应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率指标比较如下：

指标名称		兴森科技	天津普林	沪电股份	超声电子	超华科技	中京电子	平均值	崇达技术
应收账款周转率（次）	2011 年	5.01	3.24	4.59	4.39	2.87	4.08	4.03	4.81
	2010 年	5.72	3.69	4.42	4.51	2.19	4.23	4.13	4.76
	2009 年	5.55	3.35	4.01	3.75	2.51	4.12	3.88	2.90
存货周转率（次）	2011 年	15.00	6.02	9.95	5.66	2.44	4.23	7.22	9.70
	2010 年	11.96	12.48	10.71	6.01	2.22	4.44	7.97	10.04
	2009 年	10.32	10.61	8.13	5.68	2.65	4.48	6.98	11.58
总资产周转率（次）	2011 年	0.58	0.57	0.76	0.98	0.49	0.69	0.68	1.14
	2010 年	0.68	0.68	0.92	0.93	0.33	0.94	0.75	1.30
	2009 年	0.74	0.45	0.93	0.77	0.43	0.88	0.70	1.01

2、应收账款周转率分析

2009 年至 2011 年，本公司应收账款周转率分别为 2.90、4.76、4.81，扣除对关联方香港崇达线路板的应收账款影响，公司最近三年的应收账款周转率分别为 3.73 和 4.98、4.81，周转天数保持在 90 天左右，与公司的实际赊销政策一致，并高于行业平均水平。

报告期内，本公司对新老客户分别建立了不同的审批赊销政策和严格的信用审核体系，控制货物的赊销和保障应收账款的回收，使得应收账款周转率保持在较好的水平。

3、存货周转率分析

2009 年至 2011 年，本公司存货周转率分别为 11.58、10.04、9.70，存货周转速度较快，在行业内处于较高水平。

本公司存货周转率较高，与公司的生产模式密切相关。本公司生产小批量 PCB，种类多、均单面积小、交期短。本公司的生产方式是根据订单以销定产，由于原材料大部分属于通用材料，且公司处于物流及交通均很便捷的地域，因此，本公司一般在接到客户订单后开始作出采购计划，采购原材料，生产完毕后，产

品及时交给客户，不存在产品积压的情形。此外，本公司制定了相配套的采购机制和库存机制，并且采用先进的物料应用系统进行自动化和流程化控制，以适应小批量PCB的生产需要，及时有效地供给生产，进一步增强了存货管理能力。

4、总资产周转率分析

本公司的总资产周转率明显高于行业平均水平，公司的资产利用率较高。

二、盈利能力分析

最近三年，公司营业收入、利润总额、净利润年复合增长率分别为 48.85%、58.08%、56.94%，公司盈利能力较强。

公司相关盈利指标的具体情况如下所示：

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
营业收入	53,151.53	96,609.66	78,286.30	43,604.82
其中：主营业务收入	51,789.86	93,778.29	76,555.60	42,827.71
营业利润	8,257.21	15,190.94	12,420.53	6,025.14
利润总额	8,450.09	15,593.97	12,329.77	6,240.11
净利润	6,589.21	13,153.29	10,339.09	5,340.55
主营业务毛利率	32.86%	32.42%	35.70%	33.44%
净利率	12.40%	13.61%	13.21%	12.25%

（一）营业收入分析

公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成。报告期内，公司营业收入构成情况如下表：

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	51,789.86	97.44	93,778.29	97.07	76,555.60	97.79	42,827.71	98.22
其他业务收入	1,361.67	2.56	2,831.37	2.93	1,730.70	2.21	777.11	1.78
营业收入合计	53,151.53	100.00	96,609.66	100.00	78,286.30	100.00	43,604.82	100.00

公司营业收入中，主营业务收入占比约为 97%，主要来源于 PCB 销售收入；其他业务收入占比约为 3%，主要是生产 PCB 所产生的废料收入。

1、主营业务收入构成

(1) 按订单面积分类

按客户订单面积划分，本公司产品分为小批量板和大批量板。小批量板指单个订单面积在 50 平方米以下（含 50 平方米）的 PCB 订单，大批量板指单个订单面积在 50 平方米以上的 PCB 订单。

报告期内，公司产品按订单面积划分的收入构成情况如下表：

单位：万元

订单面积	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
小批量板	43,086.49	83.19	74,909.57	79.88	63,119.02	82.45	36,340.07	84.85
大批量板	8,703.37	16.81	18,868.72	20.12	13,436.58	17.55	6,487.64	15.15
合计	51,789.86	100.00	93,778.29	100.00	76,555.60	100.00	42,827.71	100.00

报告期内，本公司小批量板销售收入占主营业务收入的比例分别为 84.85%、82.45%、79.88%、83.19%；大批量板销售收入占主营业务收入的比例分别为 15.15%、17.55%、20.12%、16.81%，本公司收入主要来源于小批量板，与公司的业务定位相符。

(2) 按产品技术档次分类

按产品技术档次分类，本公司产品分为高端板和中低端板，高端板包括高层板、特殊板、HDI 板，其中高层板是指层数在 8 层及 8 层以上的线路板产品；特殊板包括厚铜板、电厚金板、铝基板、高散热板、高频板、阶梯板、软硬结合板等，公司生产的特殊板中主要以厚铜板为主；中低端板是指层数在 8 层以下的线路板产品。

报告期内，按产品技术档次划分的收入构成情况如下表：

单位：万元

产品类别	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
高端板	28,768.59	55.55	50,307.44	53.65	38,809.80	50.69	21,822.46	50.95
中低端板	23,021.27	44.45	43,470.85	46.35	37,745.80	49.31	21,005.25	49.05
合计	51,789.86	100.00	93,778.29	100.00	76,555.60	100.00	42,827.71	100.00

报告期内，本公司高端板的收入比重持续增加。

(3) 按销售区域分类

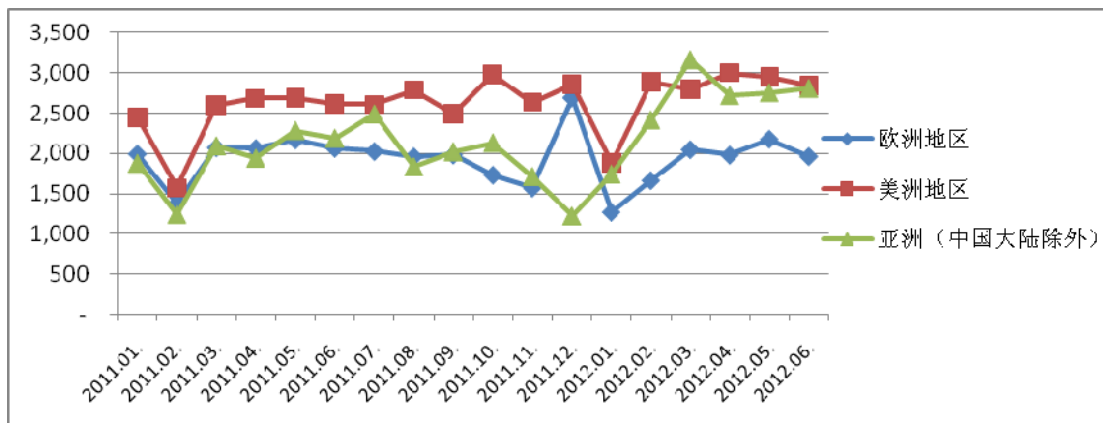
区域	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额(万元)	比例 (%)	金额(万元)	比例 (%)	金额(万元)	比例 (%)	金额(万元)	比例 (%)
一、外销	43,079.20	83.18	77,734.57	82.89	63,746.98	83.27	30,353.66	70.87
1、亚洲（中国大陆除外）	15,594.19	30.11	23,034.43	24.56	17,635.07	23.04	9,523.44	22.24
其中：香港	5,422.14	10.47	9,358.08	9.98	5,341.03	6.98	2,804.11	6.55
以色列	3,818.73	7.37	7,225.63	7.71	6,248.20	8.16	3,236.75	7.56
泰国	1,913.15	3.69	2,829.44	3.02	2,088.19	2.73	878.31	2.05
日本	1,558.22	3.01	2,048.07	2.18	1,734.26	2.27	618.50	1.44
2、美洲	16,360.77	31.59	30,962.27	33.02	24,025.60	31.38	11,829.24	27.62
其中：美国	15,409.88	29.75	28,790.23	30.70	21,779.63	28.45	11,492.57	26.83
加拿大	863.55	1.67	1,850.20	1.97	1,900.61	2.48	224.56	0.52
3、欧洲	11,124.24	21.48	23,737.87	25.31	22,086.31	28.85	9,000.98	21.02
其中：英国	2,115.71	4.09	4,971.69	5.30	5,417.48	7.08	1,076.33	2.51
德国	2,992.10	5.78	5,431.55	5.79	3,451.09	4.51	1,804.70	4.21
瑞典	1,748.82	3.38	3,411.64	3.64	3,222.08	4.21	2,176.76	5.08
意大利	1,002.66	1.94	1,698.85	1.81	2,458.22	3.21	160.92	0.38
芬兰	569.98	1.10	1,190.33	1.27	1,563.29	2.04	783.78	1.83
二、内销（中国大陆）	8,710.66	16.82	16,043.72	17.11	12,808.62	16.73	12,474.05	29.13
合计	51,789.86	100.00	93,778.29	100.00	76,555.60	100.00	42,827.71	100.00

报告期内，本公司外销收入保持较高比重，外销比例平均保持在 70%以上。外销区域主要集中在美洲、欧洲和除中国之外的亚洲其他地区。本公司外销收入主要以美元结算。

最近三年一期，欧美地区的销售收入占主营业务收入的平均比重为 55.07%，亚洲地区（中国大陆除外）销售收入占主营业务收入的平均比重为 24.99%，国外经济形势变化对本公司的出口销售具有一定影响。从 2011 年 7 月份开始，欧洲债务危机开始蔓延，欧洲地区的经济发展受到一定影响，本公司欧洲地区订单在 2011 年下半年开始有所下滑，但 12 月订单开始回升。

2011 年 1 月至 2012 年 6 月，公司对欧洲、美洲、亚洲地区（中国大陆除外）的外销收入波动情况如下图所示：

单位：万元



如果未来欧洲经济形势持续恶化，可能对公司外销收入产生不利影响。为应对国外经济形势变化对本公司可能造成的不利影响，本公司采取了积极拓展国外新兴市场、提升国内市场占有率等措施，具体包括：

① 积极开拓国际市场

公司通过发展贸易商、参加当地展会等形式，积极开拓俄罗斯、印度、巴西、立陶宛、瑞士等新兴市场，并取得了一定基础。近两年，新兴市场销售显示出较好的增长势头，新兴市场的开拓将有助于降低欧美经济危机可能对公司造成的不利影响。

最近三年一期，公司对新兴市场的销售情况如下：

单位：万元

国家	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
印度	584.63	203.15	108.8	6.72
瑞士	298.45	295.43	32.37	-
俄罗斯	801.95	1,365.91	1,164.38	855.4
巴西	87.57	253.10	345.36	112.11
立陶宛	71.35	431.99	298.4	53.51
合计	1,843.95	2,549.57	1,949.31	1027.74
占主营业务收入比重	3.56%	2.72%	2.55%	2.40%

② 进一步提高国内市场销售份额

为进一步提升国内市场的销售规模，化解外部市场的潜在风险，公司加强了国内市场的销售力度和售后服务，并已取得一定的成果，华东地区、华中地区、华北地区近 3 年内销售金额逐年递增，其中 2011 年分别较上年增长 22.16%、44.46%、350.51%。

国内市场最近三年一期销售收入按销售区域统计如下表：

单位：万元

销售区域	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
华南	4,326.50	8,260.01	7,297.84	8,693.66
华东	2,469.26	4,172.51	3,415.57	1,962.52
华中	1,142.58	1,791.94	1,240.42	1,542.37
西南	403.94	1,188.08	751.61	212.87
华北	234.36	464.84	103.18	62.63
东北	133.93	165.94	-	15.12
西北	0.09	0.08	-	-
合计	8,710.66	16,043.40	12,808.62	12,474.05
占主营业务收入比重	16.82%	17.11%	16.73%	29.13%

(4) 按销售模式分类

销售类型	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
直销	35,591.20	68.72	63,393.59	67.60	50,406.03	65.84	29,536.14	68.97
经销	16,198.66	31.28	30,384.70	32.40	26,149.57	34.16	13,291.57	31.03
合计	51,789.86	100.00	93,778.29	100.00	76,555.60	100.00	42,827.71	100.00

(5) 按客户类型分类

客户类型	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
PCB 贸易商	16,198.66	31.28	30,384.70	32.40	26,149.57	34.16	13,291.57	31.03
终端客户	12,777.11	24.67	23,315.73	24.86	17,845.63	23.31	12,794.43	29.87
PCB 设计公司	8,014.54	15.48	14,484.08	15.45	10,099.11	13.19	4,493.40	10.49
PCB 生产企业	6,792.85	13.12	12,577.05	13.41	10,864.74	14.19	5,690.46	13.29
EMS 公司	8,006.69	15.46	13,016.73	13.88	11,596.56	15.15	6,557.86	15.32
合计	51,789.86	100.00	93,778.29	100.00	76,555.60	100.00	42,827.71	100.00

(6) 按应用领域分类

应用领域	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
通信设备	23,414.20	45.21	42,941.08	45.79	35,421.67	46.27	19,934.02	46.55
工业控制	16,562.40	31.98	29,333.85	31.28	25,294.35	33.04	12,603.38	29.43
医疗仪器	5,955.83	11.50	11,093.97	11.83	7,060.92	9.22	5,213.05	12.17
安防电子	2,491.09	4.81	4,051.22	4.32	2,529.42	3.3	1,656.99	3.87

航空航天	662.91	1.28	1,772.41	1.89	1,032.19	1.35	836.23	1.95
消费电子	517.90	1.00	1,162.85	1.24	544.36	0.71	477.96	1.12
其它	2,185.53	4.22	3,422.91	3.65	4,672.68	6.1	2,106.09	4.92
合计	51,789.86	100.00	93,778.29	100.00	76,555.59	100.00	42,827.71	100.00

注：由于本公司产品约 68%左右通过经销方式销售，约 32%左右通过直销方式销售，因此上表中的数据系根据销售人员统计以及与客户沟通统计得出，可能与实际应用比例存在一定差异。

(7) 按贴牌与自有品牌分类

收入分类	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
自有品牌	50,875.76	98.23	92,507.24	98.64	75,664.11	98.84	42,812.22	99.96
贴牌	914.10	1.77	1,271.05	1.36	891.49	1.16	15.48	0.04
总计	51,789.86	100.00	93,778.29	100.00	76,555.60	100.00	42,827.71	100.00

贴牌是指公司产品生产出来以后，使用其他企业的商标及 LOGO 出售给下游客户，公司承担代理加工的任务，类似于 OEM 生产。

自有品牌是指公司产品生产出来以后，使用公司自身的商标及 LOGO 出售给下游客户和终端客户，公司承担原材料供应商的职能。

报告期内，公司贴牌客户的销售收入具体情况：

单位：万元

公司名称	合作时间	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
ASIATECH (FAR EAST) CO., LTD	2004 年 4 月	38.26	105.97	100.70	0.00
GLOBAL CIRCUITS BOARD CO.,LTD.	2004 年 5 月	49.21	55.28	68.69	0.00
ESTEC INTERNATIONAL LTD.	2004 年 10 月	657.85	926.82	626.22	0.00
Flatfield multi print international b.v.	2009 年 3 月	168.77	182.98	95.88	15.48

上述四家客户均为 PCB 贸易商。贴牌的原因：公司在发展初期，为了增加业务量，在 2004 年发展了前 3 家贴牌贸易商，为其客户代加工产品，并以客户的品牌对外销售。但是随着公司规模壮大，订单增多，为了发展自有品牌，公司原则上不再承接贴牌的订单。2009 年金融危机时，公司又接纳了第 4 家有贴牌需求的贸易商。总体来说，公司贴牌的产品比例维持非常低的水平，销售政策不鼓励贴牌产品。公司销售给 PCB 生产企业的产品均为自有品牌。

公司收入确认的总体原则以货物的风险和所有权转移为标准。公司与客户签订的合同或订单均为买断式条款，因此无论是采用经销或直销模式，也不论是以

贴牌或自有品牌销售，收入确认原则均没有差异，即：本公司将货物交付至指定地点或以客户验收作为货物风险和所有权转移的标准（一般国内销售、国外 DDU 销售方式下约定由客户验收），并据此确认收入。

公司确认收入的具体原则为：国内销售：公司在货物交付到买方指定地点，客户验收并与公司核对后确认收入；国外销售：公司出口销售 90%以上采用 FOB 的方式，少量采用 DDU 贸易方式。①采用 FOB 贸易方式：本公司将货物运输至指定装运港装运时确认收入；②采用 DDU 贸易方式，本公司在将货物交付到客户指定的地点，并由客户签收货运提单时确认收入。

2、主营业务收入增减变化分析

报告期内，本公司实现主营业务收入分别为42,827.71万元、76,555.60万元、93,778.29万元、51,789.86万元，其中：2011年较上年增长22.50%，2010年较2009年增长78.75%。最近三年公司主营业务收入年均复合增长率为47.98%。

公司产品按技术档次分类的销量、平均单价和销售收入情况如下表：

产品 品种	项目	2012年1-6月	2011年		2010年		2009年
		数额	数额	增长率	数额	增长率	数额
高端板	销量（m ² ）	128,482.12	197,344	34.33%	146,912.24	70.40%	86,215.93
	平均单价（元/m ² ）	2,239.11	2,549.22	-3.50%	2,641.70	4.37%	2,531.14
	销售收入（万元）	28,768.59	50,307.44	29.63%	38,809.80	77.84%	21,822.46
中低端板	销量（m ² ）	199,751.83	384,126	7.72%	356,595.80	70.04%	209,708.68
	平均单价（元/m ² ）	1,152.49	1,131.68	6.91%	1,058.50	5.68%	1,001.64
	销售收入（万元）	23,021.27	43,470.85	15.17%	37,745.80	79.70%	21,005.25
销售收入（万元）		51,789.86	93,778.29	22.50%	76,555.60	78.75%	42,827.71
销量（m ² ）		328,234	581,470	15.48%	503,508	70.15%	295,925
平均单价（元/m ² ）		1,577.83	1,612.78	6.07%	1,520.44	5.06%	1,447.25

（1）报告期内主营业务收入波动情况

报告期内，公司主营业务收入分月份的波动情况如下图：



（2）报告期内，公司主营业务收入增长的原因分析

报告期内，本公司按新老客户统计的收入增长情况如下：

金额	2012年1—6月VS2011年1—6月		2011年VS2010年		2010年VS2009年	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
销售收入增长	5,898.01	100.00%	17,222.69	100.00%	33,727.89	100.00%
其中：新客户收入金额	301.46	5.11%	2,809.83	16.31%	3,351.73	9.94%
老客户收入增长金额	5,596.55	94.89%	14,412.86	83.69%	30,376.16	90.06%

报告期内，本公司销售收入的增长主要来源于老客户的业务增长，对老客户的收入金额占收入增长总额的比例分别为 90.06%、83.69%、94.89%。

①2010 年主营业务收入增长的原因分析

2010 年，公司实现主营业务收入 76,555.60 万元，较 2009 年增长 33,727.89 万元，增长幅度 78.75%。主营业务收入增长的原因是来自于销售量的大幅增长和销售单价的上涨。其中，销售量增长导致主营业务收入增长 70.15%，销售单价提高导致主营业务收入增长 8.60%。

2010 年，全球经济持续复苏，PCB 行业也全面复苏，PCB 市场需求量强劲反弹，公司订单量急剧上升。一方面，深圳崇达新建生产基地于 2010 年 6 月份完全达到预计可使用状态，使公司 2010 年产能较 2009 年提高 63.54%，满足了公司快速增长的订单需求；另一方面，为了进一步扩大市场占有率，满足市场的强劲需求，公司加强了市场拓展力度，在维护老客户市场、确保老客户业务量增长的同时，也通过开拓新客户，实现了营业收入的进一步增长。2010 年公司通过有效营销，直接客户数量已经达到 360 个，较上年增加 56 个，增长幅度为

18.42%。在上述因素带动下，2010 年，公司高端板销量同比增长了 70.40%，中低端板销量同比增长了 70.04%。

2010 年，全球大宗商品价格恢复上涨，公司主要原材料和人工成本不断提高，导致公司整体生产成本上升；同时公司订单量迅猛增长导致交货周期紧张，公司根据单个订单成本及交货期情况对报价适度调整，导致高端板平均单价同比上涨了 4.37%，中低端板平均单价同比上涨了 5.68%。

②2011 年主营业务收入增长的原因分析

2011 年公司实现主营业务收入 93,778.29 万元，较 2010 年增长 17,222.69 万元，增长幅度为 22.50%。主营业务收入增长的原因是销量和单价较上年均有上涨。其中，销售量增长导致主营业务收入增长 15.48%，销售单价提高导致主营业务收入增长 7.02%。

公司 2011 年高端板和中低端板的销量均较上年有所增长，主要原因是：PCB 市场需求增长稳定，新兴电子产品的需求强劲，成为 PCB 行业新的增长点。一方面，由于本公司近两年通过生产基地扩建和购置机器设备，产能有了较大幅度提高，2011 年随着产能充分释放和公司技术水平、整体形象的提升，公司产品受到了越来越多客户的认可，订单数量继续增加；另一方面，随着产能的扩张和释放，公司招聘了一批业务骨干，积极开拓市场，争夺市场占有率。尤其在高端产品的市场扩张上，公司通过给予新客户和老客户的新业务更多优惠，提供有竞争力的市场价格争取高端板的订单。2011 年公司订单数量和订单面积较去年同期均实现较大幅度增长，高端板在收入结构中的比例进一步提高。

2011 年，PCB 主要原材料覆铜板、铜球及铜箔等采购单价均有所上升，公司依据成本因素主要针对中低端板价格进行了适度上调，虽然高端板单位价格因销售策略因素有所下滑，但因为 2011 年高端板在收入结构中的比重提高了 2.96 个百分点，同时由于高端板平均单价是中低端板的两倍以上，所以，公司产品整体销售单价较上年上涨 6.07%。

③2012 年 1—6 月，主营业务收入增长的原因分析

2012 年 1-6 月，公司实现主营业务收入 51,789.86 万元，较上年同期增长 5,898.71 万元，增长幅度为 12.85%。主营业务收入增长的原因是销量较上年增长

11.60%。

收入增长主要来源于亚洲和美洲的外销收入增长以及中国大陆地区的内销收入增长。其中：亚洲（中国大陆除外）较上年同期增长 3,977.39 万元，增长率为 34.24%，增长主要来源于泰国、印度、以色列、香港等国家和地区；美洲较上年同期增长 1,752.55 万元，增长率 12.00%，增长主要来源于美国市场。而欧洲地区由于受到欧债危机的影响收入较上年同期减少 628.52，下降比率为 5.35%。

公司 2012 年 1-6 月与上年同期的收入分区域对比如下：

单位：万元

区域	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增长额	增长率
一、外销	43,079.20	37,977.78	5,101.42	13.43%
1、亚洲（中国大陆除外）	15,594.19	11,616.80	3,977.39	34.24%
2、美洲	16,360.77	14,608.22	1,752.55	12.00%
3、欧洲	11,124.24	11,752.76	-628.52	-5.35%
二、内销（中国大陆）	8,710.66	7,914.07	796.59	10.07%
合计	51,789.86	45,891.85	5,898.01	12.85%

2012 年上半年，公司通过保持与老客户的深度合作、开拓新客户和新兴市场等途径，保持了收入的小幅增长，有效应对经济形势严峻带来的不利影响。

（3）同行业上市公司收入变动情况

同行业上市公司收入变动百分比情况列示如下：

营业收入增长率	兴森科技	沪电股份	超声电子	超华科技	天津普林	中京电子	依顿电子	崇达技术
2010 年 VS2009 年	60.00%	31.00%	17.72%	29.11%	52.47%	27.71%	36.93%	79.54%
2011 年 VS2010 年	19.16%	4.74%	-7.12%	95.57%	-13.96%	24.94%	8.52%	23.41%
2012 年 1-6 月 VS2011 年 1-6 月	7.06%	-6.14%	-	141.91%	-	-	-	12.85%

注：上述数据引用自各公司年度报告、半年度报告、招股书披露数据。其中超声电子、超华科技收入增长率数据系指其中的印制电路板业务收入。

从上述 PCB 行业上市公司公布的财务数据可以看出，2010 年 PCB 行业整体发展势头良好，PCB 上市公司营业收入均实现不同程度的增长。

2011 年，受到欧债危机等众多经济因素的影响，PCB 上市公司收入增长放缓，除超声电子、天津普林收入出现下滑，兴森科技、沪电股份、中京电子、超

华科技 PCB 业务仍实现增长。

2012 年上半年，由于经济形势较为严峻，PCB 行业上市公司业绩相比上年同期基本保持稳定。超华科技收入大幅增长的原因因为募投项目实施和收购子公司所致。

（二）主营业务毛利率分析

1、毛利构成分析

报告期内，本公司主营业务毛利构成情况如下：

产品品种	项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
高端板	毛利（万元）	10,394.92	18,047.55	15,967.27	9,107.86
	占比	61.07%	59.36%	58.42%	63.60%
中低端板	毛利（万元）	6,625.69	12,358.06	11,365.90	5,211.93
	占比	38.93%	40.64%	41.58%	36.40%
合计	毛利（万元）	17,020.61	30,405.61	27,333.17	14,319.79

本公司的主要毛利来源于高端板，报告期内，高端板产生的毛利额占主营业务毛利的比例分别为 63.60%、58.42%、59.36%、61.07%。

2、毛利率波动分析

报告期内，公司产品销售的毛利率变动主要受产品结构、产品销售价格和销售成本等因素的影响。

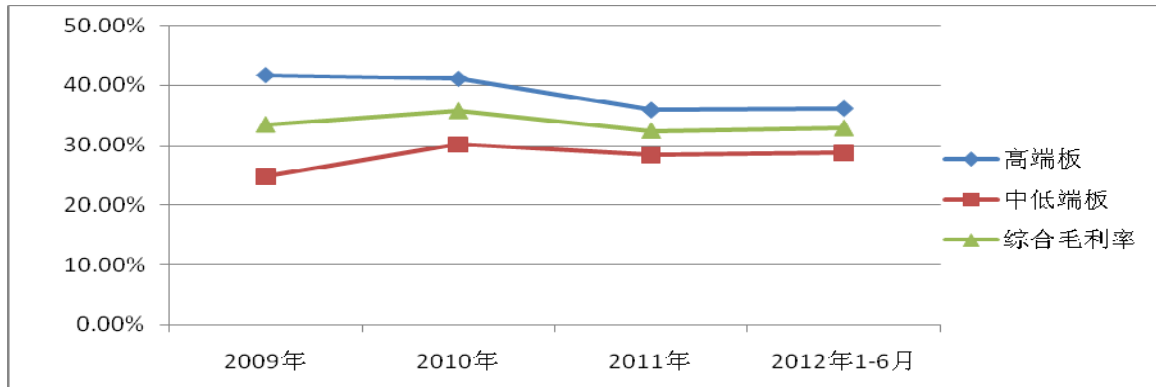
（1）产品结构对毛利率的影响分析

类别	项目	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
		金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
高端板	收入	28,768.59	55.55	50,307.44	53.65	38,809.80	50.69	21,822.46	50.95
	毛利	10,394.92	61.07	18,047.55	59.36	15,967.27	58.42	9,107.86	63.60
	毛利率	36.13%		35.87%		41.14%		41.74%	
中低端板	收入	23,021.27	44.45	43,470.85	46.35	37,745.80	49.31	21,005.25	49.05
	毛利	6,625.69	38.93	12,358.06	40.64	11,365.90	41.58	5,211.93	36.40
	毛利率	28.78%		28.43%		30.11%		24.81%	
合计	收入	51,789.86	100.00	93,778.29	100.00	76,555.60	100.00	42,827.71	100.00
	毛利	17,020.61	100.00	30,405.61	100.00	27,333.17	100.00	14,319.79	100.00
	毛利率	32.86%		32.42%		35.70%		33.44%	

报告期内，公司高端板实现的销售收入占比分别为 50.95%、50.69%、53.65%、55.55%，高端板比例逐年上升。

由于高端板的技术难度远高于中低端板，因此，高端板的毛利率也显著高于中低端板。

公司产品毛利率及综合毛利率变动图如下：



报告期内，公司的高端板收入占比分别为 50.95%、50.69%、53.65%、55.55%，高端板产生的毛利额占主营业务毛利的比例分别为 63.60%、58.42%和 59.36%、61.07%，公司高端板收入占比逐年上升。

2010 年，本公司高端板毛利额占比较 2009 年下降的主要原因为：高端板和中低端板销售收入占比以及高端板的毛利率较 2009 年基本不变，但中低端板的毛利率大幅提高，由 24.81% 上升至 30.11%，导致高端板毛利占比较 2009 年下降。2010 年本公司中低端板毛利率上升的原因为：公司中低端产品平均销售价格上涨 5.68%，由于规模效应，单位平均成本下降 1.77%。

2011 年，本公司高端板毛利额占比较 2010 年下降的主要原因为：虽然公司高端板收入和收入占比同时增长，但是高端板毛利率由 2010 年 41.14% 下降至 2011 年 35.87%，高端板收入的增长未能弥补高端板毛利下降，从而导致高端板毛利额占比较 2010 年下降。2011 年高端板毛利率较上年下降的原因：随着产能的扩张和释放，公司高端板产能增加，生产技术和管理能力提高，为了提高高端板的市场占有率，同时应对国外经济形势变化对公司的不利影响，2011 年，公司对高端板进行适度降价，单位售价较 2010 年下降 3.50%，从而导致高端板毛利率下降。

2012 年 1-6 月，本公司高端板收入占比较上年增长 1.90%，导致高端板毛利

占比上升 1.71%。2012 年上半年公司整体毛利率与 2011 年基本保持稳定。

（2）销售价格和销售成本对毛利率的影响分析

项目	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年
	数值	增长	数值	增长	数值	增长	数值
平均销售价格（元/m ² ）	1,577.83	-2.17%	1,612.78	6.07%	1,520.44	5.06%	1,447.25
平均销售成本（元/m ² ）	1,059.28	-2.81%	1,089.87	11.49%	977.59	1.48%	963.35
综合毛利率	32.86%	0.44%	32.42%	-3.28%	35.70%	2.26%	33.44%

生产成本是 PCB 生产企业确定销售价格的重要因素，但因销售价格同时受到市场供求关系影响，并且由于公司 PCB 产品种类较多，平均销售单价和平均销售成本还受公司产品结构、战略定位、产能利用等因素的影响，因此产品成本和销售价格的变化幅度并不一致。

报告期内，销售单价和销售成本变动对毛利率的影响如下表：

毛利率影响因素	2012 年 1-6 月 Vs2011 年		2011 年 Vs2010 年		2010 年 Vs2009 年	
	变动率	对毛利率影响百分点	变动率	对毛利率影响百分点	变动率	对毛利率影响百分点
1、平均销售单价（P）	-2.17%	-1.50	6.07%	3.68	5.06%	3.20
2、平均销售成本	-2.81%	1.94	11.49%	-6.96	1.48%	-0.94
其中：单位直接材料成本（a）	-6.77%	3.07	12.91%	-5.07	8.40%	-3.23
单位委外加工费用（b）	2.60%	-0.04	-30.09%	0.67	-17.10%	0.49
单位制造费用（c）	2.36%	-0.33	10.10%	-1.26	-12.70%	1.93
单位人工成本（d）	9.31%	-0.75	19.71%	-1.30	1.88%	-0.13
合计		0.44		-3.28	-	2.26

注：因素变动率对毛利率影响的计算公式如下：

p 的变动率导致毛利率的变化量=（基期单位销售成本/基期 p）×p 的变动率/（1+p 的变动率）

a 的变动率导致毛利率的变化量= -（基期 a×a 的变动率）/本期 P

b 的变动率导致毛利率的变化量= -（基期 b×b 的变动率）/本期 P

c 的变动率导致毛利率的变化量= -（基期 c×c 的变动率）/本期 P

d 的变动率导致毛利率的变化量= -（基期 d×d 的变动率）/本期 P

2010年，公司产品的综合毛利率较2009年上升了2.26个百分点。其中：产品平均销售单价较上年提高了5.06%，导致综合毛利率上升3.20个百分点；平均销售成本较上年增加了1.48%，导致综合毛利率下降了0.94个百分点。

2011年，公司产品的综合毛利率较2010年下降了3.28个百分点。其中：产品平均销售单价较上年提高了6.07%，导致综合毛利率上升3.68个百分点；平均销售成本较上年增加了11.49%，导致综合毛利率下降了6.96个百分点。

2012年1-6月，公司产品的综合毛利率较2011年上升了0.44个百分点。其中：产品平均销售单价较上年下降了2.17%，导致综合毛利率下降1.50个百分点；平均销售成本较上年下降了2.81%，导致综合毛利率上升了1.94个百分点。

（3）平均销售单价变动原因分析

最近三年一期，公司产品平均销售单价分别为1,447.25元/平方米、1,520.44元/平方米、1,612.78元/平方米、1,577.83元/平方米。

2010年公司产品平均销售单价比上年提高5.06%，主要原因是原材料和人工成本不断提高，导致公司整体生产成本上升，同时公司订单量迅速增长导致交货周期紧张，公司根据单个订单成本及交货期情况对报价适度上调。受成本上升及需求增长的影响，公司高端板的平均销售单价较上年上升4.37%，中低端板的平均销售单价较上年上升5.68%。

2011年公司产品平均销售单价比上年提高6.07%，主要原因是2011年PCB生产主要原材料采购单价继续上涨，公司依据成本因素主要针对中低端板价格进行了适度上调，虽然高端板单位价格因销售策略因素有所下滑，但因为2011年高端板在收入结构中的比重提高了2.95个百分点，同时由于高端板平均单价是中低端板的两倍以上，所以，公司产品整体销售单价较上年上涨6.07%。

2012年1-6月公司产品平均销售单价比上年下降2.17%，主要原因是2012年上半年PCB主要生产原材料的采购平均单价下降，销售价格也相应降低。

（4）平均单位销售成本变动的原因

本公司销售成本由直接材料、直接人工、制造费用和委外加工费用构成，报告期内，本公司产品平均单位成本构成及变化如下表：

产品综合平均单位销售成本构成及变化表

项目	2012年1-6月			2011年		
	金额 (元/㎡)	比重 (%)	金额变动 (%)	金额 (元/㎡)	比重 (%)	金额变动 (%)
直接材料	666.55	62.92	-6.77	714.93	65.60	12.91
委外加工费	25.94	2.45	2.60	25.29	2.32	-30.09
直接人工	139.64	13.18	9.31	127.76	11.72	19.71
制造费用	227.14	21.44	2.36	221.90	20.36	10.10
合计	1,059.28	100.00	-2.81	1,089.87	100.00	11.49

产品综合平均单位销售成本构成及变化表（续）

项目	2010 年			2009 年	
	金额 (元/m ²)	比重 (%)	金额变动 (%)	金额 (元/m ²)	比重 (%)
直接材料	633.16	64.77	8.40	584.11	60.63
委外加工费	36.17	3.70	-17.12	43.64	4.53
直接人工	106.72	10.92	1.88	104.75	10.87
制造费用	201.54	20.61	-12.70	230.85	23.97
合计	977.59	100.00	1.48	963.35	100.00

① 单位直接材料变动对产品成本的影响分析

本公司产品生产的主要原材料为覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、氰化金钾、油墨、干膜。其中，覆铜板、铜球、铜箔占比约 50%，其采购价格主要受铜价影响；半固化片占比约 12%，其采购价格主要受石油价格波动的影响。

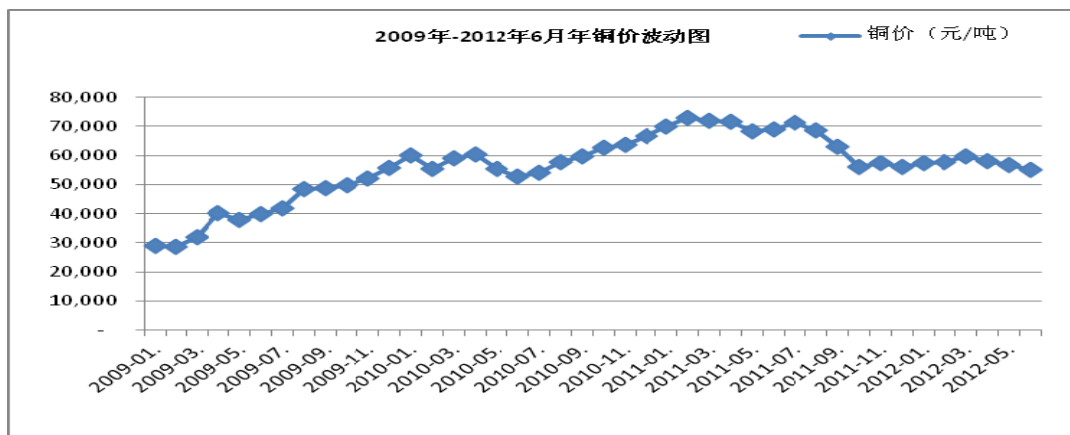
2009 年至 2012 年 6 月 30 日，公司每平方米产品所耗费的主要直接材料覆铜板、铜球、铜箔、半固化片构成如下：

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料成本	666.55	100.00%	714.93	100.00%	633.16	100.00%	584.11	100.00%
其中：覆铜板、铜球、铜箔	337.76	50.67%	357.28	49.97%	316.00	49.91%	280.12	47.96%
半固化片	79.94	11.99%	83.28	11.65%	78.20	12.35%	76.58	13.11%

报告期内，公司产品每平方米耗用的原材料波动幅度较大。主要原因是受到铜价和石油价格波动的影响导致覆铜板、铜球、半固化片涨幅较大。

报告期内，铜价的走势如下：



数据来源：上海有色网

报告期内，铜价呈现较大幅度波动，2009年-2011年2月期间，铜价呈现上升趋势，2011年2月-2011年10月，铜价开始呈现下降趋势，2011年10月-2012年6月基本保持稳定。受铜价波动的影响，覆铜板、铜球等原材料平均采购价格也随之呈现波动趋势。

报告期内，受石油价格波动的影响，半固化片的采购成本波动幅度也较大。

本公司主要原材料采购价格如下表所示：

品种	材料平均采购单价（元）						
	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年
	单价	变动	单价	变动	单价	变动	单价
覆铜板（m ² ）	93.14	-10.55%	104.12	10.79%	93.98	12.63%	83.44
铜球（KG）	53.24	-12.05%	60.54	12.11%	54.00	34.33%	40.20
铜箔（KG）	75.39	-12.49%	86.15	10.36%	78.06	25.80%	62.05
半固化片（m ² ）	12.37	-14.69%	14.50	1.67%	14.26	17.56%	12.13

由于直接材料价格变动的影响，导致公司2010年、2011年、2012年1-6月毛利率较上年下降3.23、5.07、-3.07个百分点。原材料价格的波动是导致销售成本波动最重要的因素。

② 单位直接人工变化对成本的影响分析

报告期内，单位直接人工占销售成本的比重逐年上升，分别为 10.87%、10.92%、11.72%、13.18%。单位直接人工成本受产量和工资总额的影响。

2010 年公司生产人员人数和员工工资较上年增加，但由于公司生产量较上年增长 70.15%，因此，单位产品分摊的直接人工费用较 2009 年增长幅度仅为 1.88%。

2011 年，由于 CPI 指数持续上升，公司在原有工资标准上适当调高了生产人员工资，因此，2011 年较 2010 年平均单位人工增长 19.71%；2012 年上半年较 2011 年平均单位人工增长 9.31%。

项目	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年
	数额	变动率	数额	变动率	数额	变动率	数额
销量（m ² ）	328,234	-	581,470	15.48%	503,508	70.67%	295,925

单位人工(元/m ²)	139.64	9.31%	127.76	19.71%	106.72	1.88%	104.75
占销售成本比重	13.18%	-	11.72%	-	10.92%	-	10.87%

报告期内，由于人员增加和工资上涨因素导致毛利率分别较上年减少 0.13、1.30、0.75 个百分点。

③ 单位委外加工费用变动原因分析

报告期内，由于受到产能的限制，本公司将部分生产环节如压合、沉铜板电、沉银、沉金、锣板、钻孔等委外加工，随着2010年本公司产能的扩大，委外加工费用下降。报告期内，委外加工费用占销售成本比重分别为4.53%、3.70%、2.32%、2.45%，呈逐年下降趋势。

项目	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年
	数额	变动率	数额	变动率	数额	变动率	数额
销量 (m ²)	328,234	-	581,470	15.48%	503,508	70.67%	295,925
委外加工金额 (万元)	851.59	-	1,470.39	-20.79%	1,821.19	41.06%	1,291.12
单位委外成本 (元/m ²)	25.94	2.60%	25.29	-30.09%	36.17	-17.10%	43.63
占销售成本比重	2.45%	-	2.32%		3.70%	-	4.53%

报告期内，单位委外加工费用下降导致毛利率分别较上年上升幅度为0.49、0.67、-0.04个百分点。

报告期内，本公司委外加工供应商及加工金额如下：

A. 2009年，委外加工的供应商名称及金额：

	委托加工公司名称	委外加工业务	委外加工金额 (万元)	占委托加工的比例
1	竞浩电子（深圳）有限公司	沉铜板电	198.12	15.34%
2	深圳市裕维电子有限公司	沉金	135.8	10.52%
3	深圳市盛坤电子科技有限公司	钻孔	135.34	10.48%
4	深圳市富盈电子有限公司	V-CUT/成型	133.99	10.38%
5	深圳德瑞勤电路科技有限公司	沉银	122.41	9.48%
6	深圳市龙江实业有限公司	压合	80.9	6.27%
7	深圳益联鑫电子有限公司	沉铜板电	65.06	5.04%
8	南京协力多层线路板科技有限公司	飞针测试	61.47	4.76%
9	深圳市捷迪科技有限公司	成型	51.12	3.96%

10	深圳市路维电子有限公司	光绘菲林	46.18	3.58%
	其他（共 31 家）		260.73	20.19%
	合计		1,291.12	100.00%

B. 2010年，委外加工的供应商名称及金额：

	委托加工公司名称	委外加工业务	委外加工金额 （万元）	占委托加工的比例
1	竞浩电子(深圳)有限公司	沉铜板电	259.63	14.26%
2	深圳泰阿电子有限公司	内层	154.95	8.51%
3	深圳市龙江实业有限公司	压合	145.42	7.98%
4	深圳德瑞勤电路科技有限公司	沉银	130.31	7.16%
5	深圳市惠普斯电子有限公司	沉锡	106.21	5.83%
6	深圳市捷迪科技有限公司	锣板	101.76	5.59%
7	江门市泽天达科技有限公司	压合	101.11	5.55%
8	深圳市裕维电子有限公司	沉金	99.37	5.46%
9	深圳市明正宏电子有限公司	沉金	93.53	5.14%
10	深圳市蓝宝实业有限公司	沉银	82.24	4.52%
	其他（共 32 家）		546.65	30.02%
	合计		1,821.19	100.00%

C. 2011年，委外加工的供应商名单及金额：

	委托加工公司名称	委外加工业务	委外加工金额 （万元）	占委托加工的比例
1	深圳市德瑞勤科技有限公司	沉银	237.45	16.15%
2	深圳市裕维电子有限公司	沉金	211.06	14.35%
3	珠海镇东有限公司	树脂塞孔、磨板	124.73	8.48%
4	深圳市明正宏电子有限公司	沉金	91.8	6.24%
5	龙宇电子(深圳)有限公司	压合	71.58	4.87%
6	深圳市仁创艺电子有限公司	喷锡	68.23	4.64%
7	深圳市捷迪科技有限公司	V-CUT、成型	56.79	3.86%
8	深圳市惠普斯电子有限公司	喷锡、沉锡	56.74	3.86%
9	荷利兴业科技（深圳）有限公司	钻孔	52.98	3.60%
10	深圳市华祥电路科技有限公司	钻孔	49.48	3.37%
	其他（共 34 家）		449.56	30.57%

	合计		1,470.39	100.00%
--	----	--	----------	---------

D. 2012年1-6月，委外加工的供应商名单及金额：

	委托加工公司名称	委外加工业务	委外加工金额 (万元)	占委托加工的比例
1	深圳市裕维电子有限公司	沉镍金、金手指	344.93	40.50%
2	龙宇电子（深圳）有限公司	压合	255.96	30.06%
3	深圳市志永翔科技有限公司	抗氧化、沉锡、沉银	59.41	6.98%
4	深圳市捷迪科技有限公司	成型	53.72	6.31%
5	深圳市明正宏电子有限公司	金手指、沉镍金	25.8	3.03%
6	深圳市仁创艺电子有限公司	有铅喷锡、无铅喷锡	22.53	2.65%
7	深圳市德瑞勤科技有限公司	沉锡	13.5	1.59%
8	深圳市力捷科激光技术有限公司	激光切割	11.35	1.33%
9	珠海镇东有限公司	砂带磨板、塞孔	6.27	0.74%
10	博罗县湖镇镇展佑电子销售部	线路修补	5.91	0.69%
	其他（共 22 家）		52.19	6.13%
	合计		851.59	100.00%

本公司与委外加工的供应商不存在关联关系。

④ 单位制造费用变动原因分析

报告期内，公司单位制造费用占销售成本比重约为21%，制造费用主要由水电费、折旧、人工、其他制造费用构成。随着生产量的增加，单位制造费用被摊薄而降低。

项目	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年
	数额	变动率	数额	变动率	数额	变动率	数额
销量（m ² ）	328,234	-	581,470	15.48%	503,508	70.67%	295,925
单位制造费用（元/m ² ）	227.14	2.36%	221.90	10.10%	201.54	-12.70%	230.85
占销售成本比重	21.44%	-	20.36%		20.61%		23.97%

2010年公司产量较上年大幅度提高，使得生产线利用率较高，由于规模效益导致单位产品分摊的固定费用下降，从而使得单位产品分摊的制造费用较上年下降了12.70%。单位制造费用下降部分抵消了2010年原材料涨价带来的不良影响。

2011年虽然产量较上年增长13%，但由于公司产能的扩张，固定资产较上年有较大幅度增加，导致折旧较上年增长40%，因此单位制造费用较上年增长10.10%。

2012年1-6月单位制造费用较上年增长2.36%，主要是由于公司单位固定资产折旧增加所致。

报告期内，由于制造费用变动对毛利率的影响幅度分别为1.93、-1.26、-0.33个百分点。

3、主要原材料对公司利润的敏感性分析

假设各主要原材料保持 2011 年在生产成本中的比重，则采购价格变动导致变化后的毛利率结果如下：

价格升（+）/降（-）比率	20%	10%	0%	-10%	-20%	-30%
覆铜板价格单独变动	30.14%	31.79%	33.44%	35.09%	36.74%	38.39%
半固化片价格单独变动	32.42%	32.93%	33.44%	33.95%	34.46%	34.97%
铜球价格单独变动	32.93%	33.18%	33.44%	33.70%	33.95%	34.21%
铜箔价格单独变动	32.89%	33.17%	33.44%	33.71%	33.99%	34.26%
以上材料同时变动	28.06%	30.75%	33.44%	36.13%	38.82%	41.51%
所有材料同时变动	24.71%	29.07%	33.44%	37.81%	42.17%	46.54%

材料价格变动后的毛利率=1-（1-2011 年毛利率）*（1+2011 年材料在生产成本中的比例*材料价格变动比率）

4、同行业上市公司毛利率比较

（1）本公司及可比 PCB 行业上市公司在产品、定价权和客户等方面比较

公司名称	产品特点	定价权	用户
沪电股份	1、大批量 2、客户较集中 3、产品层数较高，主要产品在 10 层以上	定位于 HDI、多层板，技术含量较高，批量大，具有市场平均定价能力	前 5 大客户集中度 50%以上，主要分布在通讯、汽车、办公及工业
超声电子 （PCB 业务）	1、大批量为主，兼顾小批量 2、客户较集中 3、产品以 HDI、多层为主	定位于 HDI、多层板市场，批量大，产品跨度大，具有市场平均定价能力	前 5 大客户集中度约 50%，主要分布在消费电子、汽车、通讯、工业
超华科技 （PCB 业务）	1、大批量为主 2、区域市场，华南占 80%以上 3、单面板为主	产品主要为单面板，面向消费电子市场，产品在细分市场有平均定价能力	国内单面 PCB 前 5 名厂商，前 5 大客户集中度约 30%，主要分布在电脑电源板、电话机板、电视机板、电脑显示器板等家用消费电子
中京电子	1、大批量为主 2、区域市场，华南占 50%以上 3、双面、多层为主	产品主要为消费电子市场定位，产品在细分市场有平均定价能力	前 5 大客户集中度 50-60%，应用于汽车、手机、家用消费电子等多个领域
天津普林	1、样板、小批量、大批量均能生产 2、国内、国外市场均衡 3、近 50%为单双面板	定位于中小批量，产品主要为双层板和多层板，市场定价权一般	前 5 大客户集中度 40%以上，主要分布在通讯产品、消费电子、汽车电子等领域

兴森科技	1、样板，均单面积 1-2 m ² 2、国内市场为主，客户较分散 3、50%以上为 8 层以上板	专业定位于样板市场，产品售价较高，在国内细分市场的具有较强的定价能力	前 5 大客户集中度很低，仅 10%；产品应用领域主要分布在通信、工业控制、医疗电子、计算机、国防等高端市场
崇达技术	1、小批量，均单面积为 8 m ² 2、国际非消费电子市场为主，客户较分散 3、50%以上为 8 层以上板	专业定位于小批量市场，在国外细分市场具有较强的定价权	前 5 大客户集中度约 35%；应用领域分布在通信设备、工业控制、医疗仪器、国防、航天航空、安防电子等工业领域

数据来源：上市公司年报、招股说明书，超声电子和超华科技毛利率仅指印制电路板业务。

（2）本公司毛利率较高、与行业变动不一致的原因

① 同行业上市公司毛利率总体分析

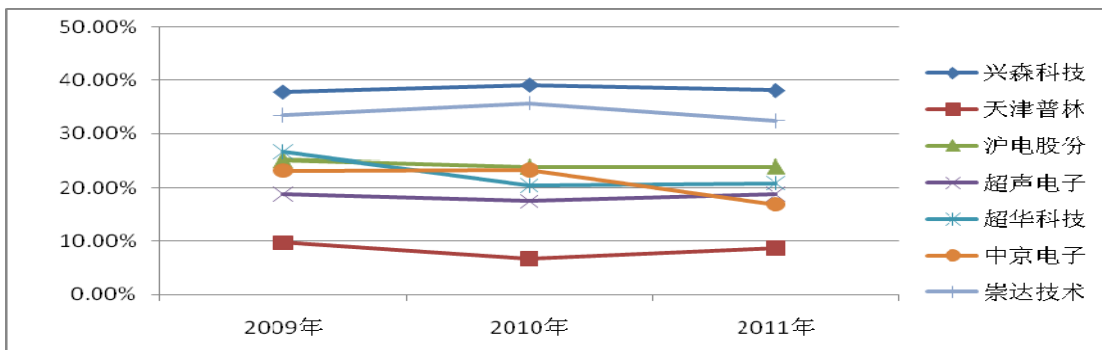
本公司主营业务毛利率与 PCB 行业上市公司比较如下：

年度	兴森科技	天津普林	沪电股份	超声电子	超华科技	中京电子	崇达技术
2011 年	38.10%	8.67%	23.97%	18.80%	20.88%	16.89%	32.40%
2010 年	39.11%	6.68%	23.92%	17.47%	20.47%	23.34%	35.70%
2009 年	37.83%	9.71%	25.13%	18.81%	26.61%	23.22%	33.44%

数据来源：上市公司年报、招股说明书，超声电子和超华科技毛利率仅指印制电路板业务。

从行业整体毛利率来看，第一，本公司的毛利率高于除兴森科技外的其他同行业上市公司；第二，PCB 行业上市公司 2009 年毛利率普遍有所上升，2010 年毛利率普遍有所下滑，2011 年大多数公司毛利率保持稳定。

PCB 同行业上市公司毛利率波动对比图



本公司和兴森科技的毛利率高于其他同行业上市公司，其主要原因与 PCB 细分行业毛利率相关：PCB 企业按照客户订单面积和应用领域划分，可进一步细分为 PCB 样板企业、小批量板企业、大批量板企业，一般来说，样板毛利率最高、小批量板毛利率居中、大批量板毛利率稍低。

PCB 样板行业主要服务于下游客户产品定型前的研究、实验、开发与中试

阶段，不同于批量板，其通常要求生产商能以最短的交货时间满足客户多品种的新产品研发需求。目前，国内样板行业仅有兴森科技、广州杰赛等少数企业，样板的产能不足，同时，由于样板要求的交货期限最短，一般为 10 天以内，样板企业需要空置部分设备满足客户交货要求，因此样板企业在报价时会额外加收制板费、工程费等费用，样板的议价能力较强，报价远高于批量板，因此毛利率最高。

大批量 PCB 行业主要服务于消费类电子领域，由于大批量 PCB 企业产品品种相对较少，交货期较长，每个订单的数量较大，大批量 PCB 生产企业通过实现大规模的量产也可保持较高的利润规模。在与客户的议价过程中，大批量 PCB 生产企业出于整单利润总额的考虑，一般会适当降低部分毛利率。目前，国内大批量 PCB 生产企业数量较多，竞争最为激烈，也是影响大批量毛利率的重要因素。因此，大批量 PCB 行业毛利率在 PCB 细分行业最低。

小批量 PCB 主要应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、国防、航天航空、安防电子等行业，行业特征介于样板和大批量板之间。小批量 PCB 要求的交货期一般为 10—20 天，交货期限较短，同时，由于下游应用领域较为广泛，客户对不同类型 PCB 的需求量较小，品种繁多，因此小批量 PCB 大多为定制产品，个性化服务程度较高，小批量 PCB 生产企业对客户的议价能力高于大批量生产企业，产品售价和毛利率介于大批量和样板之间。

② 本公司毛利率较高的原因

本公司专注于小批量 PCB 的生产，生产特征和交货期介于样板和大批量板之间，毛利率相对较高，主要原因为：

A、本公司产品交货期短，比样板企业稍长

PCB 产品的报价中，交货期是价格的一个重要影响因素。本公司拥有多品种快速交货的生产能力，报告期内平均交货期为 16 天，仅次于样板企业，本公司交货期短，议价能力较高，有效提升了公司产品的毛利率。

B、本公司产品质量较高，产品报价较高

本公司专业定位于小批量 PCB，在产品的生产和质量监控方面严格把关，

产品质量得到国内外诸多知名厂商的认可，包括 PCB 设计公司、PCB 贸易商、EMS 工厂、终端客户等。许多采购商尤其是国外采购商比较注重 PCB 生产企业的专业性，本公司凭借高质量的产品和专业化定位，在海外客户中的议价能力较高，产品报价比国内 PCB 生产企业更高。

C、从市场状况来看，国内小批量行业的竞争激烈程度低于大批量板

目前，国内 PCB 生产企业仍以大批量生产商为主，专业定位于小批量的生产企业不多，小批量生产企业的市场竞争程度低于大批量板生产企业，因此小批量 PCB 的议价能力高于大批量。

D、产品档次提高也是本公司毛利率较高的原因

2009 年开始，本公司产品结构优化，高端板占比提高至 50%以上，而目前同行业上市公司中，超声电子、超华科技、天津普林等公司仍以四层以下的中低端板为主。由于高端板技术难度更高，售价和毛利率均高于中低端板，所以本公司毛利率较高。

③ 本公司毛利率与行业波动不一致的原因

从行业毛利率整体波动上看，2010 年由于铜价回升以及市场需求回暖导致市场竞争加剧，PCB 行业上市公司毛利率呈下降趋势，但兴森科技与本公司毛利率仍有所上升。

本公司 2010 年毛利率较 2009 年上升 2.26%，与行业整体波动不一致，主要原因为：第一，本公司和兴森科技的产品主要是个性化较强的样板和小批量板，议价能力相对较高，2010 年本公司销售价格较 2009 年上升 5.06%；第二，本公司 2010 年产品产能、产量大幅度提高，规模效益导致单位产品分摊的固定费用下降，议价能力较强以及产能扩大部分抵消了原材料价格上涨带来的不利影响。

（3）与产品结构相似、新近上市的兴森科技毛利率比较分析

本公司专业定位于小批量板的生产与销售，因此与大批量板、样板行业的产品结构、毛利率均有较大差异。同行业上市公司中，除兴森科技同时生产样板和小批量板外，本公司与其他同行业上市公司存在较大的差异。因此，以下针对产品结构相似、新近上市的兴森科技与本公司作重点比较分析：

报告期内，兴森科技与本公司的综合毛利率比较表如下：

综合毛利率	崇达技术	兴森科技	差异
2012 年 1-6 月	32.86%	39.79%	-6.93%
2011 年	32.42%	38.10%	-5.68%
2010 年	35.70%	39.11%	-3.41%
2009 年	33.44%	37.83%	-4.39%

报告期内，兴森科技的综合毛利率均高于本公司，主要与行业特点相关。兴森科技 70%以上的产品为样板，而本公司 80%以上的产品为小批量板，由于样板的毛利率通常高于小批量板，因此，本公司整体毛利率低于兴森科技。

② 兴森科技小批量板毛利率与本公司比较

最近三年一期，本公司小批量 PCB 毛利率与兴森科技小批量毛利率的比较如下：

年度	崇达技术小批量毛利率	兴森科技小批量板毛利率	差异
2012 年 1-6 月	34.76%	31.79%	2.97%
2011 年	34.39%	33.47%	0.92%
2010 年	37.64%	31.75%	5.89%
2009 年	34.74%	23.70%	11.04%

2009 年、2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月，本公司毛利率分别高于兴森科技小批量板毛利率 11.04、5.89、0.92、2.97 个百分点。

根据兴森科技在招股说明书和年度报告中的披露，2009 年，兴森科技毛利率较低的原因为：广州兴森科技一期项目部分投产、深圳工厂搬迁，导致兴森科技产能利用率下降，折旧费用等成本大幅度上升，因此，2009 年毛利率较低。

2009 年，兴森科技 70%以上的营业收入来源于样板收入，公司在保证样板生产和及时交货的情况下，兼作部分小批量板，小批量 PCB 收入规模仅为 14,733.16 万元。2010 年，兴森科技公开发行股票并上市，部分募集资金投资于专门定位于小批量快速加工的生产线，不断向小批量 PCB 加工领域拓展，小批量 PCB 产能增加，规模效益逐步显现。2010 年，兴森科技小批量 PCB 销售收入同比增长约 1.26 亿元，增长率达到 86%；2011 年，小批量 PCB 规模进一步扩大，比上年增长 33%。由于规模效应及加强成本管理，使得兴森科技小批量 PCB 毛利率不断上升。2011 年，兴森科技小批量 PCB 毛利率与发行人基本一致。2012

年 1-6 月本公司小批量 PCB 毛利率基本保持稳定，兴森科技毛利率下降，导致本公司毛利率高于兴森科技小批量 PCB 毛利率 2.97 个百分点，根据兴森科技半年报披露，兴森科技在今年加强订单结构管控，强调保证样板核心业务稳定，因此 2012 年 1-6 月，兴森科技样板毛利率较上年同期增长 0.21%，但小批量毛利率下降 1.34%。

最近三年一期，兴森科技样板和小批量销售规模如下：

单位：万元

产品	2012 年 1-6 月			2011 年		
	销售金额	销售占比	毛利率	销售金额	销售占比	毛利率
样板	29,983.42	62.79%	44.53%	58,056.60	60.22%	41.00%
小批量板	17,771.51	37.21%	31.79%	36,414.96	37.77%	33.47%
合计	47,754.93	100.00%	39.79%	96,414.96	100.00%	38.10%

单位：万元

产品	2010 年			2009 年		
	销售金额	销售占比	毛利率	销售金额	销售占比	毛利率
样板	51,791.50	65.38%	43.01%	34,961.58	70.35%	43.78%
小批量板	27,425.11	34.62%	31.75%	14,733.16	29.65%	23.70%
合计	79,216.61	100.00%	39.11%	49,694.74	100.00%	37.83%

（三）期间费用分析

本公司期间费用包括销售费用、管理费用以及财务费用，报告期内各期间费用占营业收入比例的情况如下：

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
销售费用	2,056.47	22.34	3,729.95	21.83	3,330.79	4.25	1,625.04	3.73
管理费用	6,087.31	66.13	11,095.03	64.92	11,364.04	14.52	6,664.44	15.28
财务费用	1,061.20	11.53	2,264.02	13.25	1,251.23	1.60	824.67	1.89
合 计	9,204.98	100.00	17,089.00	100.00	15,946.06	20.37	9,114.15	20.90

1、销售费用

本公司的销售费用主要为运输费用和销售员工工资。报告期内，销售费用为 1,625.04 万元、3,330.79 万元、3,729.95 万元、2,056.47 万元，分别占营业收入的 3.73%、4.25%、3.86%、3.87%，所占比例相对稳定。报告期内销售费用明细见

下表:

单位: 万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
运输费及车辆费	692.88	1,389.60	1,269.35	710.91
工资、福利及社保	649.22	970.65	857.07	532.12
销售佣金及业务费	427.30	705.86	652.48	132.75
保险费	128.46	326.40	285.14	106.58
交通差旅费	38.07	96.12	96.30	31.24
折旧费	11.50	28.03	25.92	10.84
其他费用	109.04	213.28	144.53	100.60
合 计	2,056.47	3,729.95	3,330.79	1,625.04

2010 年公司销售费用较上年增长 1,705.75 万元, 增长幅度为 104.97%, 主要是由于其中的运输费用、工资、销售佣金及业务费、保险较上年有较大增长所致, 该四项费用较上年增长 1,581.68 万元。运输费用、工资分别较上年增长幅度为 78.55%、61.07%, 与销售量增长幅度 70.15%密切相关。销售佣金及业务费较上年增长幅度较大, 增长金额为 519.73 万元, 主要是由于随着 2010 年公司产能大幅度提升, 公司为了进一步拓宽销售渠道, 积极获取外国市场最新的技术资讯和市场信息服务, 以持续保持公司的行业领先地位, 公司与 Alegria Associates Inc.、NCAB International Trading Pte.Ltd 等公司签订了佣金代理协议。保险费用较上年增加 178.56 万元, 主要系随着公司销售收入的不断增长, 公司的应收账款余额增长较大, 回收风险相应增加, 为减少应收账款的回收风险, 公司在 2010 年提高了应收账款的出口保险额度, 从而导致保险费用增加。

2011 年公司销售费用较上年增加 399.16 万元, 增长幅度为 11.98%, 主要为运输费用、销售佣金及业务费、保险费等与销售收入直接相关的项目发生额增加所致。2011 年公司销售收入较上年增长 23.41%, 带动了上述费用较上年同向上升。

同行业上市公司销售费用占其营业收入的比重如下:

指标名称		兴森科技	天津普林	沪电股份	超声电子	超华科技	中京电子	平均值	崇达技术
销售费用占比	2011 年	7.56%	1.66%	4.13%	2.64%	2.43%	1.34%	3.29%	3.86%
	2010 年	6.73%	2.19%	4.11%	2.74%	2.49%	1.64%	3.32%	4.25%
	2009 年	6.96%	1.75%	4.03%	2.93%	2.27%	1.89%	3.31%	3.73%

从上表可以看出，本公司销售费用占营业收入的比重与同行业公司平均值基本接近，保持在合理水平。

2、管理费用

报告期内，本公司管理费用分别为 6,664.44 万元、11,364.04 万元、11,095.03 万元、6,087.31 万元，分别占营业收入的 15.28%、14.52%、11.48%、11.45%，具体明细见下表：

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
研发费	2,494.31	4,088.36	3,949.29	2,689.63
工资、福利及社保	1,516.44	3,668.38	2,824.61	1,651.11
维修费	330.28	886.67	726.33	313.07
折旧费	135.19	258.53	203.58	123.25
租赁费	234.87	359.16	195.46	822.06
办公费	60.89	70.97	123.02	70.93
水电费	65.49	124.37	70.91	75.74
招待费	76.53	162.68	58.05	29.61
差旅费	20.14	65.33	36.78	25.43
中介服务费	91.90	124.31	282.55	168.94
无形资产摊销	209.79	281.30	36.07	5.87
股份支付	-	-	2,185.52	-
其他	851.49	1,004.98	671.87	688.80
合计	6,087.31	11,095.03	11,364.04	6,664.44

公司管理费用主要由研发费用、工资及福利、日常管理费用组成。

① 研发费用变动分析

研发费用占管理费用比重较大，报告期内，公司研发支出分别为 2,689.63 万元、3,949.29 万元、4,088.36 万元、2,494.31 万元，分别占当期管理费用的 40.36%、43.03%、36.85%、40.98%。为保持技术领先优势与不断创新能力，公司始终将研发与技术创新作为公司发展的基础。

本公司与同行业上市公司研发费用占营业收入的比重如下：

指标名称		兴森科技	天津普林	沪电股份	超声电子	超华科技	中京电子	平均值	崇达技术
研发支	2011 年	8.01%	5.94%	4.12%	3.71%	3.72%	0.37%	4.31%	4.23%

出占比	2010 年	3.61%	8.00%	3.35%	5.41%	4.09%	3.72%	4.70%	5.04%
	2009 年	3.10%	8.27%	3.37%	6.27%	4.19%	3.62%	4.80%	6.17%

② 工资、福利及社保变动分析

管理费用中的工资薪金呈逐年增长趋势。首先是由于国内人工薪酬逐年增长，其次是由于报告期内随着公司生产规模的扩大而导致员工人数的持续增加所致。

③ 租赁费用变动分析

最近三年一期，公司管理费用中“租赁费”分别为 822.06 万元、195.46 万元、359.16 万元、234.87 万元。

2011 年较 2010 年增加租赁费 163.70 万元，主要系深圳崇达新增租赁位于沙井横岗下工业区的 2 层厂房所致。

2010 年较 2009 年大幅下降 626.60 万元，主要原因系 2009 年深圳崇达向深圳市宝恒源实业有限公司租赁位于宝安区沙井街道新桥横岗下工业区的厂区尚处于筹建期，主要开展的工作包括租赁厂房的装修、设备搬迁及购置、生产线调试等。深圳崇达将该期间该租赁厂房产生的租赁费计入“管理费用”；2010 年初，深圳崇达正式投产，根据厂房的具体用途，将相关租赁费计入“管理费用”、“制造费用”科目中。根据深圳崇达宝安分公司与深圳市宝恒源实业有限公司租赁签订的租赁合同，最近三年一期应支付给深圳市宝恒源实业有限公司的租金情况如下：

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
租赁金额	413.05	661.47	606.60	606.60
其中：计入管理费用	202.79	240.95	157.57	606.60
计入制造费用	210.26	420.52	449.03	—

另外，由于深圳崇达 2010 年全部搬迁至宝安区沙井街道新桥横岗下工业区，不再租赁位于南山区南山大道 1040 号的厂房，导致计入管理费用中“租赁费”较 2009 年降低约 100 万元。

④ 与同行业上市公司比较

同行业上市公司，管理费用占营业收入的比重如下：

指标名称		兴森科技	天津普林	沪电股份	超声电子	超华科技	中京电子	平均值	崇达技术
管理费用占比	2011年	14.94%	6.48%	6.15%	7.17%	4.08%	8.45%	7.88%	14.94%
	2010年	10.63%	5.77%	5.84%	7.32%	3.92%	6.93%	6.74%	14.52%
	2009年	8.02%	6.32%	4.59%	7.92%	3.68%	8.21%	6.46%	15.28%

与同行业上市公司相比，本公司的管理费用占营业收入的比重偏高，主要是由于公司的研发费用较高，从而导致管理费用金额较大。由于不断加大研发力度，公司目前取得专利数量在同行业处于领先地位。

3、财务费用

报告期内的财务费用如下表所示：

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
利息支出	1,180.56	1,736.99	702.61	562.98
减：利息收入	53.64	184.35	27.08	49.12
汇兑损失	-115.91	676.00	525.49	124.98
手续费及其他	50.19	35.38	50.21	185.83
合 计	1,061.20	2,264.02	1,251.23	824.67

报告期内，公司利息支出呈现较大幅度增长，主要是由于业务规模的不断扩大及江门崇达建设导致公司所需周转资金增加，因此公司的银行借款规模逐年增加，此外由于加息因素影响导致公司利息支出逐年增加。

本公司汇兑损失金额较大，主要系美元对人民币汇率波动所致，本公司70%以上产品外销，且主要以美元结算，从而导致汇兑损失较大。2012年1-6月，由于人民币贬值，导致公司汇兑收益增加。

（四）资产减值损失

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
坏账损失	379.55	200.76	392.72	-301.06
存货跌价损失	-	-	-	-
合 计	379.55	200.76	392.72	-301.06

（五）营业外收入

报告期内本公司营业外收入来源主要为补贴收入。具体明细如下：

单位：万元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
1、政府补助收入	172.83	358.52	198.35	215.75
2、固定资产处置利得	17.59	15.68	7.10	5.15
3、其他	43.09	83.50	38.94	9.71
合 计	233.51	457.70	244.39	230.61

报告期内，本公司确认的政府补助收入分别为 215.75 万元、198.35 万元、358.52 万元、172.83 万元。政府补助收入的主要内容列示如下：

单位：万元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
1、财政贷款贴息、贴保补贴、出口信用保险补助	25.33	95.50	76.16	27.80
2、科研资助、信息化建设发展资金、申请专利资助资金	2.04	77.96	46.26	20.00
3、高新技术企业补助	-	20.00	21.41	16.88
4、创新型企业成长资金补助	-	-	20.00	-
5、环保设备补贴	30.20	22.40	18.40	13.80
6、经济发展专项资金补助	-	78.00	16.12	120.00
7、其他	115.26	64.66	-	17.27
合计	172.83	358.52	198.35	215.75

（六）营业外支出

报告期内本公司营业外支出主要为固定资产处置损失以及捐赠支出。具体明细如下：

单位：万元

类别	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
1、固定资产处置损失	15.90	46.43	306.41	14.33
2、捐赠	20.50	4.27	0.18	-
3、其他	4.23	3.97	28.57	1.30
合 计	40.63	54.67	335.16	15.63

2010 年固定资产处置损失较大，主要系由于 2010 年深圳崇达搬迁完毕，对原南山工厂的部分设备及资产进行处置或报废处理。

三、现金流量分析

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
1、经营活动产生的现金流量净额	10,168.66	17,868.43	14,286.07	11,255.30

2、投资活动产生的现金流量净额	-7,593.54	-27,606.89	-22,282.05	-6,005.86
3、筹资活动产生的现金流量净额	-3,658.39	9,514.51	10,879.23	-2,274.74
4、现金及现金等价物净增加额	-1,016.14	-396.99	2,657.94	2,915.98

（一）经营活动现金流量分析

1、公司的主营业务获取现金的能力较强

本公司“销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比重详见下表：

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
销售商品、提供劳务收到的现金①	47,699.04	91,129.56	77,039.94	44,270.90
营业收入②	53,151.53	96,609.66	78,286.30	43,604.82
①/②（%）	89.74	94.33	98.41	101.53

从上表可以看出，本公司2009年、2010年、2011年、2012年1-6月的“销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比重分别为101.53%、98.41%、94.33%、89.74%，占营业收入比重平均值为95.76%，说明本公司业务获得现金的能力较强。

2、经营活动现金流量净额稳步增长

报告期内，本公司经营活动产生的现金流净额变化如下：

单位：万元

项 目	2012年 1-6月	2011年		2010年		2009年
	金额	金额	较上年 增长率	金额	较上年 增长率	金额
销售商品、提供劳务收到的现金	47,699.04	91,129.56	18.29%	77,039.94	74.02%	44,270.90
收到的税费返还	2,660.59	6,741.71	135.55%	2,862.06	258.65%	798.01
收到其他与经营活动有关的现金	412.54	1,300.91	54.66%	841.13	48.71%	565.61
经营活动现金流入小计	50,772.17	99,172.17	22.82%	80,743.13	76.93%	45,634.52
购买商品、接受劳务支付的现金	25,987.82	50,298.03	13.37%	44,365.01	94.29%	22,833.89
支付给职工以及为职工支付的现金	9,853.30	17,097.91	49.48%	11,438.53	76.46%	6,482.26
支付的各项税费	1,791.51	5,538.94	39.51%	3,970.23	146.86%	1,608.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,970.88	8,368.87	25.22%	6,683.28	93.45%	3,454.75
经营活动现金流出小计	40,603.51	81,303.74	22.34%	66,457.06	93.31%	34,379.22
经营活动产生的现金流量净额①	10,168.66	17,868.43	25.08%	14,286.07	26.93%	11,255.30
净利润②	6,589.21	13,153.29	27.22%	10,339.09	134.52%	5,340.55
占净利润的比重 ①/②	154.32%	135.85%		138.18%		210.75%

报告期内本公司经营活动现金流量净额稳步增长,其中 2010 年较 2009 年增长 26.93%, 2011 年较 2010 年增长 25.08%, 主要系公司销售规模扩大, 销售商品收到的现金增长超过购买商品支付的现金所致。

3、经营活动现金流量净额与净利润差异的原因

报告期内, 公司经营活动现金流量净额与净利润的比重分别为 210.75%、138.18%、135.85%、154.32%, 具体差异情况如下所示:

单位: 万元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
净利润	6,589.21	13,153.29	10,339.09	5,340.55
加: 资产减值准备	379.55	200.76	392.72	-301.06
固定资产折旧	2,388.65	3,689.47	2,692.84	2,207.42
无形资产摊销	209.79	281.30	36.07	5.87
长期待摊费用摊销	752.25	1,258.20	968.28	518.72
处置固定资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-1.68	30.75	299.31	9.18
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-	-	-	-
财务费用(收益以“—”号填列)	1,180.56	1,736.99	702.61	562.98
投资损失(收益以“—”号填列)		-	-	-
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-201.33	-23.39	-13.55	-18.08
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-	-	-	-
存货的减少(增加以“—”号填列)	-3,076.27	242.46	-3,534.87	-1,306.24
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-3,465.34	-3,411.36	-4,496.39	206.70
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,413.27	709.95	4,714.43	4,029.26
其他(股份支付调整净利润金额)		-	2,185.52	-
经营活动产生的现金流量净额	10,168.66	17,868.43	14,286.07	11,255.30

(二) 投资活动现金流量分析

报告期内, 本公司投资活动所产生的现金流量净额分别为-6,005.86 万元、-22,282.05 万元、-27,606.89 万元、-7,593.54 万元, 具体情况如下所示:

单位: 万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
处置固定资产收回的现金净额	6.00	15.00	56.31	-
现金流入小计	6.00	15.00	56.31	-
购建固定资产、无形资产所支付的现金	7,599.54	27,621.89	17,293.07	5,834.40
投资所支付的现金	-	-	5,045.29	171.46

支付的其他与投资活动相关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	7,599.54	27,621.89	22,338.36	6,005.86
投资活动产生的现金流量净额	-7,593.54	-27,606.89	-22,282.05	-6,005.86

投资活动现金流量净额连续三年净流出，主要是由于公司目前处于高速增长期，为扩大产能和经营规模，支付新增设备购置款及厂房装修费、环境治理工程费、土地购置款及在建工程款等资本性支出所致。

2010 年投资所支付的现金主要系集锦线路板收购香港汇锦持有的深圳崇达 40%的股权，支付股权收购款 5,045.29 万元。

（三）筹资活动现金流量分析

报告期内，本公司筹资活动所产生的现金流量净额分别为-2,274.74 万元、10,879.23 万元、9,514.51 万元、-3,658.39 万元。

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2009 年
吸收投资所收到的现金	-	-	7,590.00	-
借款所收到的现金	11,388.50	40,067.00	15,245.00	17,088.27
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	11,388.50	40,067.00	22,835.00	17,088.27
偿还债务所支付的现金	9,700.00	25,000.00	8,530.48	15,098.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,279.89	5,449.49	3,425.29	4,169.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	67.00	103.00	-	95.37
现金流出小计	15,046.89	30,552.49	11,955.77	19,363.01
筹资活动产生的现金流量净额	-3,658.39	9,514.51	10,879.23	-2,274.74

2009 年筹资活动产生的现金流量为净流出，主要系分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,169.28 万元。其中，支付股利 3,671.35 万元，系深圳崇达分配以前年度股利，该款项已于 2009 年支付完毕。

2010 年本公司筹资活动产生的现金流量金额为净流入，主要是由于本年收到股东投资款 7,590 万元及银行借款净流入 6,714.52 万元所致。2010 年 5 月姜曙光等 17 名股东向公司增资，投资金额合计 2,390 万元；2010 年 6 月，汇投投资、同威创业、超淦贸易 3 名股东向公司增资，公司收到股东缴纳投资款 5,200 万元。2010 年 6 月 23 日，集锦线路板股东会决议通过公司 2009 年度分红的议案，向截至 2010 年 6 月 23 日公司登记在册的全体股东分配现金股利 2,700 万元。截至

2010年12月28日，上述利润分配实施完毕。此外，公司由于短期借款金额较大导致利息支出较大，2010年支付借款利息筹资费用计702.61万元。

2011年本公司筹资活动产生的现金流量金额为净流入，主要是由于本年银行借款净流入15,067.00万元所致。2011年2月12日，公司召开年度股东大会审议通过《关于公司2010年度利润分配和首次公开发行前滚存利润分配的议案》，经鹏城会计师事务所审计，截至2010年12月31日，本公司累计滚存未分配利润为4,247.56万元，以2010年12月31日股本11,250万股为基数，向发行前的老股东每股派发现金0.33元（含税），合计派发现金股利3,712.50万元。截至2011年6月30日，上述利润分配实施完毕。此外，公司由于短期借款金额较大导致利息支出较大，2011年支付借款利息筹资费用计1,736.99万元。

2012年1-6月本公司筹资活动产生的现金流量金额为净流出，主要是由于银行借款净流入1,688.50万元，以及公司发放股利4,050万元所致。

四、资本支出情况分析

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，为抓住市场机遇，本公司购置了机器设备、土地使用权以及在江门崇达进行生产基地建设，以扩大公司产能。主要包括：

原值	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
机器设备（万元）	2,122.17	14,940.53	9,058.27	2,288.03
土地使用权（万元）	-	-	4,569.35	-
江门生产基地建设（万元）	1,784.67	8,304.89	115.07	-
合计（万元）	3,906.84	23,245.42	13,742.69	2,288.03

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量

在未来的2-3年，本公司可预见的重大资本支出主要是用于本次发行募集资金投资项目江门崇达小批量PCB生产基地建设，具体投资计划详见“第十二章 募集资金运用”。

五、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）公司主要的财务优势

1、毛利率较高，盈利能力不断增强

本公司为专业的小批量 PCB 生产企业，市场定位明确，竞争优势明显。报告期内，公司产品结构不断优化，对高端产品研发能力增强，主营业务收入和利润总额快速增长，毛利率逐年升高。

2、存货周转能力较强，资产使用效率较高

本公司生产小批量 PCB，品种多、均单面积小、交期短。公司的生产模式是根据订单以销定产，产品从生产到交货的时间较短，存货周转率高于同行业上市公司的平均水平，不存在产品滞销的情形，存货周转能力较强，资产使用效率较高。

3、经营活动现金流入持续增长，盈利质量较高

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为 11,255.30 万元、14,286.07 万元、17,868.43 万元、10,168.66 万元，同期公司实现归属于母公司股东的净利润分别为 4,095.07 万元、9,611.63 万元、13,153.29 万元、6,589.21 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为归属于母公司股东的净利润的 2.74 倍、1.49 倍、1.36 倍、1.54 倍，公司实现的净利润有较强的现金流支持，盈利质量较高。

（二）公司主要的财务困难

由于公司现有产能已经趋于饱和，投资扩产所需的资金量较大，在公司股票尚未发行上市前，融资渠道有限，只能依靠银行借款融资。融资渠道的单一将限制公司的快速发展，降低公司抵御市场风险的能力。

（三）财务状况未来趋势

报告期内，本公司的资产、负债规模增长迅速，但结构基本稳定，长短期偿债能力均较强。本次公开发行后，本公司资产负债率将大幅下降，流动资产比例将大幅上升，长短期偿债能力将进一步提高。随着募集资金的逐步投入，本公司的资产规模将扩大，尤其是固定资产的数量和质量都将显著提升，公司将拥有具

备竞争优势的小批量PCB生产制造平台，大大提升公司产能。资产规模、营业收入与利润将有较大幅度增长，有利于支持公司市场规模的扩张和市场竞争力的增强，从而使得本公司处于良性的可持续成长状态，财务状况将更为良好。

（四）未来影响发行人盈利能力的因素及其未来趋势

1、小批量 PCB 需求旺盛，有利于进一步提高公司盈利能力

公司生产的小批量PCB广泛用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、国防及航天航空等领域。下游需求行业在国内多数处于成长期，发展态势良好。例如我国医疗仪器近几年平均递增15%以上，预计未来三年的复合年均增长率超过25%。又如安防电子，根据IDC预测，我国安防视频市场在2012年前，能够保持20%以上的复合年均增长率。受益于下游产业的快速发展，公司主营业务增长趋势将长期持续，发展前景广阔，有利于公司进一步提高盈利能力。

2、募集资金投资项目的投产将为公司业绩成长提供支撑

随着公司本次募集资金投资项目的建成并逐步达产，公司将新增小批量PCB产能40万平方米，产能瓶颈问题得到有效解决，公司主营业务收入将大幅提升，此外，随着高端产品收入比重的提升，公司的盈利能力及抗风险能力将得到增强。

综上所述，本公司行业及产品优势明显，财务状况良好，盈利能力较强。募集资金投资项目投产后，本公司将进一步增强现有优势，提高盈利能力和竞争能力。

六、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至2012年6月30日，本公司未结清保函余额为90万美元。

（二）资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（三）其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

七、未来股利分配的具体计划

（一）公司最近三年一期分红派息情况

最近三年一期，公司具体的现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年 1-6 月
归属于母公司股东的净利润	4,095.07	9,611.63	13,153.29	6,589.21
累计未分配利润	13,081.26	12,541.94	21,413.67	23,952.88
对当年利润的分配金额	2,700.00	3,712.50	4,050.00	-
现金分配占当年净利润的比例	65.93%	38.63%	30.79%	-
现金分配占累计未分配利润的比例	20.64%	29.60%	18.91%	-

（二）公司未来分红回报规划

在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会制定了未来分红回报规划，公司未来的股东分红回报规划的主要内容如下：

1、股东回报规划制定考虑因素：在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、未来盈利规模、现金流量状况等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性。

2、股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式向股东分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

3、股东回报规划制定周期：公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报

规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。

4、2011-2013年度股东分红回报计划：2011-2013年，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

5、股东分红回报计划的变更：公司的股东分红回报计划不得随意变更。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会认为需要调整利润分配政策时，可以提交利润分配政策调整预案供公司股东大会审议，公司通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。

公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，重新制定的分红规划，其分红比例不低于《公司章程》规定的分红比例。

（三）公司本次制定的最低现金分红比例低于前三年平均比例的原因

1、公司本次制定的最低现金分红比例为20%，低于2009年-2011年度实际平均现金股利分配比例，主要原因如下：

2009年度，公司现金分红占当年实现的归属于母公司股东的净利润的比例高达65.93%，占累计未分配利润的比例为20.64%。公司现金分红的比例比较高，主要原因为公司在2010年以净资产折股，整体变更为股份有限公司，为了保证股东及时、足额缴税，公司进行了较高比例的现金分红。2010年，因净资产折股导致股东缴税金额为2,279.06万元，公司股东均已足额缴纳。

2010年度，公司现金分红占当年实现的归属于母公司股东的净利润的比例为38.63%，扣除股份支付的影响，现金分红占当年实现的归属于母公司股东的净利润的比例为31.47%。2010年分红比例较高，主要原因为：一方面，公司在进行利润分配时，未考虑股份支付对利润的影响，按照股份支付处理前归属于母公司股

东的净利润为基准实施了分配；另一方面，2010年，公司引入了新的投资者，公司治理结构逐渐规范，加之2010年度宏观经济环境向好，PCB行业市场需求旺盛，本公司销售收入和利润规模大幅度增长，现金流充足，公司增加了对投资者的回报。

2011年度，公司现金分红占当年实现的归属于母公司股东的净利润的比例为30.79%，分红比例较高，主要原因为本公司经营发展情况良好，销售收入和利润规模继续增长，公司根据章程规定对投资者进行分红回报。

公司以前年度的现金分红并不持续，且2009年较高的现金分红具有特定原因。而本公司本次制定的利润分配方案考虑了未来每年均进行现金股利分配，具有稳定、持续的特点，因此制定的现金分红的最低比例低于2009-2011年的平均分配比例。

2、本公司未来的利润分配以“进一步增强公司持续盈利能力、保证公司的可持续性发展，以期未来给予股东持续稳定的分红回报”为基本原则，本公司将在保证最低分红比例的前提下，在考虑到盈利能力、现金流量情况的基础上，规划留存部分可供分配利润，用于加速公司的发展，并根据公司实际运营情况，在资金条件允许的情况下适当提高现金分红比例，力争给投资者更多回报。

（四）股东分红回报规划考虑的因素及可行性分析

1、公司经营发展需要

本公司目前处于快速发展和扩张的阶段，从近年来公司市场开拓的情况来看，公司在行业内的市场竞争力日益增强，尤其是最近三年，公司的订单数量、订单面积和销售收入均实现了快速增长，客户数量逐年增多，与国际知名客户的合作机会越来越多，为了保证先进的制造工艺，提高研发能力，保持持续创新，满足客户对产品的需求和短交期的需要，公司每年用于固定资产投资和研发的支出较高，资金需求量较大，其中2009—2012年6月，公司购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金分别为5,834.40万元、17,293.07万元、27,621.89万元、7,599.54万元。同时，随着本公司经营规模的扩大，存货和应收账款的规模也会相应增长，对营运资金的需求较大。基于公司生产经营的需要，为保证公司的持续发展，未来三年，本公司将在足额提取10%法定公积金后，保证每年向股

东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的20%，同时，留存70%的未分配利润主要用于固定资产投资和研发支出，以及满足日常运营资金的需要。

2、外部融资环境及资本成本

目前公司融资渠道主要为信贷融资及本次发行新股融资，公司在银行的资信状况良好，有较高的资信额度，可利用的融资渠道较为畅通，但由于目前债务融资的成本较高，而且未来仅通过银行借款来满足日益扩大的资金需求，不利于公司稳健经营和未来发展，也会影响公司经营安全性和盈利能力，故自身经营积累对公司而言显得尤为重要。公司在确定股利分配政策时，需要全面考虑各种融资渠道的获取资金金额及融资成本高低，资产负债率等情况，使股利政策与公司合理的资本结构、资本成本相适应。

3、公司的盈利规模和现金流量情况

经过多年的发展，本公司在小批量PCB制造领域已经具备了较强的竞争实力和优良的品牌形象；公司资产、负债结构相对稳定，资产质量优良，主营业务突出，营业收入稳步增长，盈利能力不断提高。2009年—2012年1—6月，公司实现的归属于母公司股东净利润分别为4,095.07万元、9,611.63万元、13,153.29万元、46,851.05万元；公司现金流量状况良好，近三年一期公司经营活动产生的现金流量净额分别为11,255.30 万元、14,286.07万元、17,868.43万元、10,168.66万元，能够有效保证公司生产经营的正常开展；同时公司应收账款回收情况良好，为维持公司正常的运营及资本性支出提供了很好的资金基础。在公司完成本次发行上市及本次募集资金投资项目达产后，公司的生产规模将进一步提高，目前产能紧张的局面将得到缓解，公司产品的市场占有率将进一步上升。公司良好的盈利能力和发展前景是保证本分红回报规划实现的坚实基础，公司制定的分红回报规划具有较高的可行性和持续、稳定性。

4、股东意愿与要求

公司未来的股利分配方案将充分考虑各股东的意愿与要求，既要重视对各股东的合理投资回报，也要兼顾投资者对公司持续发展的期望。股利分配具体方案（包括现金分红比例、是否进行股票股利分配等）将在股利分配政策的基础上由股东大会根据公司当年经营的具体情况 & 未来正常经营发展的需要确定并审议

通过。

综上，公司管理层认为，公司未来分红回报规划确定的“每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十”现金分红政策，综合考虑了公司经营发展需要、财务状况、所处发展阶段、外部融资环境等多重因素，是稳健的、可行的。公司的未来分红回报规划有利于增强股利分配决策的持续性、透明度和可操作性，既注重股东分红回报，又利于公司可持续性发展。

第十一章 业务发展目标

一、发行人当年和未来两年发展规划及发展目标

（一）公司未来发展战略

本公司专注于小批量 PCB 的制造，秉承“为世界电子信息产业提供高品质的线路板和及时、满意的服务”的使命，以“诚信、互助、进步、分享，以客户为中心、以市场为导向”的核心价值观为指导，立志成为全球领先的 PCB 制造企业，为客户、员工、社会、股东创造最大价值。

公司将持续强化“多品种、小批量、短交期”的经营策略和高度柔性化管理方式，紧跟国际先进技术的发展，不断加强对具有高技术含量的高端线路板的研发，依托公司不断积累的庞大工程技术数据库，满足客户的多品种需求。

（二）公司未来两年发展目标

本公司在未来两年，计划达成以下目标：

1、市场目标

- （1）2012～2013 年，力争销售额每年保持 30%以上的增长幅度；
- （2）客户区域市场均衡发展，加大国内市场销售比重；
- （3）成为全球小批量 PCB 细分市场的领军企业。

2、管理目标

（1）持续优化与完善公司的业务流程，进一步加强快速反应能力，满足客户“多样化、个性化”的订单需要。

（2）建立不同层次的人员培训体系，强化工作绩效管理、充分挖掘员工潜能，培养一批敬业、专业的中层管理人员。

3、技术目标

立足于小批量 PCB 制造，坚持以市场为导向，不断开发生产适销对路的产品。围绕小批量板的主要应用领域通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、航天航空等高科技领域，依托公司的研发团队和技术优势，研究开发高端技术产品，满足客户多样化需求。

二、公司未来的发展计划

为了顺利实施公司的发展战略，达成经营目标，本公司制定了如下发展计划：

（一）积极实施募集资金投资项目，解决公司产能瓶颈

随着公司对国际、国内市场的不断开拓，以及小批量 PCB 下游行业大客户的不断涌现，公司产品的订单需求快速增长。本公司拟通过实施本次募集资金投资项目，扩大小批量多层 PCB 和 HDI 的生产能力合计 40 万平方米/年，同时，产能的扩张也有利于公司进一步缩短交货期限，提升公司的竞争力。

（二）优化人力资源管理体系，建设优秀团队

随着公司业务规模的迅速扩展，对各个层次人才的要求也不断提高。本公司将以优化人力资源管理体系、建设优秀团队为目标，在未来两年内加强对各层次员工的培训，建设优秀团队，提高员工的整体素质。具体包括：建立中高层、基层、专业技术人才培养体系，培养 100 名中高层管理人员、200 名基层班组长管理人员、300 名专业技术人才，以适应公司快速发展的需要。

（三）持续加大研发投入，提升技术水平，奠定规模扩张的技术基础

本公司坚持将研究、开发、创新作为企业发展的重要动力。未来几年内，公司将继续以市场和客户需求为导向，增加研发投入，采用健全的绩效激励机制和有效的沟通机制，引导全体员工进行技术创新。公司将紧随全球 PCB 行业的发展趋势，加强高端 PCB 领域的技术研发，包括柔性线路板、IC 载板等，进一步提升高端产品的比重。

（四）进一步完善销售体系，树立品牌效应

随着募集资金投资项目的开展，本公司将进一步加大销售队伍、销售体系的建设力度，包括打造全方位的销售网络，在重点城市增加销售服务机构，加强区域管理，完善销售体系，树立品牌效应。公司将加强与现有客户的合作深度，通过满足现有客户全方位的需求，提升现有客户的销售规模。同时，根据国内外PCB需求的不同特点设计相应的发展规划。在国内市场上，公司充分发挥品质、技术和效率优势，增强国内客户开发力度，提高国内市场知名度和市场占有率；在国外市场上，公司将继续稳定与海外客户的业务关系，进一步发挥贸易商资源优势 and 成本优势，巩固和发展与全球知名电子设备制造企业的业务合作关系，成为其全球供应链重要的一环。

（五）严格流程控制，进一步提高运作效率

作为小批量 PCB 生产企业，公司对客户的反应速度和交货期是衡量竞争力的重要标志。公司以“2 小时报价响应、4 小时组织生产”为目标，以满足客户短交期需求。未来几年内，本公司将继续强化各流程管理控制，依托强大的 ERP 系统，建立高度柔性化的生产线，进一步提高运作效率。

（六）收购兼并计划

公司将充分利用自身竞争优势，以控制风险、优势互补、提高效益为原则，在适当时机收购兼并 PCB 行业的相关优势企业，提升细分市场的占有率和竞争力。

三、本次募集资金运用对实现发行人发展规划和目标的作用

公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，募集资金用于扩大公司现有主导产品的生产规模，满足客户对产品短交期的需求，保持公司在小批量 PCB 行业的竞争优势。

通过新生产线的规模化建设和技术工艺改进，公司将提升现有产品的质量和性能水平；生产线建设后，可以更好地完善公司的生产工艺，提高公司接单能力和快速响应客户的交货能力。随着生产规模的扩大，规模优势得以显现，有利于提高公司盈利能力。

四、拟订上述计划所依据的假设条件

- 1、国家宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态；
- 2、国家现行的产业政策无重大改变；
- 3、公司提供的产品所处市场无重大变化；
- 4、公司所在地区的社会经济环境无重大改变；
- 5、公司管理的内外部环境保持稳定和连续；
- 6、公司本次发行能够顺利完成，并按招股说明书的计划时间募集到预期的资金；
- 7、公司计划的投资项目能如期完成并投产；
- 8、无其他不可抗力造成的重大不利影响。

五、实施上述计划所面临的主要困难

（一）资金压力

由于市场需求强劲，目前本公司处于业务高速发展的阶段，公司实施上述计划需要雄厚的资金支持。在当前现实的情况下，单凭自身的积累，本公司无法实施上述扩大产能、扩大市场份额的目标。因此，募集资金到位前，资金缺乏将严重制约公司发展。

（二）人才压力

公司属于高新技术企业，人才是公司成功的关键要素之一。随着生产规模的扩大，公司需要不断补充高级管理人才和技术人才，目前，虽然公司自主培养以及从社会招聘了一些研发、生产、销售、管理专业人才，但随着公司规模扩大，仍然面临人才不足的压力，可能会影响上述计划的实施。

六、业务发展规划与现有业务的关系

本公司的业务发展规划植根于公司现有业务，现有业务将在公司业务发展规划的实现过程中做大做强。

第十二章 募集资金运用

一、募集资金运用概况

公司本次拟向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,750 万股，占发行后总股本的 25%。本次募集资金投向经本公司股东大会审议确定，拟用于以下项目：

项 目	总投资额 (万元)	分期投资额（万元）			募集资金投入 金额 (万元)
		第一年	第二年	第三年	
小批量 PCB 生产基地建设项目	47,415	21,618	18,934	6,863	47,415

上述小批量 PCB 生产基地建设项目已取得广东省发展和改革委员会的备案文件（100700406229009 号），并已取得广东省环境保护厅粤环审【2011】149 号《关于江门崇达电路技术有限公司 PCB 生产基地建设项目环境影响报告书的批复》。

本次募集资金投资项目实施主体为本公司全资子公司江门崇达。本次募集资金到位后，将通过向江门崇达增资的方式投入，江门崇达根据本公司制定的募集资金投资计划具体实施。

如首次公开发行实际募集资金超出以上预计投资金额，本公司将按照目前的资金状况和有关的管理制度，将多余资金用于补充流动资金。首次募集资金若不能满足拟投资项目的资金需求，本公司将通过自有资金及银行贷款等方式解决。

江门崇达的具体情况详见本招股说明书“第四章 发行人基本情况”之“六、发行人控股及参股公司、分公司情况”之“（二）发行人的子公司”。

二、募集资金投资项目与公司现有业务及发展战略之间的关系

公司自成立以来就一直专注于小批量 PCB 的生产和销售，经过 17 年的经验积累，公司已经成为国内小批量 PCB 行业的领先企业。未来公司发展战略是进

一步扩大生产能力、提升研发能力、丰富产品结构、完善销售服务体系，进一步做大做强。

本次利用募集资金投入江门小批量 PCB 生产基地建设项目，是在公司现有主营业务的基础上，按照公司未来发展战略的要求，对公司现有业务的进一步深化与拓展。公司多年来积累的管理经验、技术条件、人员储备和客户资源等是该项目实施的重要基础。募投项目达产后，规模化生产将大大降低公司的生产成本，提高公司的整体盈利能力，同时，通过产品结构的优化，使公司产品整体技术含量得到提升，将有助于提升公司核心竞争力和进一步巩固公司在行业内的领先地位。

三、本次募集资金投资项目情况

（一）项目简介

本项目实施主体为本公司的全资子公司江门崇达。本项目建设地点在广东省江门市高新技术产业开发区。

本项目将充分利用本公司已有的在小批量 PCB 生产与销售领域积累的经验和技术，进一步扩大生产规模，优化产品结构，提升公司在行业中的竞争优势和地位。募投项目将生产小批量多层 PCB 和小批量 HDI 产品，设计规模为年产 36 万平方米小批量多层 PCB 和 4 万平方米小批量 HDI 产品。

（二）项目实施的必要性

1、现有产能不足，公司迫切需要扩大产能来适应行业发展和满足市场需求

在小批量 PCB 下游市场不断发展，欧美小批量 PCB 制造逐渐向中国进行产业转移的背景下，公司以在小批量 PCB 领域的专业与专注，赢得了小批量 PCB 下游行业客户的信任与青睐，优质客户不断涌现。即使在受经济危机影响最严重的 2009 年，公司的客户数量仍然出现了较大增长。2010 年随着经济形势和 PCB 行业的整体回暖，公司加大了对国际国内市场开拓的力度，订单和客户数量均实现了较大幅度增长。

公司最近三年一期客户和订单数量

项目	2012 年 1—6 月	2011 年	2010 年	2009 年
客户数量（个）	452	442	360	304
订单数（个）	45,099	70,127	60,477	37,966

从公司的产能状况看，现有产能难以满足市场与客户迅速增长的需求。早在 2008 年，公司生产线中的某些重要环节如压合、钻孔、电镀等工艺即已接近产能瓶颈，但因受全球经济危机的影响，公司放弃了在 2009 年进行大规模产能扩张的计划。2010 年，公司子公司深圳崇达完成了生产基地由深圳南山向宝安的搬迁，并购置了压合、钻孔、电镀等瓶颈工艺的机器设备，提高了产能，但受制于厂房面积的约束，公司产能仍然受到很大限制。

公司最近三年一期产能、产量与产能利用率

项目	2012 年 1—6 月	2011 年	2010 年	2009 年
产能（平方米）	372,000	660,000	612,000	374,220
产量（平方米）	330,286	576,905	513,259	300,724
产能利用率	88.79%	87.41%	83.12%	80.36%

由于产能受到限制，公司部分订单的部分生产工序采用外协加工的方式进行生产，以缓解产能不足的压力，但外协加工的方式给生产调度环节带来了较大的压力，直接影响了公司的快速供货能力。

对于从事小批量 PCB 生产和销售的企业而言，越短的交货期就意味着越强的竞争力。由于公司目前客户以国际知名的 PCB 相关企业为主，它们对产品的质量和交货周期要求都非常高，在保障产品质量的前提下，稳定而快速的交货和服务能力已是小批量 PCB 生产企业竞争力的重要体现。

公司目前所有的生产厂房均为租赁取得，受制于场地面积的限制，公司在扩大产能、满足客户的交货期、提高服务水平方面也受到了限制，公司需要建设自有厂房，大规模提升公司的产能，稳定公司现有优质高端客户群的同时继续开发国内外客户。

2、优化产品结构、提高高端市场的占有率

国内小批量 PCB 生产企业中，大多数企业工艺技术水平不高，能形成规模化、稳定、可靠生产高端产品的企业较少，高端产品产能增长有限，但随着下游行业的快速发展，高端小批量 PCB 的市场需求越来越旺盛。公司是行业内少数

具有技术领先优势的企业，已具备规模化、稳定、可靠地生产高端产品的能力。但由于受到场地及产能的限制，公司目前在高端产品领域包括小批量多层 PCB 和小批量 HDI 的产能配备和客户扩展不足，公司需要进一步优化产品结构，提高高端产品的占比。

公司计划在现有小批量 PCB 主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，充分考虑国内外同类产品的发展方向，增加小批量高层 PCB 和小批量 HDI 产品的产能，进一步优化产品结构，提高公司的盈利能力。

本项目的实施，有利于公司合理配置产能，优化产品结构，增强公司的核心竞争力，为公司的未来发展奠定良好的基础。

3、进一步巩固公司在国内小批量 PCB 行业的领先地位

公司专注于小批量 PCB 的生产和销售，经过多年的发展和积累，公司在产品技术、品牌建设、客户资源、成本管理、质量控制等方面形成了独特的优势，现已发展成为国内领先的小批量 PCB 生产企业，形成了明显的竞争优势，并具备了参与全球竞争的實力。

由于小批量 PCB 市场具有良好的发展空间，为了保持公司在小批量 PCB 行业的持续领先地位，公司需要在经营规模、生产能力、产品结构和技术实力等方面进行全方位的提升。募投项目实施后，公司在经营规模、产品档次、技术实力、管理能力等方面将迈上新的台阶，公司的核心竞争力和领先的市场地位将得到进一步的巩固。此外，募投项目的实施，将有利于缩小公司与国际知名的小批量 PCB 企业在规模、技术等方面的差距，公司产品的国际竞争力将大大增强，公司在国际上的品牌知名度将得到大幅提升，为最终实现成为全球领先的小批量 PCB 企业的目标奠定坚实的基础。

（三）项目产能消化分析

1、预计产能

本募投项目建成并完全达产后，将新增年产 36 万平方米小批量 PCB 和 4 万平方米小批量 HDI 生产能力。

项目	募投实施前产能（平方米）	募投新增（平方米）	募投增幅
----	--------------	-----------	------

小批量多层 PCB	636,000	360,000	57%
小批量 HDI	24,000	40,000	167%

2、产能消化分析

（1）良好的市场前景是募投产能规划和设计的前提

小批量 PCB 的下游行业通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、国防、航天航空等在国内多数处于成长期，发展态势良好，部分行业近几年保持在百分之二十以上的复合增长率（详见“第五章 业务和技术”之“三、行业发展状况”之“（十一）小批量 PCB 行业与上下游行业之间的关联性”）。公司的产能扩张计划有下游行业的高增长态势作为市场基础。

此外，国外小批量 PCB 产业逐渐开始向国内转移带来的市场取代机会也是公司规划大幅增加产能的重要原因。

（2）优质的客户和良好的口碑是募投项目产能消化的保障

经过多年的市场培育和拓展，公司产品的品质和售后服务优势赢得了客户的广泛认可。公司已经与全球小批量 PCB 下游客户的主要企业建立了密切的合作关系。公司拥有包括 PCB 贸易商、EMS 公司、国外 PCB 生产企业、PCB 设计公司和终端客户五种类型的客户，2009 年公司的客户数量为 304 家，到 2011 年公司的客户数量增加到 442 家。

由于公司现有产能和资金上的限制，公司并未完全满足下游客户的需求，如高端小批量 PCB、小批量 HDI 产品，由于对设备要求较高，受制于公司的固定资产的限制，目前 HDI 产能还较小，而公司已经取得了下游主要大客户的供应商资质认证，在长期的合作中得到了客户的信任，积累了良好的信誉和口碑，形成了紧密的业务合作关系。虽然受金融危机的影响，2009 年部分客户的采购额有所下降，但随着 2010 年经济形势的好转，主要客户在公司的采购额快速上升，2010 年公司主要客户 Palpilot、PCB TECHNOLOGIES LTD、PD Circuits、Kestrel international circuits ltd 等在公司的采购额增长率甚至超过 100%，因此在下游大客户面对旺盛的终端需求纷纷筹划扩大产能时，长期合作的客户也倾向于优先选择本公司。预计在公司募集资金项目投产后，新增的产能优先满足老客户的持续增加订单。

(3) 渐进式产能增长计划是产能顺利消化的有效途径

根据公司的审慎规划，募投项目建设后，产能将逐步释放，以缓解产能快速增长的压力，募投项目建设期为三年，项目从投入建设第二年方可开始投产，第二年达产率为 40%，第三年达产率为 80%，建设期完成后的第一年完全达产。

公司 2011 年销售量为 58.15 万平方米，仅考虑募投项目实施带来的产能扩张情况下，在募投项目完全达产的四年间，所有产能完全消化所对应的销售量复合增长率也仅为 15.49%，尚不足国内 PCB 产值预计复合年均增长率的两倍。公司作为国内小批量 PCB 行业的领先企业，预计能够实现这样的增长速度。

综上，本公司能够通过下游市场的增长消化新增的产能。

3、产能消化措施

(1) 进一步强化本土市场销售网络的布局，加强销售队伍的建设，提升销售管理能力

公司自成立起，就非常重视销售团队的建设，目前公司在深圳、大连、香港和江门分别设立子公司，在上海、武汉、北京设立销售服务办事处。这些子公司和销售服务机构覆盖珠三角、长三角和环渤海三大PCB产业集群区域。未来随着国内小批量下游市场逐渐向中、西部转移，公司还将在成都、西安、南京新设销售服务办事处，服务于其他市场。通过加大营销服务网络建设力度，贴近下游主要区域，提升客户的满意度，为公司新增产品的销售提供有力的服务保障。

随着募集资金投资项目的开展，公司将进一步加大销售队伍、销售体系的建设力度，包括打造全方位的销售网络，在重点城市增加销售服务机构，加强区域管理，完善销售体系，同时，公司将进一步完善对销售人员的激励和考核机制，引进优秀人才，加强专业知识和销售能力的培训，从而提高销售人员的素质，提升公司销售管理能力。

(2) 坚持国际化经营思路，迅速向海外终端市场扩张

目前，由于海外小批量PCB下游市场终端客户比较分散，且各地的贸易商拥有丰富的中小客户资源，因此，海外市场的中小终端客户主要通过贸易商来下订单。未来公司将坚持国际化经营思路，在稳定目前海外市场客户中的PCB设计公

司、国外PCB生产企业、EMS公司和贸易商的同时，大力发展终端客户，特别是小批量PCB下游市场需求量较大的终端客户。通过参加国际PCB行业展会、行业技术交流会，来进一步提高企业的国际知名度，深入了解行业发展趋势，实施品牌营销战略，提高国际知名度，增强公司在国际市场上的综合竞争力。

（3）立足于优势行业，重点开拓国防及航天航空和医疗仪器行业

通信设备行业是公司优势领域，公司与行业内多家领先企业合作多年，积累了丰富的经验。未来公司将进一步巩固这一优势，同时，公司也将重点拓展小批量PCB下游的航天航空、国防和医疗仪器行业。

国防及航天航空产业不仅仅是新的经济增长点，更是关系到国家安全的战略性新兴产业，并已成为政府重点支持的战略性新兴产业。公司已经获得了AS9100航空质量体系认证，公司将加强与航天航空领域的标杆企业合作，进一步拓展航天航空领域。

医疗仪器行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高，是一个国家综合工业水平的体现。近几年保持20%增长率的中国医疗仪器市场正处在高速发展的上升阶段，而中国正在步入老龄化社会，医疗仪器消费的刚性需求在加大，随着医疗仪器行业的迅速发展，小批量PCB的需求空间将进一步增大，公司已经成立了专门的团队，正在加大开拓医疗仪器行业的力度。

（4）加大技术研发与设计投入，充分满足客户个性化需求

公司小批量PCB生产模式都是以销定产，销售部门在接到客户订单时，第一时间将需求发送给研发设计部门，公司研发设计部门依靠经过多年的积累形成的庞大的工程技术数据库，能在2小时至1天内迅速处理不同工艺要求的订单，订单处理速度在小批量PCB行业内处于领先水平。

募投项目建成后，公司将进一步加大技术研发与设计投入，优化、完善工程技术数据库，为客户提供及时、满意的个性化需求服务，从而为公司产品的销售提供有力的支持。

（四）项目投资概算

1、项目总投资

本项目总投资预算为 47,415 万元，具体投资概算如下表：

序号	项目	投资额（万元）	占投资比例
一	固定资产投资	42,207	89.02%
	1、建筑及装修工程	6,590	13.90%
	2、设备购置费用	33,315	70.26%
	3、设备安装费用	999	2.11%
	4、其他费用	1,303	2.75%
二	铺底流动资金	5,208	10.98%
合 计		47,415	100.00%

2、设备投资计划

本项目预计购置设备 33,314.80 万元，其中生产设备投入 29,829.40 万元，环保设备 3,485.40 万元。本次新增主要设备清单如下表所示：

生产设备					
序号	设备名称	数量	单位	设备价格（万元）	
				单价	总价
开料设备					179.00
1	自动开料机	2	台	40	80.00
2	圆角机	1	台	9	9.00
3	烤炉	2	台	15	30.00
4	清洗机	2	台	30	60.00
内层设备					2,750.00
1	前处理线	4	条	70	280.00
2	自动涂布机	3	台	120	360.00
3	自动贴膜机	1	台	10	10.00
4	曝光机	10	台	150	1,500.00
5	DES	4	条	150	600.00
内层 AOI 设备					1,840.00
1	AOI	15	组	120	1,800.00
2	冲孔机	2	台	20	40.00
压合设备					1,725.00
1	棕化线	3	条	80	240.00
2	热压机	4	组	250	1000.00

3	熔合机	6	台	20	120.00
4	铆钉机	4	台	10	40.00
5	X-Ray 钻靶机	4	台	70	280.00
6	单轴锣边机	5	台	5	25.00
7	磨边机	1	台	20	20.00
钻孔设备					9,920.00
1	钻孔机(6 轴)	32	台	115.5	3,696.00
2	钻孔机(2 轴)	8	台	28	224.00
3	激光钻机	3	台	2,000.00	6,000.00
沉铜板电设备					1,490.00
1	粗磨机	3	台	90	270.00
2	Desmear & PTH	4	台	81	324.00
3	板电线	4	台	215	860.00
4	板电后磨板机	2	台	18	36.00
图电蚀刻设备					3,780.00
1	图电线	4	条	390	1,560.00
2	VCP	2	条	1,000.00	2,000.00
3	蚀刻线	2	条	110	220.00
线路图形设备					768.00
1	磨板机	2	台	75	150.00
2	自动贴膜机	3	台	10	30.00
3	平行曝光机	4	台	110	440.00
4	手动曝光机	2	台	40	80.00
5	显影机	2	台	34	68.00
外层 AOI 设备					1,680.00
1	AOI	14	组	120	1,680.00
阻焊设备					1,191.20
1	火山灰磨板机	2	条	75	150.00
2	自动喷涂线	1	条	600	600.00
3	隧道烤炉	2	条	42	84.00
4	半自动丝印机	12	台	15	180.00
5	手动丝印台	2	台	0.6	1.20
6	手动曝光机	6	台	18	108.00
7	显影机	2	条	34	68.00
字符设备					269.20
1	手动丝印台	2	台	0.6	1.20
2	半自动丝印机	8	台	15	120.00
3	隧道烤炉	2	条	65	130.00

4	立式烤箱	6	台	3	18.00
表面处理设备					535.00
1	沉金前处理	2	条	30	60.00
2	沉金后处理	2	条	15	30.00
3	沉镍金线	2	条	60	120.00
4	电厚金线	1	条	25	25.00
5	砂带磨板机	2	条	90	180.00
6	表面处理金手指	1	条	120	120.00
成型设备					2,292.00
1	铣边机(2 轴)	10	台	28	280.00
2	铣边机(4 轴)	20	台	80	1,600.00
3	手动 V-Cut	4	台	3	12.00
4	CNC V-Cut	4	台	70	280.00
5	成品清洗机	3	台	40	120.00
测试设备					1,410.00
1	通用测试机	6	台	60	360.00
2	通用自动测试机	3	台	80	240.00
3	专用测试机	7	台	6	42.00
4	飞针测试机	16	台	48	768.00
合计		292			29,829.40

环保设备

处理污染物	设备名称	数量	单位	设备价格（万元）	
				单价	总价
废气处理	排废管道	50000	m	0.004	200
	废气处理设施及铺设	50000	m	0.008	400
	废热处理设施及铺设	50000	m	0.001	50
	小计：				650
污水处理及回用	排废管道	50000	m	0.005	250
	设施基础及结构	1500	m ³ /D	0.35	525
	水处理站防腐工程	1500	m ³ /D	0.06	90
	机电设备	1500	m ³ /D	0.65	975
	管道连接	1500	m ³ /D	0.05	75
	机电控制及配电	1500	m ³ /D	0.12	180
	检测仪表及在线监控	1500	m ³ /D	0.06	90
	回用处理设施	400	m ³ /D	1	400
	回用机电控制及管道	1200	m ³ /D	0.3	120
	其它辅助设施	1200	m ³ /D	0.05	60
	小计：				2,765

隔音降噪	反射隔音墙	280	m	0.20	56.00
	隔离降噪罩	1	项	14.40	14.40
	小计:				70.40
合计					3,485.40

3、新增固定资产投资与产能匹配情况

募投项目实施前后的机器设备及环保设备投资与产能对比情况如下所示:

项目	募投前	募投新增
机器设备、环保设备、其他设备原值(元)	455,271,090.17	343,142,440
产能(平方米)	660,000	400,000
单位产能对应的设备原值(元)	689.80	857.86

注:募投新增设备值含安装费,与设备投资计划中的数值略有差异

募投新增单位产能所需的机器设备投资值高于目前现有的比值,主要原因是物价上涨因素导致。

(五) 本项目的技术水平

本项目技术为本公司现有成熟技术,本公司目前已拥有国内 PCB 行业领先的技术和较丰富的生产经验,并将通过持续创新不断完善。本项目所采用的主要技术均由公司自主研发,在国内同类产品中具有领先的技术水平。

(六) 产品工艺流程

本项目是公司产能的进一步扩大,主要目标是提高生产效率和生产能力,产品的生产、工艺流程与先有业务流程相比基本未发生变化,具体的产品的工艺流程图详见“第五章 业务和技术”之“六、发行人的主营业务情况”之“(二)主要产品的工艺流程”。

(七) 主要原材料供应情况

本项目所需主要原材料与公司目前产品的主要原材料基本一致,主要为覆铜板、半固化片、氰化金钾、磷铜球、铜箔、油墨等。公司与主要供应商建立了良好的战略协作关系,原材料供应充足,本项目新增产能所需的原材料供应可以得到有效保证。公司将进一步完善供应商管理体系,加强品质监控和互动交流,持续引进新的有竞争实力的供应商,对供方资源进行整合,确保公司未来的快速稳

定发展。

（八）环境保护

1、主要污染源和污染物分析

项目实施过程中需购置生产、办公用房，相关场地清理、室内精装修工程和机电安装工程，施工过程中将产生一定的噪音、扬尘、工程材料废料及废水等。

本项目投产后可能产生的污染源和污染物有以下几种：

① 水污染。主要来源于表面清洗和表面处理的清洗废水和显影、蚀刻废水以及生活污水。

② 废气污染。主要来源于表面处理和蚀刻工序中的酸性废气、阻焊印刷的有机废气，以及外形加工、电镀等工艺产生的粉尘等。

③ 固体废弃物。主要是边角废料、去膜废水中的膜和废水处理产生的污泥等。

④ 噪声。主要来自各种设备运行时产生的噪声，如：剪板机、机械钻孔机、空气压缩机、配电房、风机、水泵、中央空调等。

2、环境保护措施方案

本公司将综合考虑环境污染治理工作，增加环保设施投入，严格控制污染，确保将污染源和污染物控制在国家环保规定或标准范围之内，改善和保护环境。

项目建设施工过程中，尽量选用低噪声设备进行施工作业，禁止高噪声设备在休息时间作业，施工部门合理安排施工时间和施工场所，尽量减小噪声污染。施工过程中容易出现扬尘的范围需经常洒水抑制扬尘，减小大气污染。运输车辆加盖顶篷，并随时清洁打扫。施工废水需经沙地沉淀后再循环利用。

生产废水由环保公司为公司专门设计的废水处理系统集中统一处理。

生活污水排入市政污水管网由专门水处理工厂进行处理。

本项目产生的有机废气采用有机生物膜法或活性炭吸附的方法处理；酸性废气采用化学中和处理法；粉尘采用布袋除尘法治理。

固体废弃物将委托给有资质的处理单位进行处理，生活垃圾由垃圾清运公司

统一收集处理。

对固定的噪声设备采取基础减振、加装隔声罩等措施；对空调冷却塔采用加装隔声百叶的措施；对排风口采取加装消音装置的措施等。

经以上措施进行治理后，项目所产生的污染都可以得到有效控制，符合各项标准，不会对周围环境造成污染，体现项目可持续发展的理念。

3、环境保护所需要投入的资金情况

项目生产过程中环境保护资金用于污水处理站和排风系统设备购置等。环保设备购置及安装费 3,485.40 万元，环保设备清单详见本章“设备投资计划”。

4、环境影响分析结论

项目实施过程中，产生的噪音、扬尘、装修材料废料及废水等污染源，经环保措施实施后，可得到有效控制，不会对周围环境造成影响。

本项目废气可以达到广东省地方标准 DB3095-1996《大气污染物排放限值》二级标准的要求。

项目生产废水及生活废水经过各自废水处理站处理后，第二类污染物可以达到广东省 DB44/26-2001《水污染物排放限值》二时段二级标准要求；一类污染物可以达到二级标准要求，废水排放对环境的影响在可以接受的范围内。

项目产生的一般工业固废和危险废物将委托给有资质的处理单位进行处理，生活垃圾由垃圾清运公司统一收集处理。因此，项目所产生的固体废物对环境不会造成危害。

本项目高噪声设备均采用封闭式或半封闭式方式运行，周围近距离内无环境敏感点，噪声影响较小。

公司产品为多品种小批量 PCB，在后续生产过程中，经生产环节中的环保措施控制后，也不会对周围环境及人身安全造成损害。本项目中，对于资源需求仅仅涉及到日常用到的电和液化气，而污染物和污染源为生活污水、低级别机械噪声、少量粉尘和机器加工产生的金属废弃物等。本公司将按照国家标准对污染源和污染物进行防治和处理，不会对环境造成影响。

本项目已取得广东省环保厅出具的《关于江门崇达电路技术有限公司 PCB

生产基地建设项目环境影响报告书的批复》（粤环审【2011】149号）。

（九）项目选址

本项目建设地址位于广东省江门市高新技术开发区，土地面积131,266.70平方米，由江门市国土资源局出让给江门崇达。该土地为建设用地，周边交通顺畅。江门崇达已经就上述土地取得了《国有土地使用权证》（江国用（2011）第304399号）。

（十）项目组织与进度

本项目建设期为3年，项目建设进度安排如下：

项目建设进度表

进度安排	时间（36个月）																											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	14月	16月	18月	20月	22月	24月	26月	28月	30月	32月	34月	36月				
装修设计																												
建筑工程																												
装修工程																												
设备安装																												
设备调试																												
试运行																												

（十一）项目经济效益分析

本项目财务评价计算期为10年，达产后可实现年销售收入8.77亿元，年均净利润为1.08亿元。根据计算，本项目税前内部收益率为31.88%，税后内部收益率为24.05%，投资回收期（税后，含建设期3年）为5.63年。

四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响

本次发行募集资金投资项目实施后，公司将拥有具备竞争优势的小批量PCB生产制造平台、大大提升公司产能。公司资产规模、营业收入与利润总额也将有较大幅度增长。虽然募集资金投资项目需要三年的建设期，短期内净资产收益率会受到摊薄影响，但在项目建成后，新增资产与服务能力将发挥良好协同增效作用，公司盈利能力将不断增强。具体分析如下：

（一）对净资产收益率及盈利能力的影响

募集资金到位后，短期内本公司的净资产收益率将因净资产增加而有所下降，但随着投资项目效益的逐渐显现，本公司的营业收入和营业利润将大幅增长，盈利能力持续提高，净资产收益率将随之回升。

（二）对总资产及资产负债率的影响

募集资金到位后，公司总资产和所有者权益增加，资产负债率水平将大幅降低，有利于提高公司的间接融资能力，增强本公司防范财务风险的能力。

（三）对股本结构的影响

本次发行后，公司的股本结构将得到优化，股权分散有利于公司治理结构的进一步的规范。同时由于溢价发行可以增加资本公积，提高本公司股本扩张的能力。

（四）新增固定资产折旧对未来经营成果的影响

本次募集资金投资项目合计新增固定资产投资为 42,207 万元。项目实施后，每年将新增的折旧费如下表：

单位：万元

项目	第二年折旧	第三年折旧	第四年折旧	第五年至第十年 每年折旧
生产基地建设项目	1,966	3,201	3,819	3,385

募投项目开始后，第四年产能达到 100%。根据利润测算，达产后，生产基地项目的年均利润将达到 1.08 亿元左右。因此，公司的盈利可消化掉因新项目固定资产投资而导致的折旧费用增加，确保公司营业利润不会因此而下降。

第十三章 股利分配政策

一、股利分配政策

（一）公司发行前的股利分配政策

本公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入法定公积金。法定公积金累计额为本公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。本公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。本公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东大会决议进行分配的，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在本公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还本公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）公司发行后的股利分配政策

本公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。经公司第一届董事会第十次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过，《公司章程（草案）》第一百五十五条规定：“在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”。详细分配政策如下：

1、公司的利润分配政策为：

“（1）公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润；

（2）公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(3) 公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请股东大会审议批准。在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案；

(4) 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

(5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

2、公司利润分配政策决策程序如下：

公司的利润分配政策由董事会拟定并经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事同意提请股东大会审议，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面意见。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会认为需要调整利润分配政策时，可以提交利润分配政策调整预案供公司股东大会审议，公司通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。

同时，为了保障崇达技术具备利润分配的能力，子公司深圳崇达在公司章程第四十条第三款规定：“公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东决议，可从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东的出资比例进行分配，每年以现金形式分配的比例不少于公司当年实现的可分配利润的 30%”。子公司大连崇达在公司章程第二十条规定：“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东的出资比例对每年的未分配利润进行分配，每年以现金形式分配的比例不少于公司当年实现的可分配利润的 30%”。

二、报告期内利润分配情况

最近三年一期，公司具体的现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年 1-6 月
归属于母公司股东的净利润	4,095.07	9,611.63	13,153.29	6,589.21
对当年利润的分配金额	2,700.00	3,712.50	4,050.00	-
现金分配占当年净利润的比例	65.93%	38.63%	30.79%	-

2009年，公司现金分红占当年实现的归属于母公司股东的净利润的比例高达65.93%。公司现金分红的比例比较高，主要因为公司在2010年以净资产折股，整体变更为股份有限公司，为了保证股东及时、足额缴税，公司进行了较高比例的现金分红。2010年，因净资产折股导致股东缴税金额为2,279.06万元，公司股东均已足额缴纳。

2010 年，公司现金分红占当年实现的归属于母公司股东的净利润的比例为38.63%，扣除股份支付的影响，现金分红占当年实现的归属于母公司股东的净利润的比例为31.47%。2011 年，公司现金分红占当年实现的归属于母公司股东的净利润的比例为30.79%。

三、公司未来三年的分红回报规划

在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会及股东大会审议并通过了《深圳市崇达电路技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2011—2013年度）》主要内容如下：

股东回报规划制定考虑因素：在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、未来盈利规模、现金流量状况等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性。

股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式向股东分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司

股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

股东回报规划制定周期：公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。

2011-2013年度股东分红回报计划：2011-2013年，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案；

股东分红回报计划的变更：公司的股东分红回报计划不得随意变更。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会认为需要调整利润分配政策时，可以提交利润分配政策调整预案供公司股东大会审议，公司通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。

公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，重新制定的分红规划，其分红比例不低于《公司章程》规定的分红比例。

四、本次发行前滚存利润的分配安排

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司累计滚存未分配利润为 23,952.88 万元。本次发行前的未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

第十四章 其他重要事项

一、信息披露制度相关情况

发行人为完善信息披露机制，根据中国证监会的有关规定，建立了信息披露制度，规定发行人必须严格按照法律、法规和《公司章程》和《信息披露管理制度》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。发行人信息披露应体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

公司负责信息披露及协调投资者关系的部门是公司证券部，公司信息披露的负责人为董事会秘书。

董事会秘书：余忠

联系人：余忠

电话： 0755-26055208

传真： 0755-26068671

二、重要合同

截至本招股说明书签署之日，本公司正在履行或将要履行的重大合同有：

（一）业务合同

1、销售合同

2010年2月25日，发行人和艾默生网络能源有限公司签署了《框架采购协议》，合同约定发行人“应按照相关采购说明书中的要求提供采购订单中的产品和服务”，价款确定依据为“采购订单中经需方（即艾默生）确认的价格”。本协议从签署之日起两年内有效，若合同到期后双方未另行签订终止协议，将自动续延两年。

本公司与客户主要采用订单销售的方式，公司与主要客户合作关系稳定，客户直接向公司下订单生产。由于本公司专业定位于小批量 PCB 的生产和销售，

订单数量较多，均单金额较小。

2、采购合同

(1) 公司与主要供应商签署了框架采购合同，主要包括：

序号	需方	供方	采购货品	价格
1	深圳崇达	广东生益科技股份有限公司	覆铜板与半固化片	以双方确认的报价书为准
2	深圳崇达	番禺南沙殷田化工有限公司	干膜	以双方确认的报价书为准
3	深圳崇达	深圳富骏材料科技有限公司	氰化亚金钾	以双方确认的报价书为准
4	深圳崇达	佛山市承安铜业有限公司	磷铜球	以双方确认的报价书为准
5	深圳崇达	东莞联茂电子科技有限公司	覆铜板与半固化片	以双方确认的报价书为准
6	深圳崇达	中山台光电子材料有限公司	覆铜板与半固化片	以双方确认的报价书为准

2011年3月11日，本公司与国际商业机器（中国）有限公司签订了《IBM业务咨询及系统整合服务协议》（协议编号：GBS311072），约定本公司向国际商业机器（中国）有限公司购买列于本IBM业务咨询及系统整合服务协议及其附件工作说明书中的咨询及系统整合服务。项目收费金额为7,900,000.00元整，此固定价格已包括旅行费用以及其它因服务而引起的合理费用和任何适用的税金。

(2) 2012年3月1日，江门崇达与深圳市展耀科技有限公司签订了《合约书》，约定江门崇达向深圳市展耀科技有限公司采购BURKLE多层线路板压合机，数量为六冷三热，含税价格为9,512,100元。

(3) 2012年6月13日，深圳崇达与大船科技（东莞）有限公司签订了《机械设备买卖合约书》，约定深圳崇达向大船科技（东莞）有限公司购买型号为ND-6CS220日立钻孔机12台，深圳崇达应在2013年2月10日支付总货款100%。大船科技（东莞）有限公司自装机完成日起，提供一年之保固维修服务，主轴提供4000小时的保固。

(4) 2012年4月26日，江门崇达与竞铭机械股份有限公司签订了编号为938-A01109的《设备买卖合约书》，约定江门崇达向兢铭机械股份有限公司订购电镀处理自动化设备，包括除胶化学铜自动机、电镀机、二次铜电镀机、自动化学沉镍金机各一套，合约总价为1,111,907美金，CIF江门崇达。交货日期为2012年7月15日设备到厂，并于2012年8月15日前兢铭机械股份有限公司需安装调试完毕。

(5) 深圳崇达与奥宝电子(深圳)有限公司签订了《维修服务合约》，约定由奥宝电子(深圳)有限公司向深圳崇达提供正常使用下所需之预防性保养及修缮以及维修保养所需之零件及人工服务等，并授权深圳崇达使用任何因本合约所取得限于系统设备有关之软体。本合同有效期为 2010 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。深圳崇达就维修服务及软体向奥宝电子(深圳)有限公司给付每月费用，月结 30 天，月费之金额已含 17% 增值税，费用总计 5,620,419 元, 以上价格含 17% 增值税。

(二) 借款合同

截至本报告书签署之日，公司正在执行中的借款合同如下：

借 款 方	贷款方	借款合同名称及编号	借款金额 (万元)	借款期限	担保方	担保方式
深圳崇达	中国银行 深圳市分行	《人民币借款合同（中/长期）》(编号为2009年圳中银司借字第60153号)	10,000	60个月，自第一笔信用证开证日期起算	深圳崇达	抵押
					集锦线路板	保证
					姜雪飞	保证
深圳崇达	中信银行 深圳分行	《综合授信合同》（编号2011深银高新综字第003号）	10,000	2011年8月31日至2012年8月31日	姜雪飞、 发行人	保证
深圳崇达	兴业银行 深圳振华支行	《基本额度授信合同》 （编号兴银深振授信字 2011第0006号）	7,000	2011年9月1日至 2014年9月1日	姜雪飞	保证
					发行人	保证
					深圳崇达 ^{注1}	抵押
深圳崇达	工商银行 福永支行	《流动资金借款合同》 （编号40000227—2011 年福永字0021号）	2,000	2011年7月15至 2012年7月14日	姜雪飞	保证
					发行人	
江 门 崇达	兴业银行 深圳振华支行	《项目融资借款合同》(编 号：兴银深振项借字 (2011)第0001号)	30,000	2012年1月17日 至2017年1月17 日	姜雪飞	保证
					发行人	保证
					江门崇达 ^{注2}	抵押
发 行 人	招商银行 深圳福田支行	《授信协议》(编号：2012 年福字第0012350005)	10,000（授 信额度）	2012年3月28日 至2013年3月27 日	姜雪飞	保证
					朱雪花	保证
发 行 人	民生银行 深圳分行	《综合授信合同》 (编号：2012年深宝安金融 综额字004号)	10,000(授 信额度)	2012年3月23日 至2013年3月23 日	姜雪飞	保证
					发行人	保证
深 圳	中国银行	《授信额度协议》(编号：	5,000(授信	2012年3月12日	发行人	保证

崇达	深圳南头支行	2012圳中银南额协字第000120号)	额度,已提2000万元)	至2013年3月9日	姜雪飞	保证
发 行 人	工商银行深圳福永支行	《流动资金借款合同》(编号: 40000227-2012年(福永)字0009号)	100	2012年3月30日至2013年3月27日	姜雪飞	保证
					深圳崇达	保证

(三) 租赁合同

发行人及子公司的租赁合同详见“第五章、业务与技术/（七）发行人的主要固定资产和无形资产”。

(四) 建设工程施工合同

1、2011年4月7日, 江门崇达与广东电白二建工程有限公司签署了《建设工程施工合同》。根据合同约定, 广东电白二建工程有限公司承包江门崇达 PCB 生产基地(一期项目)的土石方工程、桩基础工程、土建工程、装修工程, 合同总金额为人民币 94,163,503.00 元。

2、2011年8月6日, 江门崇达与东江环保股份有限公司工程服务分公司签订了《环境污染治理项目工程承包协议》(编号为 DJGCFW20110708), 约定由东江环保股份有限公司工程服务分公司负责江门崇达废水处理及回用水处理工程的设计、施工等, 工程总造价为含税价 86,990,000.00 元。

3、2012年1月9日, 江门崇达与深圳市湛艺装饰设计工程有限公司就江门崇达一期宿舍楼内部装修工程签订了《装饰工程施工合同》, 约定由深圳市湛艺装饰设计工程有限公司承包江门崇达一期宿舍楼内部装修工程, 承包内容为一期宿舍一至十二层楼梯、公共通道、水电工程, 二至七层室内装饰及活动中心, 合同价款为 6,900,000.00 元。

4、2012年2月20日, 江门崇达与广东振兴消防工程有限公司签订了《广东省建设工程施工合同》, 工程名称为江门崇达 PCB 生产基地(一期)建设项目消防工程, 江门崇达就该工程向广东振兴消防工程有限公司发包, 工程内容为崇达生产厂房(1)、宿舍及食堂(1)消防安装工程, 合同总价为 5,200,000.00 元。

5、江门崇达与中国电子系统工程第四建设有限公司签订了《江门崇达电路技术有限公司(1#)厂房暖通项目工程施工合同》, 约定由中国电子系统工程第四建设有限公司承包江门崇达(1#)厂房暖通项目工程, 工程内容为空调自控工

程、空调配电工程、照明配电工程、一层装修工程、二层装修工程、三层装修工程、一层空调工程、二层空调工程、三层空调工程、空调水管主管道工程、工艺冻水管道工程、食堂空调工程、开料利旧空调工程、压机冷却水管道工程、机房系统工程、热回收项目工程、设备基础工程、公用管线架工程。开工日期 2012 年 5 月 10 日，竣工日期为 2012 年 8 月 20 日，总日历天数为 100 日历天。合同价款为 32,100,000.00 元。

6、2012 年 4 月 12 日，江门崇达与广东耀南建筑工程有限公司签订了《江门崇达电路技术有限公司一期道路及管网工程施工合同》，约定广东耀南建筑工程有限公司承包江门崇达一期道路及管网工程，工程施工内容：江门崇达道路及管网工程施工图设计要求，和图纸内容进行施工，包含一期道路、雨污排水管井、接（拉）线井、钢筋混凝土管沟、化粪池、隔油池等工程内容。承包方式为包工包料。工期为 75 天，初定为 2012 年 4 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日。本合同为固定总价风险包干合同，工程含税造价：5,650,000 元

三、对外担保事项

截至招股说明书签署之日，本公司不存在除子公司之外的对外担保事项。

四、重大诉讼、仲裁事项及控股股东、实际控制人重大违法情况

（一）发行人及其控股股东、控股子公司的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署之日，本公司及本公司控股子公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼、仲裁及刑事诉讼事项。

截至本招股说明书签署之日，本公司控股股东姜雪飞、共同控制人姜雪飞和朱雪花未涉及重大诉讼、仲裁或刑事诉讼事项。

（二）发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员重大诉讼或仲裁事项及受到刑事诉讼的情况

截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心

技术人员未涉及重大诉讼、仲裁及刑事诉讼事项。

（三）发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况

截至本招股说明书签署之日，本公司控股股东姜雪飞、实际控制人姜雪飞、朱雪花最近三年不存在重大违法行为。

第十五章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机

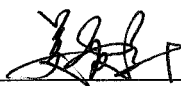
构声明

深圳市崇达电路技术股份有限公司

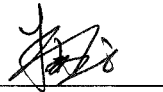
全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

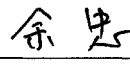
全体董事签名：



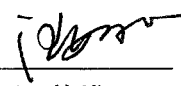
姜雪飞



朱雪花



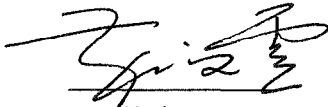
余忠



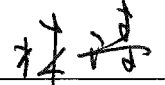
汪姜维



何 为



苏启云

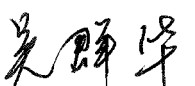


林 涛

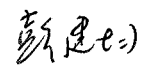
全体监事签名：



徐嘉辰



吴群华

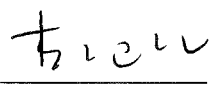


彭建均

全体高级管理人员签名：



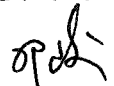
姜雪飞



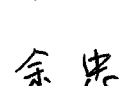
彭卫红



姜曙光

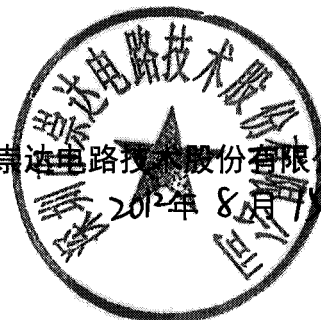


邓 峻



余 忠

深圳市崇达电路技术股份有限公司



西南证券股份有限公司

声明

本公司已对深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： 许超
许超

保荐代表人： 秦翠萍
秦翠萍

保荐代表人： 吴玎
吴玎

法定代表人： 余维佳
余维佳

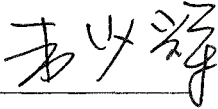


广东信达律师事务所

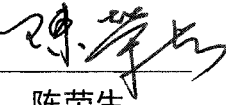
声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

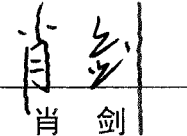
经办律师：



韦少辉



陈荣生


肖 剑

律师事务所负责人：



麻云燕



上海众华沪银会计师事务所有限公司

声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师： 傅林生
【傅林生】

陆士敏
【陆士敏】

会计师事务所负责人： 孙勇
【孙勇】

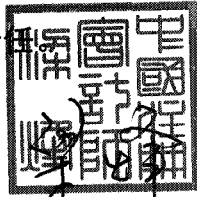


深圳市鹏城会计师事务所有限公司

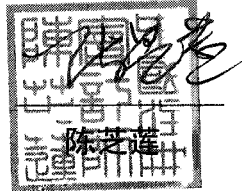
声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要, 确认招股说明书及其摘要与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师:

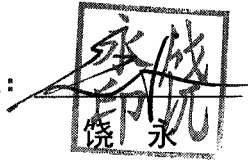


梁 烽



陈芝莲

会计师事务所负责人:



饶 永

深圳市鹏城会计师事务所有限公司



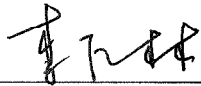
2012年8月15日

北京国友大正资产评估有限公司

声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要, 确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师:

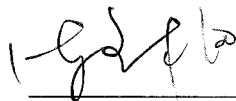


李巨林



陈 松

评估机构负责人:



陈冬梅

北京国友大正资产评估有限公司

2012年8月15日

第十六章 备查文件

投资者可在深圳证券交易所网站（<http://www.sse.org.cn>）、发行人网站（www.suntakpcb.com）以及发行人和主承销商办公地点查阅备查文件：

- （一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表及专项审核报告；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

具体的查阅时间为工作日的上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。

发行人及保荐人（主承销商）办公地址如下：

1	发行人：深圳市崇达电路技术股份有限公司 地址：深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路 3 栋三楼 法定代表人：姜雪飞 联系人：余忠 电话：0755-26068047 传真：0755-26068671
---	--

2	保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人：余维佳 联系人：秦翠萍、吴玓 电话：010-88092288 传真：010-88092031
---	--

投资者也可以于网站 [http: //www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 查阅本招股说明书等电子文件。